创业板投资风险提示

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

苏州法特迪科技股份有限公司

FTDevice Technology (Suzhou) Co., Ltd.

（苏州工业园区兴浦路 200 号 5#101、102、201、202）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者的声明

一、发行人上市的目的

（一）践行科技自立自强战略，攻坚高性能测试接口壁垒，填补本土产业链高阶空白

半导体产业系国家战略性、基础性与先导性产业。测试接口作为贯穿芯片设计验证、晶圆制造及测试、先进封装及测试及系统级测试的核心硬件，其自主可控水平直接关系到我国半导体产业链的安全性与核心竞争力。近些年来，我国在芯片设计、晶圆制造及封测领域已取得长足进步，逐步成为全球半导体产业竞争中的重要力量，但在高性能探针卡、芯片测试座等关键测试接口及其连接组件领域，市场仍由欧美日韩及中国台湾地区少数企业主导，上述半导体测试消耗型硬件的自主可控水平，仍是我国半导体产业向更高层次发展进程中亟待补齐的短板之一。

自成立以来，公司始终将突破以高性能测试座为代表的芯片测试接口技术壁垒、推动关键环节国产替代作为核心发展宗旨。面对产业前沿需求，公司已在 224Gbps 超高速信号传输、85GHz 高频射频信号传输等领域取得技术及产品突破，建立了覆盖风冷/液冷的多档位散热方案，2,000W 级方案已实现精准控温与多工位独立温区控制，可满足 AI HPC、智能手机、汽车电子等应用场景的严苛测试环境需求。

本次上市，旨在借助资本市场力量，进一步扩大先进产能、加大研发投入，并向 WLCSP 探针卡、高功率液冷散热控温等同源技术领域延伸，切实响应国家科技自立自强战略，切实承担起高性能测试消耗型硬件的国产突破使命，全面捍卫中国半导体产业链的完整性与先进性。

（二）顺应半导体产业变革，积极应对市场挑战，把握竞争格局重塑的历史机遇

当前，全球半导体测试产业正经历深刻的结构性变革。在 AI HPC 等应用驱动下，先进制程节点持续微缩并已接近物理极限，以 CoWoS、Chiplet、2.5D/3D 为代表的先进封装技术已成为延续摩尔定律的核心路径。先进制程微缩与先进封装的协同演进，推动测试接口性能全面对标高频高速、高功率、大尺寸等高阶测试需求。先进封装带来的千瓦级单封装功耗、数万根引脚的超高密度，推动高阶芯片成品测试（FT）从传统的快速筛选演进为复杂全功能验证，叠加长达数小时的老化测试（Burn-in）和系统级测试

（SLT），使得芯片测试的复杂度与耗时呈指数级上升，测试环节的重要性及价值量显著提升。由此，产业结构变革带来新一轮发展机遇，国产替代窗口加速开启。

同时，产业结构性变革也对芯片测试接口企业的技术能力、产能规模及解决方案完整性构成严峻挑战。客户对测试接口的性能指标、交付周期、研发能力及全生命周期服务能力的要求持续提升；叠加地缘政治格局变化与国产替代需求日益迫切，共同推动测试接口领域全球竞争格局加速重塑，并带来新的市场挑战。

面对上述机遇与挑战，公司将坚持以核心技术持续突破为底层支撑，以早期介入客户芯片设计、共同开发的协同模式构建差异化壁垒，并在此基础上全面实施“平台化”战略升级，即从单一的高性能测试座领先企业，升级为覆盖测试座、WLCSP 探针卡、负载板、芯片测试液冷板及封测接口组件的综合性芯片测试接口解决方案供应商，在历史性的产业结构变革机遇中拓宽成长边界，为投资者创造长期价值。

（三）借助资本市场深化全球化布局，扩充先进产能与引智聚才，加速赶超国际巨头

公司所处半导体测试接口行业属于资金与技术密集型行业，持续的技术研发、产能建设及高端人才引进均需充足的资本支撑。根据 Yole 统计数据，2025 年公司位居全球半导体测试座行业第十位，是前十大厂商中唯一的中国境内企业。但全球测试接口行业呈现显著的境外头部企业群聚效应，公司与全球头部企业在营收规模、产品线完整度、国际市场覆盖等方面仍存在差距，国际竞争力仍有显著提升空间，国际化布局有待加速。

通过本次上市，公司可借助资本市场平台显著提升品牌价值与资本实力，增强对高端人才的吸引力，加快缩小与全球头部企业的差距，进一步夯实研发与产能基础，赋能公司高质量发展。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

公司严格按照上市公司治理标准建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会规范运作，各项规章制度有效执行。同时，公司立足长期可持续发展，制定了明确的利润分配计划和股东回报规划，切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次募集资金将投资于先进生产基地建设项目、针对高功率芯片液冷散热控温技术的研发及生产项目、总部及研发中心项目以及补充流动资金项目。本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务，将在夯实技术水平、丰富产品线布局、巩固市场领先地位并增强竞争优势、提供流动资金支持等方面助力公司经营战略的实施，提升公司经营规模和盈利能力，是公司推进未来发展规划的重要举措。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

报告期内，公司收入规模保持稳健增长，测试座等封装测试消耗型硬件产品已实现在汽车电子与智能驾驶、人工智能、智能终端与物联网、工业控制等关键领域的产业化应用，行业认可度持续提升，具备稳健的持续经营能力。

面向国家半导体产业自主可控战略需求，公司将持续聚焦半导体测试硬件的技术前沿，依托成熟的研发体系和技术平台，重点突破高性能半导体封装测试消耗型硬件领域的关键技术，为我国半导体产业发展提供可靠的测试硬件解决方案。

在测试座领域，公司将紧扣技术演进趋势，积极布局系统级测试（SLT）等前沿应用方向。一方面，持续提升产品在高频高速信号传输完整性与稳定性、高功率散热及精准温控等核心指标上的性能，向更高精度、更高可靠性迈进；另一方面，深化产品创新，满足先进制程、先进封装对复杂测试环境的严苛要求。在探针卡、负载板、液冷散热等业务领域，公司将充分依托在测试座领域积累的客户资源与精密制造技术同源优势，加快研发突破与产业化进程，逐步补齐产品矩阵，构建全流程测试接口解决方案提供能力。同时，公司将稳步拓展在存储芯片、功率器件、AI 算力中心等更广泛应用场景的市场份额，不断拓宽业务边界与成长空间。

公司将持续投入研发资源，加强人才队伍建设，完善企业治理结构，并充分发挥资本市场的助推作用，持续巩固和提升市场竞争优势，努力成为全球领先的半导体封装测试消耗型硬件解决方案提供商。

（本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页）

董事长签字：

王强

苏州法特迪科技股份有限公司

2026 年 9 月 22 日

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次公开发行新股数量不超过 1,300.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块	深圳证券交易所创业板
发行后总股本	不超过 5,200.00 万股
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

目 录

声 明 1

致投资者的声明 2

一、发行人上市的目的 2

二、发行人现代企业制度的建立健全情况 3

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 4

四、发行人持续经营能力及未来发展规划 4

本次发行概况 6

目 录 7

第一节 释义 11

一、一般释义 11

二、专业释义 15

第二节 概览 18

一、重大事项提示 18

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 20

三、本次发行情况 21

四、发行人主营业务经营情况 22

五、发行人符合创业板定位情况 25

六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 29

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 30

八、发行人选择的具体上市标准 30

九、发行人公司治理特殊安排 30

十、募集资金运用与未来发展规划 30

十一、其他对发行人有重大影响的事项 32

第三节 风险因素 33

一、与发行人相关的风险 33

二、与行业相关的风险 36

三、其他风险 37

第四节 发行人基本情况 38

一、发行人基本情况.....38
二、发行人设立情况以及报告期内股本和股东变化情况.....38
三、发行人成立以来重要事件（含报告期内的重大资产重组）.....46
四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.....46
五、发行人股权结构.....46
六、发行人分公司、子公司及参股公司情况.....47
七、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况.....48
八、发行人特别表决权股份或类似安排.....58
九、发行人协议控制架构的情况.....58
十、发行人股本情况.....58
十一、董事、高级管理人员及核心技术人员.....74
十二、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.....82
十三、发行人员工情况.....84
第五节 业务与技术.....87
一、发行人主营业务及主要产品情况.....87
二、发行人所处行业基本情况.....100
三、发行人在行业中的竞争地位.....124
四、发行人销售情况和主要客户.....133
五、发行人采购情况和主要供应商.....136
六、发行人主要固定资产及无形资产.....139
七、发行人与业务相关的资质及许可情况.....140
八、发行人核心技术与研发情况.....141
九、发行人安全生产及环境保护情况.....149
十、发行人境外经营情况.....150
第六节 财务会计信息与管理层分析.....151
一、财务报表.....151
二、审计意见、关键审计事项.....155
三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况.....157
四、分部信息.....158

五、主要会计政策及会计估计.....158
六、非经常性损益情况.....165
七、税项.....166
八、主要财务指标.....168
九、经营成果分析.....170
十、资产质量分析.....186
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....198
十二、重大投资或重大资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.....205
十三、资产负债表期后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项.....205
十四、盈利预测.....205
第七节 募集资金运用与未来发展规划.....206
一、募集资金运用概况.....206
二、本次募集资金投资项目的具体情况.....208
三、发行人未来发展规划.....208
第八节 公司治理与独立性.....212
一、发行人公司治理情况.....212
二、发行人内部控制情况.....212
三、报告期内发行人违法违规及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况.....212
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.....213
五、发行人独立运行情况.....213
六、同业竞争.....214
七、关联方及关联关系.....215
八、关联交易.....218
第九节 投资者保护.....222
一、本次发行前滚存利润分配方案.....222
二、发行人股利分配政策.....222
三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况.....229

第十节 其他重要事项 230
一、重大合同 230
二、对外担保情况 233
三、重大诉讼、仲裁或其他事项 233
第十一节 声明 234
一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明 234
二、发行人实际控制人声明 237
三、保荐人（主承销商）声明 238
四、发行人律师声明 241
五、审计机构声明 242
六、资产评估机构声明 243
七、验资机构声明 245
八、出资复核机构声明 247
第十二节 附件 248
一、备查文件 248
二、查阅时间及地点 248
附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 250
附件二：与投资者保护相关的承诺 252
附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 280
附件四：公司治理制度的建立健全及运行情况 282
附件五：公司专利具体情况 284
附件六：募集资金运用情况 290
附件七：公司租赁情况 299

第一节 释义

在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有以下含义：

一、一般释义

法特迪有限	指	法特迪精密科技（苏州）有限公司，系发行人前身
法特迪、公司、本公司、发行人、母公司	指	苏州法特迪科技股份有限公司
本次发行	指	本次发行人首次公开发行不超过 1,300.0000 万股 A 股股票的行为
法特迪电子	指	法特迪电子科技（苏州）有限公司，发行人全资子公司
蓝泽科技	指	蓝泽半导体科技（芜湖）有限公司，发行人全资子公司
芜湖分公司	指	苏州法特迪科技股份有限公司芜湖分公司，发行人分公司
杭州分公司	指	苏州法特迪科技股份有限公司杭州分公司，发行人分公司
济沧海	指	宁波济沧海企业管理合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台之一，发行人实际控制人担任执行事务合伙人，曾用名苏州济沧海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
杭州端一	指	杭州端一企业管理合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台之一，发行人实际控制人担任执行事务合伙人
杭州且何	指	杭州且何企业管理合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台之一，发行人实际控制人担任执行事务合伙人
长川科技	指	杭州长川科技股份有限公司，系发行人股东
强一股份	**指**	**强一半导体（苏州）股份有限公司及其前身强一半导体（苏州）有限公司**
科为升	**指**	**科为升视觉技术（苏州）有限公司**
共青城长柳	指	共青城长柳投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人、历史股东
半导体装备基金	指	上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人发起人、历史股东
天堂硅谷	指	杭州天堂硅谷创业投资管理有限公司，系发行人历史股东，曾用名温州天堂硅谷创业投资管理有限公司、宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司
天堂硅谷集团	**指**	**天堂硅谷创业投资集团有限公司**
天堂硅谷长实	指	杭州天堂硅谷长实股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
众实十一号基金	指	天堂硅谷众实十一号私募投资基金
众实十三号基金	指	天堂硅谷众实十三号私募投资基金
本坚芯汇	指	杭州本坚芯汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东，曾用名湖州本坚芯汇股权投资合伙企业（有限合伙）
三花弘道	指	杭州三花弘道创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
永鑫开拓	指	苏州永鑫开拓创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
永鑫融堰	指	泰州永鑫融堰创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

赋实投资	指	杭州赋实投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人发起人、历史股东
创新资本	指	深圳市创新资本投资有限公司，系发行人股东
湾区社保基金	指	社保基金湾区科技创新股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙），系发行人股东
苏州融享	指	苏州融享创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
半导体装备二期基金	指	上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
嘉兴鑫先	指	嘉兴鑫先创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
嘉兴芯测	指	嘉兴芯测股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
宝台杜鹃	指	广东宝台杜鹃创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
嘉兴芯传	指	嘉兴芯传创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
冯源晟芯	指	晋江冯源晟芯创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
冯源仁芯	指	泉州冯源仁芯创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
元利一期	指	杭州元利一期股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
铜陵施捷	指	铜陵施捷科技合伙企业（有限合伙），系发行人股东
芯云半导体	指	杭州芯云半导体集团有限公司及其合并报表范围内的子公司
日月光	指	矽品科技（苏州）有限公司、环旭电子股份有限公司等同一控制下公司
京隆科技	指	京隆科技（苏州）有限公司
长电科技	**指**	**江苏长电科技股份有限公司及其同一控制下公司**
通富微电	**指**	**通富微电子股份有限公司及其同一控制下公司**
华天科技	**指**	**天水华天科技股份有限公司及其同一控制下公司**
伟测科技	**指**	**上海伟测半导体科技股份有限公司及其同一控制下公司**
矽品科技	**指**	**矽品科技（苏州）有限公司等同一控制下公司**
渠梁电子	**指**	**渠梁电子有限公司等同一控制下公司**
盛合晶微	**指**	**盛合晶微半导体（江阴）有限公司及其同一控制下公司**
摩尔线程	**指**	**摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司及其同一控制下公司**
壁仞科技	**指**	**上海壁仞科技股份有限公司及其同一控制下公司**
燧原科技	**指**	**上海燧原科技股份有限公司及其同一控制下公司**
沐曦股份	**指**	**沐曦集成电路（上海）股份有限公司及其同一控制下公司**
飞腾信息	**指**	**飞腾信息技术有限公司及其同一控制下公司**
清微智能	**指**	**北京清微智能科技股份有限公司及其同一控制下公司**
奕行智能	**指**	**奕行智能（北京）科技股份有限公司及其同一控制下公司**
盛科通信	**指**	**苏州盛科通信股份有限公司及其同一控制下公司**

MPS	指	Chengdu Monolithic Power Systems Co., Ltd.及其同一控制下公司
英飞凌、Infineon	**指**	**Infineon Technologies AG 及其同一控制下公司**
爱芯元智	**指**	**爱芯元智半导体股份有限公司及其同一控制下公司**
北极雄芯	**指**	**北极雄芯信息科技（西安）有限公司及其同一控制下公司**
复旦微电	指	上海复旦微电子集团股份有限公司及其合并报表范围内的子公司
新紫光集团	指	展讯通信（上海）有限公司及其同一控制下公司
全志科技	**指**	**珠海全志科技股份有限公司及其同一控制下公司**
中兴通讯	**指**	**中兴通讯股份有限公司及其同一控制下公司**
Microchip	**指**	**Microchip Technology Inc.及其同一控制下公司**
恩智浦、NXP	**指**	**恩智浦半导体公司及其同一控制下公司**
地平线	**指**	**北京地平线信息技术有限公司及其同一控制下公司**
瑞芯微	**指**	**瑞芯微电子股份有限公司及其同一控制下公司**
纳芯微	**指**	**苏州纳芯微电子股份有限公司及其同一控制下公司**
士兰微	**指**	**杭州士兰微电子股份有限公司及其同一控制下公司**
四维图新	**指**	**北京四维图新科技股份有限公司及其同一控制下公司**
安路科技	**指**	**上海安路信息科技股份有限公司及其同一控制下公司**
迪克微	**指**	**苏州迪克微电子有限公司**
浙江日拓	**指**	**浙江日拓电子股份有限公司**
欧瑞特	**指**	**深圳市欧瑞特实业有限公司**
先得利	**指**	**先得利精密测试探针（深圳）有限公司**
矽图	**指**	**苏州矽图电子科技有限公司**
中电科集团	指	中国电子科技集团公司第二十四研究所及其同一控制下公司
Enplas	指	日本上市公司，代码 6961.T
Yamaichi	指	日本上市公司，代码 6941.T
WinWay	指	中国台湾上市公司，代码 6515.TW
Leeno	**指**	**韩国上市公司，代码 058470.KQ**
Cohu	**指**	**美国上市公司，代码 COHU.O**
Yokowo	**指**	**日本上市公司，代码 6800.T**
韬盛科技	指	上海韬盛电子科技股份有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	现行《苏州法特迪科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《苏州法特迪科技股份有限公司章程（草案）》，公司 2026 年第一次临时股东会审议通过并于本次发行上市后生效
股东会	指	苏州法特迪科技股份有限公司股东大会、股东会
董事会	指	苏州法特迪科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州法特迪科技股份有限公司监事会，已取消
《股东会议事规则》	指	《苏州法特迪科技股份有限公司股东会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《苏州法特迪科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《苏州法特迪科技股份有限公司监事会议事规则》
《独立董事工作制度》	指	《苏州法特迪科技股份有限公司独立董事工作制度》
《董事会秘书工作细则》	指	《苏州法特迪科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
《投资者关系管理制度》	指	《苏州法特迪科技股份有限公司投资者关系管理制度》
《信息披露管理制度》	指	《苏州法特迪科技股份有限公司信息披露管理制度》
《募集资金管理制度》	指	《苏州法特迪科技股份有限公司募集资金管理制度》
招股说明书	指	苏州法特迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
《创业板上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
社会公众股、A 股	指	发行人根据本招股说明书向社会公开发行的面值为 1 元的人民币普通股
保荐人、主承销商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
发行人会计师、申报会计师、审计机构、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、申报律师、国浩律师	指	国浩律师（杭州）事务所
资产评估机构、坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
Frost & Sullivan	指	弗若斯特沙利文，是一家国际咨询公司
报告期、报告期内、报告期各期	指	2023 年度、2024 年度、2025 年度**和 2026 年 1-6 月**
报告期末	指	**2026 年 6 月 30 日**
报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日**和 2026 年 6 月 30 日**
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

二、专业释义

集成电路、芯片、IC	指	Integrated Circuit，按照特定电路设计，通过特定的集成电路技术，采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
封装	指	将晶圆切割后的裸芯片（Die）安装在特定载体上，通过引线键合或微凸块等方式实现电路连接，并采用专用材料进行密封，以提供机械支撑、电气互连、环境保护及热量管理的半导体后道制造工序
制程	指	在生产芯片过程中，集成电路的精细度，亦指 IC 内电路与电路之间的距离
晶圆测试、CP 测试	指	Circuit Probing，在芯片制造流程中处于晶圆制造和封装之间，在晶圆裂片前对裸露的芯片进行测试，以验证其功能
成品测试、FT 测试、FT	指	Final Test，在芯片完成封装后，对芯片电性能及功能进行测试
老化测试	指	Burn-in、Burn-in Test，模拟芯片在长期使用中可能承受的严苛工作条件，筛除早期失效产品，从而提升芯片在终端应用中的长期可靠性
系统级测试、SLT 测试、SLT	指	System Level Test，通过模拟芯片真实应用场景，对芯片进行系统级验证
封装测试	指	封装系为芯片安装外壳，起到安放、固定、密封、保护芯片等作用；测试系检测封装前后的芯片性能、功能等是否可正常运作、是否符合设计规格
ATE、测试机	指	Automatic Test Equipment，简称“ATE”，用于集成电路等电子元器件制造过程中，自动完成功能、性能及可靠性检测的机电一体化测试系统，是保障芯片出厂品质的关键设备
探针台	指	Prober，是一种用于半导体芯片、集成电路及其他微电子器件电性能测试的精密设备，它通过精密的探针与晶圆或芯片上的测试点接触，实现外部测试仪器与芯片内部电路的连接，以进行参数测量、功能验证和失效分析
分选机	指	Handler，是一种与测试机联动的自动化设备，负责芯片的自动上下料、电性测试，并能根据测试结果对芯片进行良品筛选与性能等级分档
测试消耗型硬件	指	是用于半导体测试过程中实现接口连接、信号传输、机械固定、定位导向以及散热温控等功能的硬件，会因使用而磨损或消耗，其性能直接决定测试精度与效率
测试接口	指	Interface，是测试消耗型硬件核心组成部分，用于半导体测试过程中实现接口连接、信号传输，会因使用而磨损或消耗
晶圆测试消耗型硬件	指	用于晶圆制造后、封装前的晶圆测试环节，会因接触和频繁探测而磨损的接口部件，主要包括探针卡及其 PCB
封装测试消耗型硬件	指	用于封装后芯片测试环节、会因接触和插拔而磨损的接口部件，主要包括测试座、分选换型套件以及测试接口连接模组等
测试座	指	Socket，又称“测试插座”，是连接测试设备与待测芯片的接口部件，主要应用于封装后测试环节，根据测试场景不同可分为功能测试座、老化测试座与 SLT 测试座等
功能测试座	指	Test Socket，连接待测芯片与测试设备的接口部件，在待测芯片与测试设备之间建立稳定的电源、信号传输及控制通道，主要分为 FT 测试座与 SLT 测试座
FT 测试座	指	Final Test Socket，主要用于成品测试，侧重高速高频信号的传输，对芯片进行电性参数及功能验证
SLT 测试座	指	System Level Test Socket，主要用于系统级测试，在模拟真实系统环境下测试芯片的模块协同、逻辑功能、系统兼容性及稳定性

老化测试座	指	Burn-in Socket，又称“老化座”，主要用于老化测试，通过模拟严苛环境（高温/低温、高功率、大电流或高电压等）对芯片进行长时间加速应力测试来验证芯片的长期可靠性
探针卡	指	Probe Card，一种应用于半导体晶圆测试的硬件，是测试设备与待测晶圆的接口部件
分选换型套件、Kit	指	Change Kit，一种负责芯片在分选机与测试座之间的精密定位与传输的接口部件
测试接口连接模组	指	一种测试机与负载板之间信号高保真传输与机械可靠连接的接口部件
负载板	指	Load Board，半导体测试中连接测试设备与待测芯片的专用电路板，负责传输测试信号、电力并提供机械接口，是确保测试准确性的载体
探针	指	Pin，连接待测芯片与测试座的核心元件
PCB	指	Printed Circuit Board，一种重要的电子部件，是电子元器件的支撑体和电子元器件电气连接的载体，由于采用电子印刷术制作而成，故被称为“印刷”电路板
先进制程	指	代表当前行业最前沿技术水平的半导体晶圆前道制造工艺节点，其通过持续缩小微观晶体管特征尺寸，以实现芯片更高晶体管集成度、更强计算性能与更低运行功耗
先进封装	指	区别于传统单芯片封装，采用微凸块（Micro-bump）、硅通孔（TSV）及 2.5D/3D 高密度空间堆叠等新型互连技术，将单个或多个异质裸片进行超高带宽、极微间距异构集成的新一代半导体封装工艺
同轴	指	一种由内外导体及中间介质构成的双导体传输结构，具有低辐射损耗和抗干扰特性
WLCSP	指	Wafer Level Chip Scale Packaging，晶圆级芯片封装方式
CoWoS	指	一种先进的半导体封装工艺，广泛应用于高性能计算、人工智能和数据中心等领域
Chiplet	指	芯粒，一种先进封装技术，通过集成多个小芯片（Die）提升芯片性能，降低制造成本
2.5D/3D	指	2.5D/3D 封装，半导体行业为突破传统平面封装性能瓶颈、实现“高密度集成”而发展的先进封装技术
SoC	指	System on Chip，将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路
GPU	指	一种专门用于处理图像和图形运算工作的协处理器，能够执行大量并行计算任务，广泛应用于游戏、科学计算和人工智能等领域
CPU	指	作为计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元，主要负责解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据
DCU	**指**	**Deep-learning Computing Unit（深度计算处理器），基于通用的 GPGPU 架构，设计、发布的适合计算密集型和运算加速领域的协处理器**
HPC	指	是利用超级计算机或计算机集群系统，通过并行计算以极快速度处理海量数据和复杂计算任务的一门技术科学
AI	指	人工智能，是一门研究开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的新兴技术科学，旨在通过理论、方法、技术及应用系统使机器能够像人类一样进行识别、认知、分析和决策
mΩ、Ω、kΩ	指	毫欧、欧、千欧，电阻单位
Gbps	指	千兆比特每秒，速率单位
Hz、GHz	指	赫兹、吉赫兹，频率单位
W	指	瓦，功率单位

本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

本招股说明书引用的第三方数据或结论，均已注明资料来源，确保权威、客观、独立并符合时效性要求。其中部分数据或结论来自于 Frost & Sullivan、Yole 出具的研究报告，以上报告系发行人向 Frost & Sullivan、Yole 购买，并非专门为本次发行准备，且发行人未提供帮助；除向 Frost & Sullivan、Yole 购买行业研究报告外，发行人未就第三方数据支付费用。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

（一）特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”章节全文，并特别关注下列风险：

1、经营业绩下滑风险

报告期内，公司营业收入分别为 22,547.96 万元、30,951.23 万元、54,402.48 万元**和 44,027.78 万元**，归属于母公司股东的净利润分别为 3,831.75 万元、6,167.86 万元、13,197.53 万元**和 13,027.28 万元**；得益于下游应用领域市场需求持续强劲、半导体封装测试消耗型硬件国产替代进程提速、公司核心产品性能持续突破并获得境内外优质客户广泛认可、产品线不断丰富并持续拓宽应用场景等因素，公司报告期内营业收入实现大幅增长。如未来受到行业周期、市场波动、下游市场需求变化、**老化测试座需求增速不及预期、功能测试座、探针及分选换型套件等其他产品未能形成足量增量收入**、公司新产品推广不及预期、原材料成本上升、公司研发投入加大、已实施或新增股权激励导致的大额股份支付费用等影响，且公司未能采取**产品升级、生产效率提升或成本优化等**有效措施及时应对上述变化，公司可能面临经营业绩下滑的风险，极端情况下有可能存在上市当年营业利润同比下滑超过 50%甚至亏损的风险。

2、毛利率波动风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 36.66%、35.90%、38.29%**和 44.43%**。公司产品毛利率水平受产品销售价格、销售策略、成本波动、市场竞争等多个因素共同影响，不同产品之间的毛利率存在差异，产品结构占比波动亦会对综合毛利率产生影响。未来，公司如果无法持续进行技术创新或者行业竞争加剧、产品领先优势下降，或者公司产品销售价格、成本控制能力、产品结构发生较大不利变动，都可能导致公司毛利率水平出

现波动，给公司的经营带来一定风险。

3、单一产品依赖风险

报告期内，公司老化测试座产品收入分别为 5,116.33 万元、11,278.62 万元、29,876.84 万元和 29,381.69 万元，占主营业务收入的比例分别为 22.70%、36.45%、54.95%和 66.79%，收入占比呈上升趋势，系报告期内公司最主要的产品，公司对其存在一定的依赖。若未来高性能芯片量产测试进度、老化测试覆盖率或国产替代进程不及预期，或者公司新产品迭代、客户验证及市场开拓不及预期，导致老化测试座的销售价格或销量下降，而功能测试座、封测接口组件等其他产品未能及时实现规模增长，则可能对发行人的生产经营产生重大不利影响。

4、应收账款坏账损失的风险

报告期各期末，公司应收账款的账面余额分别为 8,096.98 万元、14,649.38 万元、30,446.29 万元**及 35,417.97 万元**，应收账款坏账准备分别为 416.39 万元、732.47 万元、1,522.52 万元**和 1,770.90 万元**。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额可能进一步增加，较高的应收账款余额会影响公司的资金周转效率、限制公司业务的快速发展。如果公司采取的收款措施不力或客户经营状况发生不利变化，则公司应收账款发生坏账损失风险的可能性将会增加。

5、存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货的账面余额分别为 4,325.74 万元、6,052.63 万元、10,347.85 万元**和 17,071.60 万元**，其跌价准备分别为 1,164.70 万元、1,166.58 万元、1,375.11 万元**和 1,641.80 万元**，呈现快速增长态势。随着公司业务规模的持续扩大，预计未来存货规模或将相应上升。虽然公司采用“以销定产，适当备货”的生产模式，以客户订单需求为导向组织生产，但产品从原材料采购、生产出货至客户签收或验收需要经历一定周期，若未来因市场环境出现重大不利变化、产品更新迭代或客户需求变化等原因导致公司原材料等出现积压、库存商品等出现滞销或贬值，公司存货将面临产生跌价损失的风险，从而影响公司的经营业绩和财务状况。

6、产品研发与技术开发风险

报告期内，公司研发投入金额分别为 1,122.79 万元、1,446.38 万元、2,126.55 万元**和 1,548.44 万元**，公司研发投入金额持续增长。未来随着应用领域的拓展、市场需求

的变动以及技术水平的提升，公司需结合下游市场需求和行业技术发展趋势，对公司的现有技术和产品进行持续迭代和升级以保持核心竞争力。公司研发项目具有资金投入规模大、技术难度高、项目周期长的特点，如果公司未能准确把握市场发展趋势，或未来研发资金不足，可能导致公司研发项目无法按计划取得成果，甚至出现研发失败的情形，从而对公司的业务发展造成不利影响。

（二）本次发行相关主体作出的重要承诺

公司实际控制人王强及其控制的员工持股平台济沧海、杭州端一、杭州且何已作出关于业绩下滑情形的相关承诺，主要内容如下：发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月。

本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺”。

（三）本次发行前滚存利润分配方案及本次发行后股利分配政策

本公司提示投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，具体内容详见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“一、本次发行前滚存利润分配方案”及“二、发行人股利分配政策”。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况

发行人名称	苏州法特迪科技股份有限公司	成立日期	2014 年 2 月 11 日
注册资本	3,900.0000 万元	法定代表人	王强
注册地址	苏州工业园区兴浦路 200 号 5#101、102、201、202	主要生产经营地址	苏州工业园区兴浦路 200 号 5#101、102、201、202
控股股东	-	实际控制人	王强
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无

（二）本次发行的有关中介机构

保荐人	中信证券股份有限公司	主承销商	中信证券股份有限公司
发行人律师	国浩律师（杭州）事务所	其他承销机构	无
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	资产评估机构	坤元资产评估有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。	

（三）本次发行其他有关中介机构

股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	**收款银行**	【】
其他与本次发行有关的机构		无	

三、本次发行情况

（一）本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 1,300.0000 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 1,300.0000 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过 5,200.0000 万股		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】（发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	【】	发行前每股收益	【】
发行后每股净资产	【】	发行后每股收益	【】
发行市净率	【】（按发行价格除以发行后每股净资产计算）		
预测净利润	无		
发行方式	本次发行将采用网下向询价对象配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或者中国证监会认可的其他方式		
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设证券账户并已开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		

募集资金投资项目	先进生产基地建设项目
	针对高功率芯片液冷散热控温技术的研发及生产项目
	总部及研发中心项目
	补充流动资金项目
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元。其中：承销及保荐费【】万元；审计及验资费【】万元；律师费【】万元；其他【】万元
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售认购本次公开发行新股的，公司将依据相关法律法规的要求，适时履行相应审议程序及其他相关所需程序，并依法详细披露
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐人将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照深交所相关规定执行。保荐人及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向深交所提交相关文件
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不适用

（二）本次发行上市的重要日期

刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

四、发行人主营业务经营情况

（一）主营业务概况

公司是半导体封装测试消耗型硬件解决方案提供商，主营业务为高性能测试座、封测接口组件等产品的研发、生产及销售，覆盖半导体领域从芯片设计至量产交付的全生命周期，为芯片设计公司、封测服务企业、测试设备厂商等半导体产业链关键环节客户提供封装测试消耗型硬件解决方案。公司产品主要应用于 GPU、CPU、SoC 等高性能芯片的核心测试环节，服务于 AI HPC、智能终端、汽车电子、工业控制等国民经济重要领域，实现了高性能芯片封装测试消耗型硬件的国产替代，助力我国集成电路产业的自主可控及战略升级。根据 Yole 统计数据，2025 年公司位居全球半导体测试座行业第十位，也是全球前十大厂商中唯一的中国境内企业。

半导体封装测试消耗型硬件是连通测试设备与待测芯片之间的核心纽带，主要承担低损耗高速信号传输、严苛测试环境维持以及高精度定位接触等功能，其自身的技术指

标直接决定了芯片整体测试方案的精度与效率。在芯片设计的工程验证阶段，公司产品可协助客户识别芯片设计缺陷、优化封装方案并提高芯片研发验证效率；在芯片量产的成品测试（FT）、老化测试（Burn-in）和系统级测试（SLT）阶段，公司产品可保障客户有效筛除芯片性能偏差、提高芯片交付良率及可靠性。

随着高性能芯片通过制程微缩及 Chiplet、2.5D/3D 等复杂封装结构持续向高速率、高频率、高功率方向演进，封装测试消耗型硬件的应用场景日益复杂，对其信号传输完整性与稳定性、高功率散热及精准温控以及结构精密程度提出了更高要求，行业技术壁垒和工艺门槛不断提高。面对前沿需求，公司始终聚焦前沿测试场景并持续突破，已形成“高频高速信号的测试座设计与制造”“宽温区、高功率测试座设计与制造”“高性能测试探针设计”“高精度微间距测试座精密制造”“测试分选套件精密制造”与“高速测试机接口模组制造”六大核心技术体系，能够持续满足高性能芯片测试的前沿需求，产品性能指标与工艺水平已达到行业先进水平：在高速高频领域，公司产品可支持最高 224Gbps 超高速信号传输、85GHz 高频射频信号传输；在高功率散热及精准温控领域，公司已开发出适配 2,000W 高功率、满足±1.5℃精准控温的老化测试方案；在精密制造方面，公司测试座产品已实现了万针级高密度布局、250 微米级探针间距以及 110mm×110mm 超大尺寸同轴结构制造；上述行业先进的技术水平助力公司产品精准适配 AI 算力芯片、智能手机 SoC、车规级芯片等高性能芯片测试需求。截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有 **68** 项发明专利与 **65** 项实用新型专利，建有省级企业技术中心及省级集成电路芯片测试连接器工程技术研究中心，获评国家级专精特新重点“小巨人”企业、**博士后科研工作站**。

公司客户主要包括芯片设计公司、封测服务企业及测试设备厂商等半导体产业链核心参与者，已成为日月光、芯云半导体、京隆科技、长电科技、通富微电、华天科技、伟测科技以及渠梁电子等业内主流半导体封测服务企业的稳定供应商。公司客户广泛分布于国民经济各重要领域，在 AI HPC 领域，公司客户覆盖 A 公司、**D 公司**、B 公司、C 公司、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、燧原科技、龙芯中科、清微智能等国内头部算力企业；在智能终端方向，公司长期服务的客户包括 A 公司、新紫光集团、中兴通讯、全志科技、Apple、Microchip 等境内外芯片设计公司；在汽车电子领域，公司已进入 MPS、英飞凌、Bosch、安世半导体、恩智浦、A 公司、地平线、瑞芯微、纳芯微、士兰微、四维图新等境内外汽车电子产业链企业的供应商体系；在工业控制等其他重要

领域，公司客户亦包括 MPS、复旦微电、安路科技等知名企业。公司凭借核心技术持续突破、产业链深度协同、全生命周期服务、供应链自主可控以及规模化交付能力，已深入参与全球高性能半导体封装测试消耗型硬件市场竞争。

（二）主要经营模式概览

公司专注于半导体封装测试消耗型硬件领域，主要通过向芯片设计公司、封测服务企业、测试设备厂商等客户直接销售自主研发生产的测试座、封测接口组件等产品，满足客户多方位、一体化的测试需求。

研发方面，公司采取技术趋势导向、客户需求导向相结合的研发模式。公司建立了规范的研发管理体系，形成了与半导体测试行业特点高度契合的研发模式。公司始终围绕行业技术趋势和客户实际需求，以提升产品性能、拓展产品种类为目标，结合公司中长期发展规划，系统性地开展技术预研、技术开发、产品预研、新产品开发及产品升级等多层次的研发布局。

采购方面，公司主要采取“以产定采”的采购模式。公司采购活动以客户订单、生产计划、交付周期及安全库存为基础，结合供应商交期、市场价格变化及关键物料供应情况，制定并实施采购计划。

生产方面，公司主要采取“以销定产、适度备货”的生产模式。由于半导体测试座及封测接口组件具有高度定制化、产品规格多样的特点，公司通常紧密围绕客户的具体订单需求组织生产活动，并结合通用结构件及部分标准化部件的需求情况进行适度备货，以提高生产响应速度和交付效率。

销售方面，公司始终坚持以客户需求为导向，主要采取直销模式开展业务。半导体封装测试消耗型硬件产品具有高度定制化特点，通常需要公司与客户在项目早期即开展深入需求沟通，直销模式有利于公司准确理解客户需求、快速响应产品设计变更以及提升生产效率，并与客户形成长期稳定合作关系。

（三）发行人行业竞争地位

公司是半导体封装测试消耗型硬件解决方案提供商，主营业务为高性能测试座、封测接口组件等产品的研发、生产及销售，产品覆盖芯片工程验证、FT 测试、老化测试及 SLT 测试等关键测试场景。

半导体封装测试消耗型硬件是半导体集成电路封装测试环节的关键硬件，主要包括测试座（Socket）、负载板（Load Board）、分选换型套件（Kit）和测试接口连接模组等核心部件，广泛应用于芯片的设计验证、成品测试（FT）、老化测试（Burn-in）以及系统级测试（SLT）等全生命周期环节，承担着连接、高保真信号传输及极端环境模拟等核心功能，是保障芯片成品良率与长期可靠性的重要基石。根据 Frost & Sullivan 数据，2025 年，公司在半导体封装测试消耗型硬件中国大陆市场排名第一，在中国大陆市场已取得较为突出的行业竞争地位。

测试座是半导体封装测试消耗型硬件中需求量与价值量最高的细分品类。作为连接待测芯片与测试设备的核心纽带，测试座的性能直接决定了信号传输的完整性、测试结果的可靠性及量产效率。公司在测试座全球市场及中国大陆市场已取得较为突出的行业竞争地位，根据 Yole 统计数据，2025 年公司位居全球半导体测试座行业第十位，也是全球前十大厂商中唯一的中国境内企业；根据 Frost & Sullivan 数据，2025 年公司在半导体测试座中国大陆市场排名第一。

五、发行人符合创业板定位情况

（一）公司所属行业符合创业板定位

公司主营业务为高性能测试座、封测接口组件等产品的研发、生产及销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司属于“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。同时，根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类》，公司主营业务属于“1.2 电子核心产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。此外，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》，公司主营业务所属领域为“鼓励类”之“信息产业”相关条目，符合战略性新兴产业的发展方向。

综上，公司所处行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条“负面清单”规定的行业，不属于产能过剩行业或《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业，亦不属于学前教育、学科类培训、类金融业务的企业。

（二）公司符合创业板定位相关指标要求

创业板定位相关标准（一）	是否符合	指标情况
最近三年研发投入复合增长率不低于 15%，最近一年投入金额不低于 1,000 万元	☑ 是 □否	2023-2025 年度，公司研发投入分别为 1,122.79 万元、1,446.38 万元和 2,126.55 万元，研发投入复合增长率 37.62%

创业板定位相关标准（一）	是否符合	指标情况
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%	☑ 不适用	发行人最近一年营业收入超过 3 亿元，不适用《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条指标（一）规定的营业收入复合增长率要求

综上，公司符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》关于创业板定位相关标准（一）的要求。

（三）发行人关于符合创业板定位的具体说明

1、公司能够通过创新、创造、创意促进新质生产力发展的具体情况

半导体产业系国家战略性、基础性与先导性产业。测试接口作为贯穿芯片设计验证、晶圆制造及测试、先进封装及测试及系统级测试的核心硬件，其自主可控水平直接关系到我国半导体产业链的安全性与核心竞争力。近些年来，我国在芯片设计、晶圆制造及封测领域已取得长足进步，逐步成为全球半导体产业竞争中的重要力量，但在高性能探针卡、测试座等关键测试接口及其连接组件领域，市场仍由欧美日韩及中国台湾地区少数企业主导，上述半导体测试消耗型硬件的自主可控水平，仍是我国半导体产业向更高层次发展进程中亟待补齐的短板之一。

自成立以来，公司始终将突破以高性能测试座为代表的芯片测试接口技术壁垒、推动关键环节国产替代作为核心发展宗旨。面对产业前沿需求，公司已在 224Gbps 超高速信号传输、85GHz 高频射频信号传输等领域取得技术及产品突破，形成了覆盖风冷、液冷方式的多档位散热解决方案，同时实现了 2,000W 高功率测试环境高效散热、精准控温与多工位独立温区控制，可满足 AI HPC、智能手机、汽车电子等应用场景的严苛测试环境需求。公司产品已应用于国产 GPU、CPU、SoC 等高性能芯片的核心测试环节，并已服务于 AI HPC、智能终端、汽车电子、工业控制等国民经济重要领域，加速了高性能芯片封装测试消耗型硬件的国产替代进程，助力了我国集成电路产业的自主可控及升级。

2、公司的技术创新性及其表征

随着高性能芯片通过制程微缩及 Chiplet、2.5D/3D 等先进封装技术持续向高速率、高频率、高功率方向演进，封装测试消耗型硬件的应用场景日益复杂，对其信号传输完整性与稳定性、高功率散热及精准温控、结构精密程度等方面提出了更高要求，行业技术壁垒和工艺门槛不断提高。

面对前沿需求，公司始终聚焦前沿测试场景并持续突破，已形成“高频高速信号的测试座设计与制造”“宽温区、高功率测试座设计与制造”“高性能测试探针设计”“高精度微间距测试座精密制造”“测试分选套件精密制造”与“高速测试机接口模组制造”六大核心技术体系，能够持续满足高性能芯片测试的前沿需求，产品性能指标与工艺水平已达到行业先进水平：在高速高频领域，公司产品可支持最高 224Gbps 超高速信号传输、85GHz 高频射频信号传输；在高功率散热及精准温控领域，公司已开发出适配 2,000W 高功率、满足±1.5℃精准控温的老化测试方案；在精密制造方面，公司测试座产品已实现了万针级高密度布局、250 微米级探针间距以及 110mm×110mm 超大尺寸同轴结构制造；上述行业先进的技术水平助力公司产品精准适配 AI 算力芯片、智能手机 SoC、车规级芯片等高性能芯片测试需求。

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有 **68** 项发明专利与 **65** 项实用新型专利，建有省级企业技术中心及省级集成电路芯片测试连接器工程技术研究中心，获评国家级专精特新重点“小巨人”企业、**博士后科研工作站**。

3、公司具有较强的成长性

（1）报告期内主营业务具有成长性

报告期内，公司主营业务收入分别为 22,541.92 万元、30,939.03 万元、54,368.05 万元**和 43,988.01 万元**，净利润分别为 3,831.75 万元、6,167.86 万元、13,197.53 万元**和 13,027.28 万元**。受益于 AI 产业化进程加速、高性能 GPU、CPU、SoC 等芯片产品持续升级、半导体封装测试环节国产替代加快以及下游客户需求快速增长，报告期内公司主营业务收入及净利润持续增长，2023 年至 2025 年主营业务收入及净利润的复合增长率分别为 55.30%、85.59%，主营业务保持增长，具有较好的成长性。

（2）公司产品市场空间广阔且快速扩容，多重因素带来更大增长潜力

目前全球半导体封装测试消耗型硬件市场正处于高速扩张期，其增长动力主要来自先进制程与先进封装技术演进、高性能芯片封装测试需求量增长以及封装测试环节复杂化、系统化升级。一方面，先进制程持续逼近物理极限，先进封装技术成为推动芯片算力密度提升的重要手段，封装工艺的复杂性显著提升了芯片测试的复杂度与覆盖率要求；另一方面，AI HPC、先进存储、智能终端、汽车电子及工业控制等下游应用快速发展，带来了海量的高性能芯片测试需求。此外，测试自动化与高并发并行测试技术的

进步，也为相关消耗型硬件市场的扩容提供了坚实的基础。

根据 Frost & Sullivan 数据，全球半导体封装测试消耗型硬件市场规模预计将从 2026 年的 332.3 亿元增长至 2030 年的 448.8 亿元，复合增长率为 7.8%；中国大陆市场预计将从 2026 年的 61.1 亿元增长至 2030 年的 87.7 亿元，复合增长率为 9.4%。相较全球市场，中国大陆半导体封装测试消耗型硬件市场在高性能芯片自主可控需求及技术迭代等多重有利因素的推动下呈现出强劲的增长态势，并为具备相应核心技术持续突破、产业链深度协同、全生命周期服务、供应链自主可控以及规模化交付能力的国产厂商带来持续的业务增长动能。

（3）公司成长性以核心技术为支撑

面对前沿需求，公司始终聚焦前沿测试场景并持续突破，已形成六大核心技术体系。

报告期内，公司核心技术全面应用于各系列封装测试消耗型硬件及其相关配件产业化，核心技术产品收入占营业收入的比例如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产品收入	**42,261.54**	52,787.90	29,753.45	21,445.29
营业收入	**44,027.78**	54,402.48	30,951.23	22,547.96
占比	**95.99%**	**97.03%**	**96.13%**	**95.11%**

在测试座领域取得了领先行业地位的同时，公司依托自身核心技术体系及行业内在发展逻辑，持续在封测接口组件、WLCSP 探针卡、负载板、微流道液冷板等高附加值业务领域进行战略布局，为公司的持续发展和市场竞争提供了坚实的技术底座。

（4）半导体产业变革为公司提供新一轮成长机遇

当前，全球半导体测试产业正经历深刻的结构性变革。在 AI HPC 等应用驱动下，先进制程与先进封装的协同演进，推动半导体封装测试消耗型硬件的性能全面对标高频高速、高功率、大尺寸等高阶测试需求。先进封装带来的千瓦级单封装功耗、数万根引脚的超高密度布局以及快速增长的信号频率与传输速率，推动芯片测试环节由传统的单一成品测试（FT）、快速筛选演进为复杂全功能验证，叠加长达数小时的老化测试（Burn-in）和系统级测试（SLT），芯片测试的复杂度与耗时快速上升，测试环节的重要性及价值量显著提升。

同时，产业结构性变革也对芯片测试接口企业的技术能力、产能规模及解决方案完整性构成严峻挑战。客户对测试接口的性能指标、交付周期、研发能力及全生命周期服务能力的要求持续提升；叠加地缘政治格局变化与国产替代需求日益迫切，共同推动半导体测试领域的全球竞争格局加速重塑，国产替代窗口加速开启。

公司是半导体封装测试消耗型硬件解决方案提供商，公司产品主要应用于 GPU、CPU、SoC 等高性能芯片的核心测试环节，服务于 AI HPC、智能终端、汽车电子、工业控制等国民经济重要领域。公司客户群体已涵盖境内外知名芯片设计公司、封测服务企业及测试设备厂商等半导体产业链核心参与者。根据 Yole 统计数据，2025 年公司位居全球半导体测试座行业第十位，也是全球前十大厂商中唯一的中国境内企业。公司坚持以核心技术持续突破为底层支撑，以早期介入客户芯片设计、共同开发的协同模式构建差异化壁垒，并在此基础上全面实施“技术领先、产品延伸、平台化发展”战略，在历史性的产业结构变革机遇中，未来伴随国产半导体测试消耗型硬件解决方案需求量的提升，公司的业绩有望随之增长。

综上，公司符合创业板定位。

六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

报告期内，公司主要财务数据和财务指标如下：

项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额（万元）	**83,864.31**	60,216.79	38,790.29	26,600.20
归属于母公司所有者权益（万元）	**54,888.45**	41,297.42	28,950.25	21,049.54
资产负债率（合并）	**34.55%**	31.42%	25.37%	20.87%
资产负债率（母公司）	**38.10%**	36.64%	33.08%	31.51%
营业收入（万元）	**44,027.78**	54,402.48	30,951.23	22,547.96
净利润（万元）	**13,027.28**	13,197.53	6,167.86	3,831.75
归属于母公司所有者的净利润（万元）	**13,027.28**	13,197.53	6,167.86	3,831.75
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	**12,757.06**	12,339.83	5,647.92	3,447.42
基本每股收益（元）	**3.34**	3.38	1.63	1.03
稀释每股收益（元）	**3.34**	3.38	1.63	1.03
加权平均净资产收益	**27.09%**	37.57%	24.95%	18.69%

项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
率				
经营活动产生的现金流量净额（万元）	**4,817.54**	4,061.91	1,065.68	3,167.65
现金分红（万元）	**-**	1,950.00	-	2,500.00
研发投入占营业收入比例	**3.52%**	3.91%	4.67%	4.98%

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

本招股说明书已披露的财务报告的审计基准日为**2026 年 6 月 30 日**。财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日之间，公司经营情况良好，公司产业政策、税收政策、行业市场环境、主要经营模式、主要客户及供应商的构成、经营管理层及核心技术人员未发生重大不利变化，董事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

八、发行人选择的具体上市标准

发行人 2024 年度、2025 年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 5,647.92 万元、12,339.83 万元。发行人符合《创业板上市规则》中“最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元”的上市标准。

九、发行人公司治理特殊安排

截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理特殊安排。

十、募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金运用概况

本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	先进生产基地建设项目	74,223.83	74,223.83
2	针对高功率芯片液冷散热控温技术的研发及生产项目	52,869.60	52,869.60
3	总部及研发中心项目	29,636.34	29,636.34
4	补充流动资金项目	23,710.57	23,710.57

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
合计		180,440.34	180,440.34

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将通过自筹资金解决；若本次发行实际募集资金高于募集资金投资项目投资额，剩余部分公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用。

本次募集资金投资项目的实施不会新增构成重大不利影响的同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

（二）未来发展规划

自成立以来，公司始终专注以半导体测试座为核心的封装测试消耗型硬件的研发、设计、生产和销售，致力于为集成电路产业链客户提供高性能、高可靠性的测试接口产品及解决方案。公司紧跟芯片向高频高速、高功率方向演进的技术趋势，持续推进核心技术攻关和产品迭代升级，推动半导体封装测试消耗型硬件的自主可控和国产替代进程。公司产品及服务已获得境内外知名的芯片设计公司、封测服务企业、测试设备厂商等客户认可，报告期内经营规模持续增长，行业影响力不断提升。

未来，公司将围绕半导体封装测试消耗型硬件的核心主业，坚持“技术领先、产品延伸、平台化发展”的战略方向，以客户前沿测试需求为牵引，持续提升高频高速信号传输、高功率散热及精准控温、高密度微间距精密加工等关键技术能力，不断完善覆盖测试座、**封测接口组件**、WLCSP 探针卡、负载板以及芯片测试液冷板、微流道液冷板的产品矩阵，进一步提升公司在全球半导体测试消耗型硬件领域的综合竞争力，力争发展成为全球领先的半导体测试消耗型硬件解决方案提供商。

短期来看，公司将以本次募集资金投资项目的实施为重要抓手，进一步强化产能、研发和新产品产业化能力。在产能建设方面，公司将依托“先进生产基地建设项目”，重点提升 AI 及超算芯片功能测试座、AI 及超算芯片老化测试座等核心产品的规模化生产能力，并完善 WLCSP 探针卡、**分选换型套件**等配套产品线，提升高性能产品交付能力和产品性能一致性。在前沿技术产品拓展方面，公司将依托“针对高功率芯片液冷散

热控温技术的研发及生产项目”，聚焦 AI HPC 等高功率芯片在老化测试下的散热控温需求，提升公司在千瓦级以上高功率芯片测试热管理领域的研发和产业化能力。在研发平台建设方面，公司将依托“总部及研发中心项目”，构建集技术研发、实验测试、设计仿真和运营管理于一体的综合性平台，开展关键技术攻关，增强底层研发能力和技术成果转化效率。

长期来看，公司将充分发挥募投项目对产能扩张、产品延伸以及研发升级的支撑作用，深化在半导体测试消耗型硬件的系统化布局。公司将坚持核心技术自主研发，围绕客户芯片工程验证、成品测试、老化测试和系统级测试等全生命周期需求，强化早期介入和协同开发能力，提升客户黏性和综合服务能力。在此基础上，公司将推动业务由以测试座为核心的供应商，逐步升级为覆盖**封测接口组件**、WLCSP 探针卡、负载板、芯片测试液冷板、微流道液冷板的综合性半导体测试消耗型硬件解决方案提供商，进一步拓宽业务边界和成长空间。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日，不存在其他对公司有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、与发行人相关的风险

（一）技术风险

1、产品研发与技术开发风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“6、产品研发与技术开发风险”。

2、技术人才流失风险

公司所处的行业属于技术密集型、人才密集型产业。随着行业技术水平的不断发展，公司对高端研发人才的需求将日益增长。未来，若公司薪酬水平较同行业竞争对手丧失竞争优势，或人力资源政策及内部晋升制度未能得到有效执行，公司可能无法持续引进高端技术人才，甚至出现现有骨干技术人员流失的情形，从而对公司的持续创新能力造成不利影响。

3、知识产权保护相关的风险

公司所处的行业属于知识密集型、技术密集型产业，知识产权保护对公司的核心技术积累、持续研发能力和市场竞争力具有重要意义。公司在产品研发过程中涉及专利等多项知识产权，需通过申请专利等方式保护自身核心技术，并降低侵犯他人知识产权的风险。但相关措施无法完全避免公司与竞争对手等相关方产生知识产权争议，或公司的知识产权被竞争对手等相关方侵权的可能，相关情形可能对公司的正常经营活动产生不利影响。

（二）经营风险

1、对主要终端客户存在重大依赖的风险

报告期内，公司来自于 A 公司及已知的为其芯片提供测试服务的直接客户的收入分别为 1,592.74 万元、8,807.29 万元、26,921.54 万元和 28,205.58 万元，占主营业

务收入的比例分别为 7.07%、28.47%、49.52%和 64.12%，公司对 A 公司存在重大依赖。相关产品主要应用于 AI 芯片、手机 SOC 等芯片产品测试环节。A 公司作为国内高端芯片国产替代进程中的重要企业，其相关芯片产品研发、验证及量产需求变化对上游半导体测试环节具有一定影响。报告期内，公司业务增长受益于 A 公司相关芯片测试需求提升。

公司已积极拓展境内外其他半导体客户，并与多家知名芯片设计企业、晶圆制造企业及封测企业建立合作关系，但受半导体行业重要终端客户供应链体系稳定性较高、测试座产品验证周期较长、客户导入周期较长等因素影响，公司终端客户集中度在未来一定期间内仍可能保持较高水平，未来一定期间内，公司来自于 A 公司及可识别的为其芯片提供测试服务的收入占比仍可能保持较高水平。

若未来 A 公司因自身经营战略调整、芯片产品研发及量产计划变化、供应链体系调整、市场竞争环境变化等原因，导致其对公司相关产品采购需求下降，或公司与 A 公司的合作关系发生重大不利变化，同时公司未能及时拓展新的客户资源及业务机会，则可能对公司的经营业绩和持续盈利能力产生不利影响。

2、单一产品依赖风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“3、单一产品依赖风险”

3、客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五大客户实现营业收入分别为 9,800.78 万元、15,587.86 万元、35,815.76 万元**和 30,717.24 万元**，占当期营业收入的比重分别为 43.47%、50.36%、65.83%**和 69.77%**，客户集中度相对较高。因公司的经营业绩与主要客户经营情况相关性较高，若未来公司主要客户经营情况发生重大问题或公司与客户合作关系发生不利变化，公司可能面临客户订单减少或客户流失等风险，进而影响公司生产经营，对公司的业绩造成不利影响。

4、产品质量风险

公司下游客户对公司产品的质量要求较高，而公司产品的质量和性能受到原材料质量、产品设计、生产制造等多种因素的影响，无法完全排除因不可控因素出现产品质量问题的可能。如果公司产品在生产或使用过程中出现性能不稳定或质量问题，可能影响

客户满意度，甚至引发质量纠纷或客户流失，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

5、税收优惠政策变动的风险

公司享受的税收优惠政策主要包括高新技术企业所得税优惠、集成电路企业增值税加计抵减政策、研究开发费用加计扣除、小微企业税收优惠等。如果未来国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，导致公司适用的税收优惠政策发生不利变化，或者公司因未能持续维持国家高新技术企业资格等原因无法继续享受相关税收优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。

6、经营场所租赁的风险

报告期内，公司部分生产经营场所通过租赁方式取得。虽然公司相关经营场所的租赁关系处于持续稳定状态，但仍不排除未来出现租赁合同无法继续履行、到期无法续租、租金大幅上涨或出租方违约等情形。如果发生上述情形，公司可能因需要搬迁而产生额外费用，并可能在短期内影响公司的正常经营。

（三）财务风险

1、经营业绩下滑风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“1、经营业绩下滑风险”。

2、毛利率波动风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“2、毛利率波动风险”。

3、应收账款坏账损失的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“**4**、应收账款坏账损失的风险”。

4、存货跌价的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“**5**、存货跌价的风险”。

5、老化测试座产品毛利率下降的风险

报告期内，发行人老化测试座毛利率分别为 15.69%、22.78%、33.29%和 42.63%，呈上升趋势，主要受高功率、高附加值产品销售占比提升影响。若未来下游高性能芯片测试需求不及预期，市场竞争加剧导致客户压低采购价格，或公司高附加值老化测试座产品导入、量产及交付进度不及预期，或原材料、人工等成本上涨幅度超过产品售价调整幅度，则发行人老化测试座产品结构、单位售价及毛利率可能发生不利变化，进而对发行人的经营业绩产生不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）市场竞争加剧及市场份额下降风险

公司是半导体封装测试消耗型硬件解决方案供应商，专注于设计、开发与制造高性能测试座及相关配套产品。但是和国际龙头企业相比，公司在市场占有率、产品成熟度、多应用领域经验等方面仍然存在诸多差距。同时，随着行业内其他厂商在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，也不排除出现部分国内厂商抢占市场份额，公司所处行业市场竞争日趋激烈的情形。**公司所处行业存在芯片设计迭代频繁、测试需求定制化强等特征，**若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，**未能持续保持产品技术迭代与规模化交付能力，未能在新兴测试需求中保持技术指标先进性，**不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，**或核心技术被替代与被模仿，或主要客户导入备选供应商、国际主要竞争对手加大境内市场投入，或公司对境外客户拓展及服务网络建设进展不及预期，**则公司可能无法有效应对激烈的市场竞争，公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

（二）宏观经济及行业周期性波动风险

公司产品和服务目前主要面向半导体测试领域。其中，半导体行业与宏观经济形势密切相关，其需求直接受到芯片制造及终端应用市场的影响。尽管半导体行业面临全球化竞争与合作，并属于国家政策大力支持的战略新兴行业，但其受到国内外宏观经济、行业发展规律、行业法规和产业政策等因素的影响，存在一定的周期性。如果未来国内外宏观经济增长放缓或产业政策支持力度减弱使得行业发生周期性波动，可能导致公司产品的市场需求未来短期内有所下降，从而对公司的业务发展和经营业绩产生一定的不利影响。

三、其他风险

（一）发行失败风险

本次发行上市相关文件须经过深圳证券交易所审核，并报送中国证监会履行注册程序。本次发行能否通过深交所审核并取得中国证监会予以注册决定存在不确定性。本次发行结果会受到届时市场环境、投资者偏好、价值判断、市场供需等多方面因素的综合影响，若上述因素出现不利变动，本次发行存在因发行认购不足而导致发行失败的风险。

（二）募投项目实施的风险

本次募投项目基于现有的业务情况、行业发展趋势、国家经济环境、产业政策和未来技术发展方向制定。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精准预测，项目实施过程中可能出现投资额变动、无法按期投产等问题，从而导致募投项目实施效果无法达到预期的效益水平，甚至对公司的经营成果造成一定程度的不利影响。

（三）募投项目新增折旧和摊销影响公司盈利能力的风险

根据募集资金使用计划，本次募集资金投资项目建成后，资产规模将大幅增加，导致各年折旧和摊销费用相应增加，**本次发行的募集资金投资项目预计稳定达产后每年新增折旧摊销费用峰值达 9,807.98 万元**。若**因市场环境变化或公司经营管理不善等原因，**募集资金投资项目不能较快产生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧和无形资产产生的摊销，则募投项目的投资建设将在一定程度上影响公司未来的净利润和净资产收益率。

（四）募投项目新增产能的消化风险

报告期内，公司主要产品测试座相关生产设备的产能利用率分别为 98.05%、100.20%、100.67%和 113.02%。公司本次发行募集资金拟运用于先进生产基地建设项目、针对高功率芯片液冷散热控温技术的研发及生产项目、总部及研发中心项目等。上述项目新增生产规模结合了公司对半导体测试消耗型硬件及上下游领域开拓情况的预估，尽管公司本次募集资金投向系经过充分的可行性论证和市场分析而确定，但如果未来市场需求发生重大不利变化，或公司对新市场开拓不力或新技术迭代缓慢，将可能导致订单需求不足，进而导致部分生产设备闲置、人员冗余，公司存在产能不能及时消化的风险。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	苏州法特迪科技股份有限公司
英文名称	FTDevice Technology (Suzhou) Co., Ltd.
注册资本	3,900.00 万元
法定代表人	王强
有限公司成立日期	2014 年 2 月 11 日
股份公司成立日期	2023 年 11 月 22 日
注册地址	苏州工业园区兴浦路 200 号 5#101、102、201、202
主要生产经营地址	苏州工业园区兴浦路 200 号 5#101、102、201、202
邮政编码	215000
电话	0512-65916786
传真	0512-65916786
互联网网址	https://www.ftdevice.com
电子信箱	ftdzqb@ftdevice.com
信息披露和投资者关系的负责部门	证券业务部
信息披露和投资者关系的负责人	张辉
信息披露和投资者关系的电话号码	0512-65916786

二、发行人设立情况以及报告期内股本和股东变化情况

（一）有限公司设立情况

2014 年 2 月，瞿苏缨、王全章和王春共同投资设立法特迪有限，认缴出资额为 500 万元，出资方式为货币。法特迪有限设立时，瞿苏缨、王全章、王春分别系为周明、王强、田治峰代持其股权，相关方于 2016 年 9 月解除了代持，具体代持原因及解除过程详见本节“二、发行人设立情况以及报告期内股本和股东变化情况”之“（四）历史上股权代持及代持解除情况”。

2014 年 2 月 11 日，法特迪有限取得江苏省苏州工业园区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

法特迪有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	瞿苏缨	200.00	40.00
2	王全章	150.00	30.00
3	王春	150.00	30.00
合计		**500.00**	**100.00**

（二）股份公司设立情况

公司系由法特迪有限整体变更发起设立的股份有限公司。2023 年 10 月 9 日，天健会计师出具《审计报告》（天健审〔2023〕9631 号），根据该审计报告，截至审计基准日 2023 年 7 月 31 日，法特迪有限经审计的资产净额账面价值为 199,232,523.52 元。2023 年 10 月 10 日，坤元评估出具《评估报告》（坤元评报〔2023〕753 号），根据该评估报告，截至评估基准日 2023 年 7 月 31 日，法特迪有限资产净额评估价值为 212,815,959.34 元。

2023 年 10 月 10 日，法特迪有限召开股东会，同意公司整体变更设立为股份有限公司，股份有限公司的名称为“苏州法特迪科技股份有限公司”，以经天健会计师审计的账面净资产为基础折股，折合为股份有限公司股本 3,732.0000 万股，每股面值人民币 1 元，大于股本的部分计入股份公司资本公积。

2023 年 10 月 26 日，公司召开苏州法特迪科技股份有限公司创立大会暨首次股东大会，会议审议通过《关于设立苏州法特迪科技股份有限公司的议案》《关于制定苏州法特迪科技股份有限公司章程的议案》等议案。

2023 年 10 月 23 日，天健会计师出具《验资报告》（天健验〔2023〕563 号），经其审验，截至 2023 年 10 月 17 日，公司已收到全体出资者以其拥有的法特迪有限净资产折合的实收资本 3,732.0000 万元。

2023 年 11 月 22 日，公司取得江苏省市场监督管理局核发的《营业执照》。

公司整体变更设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王强	528.8246	14.1700
2	天堂硅谷长实	447.8402	12.0000
3	赵轶	402.5460	10.7863
4	共青城长柳	373.5733	10.0100

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
5	长川科技	335.8800	9.0000
6	济沧海	334.7649	8.9701
7	赋实投资	311.0000	8.3333
8	半导体装备基金	186.2268	4.9900
9	田治峰	181.3702	4.8599
10	方东晖	179.1360	4.8000
11	本坚芯汇	149.2800	4.0000
12	三花弘道	93.3000	2.5000
13	张少波	89.5680	2.4000
14	永鑫开拓	74.6400	2.0000
15	宋晓燕	44.0500	1.1803
合计		**3,732.0000**	**100.0000**

（三）发行人报告期内股本和股东变化情况

1、发行人报告期初股权结构

2023 年 1 月 1 日，法特迪有限注册资本为 1,111.1111 万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	王强	157.4445	14.1700
2	天堂硅谷长实	133.3334	12.0000
3	赵轶	119.8482	10.7863
4	共青城长柳	111.2223	10.0100
5	长川科技	100.0000	9.0000
6	济沧海	99.6680	8.9701
7	赋实投资	92.5926	8.3333
8	半导体装备基金	55.4444	4.9900
9	田治峰	53.9985	4.8599
10	方东晖	53.3333	4.8000
11	本坚芯汇	44.4444	4.0000
12	三花弘道	27.7778	2.5000
13	张少波	26.6667	2.4000
14	永鑫开拓	22.2222	2.0000
15	宋晓燕	13.1148	1.1803

序号	股东名称/姓名	注册资本（万元）	持股比例（%）
合计		**1,111.1111**	**100.0000**

2、发行人报告期初至今股本和股东变化情况

报告期初至今，公司历次股本和股东变化情况简要如下：

时间	变动事项	股东变化情况	变动后注册资本/股本（万元）
2023 年 11 月	股改	公司整体变更设立为股份有限公司	3,732.0000
2024 年 9 月	增资	公司新增注册资本 168.0000 万元，其中杭州端一认缴 89.0000 万元，杭州且何认缴 79.0000 万元	3,900.0000
2025 年 11 月至 2026 年 2 月	股权转让	创新资本、湾区社保基金、永鑫融堰、苏州融享、嘉兴鑫先、半导体装备二期基金、嘉兴芯测、黄建满、宝台杜鹃、嘉兴芯传、徐越、冯源晟芯、冯源仁芯、陈军、江俊豪、郑梅莲、魏来、铜陵施捷、石磊、元利一期因看好公司未来发展以受让老股方式入股，具体情况详见本节“十、发行人股本情况”之“（五）发行人申报前十二个月新增股东情况”	3,900.0000

自上述最后一次股权变动至本招股说明书签署日，公司股权结构未再发生变动。

3、发行人目前股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股本为 3,900.0000 万元，股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	王强	528.8246	13.5596
2	天堂硅谷长实	447.8402	11.4831
3	济沧海	334.7649	8.5837
4	长川科技	194.5050	4.9873
5	赵轶	192.9210	4.9467
6	嘉兴芯测	185.2500	4.7500
7	田治峰	181.3702	4.6505
8	方东晖	179.1360	4.5932
9	湾区社保基金	148.9814	3.8200
10	半导体装备二期基金	121.8750	3.1250
11	永鑫融堰	117.0000	3.0000
12	三花弘道	93.3000	2.3923
13	黄建满	90.1875	2.3125
14	张少波	89.5680	2.2966

序号	股东名称/姓名	注册资本（万元）	持股比例（%）
15	杭州端一	89.0000	2.2821
16	杭州且何	79.0000	2.0256
17	永鑫开拓	74.6400	1.9138
18	宝台杜鹃	67.8858	1.7407
19	嘉兴芯传	65.8125	1.6875
20	徐越	63.3750	1.6250
21	嘉兴鑫先	48.7500	1.2500
22	江俊豪	48.7500	1.2500
23	铜陵施捷	48.7500	1.2500
24	石磊	48.7500	1.2500
25	冯源晟芯	45.0485	1.1551
26	宋晓燕	44.0500	1.1295
27	元利一期	43.8750	1.1250
28	陈军	41.2725	1.0583
29	本坚芯汇	37.3200	0.9569
30	创新资本	37.2454	0.9550
31	冯源仁芯	32.9515	0.8449
32	郑梅莲	29.2500	0.7500
33	魏来	24.3750	0.6250
34	苏州融享	24.3750	0.6250
合计		**3,900.0000**	**100.0000**

（四）历史上股权代持及代持解除情况

公司历史上曾存在股权代持情形。截至本招股说明书签署日，公司历史上股权代持均已经解除，公司股权清晰，不存在纠纷或潜在纠纷的情形。具体情况如下：

1、法特迪有限设立时的代持及解除情况

2014 年 2 月，公司前身法特迪有限设立时，出于办理工商登记行政手续便利及后续业务发展考虑，三位创始股东周明、王强、田治峰分别委托瞿苏缨（周明朋友）、王全章（王强同学）、王春（田治峰亲属）代持法特迪有限的股权。

法特迪有限设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	实际持有人	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	瞿苏缨	周明	200.00	40.00
2	王全章	王强	150.00	30.00
3	王春	田治峰	150.00	30.00
合计			**500.00**	**100.00**

2016 年 9 月，瞿苏缨、王全章、王春将法特迪股权转让给周明、王军、田治峰、济沧海，具体详见本节“二、发行人设立情况以及报告期内股本和股东变化情况”之“（四）历史上股权代持及代持解除情况”之“2、创始股东及员工持股平台之间的代持及解除情况”之“（1）2016 年 9 月的代持情况”。

至此，法特迪有限设立时瞿苏缨、王全章、王春作为代持人的代持全部解除完毕。

2、创始股东及员工持股平台之间的代持及解除情况

（1）2016 年 9 月的代持情况

2016 年 9 月，瞿苏缨、王全章、王春将法特迪有限股权转让给周明、王军、田治峰、济沧海：瞿苏缨将其持有的 33.80%计 338.00 万元出资额转让给周明，将其持有的 6.20%计 62.00 万元出资额转让给济沧海；王全章将其持有的 15.85%计 158.50 万元出资额转让给王军，将其持有的 14.15%计 141.50 万元出资额转让给济沧海；王春将其持有的 25.35%计 253.50 万元出资额转让给田治峰，将其持有的 4.65%计 46.50 万元出资额转让给济沧海。

本次股权转让，一方面，瞿苏缨、王全章、王春作为代持人的股权代持解除，出于办理工商登记行政手续便利及后续业务发展的考虑，王强直接持有的法特迪有限股权由其弟弟王军代持；另一方面，三名创始股东合计将所持法特迪有限 15.5%股权转至员工持股平台济沧海用于股权激励，其中 13%实际授予济沧海平台内员工，1%授予王强，1.5%作为股权激励预留份额。

本次股权转让完成后，法特迪有限股权结构如下：

序号	股东姓名	代持情况	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	周明	-	338.00	33.80
2	王军	王军代王强持有	158.50	15.85
3	田治峰	-	253.50	25.35

序号	股东姓名	代持情况	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
4	济沧海	王强通过济沧海间接持有法特迪有限12%股权，其中：10.5%系王强本人所有；1.5%作为股权激励预留份额，周明、王强、田治峰按照 4:3:3 比例享有；济沧海其他合伙人间接持有法特迪有限 13%股权	250.00	25.00
合计			**1,000.00**	**100.00**

（2）2017 年 3 月的代持情况

2017 年 3 月，三名创始股东将股权激励预留份额由 1.5%提高至 11%，按照 4:3:3 承担：周明将其持有的法特迪有限 3.80%股权转让给济沧海；田治峰将其持有的法特迪有限 2.85%股权转让给济沧海；王军将其持有的法特迪有限 1.782%股权转让给济沧海，王强将其通过济沧海间接持有的法特迪有限 1.068%股权转化为预留份额，与王军转让的 1.782%股权合计为 2.85%。

本次股权转让及转化完成后，法特迪有限股权结构如下：

序号	股东姓名	代持情况	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	周明	-	300.0000	30.0000
2	王军	王军代王强持有	140.6800	14.0680
3	田治峰	-	225.0000	22.5000
4	济沧海	济沧海受让的法特迪有限 8.432%股权为股权激励预留份额，周明、王强、田治峰按照 4:3:3 享有； 王强通过济沧海间接持有法特迪有限12%股权，其中：9.432%系王强本人所有；2.568%作为预留份额，周明、王强、田治峰按照 4:3:3 比例享有； 济沧海其他合伙人间接持有法特迪有限13%股权	334.3200	33.4320
合计			**1,000.0000**	**100.0000**

（3）2018 年 3 月的代持情况

2018 年 3 月，济沧海将其持有的法特迪有限 19.432%的股权转让给王强，其中：11%系未实际授予的股权激励预留份额，不再继续预留，因王强负责经营管理公司，周明、王强、田治峰共同决定给予王强 1%，剩余 10%为周明、王强、田治峰按照 4:3:3 比例享有，故而王强所持股权中代周明持有 4%、代田治峰持有 3%；8.432%系王强将通过济沧海间接持有的法特迪有限股权转至其本人名下直接持有，济沧海同步进行出资人架

构调整。至此，员工持股平台层面的股权代持全部解除完毕。

本次股权转让完成后，法特迪有限股权结构如下：

序号	股东姓名	代持情况	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	周明	-	300.0000	30.0000
2	王军	王军代王强持有	140.6800	14.0680
3	田治峰	-	225.0000	22.5000
4	济沧海	-	140.0000	14.0000
5	王强	王强本人实际持有 12.432%，代周明持有 4%、代田治峰持有 3%	194.3200	19.4320
合计			**1,000.0000**	**100.0000**

（4）代持解除情况

2018 年 9 月至 2019 年 12 月，王军、王强陆续向外部投资人转让持有的法特迪有限股权，具体如下：

转让时间	转让方	实际持有人	受让方	转让出资额（万元）	出资比例（%）
2018 年 9 月	王军	王强	天堂硅谷（代众实十一号基金）	70.3400	7.0340
2019 年 2 月	王军	王强	天堂硅谷（代众实十三号基金）、共青城长柳	43.9626	4.3963
2019 年 12 月	王军	王强	长川科技	26.3774	2.6377
小计				**140.6800**	**14.0680**
2018 年 9 月	王强	周明	天堂硅谷（代众实十一号基金）	20.0000	2.0000
2019 年 2 月	王强	周明	天堂硅谷（代众实十三号基金）、共青城长柳	12.5000	1.2500
2019 年 12 月	王军（代王强）	周明	长川科技	7.5000	0.7500
小计				**40.0000**	**4.0000**
2018 年 9 月	王强	田治峰	天堂硅谷（代众实十一号基金）	15.0000	1.5000
2019 年 2 月	王强	田治峰	天堂硅谷（代众实十三号基金）、共青城长柳	9.3750	0.9375
2019 年 12 月	王军（代王强）	田治峰	长川科技	5.6250	0.5625
小计				**30.0000**	**3.0000**

截至 2019 年 12 月，王强代周明、田治峰二人合计持有的全部 7%股权及王军代王强持有的全部 14.0680%股权已转让完毕，相关款项已与实际持有人结清。

至此，创始股东及员工持股平台之间相关的代持全部解除完毕。

3、基金管理人代其管理的契约型基金持股的代持及解除情况

2018 年 9 月至 2019 年 2 月，因契约型基金无法作为股东实体，天堂硅谷作为契约型基金众实十一号基金及众实十三号基金的管理人，通过受让股权的形式取得了法特迪有限股权，代众实十一号基金持有 40%股权，代众实十三号基金持有 13.3333%股权。2020 年 11 月公司进行了股权激励，注册资本由 1,000 万元增至 1,111.1111 万元；增资后天堂硅谷代众实十一号基金持有 36%股权，代众实十三号基金持有 12%股权。

2021 年 1 月，天堂硅谷将代众实十一号基金持有的 36%股权转让给基金投资人赵轶、宋晓燕，进行了原状分配，解除了代持；2021 年 5 月，天堂硅谷将代众实十三号基金持有的 12%股权转让给由众实十三号基金投资人按照出资比例设立的天堂硅谷长实，解除了代持。

至此，公司历史上曾存在股权代持已全部解除完毕。

三、发行人成立以来重要事件（含报告期内的重大资产重组）

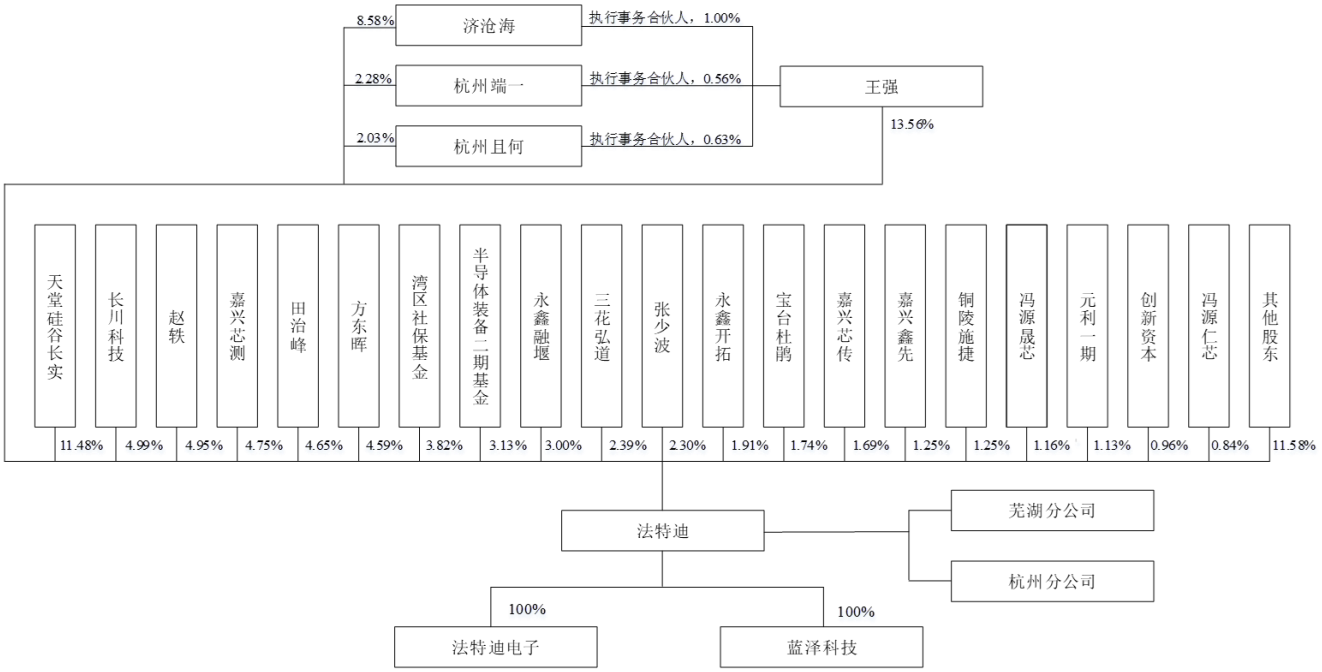
成立至今，公司未曾发生重大资产重组等重要事件。

四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况

截至本招股说明书签署日，公司未在其他证券市场上市或挂牌。

五、发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股权结构图如下：



六、发行人分公司、子公司及参股公司情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有 2 家控股子公司、2 家分公司，具体情况如下：

（一）控股子公司

截至本招股说明书签署日，公司控股子公司的基本情况如下：

1、法特迪电子

名称：	法特迪电子科技（苏州）有限公司		
成立时间：	2020 年 9 月 18 日		
注册资本：	3,000.00 万元		
实收资本：	3,000.00 万元		
股东构成：	公司持股 100.00%		
注册地址：	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路 200 号 5#101、102、201、202		
主要生产经营地：	江苏省苏州市		
主营业务及其与发行人主营业务的关系：	报告期内无实际经营业务		
主要财务数据（万元）：	**项目**	**2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月**	**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**
	总资产	**3,972.52**	3,972.38
	净资产	**3,972.51**	3,972.38
	营业收入	**-**	-

	净利润	**0.13**	-8.32
	审计情况	上述数据已经天健会计师在合并范围内审计	

2、蓝泽科技

名称：	蓝泽半导体科技（芜湖）有限公司		
成立时间：	2021 年 9 月 23 日		
注册资本：	1,000.00 万元		
实收资本：	700.00 万元		
股东构成：	公司持股 100.00%		
注册地址：	芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区中兴五路 1 号 5 幢		
主要生产经营地：	安徽省芜湖市		
主营业务及其与发行人主营业务的关系：	主要从事分选换型套件产品的研发及生产，属于公司产品矩阵的组成部分		
主要财务数据（万元）：	**项目**	**2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月**	**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**
	总资产	**3,149.46**	2,278.34
	净资产	**1,755.34**	1,491.42
	营业收入	**2,181.65**	3,276.60
	净利润	**258.13**	581.62
	审计情况	上述数据已经天健会计师在合并范围内审计	

（二）分公司情况

截至本招股说明书签署日，公司分公司的基本情况如下：

序号	公司名称	成立时间	主营业务情况
1	苏州法特迪科技股份有限公司芜湖分公司	2021 年 3 月 29 日	测试座产品研发设计
2	苏州法特迪科技股份有限公司杭州分公司	2025 年 10 月 30 日	负载板产品研发

七、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况

（一）控股股东和实际控制人基本情况

1、控股股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，公司股权比例较为分散，任一股东及其一致行动人持股比例均未超过 30%，不存在依据持有的股份所享有的表决权足以对发行人股东会的决议产生重大影响的单一股东。因此，公司无控股股东。

2、实际控制人的基本情况

截至本招股说明书签署日，王强直接持有公司 13.5596%的股份，并通过其担任执行事务合伙人的员工持股平台济沧海、杭州端一、杭州且何合计间接控制公司 12.8914%的股份。王强通过直接及间接持股方式合计控制公司 26.4510%的股份，系公司实际控制人。

公司实际控制人王强的基本情况如下：

王强先生：1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：3402211977******。其主要经历如下：2000 年 7 月至 2001 年 7 月，任深圳创维公司销售工程师；2003 年 2 月至 2003 年 9 月，任旺杰芯微电子（上海）有限公司销售工程师；2003 年 10 月至 2006 年 4 月，任库力索法半导体（苏州）有限公司销售工程师；2006 年 4 月至 2006 年 10 月，任普铄电子（上海）有限公司销售经理；2006 年 10 月至 2009 年 4 月，任 Redpeak Inc 销售经理；2009 年 4 月至 2012 年 11 月，任上海韬盛电子科技有限公司销售经理；2012 年 12 月至 2014 年 2 月，任苏州韬盛电子科技有限公司销售经理；2014 年 2 月至 2015 年 8 月，任法特迪有限副总经理；2015 年 8 月至 2019 年 2 月，任法特迪有限总经理；2019 年 2 月至 2021 年 12 月，任法特迪有限董事兼总经理；2021 年 12 月至 2023 年 11 月任法特迪有限董事长、总经理；2020 年 9 月至今任法特迪电子执行董事；2021 年 9 月至今任蓝泽科技执行董事兼总经理；2023 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。

（二）实际控制人的一致行动人

截至本招股说明书签署日，公司员工持股平台济沧海、杭州端一、杭州且何为实际控制人的一致行动人，基本情况如下：

1、济沧海

截至本招股说明书签署日，济沧海持有公司 8.5837%股份。济沧海的基本情况如下：

名称：	宁波济沧海企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间：	2016 年 8 月 4 日
出资额：	1,423.76 万元
执行事务合伙人：	王强
统一社会信用代码：	91320594MA1MQUR63Q

住所：	浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼二十号 553 室
经营范围：	一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主营业务及与发行人主营业务关系：	员工持股平台，仅持有公司股份，未从事其他经营活动

截至本招股说明书签署日，济沧海的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	王强	执行事务合伙人、普通合伙人	董事长、总经理	14.29	1.00
2	贺涛	有限合伙人	董事、副总经理	301.58	21.18
3	朱伟	有限合伙人	董事、蓝泽科技运营总经理	230.15	16.17
4	丁宁	有限合伙人	职工董事、质量总监	204.76	14.38
5	唐俊	有限合伙人	销售部总经理	198.41	13.94
6	郭文霞	有限合伙人	财务总监	158.72	11.15
7	王爱华	有限合伙人	采购总监	158.72	11.15
8	金永斌	有限合伙人	副总经理	142.85	10.03
9	张娟	有限合伙人	仓库副经理	14.29	1.00
合计				**1,423.76**	**100.00**

2、杭州端一

截至本招股说明书签署日，杭州端一持有公司 2.2821%股份。杭州端一的基本情况如下：

名称：	杭州端一企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间：	2024 年 8 月 22 日
出资额：	596.30 万元
执行事务合伙人：	王强
统一社会信用代码：	91330101MADX1XHK8C
住所：	浙江省杭州市西湖区西湖街道孤山后山路 2 号-47
经营范围：	一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主营业务及与发行人主营业务关系：	员工持股平台，仅持有公司股份，未从事其他经营活动

截至本招股说明书签署日，杭州端一的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	王强	执行事务合伙人、普通合伙人	董事长、总经理	3.35	0.56
2	张辉	有限合伙人	副总经理、董事会秘书	100.50	16.85
3	董建	有限合伙人	销售总监	53.60	8.99
4	徐倩	有限合伙人	资深客服经理	40.20	6.74
5	姜迪	有限合伙人	销售经理	40.20	6.74
6	张立群	有限合伙人	销售经理	33.50	5.62
7	王晓根	有限合伙人	业务总监	33.50	5.62
8	朱宇航	有限合伙人	销售经理	33.50	5.62
9	唐俊	有限合伙人	销售部总经理	26.80	4.49
10	董月红	有限合伙人	行政经理	26.80	4.49
11	陈雪明	有限合伙人	AE 工程师	20.10	3.37
12	陈伟	有限合伙人	研发经理	20.10	3.37
13	邹国华	有限合伙人	AE 经理	16.75	2.81
14	胡阳	有限合伙人	客服主管	16.75	2.81
15	闫雪亮	有限合伙人	高级研发专家	13.40	2.25
16	赵光磊	有限合伙人	编程高级工程师	13.40	2.25
17	庄重	有限合伙人	EHS 副经理	13.40	2.25
18	马玉霞	有限合伙人	财务副经理	13.40	2.25
19	戴娟	有限合伙人	研发工程师	10.05	1.69
20	章圣达	有限合伙人	研发副经理	10.05	1.69
21	刘盛宇	有限合伙人	工艺工程部主管	6.70	1.12
22	江辉平	有限合伙人	资深测试开发总监	6.70	1.12
23	程保修	有限合伙人	机加工编程高级工程师	6.70	1.12
24	王全章	有限合伙人	高级工艺工程师	6.70	1.12
25	章龙军	有限合伙人	销售工程师	6.70	1.12
26	王军	有限合伙人	厂务副主管	6.70	1.12
27	诸静丽	有限合伙人	人事专员	6.70	1.12
28	董继强	有限合伙人	AE 工程师	3.35	0.56
29	王志山	有限合伙人	AE 工程师	3.35	0.56
30	杨强	有限合伙人	机加工编程高级工程师	3.35	0.56
合计				**596.30**	**100.00**

3、杭州且何

截至本招股说明书签署日，杭州且何持有公司 2.0256%股份。杭州且何的基本情况如下：

名称：	杭州且何企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间：	2024 年 8 月 22 日
出资额：	529.30 万元
执行事务合伙人：	王强
统一社会信用代码：	91330101MADYATGR8F
住所：	浙江省杭州市西湖区西湖街道孤山后山路 2 号-48
经营范围：	一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主营业务及与发行人主营业务关系：	员工持股平台，仅持有公司股份，未从事其他经营活动

截至本招股说明书签署日，杭州且何的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	王强	执行事务合伙人、普通合伙人	董事长、总经理	3.35	0.63
2	李成君	有限合伙人	运营总监	67.00	12.66
3	王传刚	有限合伙人	资深设计经理	53.60	10.13
4	马说俊	有限合伙人	生产计划经理	33.50	6.33
5	姜扬	有限合伙人	设计副经理	30.15	5.70
6	侯燕兵	有限合伙人	设计副经理	30.15	5.70
7	侯文	有限合伙人	设计副经理	30.15	5.70
8	张宇杰	有限合伙人	总经理助理	30.15	5.70
9	赵凤剑	有限合伙人	生产经理	26.80	5.06
10	李伟	有限合伙人	ME 副经理	20.10	3.80
11	仲金花	有限合伙人	FA 实验室副经理	16.75	3.16
12	张娟	有限合伙人	仓库副经理	13.40	2.53
13	陈彦平	有限合伙人	品质部领班	13.40	2.53
14	张玲飞	有限合伙人	装配高级工程师	13.40	2.53
15	周聪利	有限合伙人	质量副经理	13.40	2.53
16	王慧娟	有限合伙人	设计主管	13.40	2.53
17	张骏	有限合伙人	设计副主管	10.05	1.90
18	张创	有限合伙人	装配副经理	10.05	1.90

序号	合伙人名称	合伙人类型	职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
19	刘慧琳	有限合伙人	品质部副主管	10.05	1.90
20	肖士强	有限合伙人	机加工主管	6.70	1.27
21	程香莲	有限合伙人	装配领班	6.70	1.27
22	邵永峰	有限合伙人	质量经理	6.70	1.27
23	陈栋	有限合伙人	IT 专家	6.70	1.27
24	张俊	有限合伙人	研发主管	6.70	1.27
25	陈烨	有限合伙人	生产计划副主管	6.70	1.27
26	贺勇	有限合伙人	仓库主管	6.70	1.27
27	吕品楠	有限合伙人	设计中级工程师	6.70	1.27
28	李浩宇	有限合伙人	设计高级工程师	3.35	0.63
29	饶桐	有限合伙人	设计高级工程师	3.35	0.63
30	杨柳	有限合伙人	设计高级工程师	3.35	0.63
31	姬志峰	有限合伙人	品质部副主管	3.35	0.63
32	陶杨	有限合伙人	设计高级工程师	3.35	0.63
33	徐海林	有限合伙人	设计高级工程师	3.35	0.63
34	詹杰	有限合伙人	设计副主管	3.35	0.63
35	罗攀	有限合伙人	证券事务代表	3.35	0.63
36	姜建峰	有限合伙人	机加工领班	3.35	0.63
37	于刚	有限合伙人	机加工副领班	3.35	0.63
38	宋庆国	有限合伙人	机加工领班	3.35	0.63
合计				**529.30**	**100.00**

（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在被质押、冻结、发生诉讼纠纷或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，公司无控股股东，公司实际控制人持有的公司股份不存在被质押、冻结、发生诉讼纠纷或其他有争议的情况。

（四）控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况

报告期内，公司无控股股东，公司实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

（五）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东

截至本招股说明书签署日，除公司实际控制人及其一致行动人外，其他持有公司5%以上股份的股东为天堂硅谷长实、赵轶及长川科技、半导体装备二期基金及嘉兴芯传和嘉兴芯测，基本情况如下：

1、天堂硅谷长实

截至本招股说明书签署日，天堂硅谷长实持有公司 11.4831%股份。天堂硅谷长实的基本情况如下：

名称：	杭州天堂硅谷长实股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：	2021 年 2 月 8 日
出资额：	2,100.00 万元
执行事务合伙人：	杭州天堂硅谷创业投资管理有限公司
统一社会信用代码：	91330109MA2KDWHEXK
住所：	浙江省杭州市萧山区闻堰街道金融小镇二期中区块南岸 3 号楼 137-361 室
经营范围：	股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务关系：	股权投资，与发行人主营业务无关

截至本招股说明书签署日，天堂硅谷长实的出资结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭州市工业企业投资发展有限公司	有限合伙人	900.00	42.86
2	张成	有限合伙人	500.00	23.81
3	赵时峰	有限合伙人	350.00	16.67
4	杭州天堂硅谷创业投资管理有限公司	普通合伙人	150.00	7.14
5	陈玲燕	有限合伙人	100.00	4.76
6	胡琦	有限合伙人	100.00	4.76
合计			**2,100.00**	**100.00**

2、赵轶及长川科技

截至本招股说明书签署日，赵轶系长川科技控股股东、实际控制人之一，赵轶持有公司 4.9467%股份，长川科技持有公司 4.9873%股份，合计持有公司 9.9340%股份。赵轶及长川科技的具体情况如下：

（1）赵轶

赵轶，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2007 年 12 月任职于杭州士兰微电子股份有限公司，任生产总监；2008 年 4 月创办并任职于长川科技，历任总经理、执行董事、董事长兼总经理；2015 年 4 月至今任长川科技董事长、总经理；2014 年 10 月至 **2024 年 8 月**兼任常州长川执行董事。

（2）长川科技

长川科技为上市公司，证券代码为 300604，其基本情况如下：

名称：	杭州长川科技股份有限公司
成立时间：	2008 年 4 月 10 日
注册资本：	**64,394.34** 万元
法定代表人：	赵轶
统一社会信用代码：	91330100673958539H
住所：	浙江省杭州市滨江区聚才路 410 号
经营范围：	生产：半导体设备（测试机、分选机）。服务：半导体设备、光机电一体化技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让；批发、零售：半导体设备，光机电一体化产品，从事进出口业务，设备租赁，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务关系：	长川科技主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备，目前公司主要销售产品为测试机、分选机、自动化设备及 AOI 光学检测设备等。报告期内，长川科技作为公司客户，向公司采购分选换型套件等产品

数据来源：长川科技**于 2026 年 8 月 6 日公告的《2025 年度向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》**等公开信息披露。

截至 2026 年 **7 月 27 日**，长川科技前十大股东如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	赵轶	**21.98**
2	钟锋浩	**4.93**
3	香港中央结算有限公司	**3.74**
4	孙峰	**2.49**
5	**广发证券股份有限公司一国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金**	**1.55**
6	**UBS AG**	**1.54**
7	杭州长川投资管理合伙企业（有限合伙）	**1.14**
8	韩笑	**0.76**
9	**中国银行股份有限公司一易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金**	**0.76**

序号	股东名称	持股比例（%）
10	中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	0.68
合计		39.57

数据来源：长川科技于 2026 年 8 月 6 日公告的《2025 年度向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》。

3、半导体装备二期基金及嘉兴芯传、嘉兴芯测

截至本招股说明书签署日，半导体装备二期基金及嘉兴芯传、嘉兴芯测为同一控制下的企业，半导体装备二期基金持有公司 3.1250%股份，嘉兴芯传持有公司 1.6875%股份，嘉兴芯测持有公司 4.7500%股份，合计持有公司 9.5625%股份。半导体装备二期基金、嘉兴芯传、嘉兴芯测的基本情况如下：

（1）半导体装备二期基金

名称：	上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）			
成立时间：	2023 年 5 月 22 日			
出资额：	212,450.00 万元			
执行事务合伙人：	上海半导体装备材料产业投资管理有限公司			
类型	有限合伙			
统一社会信用代码：	91310000MACJNL2E6Y			
住所：	上海市青浦区盈港路 710 号 219 室			
经营范围：	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
出资人构成	序号	姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	1	江西景德镇国控产业母基金合伙企业（有限合伙）	40,000.00	18.83
	2	上海先导基电科技股份有限公司	40,000.00	18.83
	3	上海国盛（集团）有限公司	25,000.00	11.77
	4	宁波甬前股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000.00	9.41
	5	上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	4.71
	6	上海崧源眸远私募投资基金有限公司	10,000.00	4.71
	7	上海浦东引领区海通私募投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000.00	4.71
	8	长三角一体化示范区（苏州吴江）汾源产业投资中心（有限合伙）	10,000.00	4.71
	9	翱捷科技股份有限公司	6,000.00	2.82

	10	福建惠安先导产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,500.00	2.59
	11	上海飞凯材料科技股份有限公司	5,000.00	2.35
	12	湖州南浔恒诚资产经营有限公司	5,000.00	2.35
	13	无锡锡东产业投资中心（有限合伙）	4,990.00	2.35
	14	衢州汇衢股权投资合伙企业（有限合伙）	4,000.00	1.88
	15	珠海兴格资本投资有限公司	3,000.00	1.41
	16	先导科技集团有限公司	2,510.00	1.18
	17	福建石狮狮城半导体产业有限责任公司	2,500.00	1.18
	18	上海芯徽程企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000.00	0.94
	19	北银理财有限责任公司	2,000.00	0.94
	20	平潭阳光智谷投资合伙企业（有限合伙）	2,000.00	0.94
	21	上海吉六零擎松创业投资合伙企业（有限合伙）	1,900.00	0.89
	22	杭州长川科技股份有限公司	1,000.00	0.47
	23	上海半导体装备材料产业投资管理有限公司	50.00	0.02
	合计		**212,450.00**	**100.00**
主营业务及与发行人主营业务关系：	股权投资，与发行人主营业务无关			

（2）嘉兴芯传

名称：	嘉兴芯传创业投资合伙企业（有限合伙）			
成立时间：	2025 年 11 月 17 日			
出资额：	3,000.00 万元			
执行事务合伙人：	上海宏天元投资管理有限公司			
类型：	有限合伙			
统一社会信用代码：	91330402MAK21CU20D			
住所：	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 216 室-61			
经营范围：	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			
出资人构成	**序号**	**姓名/名称**	**出资额（万元）**	**出资比例（%）**
	1	甘明春	888.89	29.63
	2	段雪侠	555.56	18.52
	3	上海梵兑企业管理合伙企业（有限合伙）	555.56	18.52
	4	朱建兰	333.33	11.11
	5	沈超	222.22	7.41

	6	胡子健	166.67	5.56
	7	姚瑛	111.11	3.70
	8	黄学武	111.11	3.70
	9	上海宏天元投资管理有限公司	55.56	1.85
	合计		**3,000.00**	**100.00**
主营业务及与发行人主营业务关系：	股权投资，与发行人主营业务无关			

（3）嘉兴芯测

名称：	嘉兴芯测股权投资合伙企业（有限合伙）			
成立时间：	2025 年 10 月 29 日			
出资额：	20,200.00 万元			
执行事务合伙人：	上海芯徵程企业管理合伙企业（有限合伙）			
类型：	有限合伙			
统一社会信用代码：	91330402MAG2HQR707			
住所：	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 216 室-53			
经营范围：	一般项目：股权投资；以私募基金从事创业投资活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			
出资人构成：	**序号**	**姓名/名称**	**出资额（万元）**	**出资比例（%）**
	1	广东红土和裕股权投资基金（有限合伙）	19,900.00	98.51
	2	上海芯徵程企业管理合伙企业（有限合伙）	300.00	1.49
	合计		**20,200.00**	**100.00**
主营业务及与发行人主营业务关系：	股权投资，与发行人主营业务无关			

八、发行人特别表决权股份或类似安排

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排。

九、发行人协议控制架构的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构。

十、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本情况

本次发行前公司总股本为 3,900.0000 万股，本次拟公开发行不超过 1,300.0000 万股

的人民币普通股（不含行使超额配售选择权增发的股票），公开发行股份比例不低于发行后总股本的 25%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及老股东公开发售股份的情形。假设本次公开发行股份 1,300.0000 万股，本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

序号	股东名称/姓名	发行前		发行后	
		持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王强	528.8246	13.5596	528.8246	10.1697
2	天堂硅谷长实	447.8402	11.4831	447.8402	8.6123
3	济沧海	334.7649	8.5837	334.7649	6.4378
4	长川科技	194.5050	4.9873	194.5050	3.7405
5	赵轶	192.9210	4.9467	192.9210	3.7100
6	嘉兴芯测	185.2500	4.7500	185.2500	3.5625
7	田治峰	181.3702	4.6505	181.3702	3.4879
8	方东晖	179.1360	4.5932	179.1360	3.4449
9	湾区社保基金	148.9814	3.8200	148.9814	2.8650
10	半导体装备二期基金	121.8750	3.1250	121.8750	2.3438
11	永鑫融堰	117.0000	3.0000	117.0000	2.2500
12	三花弘道	93.3000	2.3923	93.3000	1.7942
13	黄建满	90.1875	2.3125	90.1875	1.7344
14	张少波	89.5680	2.2966	89.5680	1.7225
15	杭州端一	89.0000	2.2821	89.0000	1.7115
16	杭州且何	79.0000	2.0256	79.0000	1.5192
17	永鑫开拓	74.6400	1.9138	74.6400	1.4354
18	宝台杜鹃	67.8858	1.7407	67.8858	1.3055
19	嘉兴芯传	65.8125	1.6875	65.8125	1.2656
20	徐越	63.3750	1.6250	63.3750	1.2188
21	嘉兴鑫先	48.7500	1.2500	48.7500	0.9375
22	江俊豪	48.7500	1.2500	48.7500	0.9375
23	铜陵施捷	48.7500	1.2500	48.7500	0.9375
24	石磊	48.7500	1.2500	48.7500	0.9375
25	冯源晟芯	45.0485	1.1551	45.0485	0.8663
26	宋晓燕	44.0500	1.1295	44.0500	0.8471
27	元利一期	43.8750	1.1250	43.8750	0.8438
28	陈军	41.2725	1.0583	41.2725	0.7937

序号	股东名称/姓名	发行前		发行后	
		持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
29	本坚芯汇	37.3200	0.9569	37.3200	0.7177
30	创新资本（CS）	37.2454	0.9550	37.2454	0.7163
31	冯源仁芯	32.9515	0.8449	32.9515	0.6337
32	郑梅莲	29.2500	0.7500	29.2500	0.5625
33	苏州融享	24.3750	0.6250	24.3750	0.4688
34	魏来	24.3750	0.6250	24.3750	0.4688
本次公开发行的股份		-	-	1,300.0000	25.0000
合计		**3,900.0000**	**100.0000**	**5,200.0000**	**100.0000**

（二）本次发行前公司前十名股东持股情况

截至本招股说明书签署日，公司前十名股东及其直接持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	直接持股数量（万股）	直接持股比例（%）
1	王强	528.8246	13.5596
2	天堂硅谷长实	447.8402	11.4831
3	济沧海	334.7649	8.5837
4	长川科技	194.5050	4.9873
5	赵轶	192.9210	4.9467
6	嘉兴芯测	185.2500	4.7500
7	田治峰	181.3702	4.6505
8	方东晖	179.1360	4.5932
9	湾区社保基金	148.9814	3.8200
10	半导体装备二期基金	121.8750	3.1250

（三）本次发行前公司前十名自然人股东及其在发行人处任职情况

截至本招股说明书签署日，公司前十名自然人股东及其在公司担任职务的情况如下：

序号	股东名称/姓名	直接持股数量（万股）	直接持股比例（%）	任职情况
1	王强	528.8246	13.5596	董事长、总经理
2	赵轶	192.9210	4.9467	无
3	田治峰	181.3702	4.6505	无
4	方东晖	179.1360	4.5932	无

（四）发行人股本中的国有股份及外资股份情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在外资股东，创新资本（CS）为国有股东。根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定，如发行人发行股票并上市，创新资本的证券账户应当标注“CS”标识。截至本招股说明书签署日，根据创新资本出具的《关于深圳市创新资本投资有限公司证券账户标识的说明》，其证券账户已标注“CS”标识。

（五）发行人申报前十二个月新增股东情况

截至本招股说明书签署日，公司现有股东中最近十二个月新增股东的股份取得情况如下：

1、新增股东的入股原因、入股价格及定价依据

公司申报前十二个月内，创新资本、湾区社保基金、永鑫融堰、苏州融享、嘉兴鑫先、半导体装备二期基金、嘉兴芯测、黄建满、宝台杜鹃、嘉兴芯传、徐越、冯源晟芯、冯源仁芯、陈军、江俊豪、郑梅莲、魏来、铜陵施捷、石磊、元利一期因看好公司未来发展以受让老股方式入股，新增股东入股情况如下：

序号	新增股东	转让方	取得时间	受让股数（万股）	受让对价（万元）	单价（元/股）	定价依据
1	创新资本	半导体装备基金	2025 年 11 月	37.2454	1,528.01	41.0256	根据公司估值 16 亿元
2	湾区社保基金		2025 年 11 月	148.9814	6,112.06		
3	永鑫融堰	赵轶	2025 年 11 月	117.0000	4,800.00		
4	苏州融享		2025 年 11 月	24.3750	1,000.00		
5	黄建满		2025 年 12 月	68.2500	2,800.00		
6	徐越	长川科技	2025 年 12 月	63.3750	2,600.00		
7	冯源晟芯		2025 年 12 月	45.0485	1,848.34	41.03	根据公司估值 16.0017 亿元
8	冯源仁芯		2025 年 12 月	32.9515	1,352.00		
9	半导体装备二期基金	赋实投资	2025 年 12 月	121.8750	5,000.00	41.0256	根据公司估值 16 亿元
10	嘉兴芯传		2025 年 12 月	3.8750	158.97		
11	嘉兴芯测		2025 年 12 月	185.2500	7,600.00		
12	嘉兴鑫先	共青城长柳	2025 年 12 月	48.7500	2,000.00		
13	嘉兴芯传		2025 年 12 月	61.9375	2,541.03		
14	宝台杜鹃		2025 年 12 月	67.8858	2,785.06		

序号	新增股东	转让方	取得时间	受让股数（万股）	受让对价（万元）	单价（元/股）	定价依据
15	魏来		2026 年 2 月	24.3750	1,000.00		
16	石磊		2026 年 2 月	48.7500	2,000.00		
17	郑梅莲		2026 年 2 月	29.2500	1,200.00		
18	铜陵施捷		2026 年 2 月	48.7500	2,000.00		
19	元利一期		2026 年 2 月	43.8750	1,800.00		
20	陈军	本坚芯汇	2026 年 1 月	41.2725	1,693.23		
21	江俊豪		2026 年 1 月	48.7500	2,000.00		
22	黄建满		2026 年 1 月	21.9375	900.00		

2、公司新增股东基本情况

（1）创新资本

名称：	深圳市创新资本投资有限公司			
成立时间：	2001 年 5 月 10 日			
注册资本：	150,000 万元			
法定代表人：	马楠			
统一社会信用代码：	914403007285722630			
住所：	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201			
经营范围：	创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资、创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。			
出资人构成	**序号**	**姓名/名称**	**出资额（万元）**	**出资比例**
	1	深圳市创新投资集团有限公司	150,000.00	100.00%
	合计		**150,000.00**	**100.00%**
主营业务及与发行人主营业务关系：	股权投资，与发行人主营业务无关			

（2）湾区社保基金

名称：	社保基金湾区科技创新股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）
成立时间：	2024 年 2 月 21 日
出资额：	510,000 万元
执行事务合伙人：	深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司
类型：	有限合伙
统一社会信用代码：	91440300MADAH5D099

住所：	深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园 5 号楼 209M			
经营范围：	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）			
出资人构成：	**序号**	**姓名/名称**	**出资额（万元）**	**出资比例**
	1	全国社会保障基金理事会	500,000.00	98.04%
	2	深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司	10,000.00	1.96%
	合计		**510,000.00**	**100.00%**
主营业务及与发行人主营业务关系：	股权投资，与发行人主营业务无关			

（3）永鑫融堰

名称：	泰州永鑫融堰创业投资合伙企业（有限合伙）			
成立时间：	2025 年 3 月 27 日			
出资额：	30,000 万元			
执行事务合伙人：	苏州永鑫开元创业投资合伙企业（有限合伙）			
类型：	有限合伙			
统一社会信用代码：	91321204MAEE0JK20E			
住所：	江苏省泰州市姜堰区三水街道科技路 159 号智能应急产业园 22 幢			
经营范围：	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
出资人构成：	**序号**	**姓名/名称**	**出资额（万元）**	**出资比例**
	1	泰州三水投资开发有限公司	8,700.00	29.00%
	2	泰州市盛鑫创业投资管理有限公司	6,000.00	20.00%
	3	江苏大洋投资有限公司	2,000.00	6.67%
	4	胜科纳米（苏州）股份有限公司	2,000.00	6.67%
	5	黄裕中	1,500.00	5.00%
	6	吴彩香	1,000.00	3.33%
	7	中衡设计集团股份有限公司	1,000.00	3.33%
	8	苏州市吴中食品有限公司	1,000.00	3.33%
	9	钱宏根	600.00	2.00%
	10	钱新华	600.00	2.00%
	11	许鹏程	500.00	1.67%
	12	黄宝生	500.00	1.67%

	13	孙林华	500.00	1.67%
	14	张浩炯	500.00	1.67%
	15	丁朝辉	500.00	1.67%
	16	蒋风韵	500.00	1.67%
	17	严文戟	500.00	1.67%
	18	钱春华	500.00	1.67%
	19	苏州永鑫共创股权投资合伙企业（有限合伙）	500.00	1.67%
	20	泰州市潼创投资管理有限公司	300.00	1.00%
	21	刘阳	250.00	0.83%
	22	赵庆利	250.00	0.83%
	23	江苏锐才服务外包有限公司	200.00	0.67%
	24	苏州永鑫开元创业投资合伙企业（有限合伙）	100.00	0.33%
	合计		**30,000.00**	**100.00%**
主营业务及与发行人主营业务关系：	股权投资，与发行人主营业务无关			

（4）苏州融享

名称：	苏州融享创业投资合伙企业（有限合伙）			
成立时间：	2022 年 6 月 22 日			
出资额：	50,000 万元			
执行事务合伙人：	苏州高新创业投资集团融享投资管理有限公司			
类型	有限合伙			
统一社会信用代码：	91320505MABQFERP7U			
住所：	苏州高新区塔园路 379 号 1 幢 4 楼东南			
经营范围：	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
出资人构成	**序号**	**姓名/名称**	**出资额（万元）**	**出资比例**
	1	苏州高新创业投资集团有限公司	49,500.00	99.00%
	2	苏州高新创业投资集团融享投资管理有限公司	500.00	1.00%
	合计		**50,000.00**	**100.00%**
主营业务及与发行人主营业务关系：	股权投资，与发行人主营业务无关			

（5）半导体装备二期基金

半导体装备二期基金的基本情况详见本节“七、发行人控股股东、实际控制人及其

他主要股东情况”之“（五）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东”之“3、半导体装备二期基金及嘉兴芯传、嘉兴芯测”之“（1）半导体装备二期基金”。

（6）嘉兴芯传

嘉兴芯传的基本情况详见本节“七、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况”之“（五）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东”之“3、半导体装备二期基金及嘉兴芯传、嘉兴芯测”之“（2）嘉兴芯传”。

（7）嘉兴芯测

嘉兴芯测的基本情况详见本节“七、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况”之“（五）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东”之“3、半导体装备二期基金及嘉兴芯传、嘉兴芯测”之“（3）嘉兴芯测”。

（8）宝台杜鹃

<table>
<tr><td>名称：</td><td colspan="4">广东宝台杜鹃创业投资基金合伙企业（有限合伙）</td></tr>
<tr><td>成立时间：</td><td colspan="4">2024 年 7 月 10 日</td></tr>
<tr><td>出资额：</td><td colspan="4">3,107 万元</td></tr>
<tr><td>执行事务合伙人：</td><td colspan="4">深圳诺辉岭南私募创业投资基金管理有限公司</td></tr>
<tr><td>类型：</td><td colspan="4">有限合伙</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码：</td><td colspan="4">91440605MADRF69F3M</td></tr>
<tr><td>住所：</td><td colspan="4">佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405（住所申报，集群登记）</td></tr>
<tr><td>经营范围：</td><td colspan="4">一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">出资人构成：</td><td>序号</td><td>姓名/名称</td><td>出资额（万元）</td><td>出资比例</td></tr>
<tr><td>1</td><td>张土生</td><td>700.00</td><td>22.53%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>段小龙</td><td>486.00</td><td>15.64%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>万海燕</td><td>400.00</td><td>12.87%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>陈保红</td><td>320.00</td><td>10.30%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>方科</td><td>200.00</td><td>6.44%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>饶职辉</td><td>200.00</td><td>6.44%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>何忠伟</td><td>200.00</td><td>6.44%</td></tr>
<tr><td>8</td><td>江海</td><td>200.00</td><td>6.44%</td></tr>
</table>

	9	韩乐闻	100.00	3.22%
	10	张齐	100.00	3.22%
	11	鲍培斌	100.00	3.22%
	12	任永轶	100.00	3.22%
	13	深圳诺辉岭南私募创业投资基金管理有限公司	1.00	0.03%
	合计		**3,107.00**	**100.00%**
主营业务及与发行人主营业务关系：	股权投资，与发行人主营业务无关			

（9）嘉兴鑫先

名称：	嘉兴鑫先创业投资合伙企业（有限合伙）			
成立时间：	2023 年 8 月 22 日			
出资额：	4,156 万元			
执行事务合伙人：	青岛鑫芯创业投资管理有限公司			
类型：	有限合伙			
统一社会信用代码：	91330402MACU6UPW1W			
住所：	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 198 室-85（自主申报）			
经营范围：	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			
出资人构成：	**序号**	**姓名/名称**	**出资额（万元）**	**出资比例**
	1	陆鹏飞	3,000.00	72.18%
	2	祁俊松	400.00	9.62%
	3	钟鑫生	400.00	9.62%
	4	王绍迪	200.00	4.81%
	5	包燕飞	150.00	3.61%
	6	青岛鑫芯创业投资管理有限公司	6.00	0.14%
	合计		**4,156.00**	**100.00%**
主营业务及与发行人主营业务关系：	股权投资，与发行人主营业务无关			

（10）冯源晟芯

名称：	晋江冯源晟芯创业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：	2021 年 5 月 26 日
出资额：	27,000 万元

执行事务合伙人：	冯源（宁波）私募基金管理有限公司			
类型：	有限合伙			
统一社会信用代码：	91350128MA8T9BDT7B			
住所：	福建省晋江市东石镇石东路 236 号 2 楼 202			
经营范围：	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
出资人构成：	**序号**	**姓名/名称**	**出资额（万元）**	**出资比例**
	1	泉州市泉创冯芯投资合伙企业（有限合伙）	3,200.00	11.85%
	2	上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）	3,000.00	11.11%
	3	东莞市东康实业投资有限公司	2,200.00	8.15%
	4	虞晗	1,850.00	6.85%
	5	方荣波	1,000.00	3.70%
	6	陈杰	1,000.00	3.70%
	7	刘志碧	1,000.00	3.70%
	8	黄健	1,000.00	3.70%
	9	泉州市文化旅游创新股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	3.70%
	10	优利德科技（中国）股份有限公司	1,000.00	3.70%
	11	袁伍妹	840.00	3.11%
	12	叶枫	800.00	2.96%
	13	王艳艳	600.00	2.22%
	14	方荣幸	500.00	1.85%
	15	李斌	500.00	1.85%
	16	侯茸茸	500.00	1.85%
	17	贾松	500.00	1.85%
	18	虞小荣	500.00	1.85%
	19	周伟雄	500.00	1.85%
	20	刘爱琴	500.00	1.85%
	21	张松鹤	400.00	1.48%
	22	张振浩	400.00	1.48%
	23	谢亮	300.00	1.11%
	24	余红斌	300.00	1.11%
	25	陈剑青	300.00	1.11%

	26	王超	250.00	0.93%
	27	史亚军	200.00	0.74%
	28	王燏	200.00	0.74%
	29	崔前海	200.00	0.74%
	30	沈宏	200.00	0.74%
	31	干志均	200.00	0.74%
	32	于江勇	200.00	0.74%
	33	白云海	200.00	0.74%
	34	沙力	200.00	0.74%
	35	宁波军梅燃料油贸易有限公司	200.00	0.74%
	36	尹辉	150.00	0.56%
	37	张力仁	100.00	0.37%
	38	潘晓雷	100.00	0.37%
	39	高昕	100.00	0.37%
	40	解洪涛	100.00	0.37%
	41	李建强	100.00	0.37%
	42	严旭燕	100.00	0.37%
	43	洪灿	100.00	0.37%
	44	项时奋	100.00	0.37%
	45	马洪敏	100.00	0.37%
	46	李文林	100.00	0.37%
	47	司传煜	100.00	0.37%
	48	冯源（宁波）私募基金管理有限公司	10.00	0.04%
	合计		**27,000.00**	**100.00%**
主营业务及与发行人主营业务关系：	股权投资，与发行人主营业务无关			

（11）冯源仁芯

名称：	泉州冯源仁芯创业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：	2025 年 2 月 17 日
出资额：	57,677 万元
执行事务合伙人：	冯源（宁波）私募基金管理有限公司
类型	有限合伙
统一社会信用代码：	91350502MAEBLLP2X3

住所：	福建省泉州经济技术开发区玉狮路 69 号 A 栋 1 号楼 315 室 2-9 号			
经营范围：	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
出资人构成	**序号**	**姓名/名称**	**出资额（万元）**	**出资比例**
	1	泉州市产业股权投资基金有限公司	10,000.00	17.34%
	2	泉州经济技术开发区投资集团有限公司	10,000.00	17.34%
	3	石家庄海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,000.00	15.60%
	4	虞仁荣	7,350.00	12.74%
	5	浙江安吉新启胜股权投资有限公司	5,000.00	8.67%
	6	衢州信安众合股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000.00	8.67%
	7	泉州市金同优选投资合伙企业（有限合伙）	4,000.00	6.94%
	8	福建省产业股权投资基金有限公司	3,000.00	5.20%
	9	虞晗	2,750.00	4.77%
	10	泉州市创新投资发展合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1.73%
	11	冯源（宁波）私募基金管理有限公司	577.00	1.00%
	合计		**57,677.00**	**100.00%**
主营业务及与发行人主营业务关系：	股权投资，与发行人主营业务无关			

（12）铜陵施捷

名称：	铜陵施捷科技合伙企业（有限合伙）			
成立时间：	2025 年 11 月 18 日			
出资额：	3,520 万元			
执行事务合伙人：	合肥大通钧和私募基金管理有限公司			
类型	有限合伙			
统一社会信用代码：	91340705MAK1G1EG4F			
住所：	安徽省铜陵市铜官区东郊办事处街道铜官区数字经济产业园一期 1215 号			
经营范围：	一般项目：信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）			
出资人构成	**序号**	**姓名/名称**	**出资额（万元）**	**出资比例**
	1	铜陵亨贞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,170.00	33.24%
	2	铜陵钧和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,170.00	33.24%

	3	苏州钧和如一创业投资合伙企业（有限合伙）	1,170.00	33.24%
	4	合肥大通钧和私募基金管理有限公司	10.00	0.28%
	合计		**3,520.00**	**100.00%**
主营业务及与发行人主营业务关系：	股权投资，与发行人主营业务无关			

（13）元利一期

名称：	杭州元利一期股权投资合伙企业（有限合伙）			
成立时间：	2022 年 11 月 9 日			
出资额：	5,201 万元			
执行事务合伙人：	杭州元亨利贞私募基金管理有限公司			
类型	有限合伙			
统一社会信用代码：	91330110MAC3LCXK2X			
住所：	浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399 号 21 幢 101-6-1			
经营范围：	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			
出资人构成	**序号**	**姓名/名称**	**出资额（万元）**	**出资比例**
	1	杭州元亨利贞私募基金管理有限公司	3,401.00	65.39%
	2	周南	1,000.00	19.23%
	3	赵金宇	300.00	5.77%
	4	刘露芬	300.00	5.77%
	5	柏赵华	100.00	1.92%
	6	毕嘉昱	100.00	1.92%
	合计		**5,201.00**	**100.00%**
主营业务及与发行人主营业务关系：	股权投资，与发行人主营业务无关			

（14）黄建满

黄建满，男，中国国籍，其住所为浙江省温岭市*******，身份证号码为3326231978********。

（15）徐越

徐越，男，中国国籍，其住所为浙江省杭州市西湖区*******，身份证号码为3390051975********。

（16）江俊豪

江俊豪，男，中国国籍，其住所为浙江省温岭市*******，身份证号码为3310811991********。

（17）陈军

陈军，男，中国国籍，其住所为浙江省杭州市萧山区*******，身份证号码为3390051981********。

（18）魏来

魏来，男，中国国籍，其住所为北京市海淀区*******，身份证号码为1101051983********。

（19）石磊

石磊，男，中国国籍，其住所为山东省济南市天桥区*******，身份证号码为1427331980********。

（20）郑梅莲

郑梅莲，女，中国国籍，其住所为浙江省杭州市拱墅区*******，身份证号码为3301061972********。

3、新增股东与发行人其他股东、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员之间的关联关系情况

截至本招股说明书签署日，该等新增股东与公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司其他股东关联关系详见本节“十、发行人股本情况”之“（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及各自持股比例”。

4、新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员的关联关系情况

截至本招股说明书签署日，该等新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。

5、新增股东是否存在股份代持情形

截至本招股说明书签署日，该等新增股东所持股份均为其真实持有，不存在股份代

持情形。

（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及各自持股比例

截至本招股说明书签署日，公司直接股东之间的关联关系、一致行动关系及持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	关联关系及一致行动关系
1	王强	528.8246	13.5596	王强任员工持股平台济沧海、杭州端一、杭州且何执行事务合伙人
	济沧海	334.7649	8.5837	
	杭州端一	89.0000	2.2821	
	杭州且何	79.0000	2.0256	
2	赵轶	192.9210	4.9467	赵轶系长川科技控股股东、实际控制人之一，任长川科技董事长兼总经理
	长川科技	194.5050	4.9873	
3	半导体装备二期基金	121.8750	3.1250	半导体装备二期基金、嘉兴芯传、嘉兴芯测属于同一控制下的企业
	嘉兴芯传	65.8125	1.6875	
	嘉兴芯测	185.2500	4.7500	
4	湾区社保基金	148.9814	3.8200	湾区社保基金、创新资本属于同一控制下的企业
	创新资本	37.2454	0.9550	
5	冯源晟芯	45.0485	1.1551	冯源晟芯、冯源仁芯属于同一控制下的企业
	冯源仁芯	32.9515	0.8449	
6	永鑫融堰	117.0000	3.0000	永鑫融堰、永鑫开拓属于同一控制下的企业
	永鑫开拓	74.6400	1.9138	
7	张少波	89.5680	2.2966	张少波任三花弘道执行事务合伙人
	三花弘道	93.3000	2.3923	

除上述情况外，公司其他直接股东之间不存在关联关系。

（七）现有股东私募投资基金备案情况

截至本招股说明书签署日，公司共有法人及合伙企业股东 21 名，其中 15 名为私募投资基金，均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等规定在中国证券投资基金业协会进行登记或备案，具体情况如下：

序号	股东名称	私募基金备案情况	管理人登记情况
1	半导体装备二期基金	基金编号为 SB2172	基金管理人为上海半导体装备材料产业投资管理有限公司，登记编号为 P1068757
2	天堂硅谷长实	基金编号为 SQH020	基金管理人为杭州天堂硅谷创业投资管理有限公司，登记编号为 P1001003

序号	股东名称	私募基金备案情况	管理人登记情况
3	本坚芯汇	基金编号为 SVC175	基金管理人为杭州本坚私募基金管理有限公司，登记编号为 P1072224
4	永鑫开拓	基金编号为 STD538	基金管理人为苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业（普通合伙），登记编号为 P1017017
5	湾区社保基金	基金编号为 SAHT85	基金管理人为深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司，登记编号为 P1069346
6	永鑫融堰	基金编号为 SAXF00	基金管理人为苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业（普通合伙），登记编号为 P1017017
7	苏州融享	基金编号为 STX392	基金管理人为苏州高新创业投资集团融享投资管理有限公司，登记编号为 P1070304
8	嘉兴鑫先	基金编号为 SAES53	基金管理人为青岛鑫芯创业投资管理有限公司，登记编号为 P1072713
9	嘉兴芯测	基金编号为 SBJT94	基金管理人为上海半导体装备材料产业投资管理有限公司，登记编号为 P1068757
10	宝台杜鹃	基金编号为 SBLD73	基金管理人为深圳诺辉岭南私募创业投资基金管理有限公司，登记编号为 P1032386
11	嘉兴芯传	基金编号为 SBLG67	基金管理人为上海宏天元投资管理有限公司，登记编号为 P1024913
12	冯源晟芯	基金编号为 SZE762	基金管理人为冯源（宁波）私募基金管理有限公司，登记编号为 P1071503
13	冯源仁芯	基金编号为 SAUP72	基金管理人为冯源（宁波）私募基金管理有限公司，登记编号为 P1071503
14	元利一期	基金编号为 SZZ778	基金管理人为杭州元亨利贞私募基金管理有限公司，登记编号为 P1070866
15	创新资本	基金编号为 SD2403	基金管理人为创新资本，登记编号为 P1000980

截至本招股说明书签署日，除上述股东外，发行人其他非自然人股东的情况具体如下：

序号	股东名称	是否属于私募基金	不属于私募投资基金的认定依据
1	济沧海	否	员工持股平台
2	杭州端一	否	员工持股平台
3	杭州且何	否	员工持股平台
4	长川科技	否	上市公司
5	三花弘道	否	不存在以非公开方式募集资金的情形
6	铜陵施捷	否	不存在以非公开方式募集资金的情形

上述股东皆不存在以非公开方式募集资金的情形，不属于需要依据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》的规定履行备案程序的私募投资基金。

（八）发行人股东公开发售股份的情况

公司本次发行不涉及股东公开发售股份的情况。

（九）股东特殊权利条款及其解除情况

2021 年 12 月，半导体装备基金入股成为法特迪有限股东，法特迪有限及当时之全体股东共同签署了《关于法特迪精密科技（苏州）有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），《股东协议》中存在如“最优惠待遇”“投资者保护性权利”等股东特殊权利条款。

2026 年 4 月，上述签署了《股东协议》且仍为公司股东的股东及公司共同签署了《股东协议解除协议》，确认自《股东协议解除协议》签署之日起，《股东协议》即失效且自始无效。

除上述情况外，截至本招股说明书签署日，公司与股东之间不存在有效存续的股东特殊权利相关约定。

十一、董事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

1、董事会成员

截至本招股说明书签署日，公司董事会由 7 名成员组成，其中独立董事 3 名，具体职务及任期情况如下：

姓名	职务	提名人	本届任职期间
王强	董事长、总经理	王强	2023 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日
贺涛	董事、副总经理	王强	2023 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日
朱伟	董事、蓝泽科技运营总经理	王强	2023 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日
丁宁	职工董事、质量总监	职工代表大会	2025 年 11 月 6 日至 2026 年 11 月 21 日
庞凌	独立董事	王强	2023 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日
王要玉	独立董事	王强	2023 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日
王帆	独立董事	王强	2023 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日

公司现任董事简历如下：

王强的基本情况详见本节“七、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况”

之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”。

贺涛，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 1 月至 2009 年 8 月，任安拓锐高新测试技术（苏州）有限公司设计工程师；2009 年 8 月至 2010 年 6 月，任美博科技（苏州）有限公司设计工程师；2010 年 7 月至 2012 年 7 月，任上海韬盛电子科技有限公司设计经理；2012 年 8 月至 2014 年 3 月，任苏州韬盛电子科技有限公司设计经理；2014 年 4 月至 2023 年 11 月，任法特迪有限运营总监；2023 年 11 月至今，任公司董事、副总经理。

朱伟，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005 年 4 月至 2006 年 11 月，任库力索法半导体（苏州）有限公司工程部制造工程师；2006 年 12 月至 2010 年 3 月，任安拓锐高新测试技术（苏州）有限公司工程部制造工程师；2010 年 4 月至 2011 年 5 月，任美博科技（苏州）有限公司生产经理；2011 年 5 月至 2012 年 7 月，任上海韬盛电子科技有限公司生产经理；2012 年 8 月至 2014 年 2 月，任苏州韬盛电子科技有限公司生产经理；2014 年 3 月至 2023 年 11 月，任法特迪有限工程总监；2020 年 9 月至今任法特迪电子监事；2021 年 9 月至今任蓝泽科技运营总经理；2023 年 11 月至今，任公司董事。

丁宁，男，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 3 月至 2010 年 5 月，任安拓锐高新测试技术（苏州）有限公司品质部领班；2010 年 6 月至 2011 年 3 月，任美博科技（苏州）有限公司品质部主管；2011 年 3 月至 2012 年 7 月，任上海韬盛电子科技有限公司品质部主管；2012 年 8 月至 2014 年 4 月，任苏州韬盛电子科技有限公司品质部主管；2014 年 4 月至 2020 年 9 月，任法特迪有限质量部经理；2020 年 10 月至 2021 年 12 月，任法特迪电子质量部经理；2022 年 1 月至 2023 年 10 月，任法特迪有限质量部总监；2023 年 11 月至 2025 年 11 月任公司监事会主席；2023 年 11 月至今任公司质量部总监；2025 年 11 月至今任公司职工董事、质量总监。

庞凌，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994 年 8 月至 1997 年 9 月历任苏州东方律师事务所、苏州正文律师事务所律师，1997 年 9 月起在苏州大学工作，现任苏州大学王健法学院教授、苏州大学学位评定委员会秘书处（学位办）副秘书长（副主任）、民革苏州市委副主委，2023 年 5 月至今担任江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事，2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

王帆，女，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，审计署审计科研所博士后。2012 年起在浙江工商大学工作，现任浙江工商大学教授、审计系主任，曾在浙江省审计厅担任研究员，温莎大学访问学者，浙江省之江青年，ESI 高被引学者（2022），浙江省高级审计师评审专家，教育部专业硕士评估专家，教育部专业硕士论文评审专家，国家社科同行评议专家，中国政府审计研究中心（CCGAR）研究员。2022 年 5 月至今任宁波伏尔肯科技集团股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任浙江锋龙电气股份有限公司独立董事，2026 年 4 月至今任浙江万里学院特聘教授，2023 年 11 月至今任公司独立董事。

王要玉，男，1983 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2011 年 5 月至 10 月任香港城市大学管理科学系研究助理，2011 年 11 月至今历任苏州大学商学院讲师、副教授、教授；现任苏州大学商学院党委书记、教授、博士生导师，江苏省价格协会副会长、江苏省国际税收研究会副会长。2021 年 4 月至 2023 年 8 月任苏州市吴江城市投资发展集团有限公司董事，2022 年 6 月至 2024 年 12 月任苏州小棉袄信息技术股份有限公司独立董事，2025 年 2 月至今任苏州市能源发展集团有限公司董事，2023 年 11 月至今任公司独立董事。

2、高级管理人员

截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员共 5 名，具体职务及任期情况如下：

姓名	职务	本届任职期间
王强	总经理	2023 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日
贺涛	副总经理	2023 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日
金永斌	副总经理	2023 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日
张辉	副总经理、董事会秘书	2023 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日
郭文霞	财务总监	2023 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日

公司现任高级管理人员简历如下：

王强的基本情况详见本节“七、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”。

贺涛的基本情况详见本节“十一、董事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况”之“1、董事会成员”。

金永斌，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2002 年 7 月至 2018 年 9 月，历任飞利浦半导体（苏州）有限公司（后更名为“日月新半导体（苏州）有限公司”）测试工程师、新产品开发工程处长；2018 年 10 月至 2023 年 10 月，任法特迪有限副总经理；2023 年 11 月至今，任公司副总经理。

张辉，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 高级管理人员工商管理硕士学位，具有高级会计师、注册税务师专业资格、杭州市会计领军人才。其主要经历如下：2002 年 7 月至 2005 年 4 月，历任浙江万马高分子材料股份有限公司主办会计、财务副经理，2005 年 5 月至 2009 年 10 月，历任浙江万马集团审计监察部经理助理、财务经理助理；2009 年 11 月至 2019 年 1 月，历任杭州可靠护理用品股份有限公司财务经理、财务总监；2019 年 2 月至 2020 年 7 月，任井冈山惊石农业科技有限公司财务总监;2020 年 7 月至 2021 年 3 月,任杭州蜜淘网络科技有限公司财务总监；2021 年 3 月至 2022 年 9 月，任法特迪有限财务总监；2022 年 10 月至 2023 年 10 月，任法特迪有限战略投资部副总经理；2023 年 11 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

郭文霞，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中级会计专业资格。2002 年 12 月至 2005 年 7 月，任爱美克空气过滤器（苏州）有限公司财务部会计；2005 年 8 月至 2007 年 12 月，任群策精密金属（苏州）有限公司财务部财务主管；2008 年 1 月至 2011 年 7 月，任苏州赛马特殊金属精密加工有限公司财务部财务经理；2011 年 8 月至 2018 年 11 月，任苏州宝迈通讯科技有限公司财务部财务负责人；2018 年 11 月至 2022 年 9 月，任法特迪有限财务经理；2021 年 9 月至今任蓝泽科技财务负责人；2022 年 10 月至 2023 年 10 月，任法特迪有限财务总监；2023 年 11 月至今，任公司财务总监。

3、核心技术人员

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员共有 3 名，具体职务情况如下：

姓名	职务
王强	董事长、总经理
贺涛	董事、副总经理
金永斌	副总经理

（1）核心技术人员认定依据

根据生产经营的需要和对企业生产经营发挥的实际作用，公司核心技术人员的确定标准主要参考员工与公司业务匹配的学历背景、专业背景、工作经历、工作职责、所负

责的具体研发方向、所取得的研发成果、所获取的发明及专利情况、对公司产品研发的具体技术贡献以及对公司发展做出的贡献等情况综合认定。

（2）核心技术人员基本情况

公司核心技术人员的简历如下：

王强的基本情况详见本节“七、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”。

贺涛的基本情况详见本节“十一、董事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况”之“1、董事会成员”。

金永斌的基本情况详见本节“十一、董事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况”之“2、高级管理人员”。

4、董事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况（除公司及公司控股子公司外）如下：

姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职企业与发行人的关联关系
王强	董事长、总经理	济沧海	执行事务合伙人	员工持股平台，公司实际控制人的一致行动人
		杭州且何	执行事务合伙人	员工持股平台，公司实际控制人的一致行动人
		杭州端一	执行事务合伙人	员工持股平台，公司实际控制人的一致行动人
庞凌	独立董事	苏州大学	法学院教授、学位评定委员会秘书处（学位办）副秘书长	无关联关系
		中国国民党革命委员会苏州市委员会	副主委	无关联关系
		江苏常熟农村商业银行股份有限公司	独立董事	无关联关系
王帆	独立董事	浙江工商大学	教授、审计系主任	无关联关系
		宁波伏尔肯科技集团股份有限公司	独立董事	无关联关系
		浙江锋龙电气股份有限公司	独立董事	无关联关系
		浙江万里学院	特聘教授	无关联关系

姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职企业与发行人的关联关系
王要玉	独立董事	苏州大学商学院	教授、党委书记	无关联关系
		江苏省价格协会	副会长	无关联关系
		江苏省国际税收研究会	副会长	无关联关系
		苏州市能源发展集团有限公司	董事	无关联关系

5、董事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

6、董事、高级管理人员及核心技术人员合法合规情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员最近三年不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

（二）发行人与董事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况

截至本招股说明书签署日，除独立董事外的董事、高级管理人员及核心技术人员与公司签署了《劳动合同》《保密及禁止竞业协议》，独立董事与公司签署了《独立董事聘任合同》。自前述协议签订以来，相关董事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行合同约定的义务和职责，遵守相关承诺，未发生违反合同义务、责任或承诺的情形。

除上述协议外，公司董事、高级管理人员和核心技术人员未与公司签订对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的其他协议。

（三）董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况

1、公司董事、高级管理人员、核心技术人员直接持股情况

姓名	职务	持股数（万股）	持股比例（%）
王强	董事长、总经理	528.8246	13.5596

2、公司董事、高级管理人员、核心技术人员间接持股情况

截至本招股说明书签署日，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员、核心技术人员通过济沧海、杭州且何、杭州端一等员工持股平台间接持有公司股份，具体如下：

姓名	职务	持股平台名称	员工持股平台出资额（万元）	员工持股平台出资比例（%）	间接持有公司股份比例（%）
王强	董事长、总经理	济沧海	14.2857	1.0034	0.0861
		杭州且何	3.3500	0.6329	0.0128
		杭州端一	3.3500	0.5618	0.0128
贺涛	董事、副总经理	济沧海	301.5797	21.1819	1.8182
朱伟	董事、蓝泽科技运营总经理	济沧海	230.1512	16.1650	1.3876
丁宁	职工董事、质量总监	济沧海	204.7562	14.3814	1.2345
郭文霞	财务总监	济沧海	158.7226	11.1481	0.9569
金永斌	副总经理	济沧海	142.8503	10.0333	0.8612
张辉	副总经理、董事会秘书	杭州端一	100.5000	16.8539	0.3846

3、公司董事、高级管理人员、核心技术人员近亲属持有公司股份的情况

截至本招股说明书签署日，存在部分公司董事（独立董事除外）、高级管理人员、核心技术人员的近亲属间接持有公司股份的情况，具体如下：

姓名	在公司职务	与董事、高管、核心技术人员的亲属关系	持股平台名称	员工持股平台出资额（万元）	员工持股平台出资比例（%）	间接持有公司股份比例（%）
王军	厂务副主管	系公司董事长、总经理王强的弟弟	杭州端一	6.7000	1.1236	0.0256
张娟	仓库副经理	系公司董事长、总经理王强的弟弟王军的配偶	济沧海	14.2857	1.0034	0.0861
			杭州且何	13.4000	2.5316	0.0513
贺勇	仓库主管	系公司董事、副总经理贺涛的哥哥	杭州且何	6.7000	1.2658	0.0256

4、公司董事、高级管理人员、核心技术人员所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有的公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

（四）董事、取消监事会前在任监事、董事会审计委员会成员、高级管理人员及核心技术人员最近两年内的变动情况

1、董事变动情况

最近两年，公司董事会成员变动情况如下：

变动时间	变动前董事会成员	变动后董事会成员	变动情况	变动原因
2025 年 10 月 22 日	王强、贺涛、朱伟、李明、王帆、庞凌、王要玉	王强、贺涛、朱伟、王帆、庞凌、王要玉	李明退出	李明辞去董事职务
2025 年 11 月 6 日	王强、贺涛、朱伟、王帆、庞凌、王要玉	王强、贺涛、朱伟、丁宁（职工董事）、王帆、庞凌、王要玉	选举丁宁担任职工董事	选举丁宁担任职工董事

2、取消监事会前在任监事变动情况

最近两年，公司取消监事会前在任监事变动情况如下：

变动时间	变动前监事	变动后监事	变动情况	变动原因
2025 年 11 月 6 日	丁宁、侯文、王传刚（职工监事）	无	取消监事	根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，公司取消监事，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权

3、董事会审计委员会成员变动情况

最近两年，公司董事会审计委员会成员未发生变动。

4、高级管理人员变动情况

最近两年，公司高级管理人员未发生变动。

5、核心技术人员变动情况

最近两年，公司核心技术人员未发生变动。

（五）董事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员、核心技术人员不存在与公司及公司业务相关的对外投资。

（六）董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

1、薪酬组成、确定依据及履行的程序

公司的独立董事除领取固定津贴外，不享受其他福利待遇。在公司任职的董事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、津贴及奖金等组成，依据其在公司担任的经营管理岗位确定。公司股东会决定董事报酬事项，董事会决定高级管理人员报酬事项和奖惩事项。公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据董事及高级管理人员担任经营管理岗位的主要范围、职责、重要性以及同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪

酬制度执行情况进行监督。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。

2、报告期内薪酬总额占公司利润总额的比重

报告期内，公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额占公司利润总额的比例分别为 12.59%、8.92%、4.29%**和 2.33%**。

3、最近一年从公司及公司关联企业领取薪酬的情况

公司董事、高级管理人员及核心技术人员 2025 年度在公司领取的薪酬情况如下：

姓名	职务	2025 年度薪酬总额（万元）
王强	董事长、总经理	138.50
贺涛	董事、副总经理	92.69
朱伟	董事、蓝泽科技运营总经理	75.52
丁宁	职工董事	75.00
庞凌	独立董事	8.00
王要玉	独立董事	8.00
王帆	独立董事	8.00
金永斌	副总经理	90.11
张辉	董事会秘书、副总经理	91.55
郭文霞	财务总监	75.64
合计		**662.99**

除上述薪酬待遇外，公司现任董事、高级管理人员和核心技术人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。

十二、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排

（一）股权激励安排的基本情况

本次公开发行申报前，公司通过济沧海、杭州端一、杭州且何三个员工持股平台实施了多轮股权激励，股权激励对象均为公司员工，该等股权激励均已实施完毕，具体情况如下：

1、员工持股平台基本情况

公司员工持股平台济沧海、杭州端一、杭州且何的基本情况详见本节“七、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况”之“（二）实际控制人的一致行动人”。

2、员工持股平台股份锁定期

截至本招股说明书签署日，济沧海、杭州端一、杭州且何作为公司员工持股平台及直接股东，已根据相关要求，承诺自公司上市后 36 个月内不转让其持有的公司股份；激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员或者其他特殊情况的则按照相关法律法规的规定承诺相应锁定期，具体详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺”之“（一）关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”。

济沧海的合伙协议未约定锁定期，但规定：合伙人必须为公司董事、高管、核心技术人员或其他核心人员，有限合伙人向合伙人以外的人转让份额需经过其他合伙人一致同意，有限合伙人内部互相转让份额时应该通知其他合伙人，普通合伙人王强享有优先受让权或可指定其他合伙人受让。有限合伙人退伙需经过全体合伙人一致同意，相应财产份额应转让给普通合伙人王强或由王强指定的其他有限合伙人受让，如王强放弃优先受让且不指定受让主体，则合伙企业可以减资。

根据杭州端一、杭州且何的员工股权激励协议的相关约定，在激励计划约定的服务期（指激励对象应自按照激励计划的规定在获得被授予的公司股权之日起持续在公司至少全职工作 5 年）内，如激励对象离职、辞职、劳动合同期满不再与公司续签劳动合同、与公司协商提前终止劳动关系等，激励对象应当将其持有的持股平台份额全部转让给执行事务合伙人或其指定主体。

（二）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及上市后的行权安排

公司上述股权激励有利于充分调动员工的工作积极性、进一步提高骨干团队和人才队伍的稳定性，为公司持续、稳定、快速地发展提供重要保障。

公司依据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，根据评估值确定激励股权的公允价值，并根据锁定期或预计服务期按期分摊确认股份支付费用，相应调整资本公积。报告期内，股权激励相关的股份支付金额如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
股份支付金额	**563.75**	1,099.64	607.25	170.33
占当期归属于母公司股东的净利润的比例	**4.33%**	8.33%	9.85%	4.45%

截至本招股说明书签署日，公司员工持股平台济沧海、杭州且何、杭州端一均系公司实际控制人的一致行动人，实际控制人控制公司 26.4510%的股份。上述股权激励对公司控制权不存在重大不利影响。

除上述已实施完毕的股权激励外，公司不存在尚未实施完毕的股权激励，亦不存在上市后的行权安排。

十三、发行人员工情况

（一）员工人数

报告期各期末，公司员工人数如下：

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
员工总人数（人）	**602**	443	303	295

（二）员工结构

截至**报告期**末，公司员工结构具体如下：

项目	类别	人数（人）	占比
专业结构	管理人员	**26**	**4.32%**
	生产和技术人员	**454**	**75.42%**
	销售人员	**23**	**3.82%**
	研发人员	**91**	**15.12%**
	财务人员	**8**	**1.33%**
	合计	**602**	**100.00%**
学历结构	硕士及以上	**20**	**3.32%**
	本科	**174**	**28.90%**
	大专	**162**	**26.91%**
	大专以下	**246**	**40.86%**
	合计	**602**	**100.00%**
年龄结构	30 岁以下	**251**	**41.69%**
	30-39 岁	**262**	**43.52%**

项目	类别	人数（人）	占比
	40-49 岁	83	13.79%
	50 岁以上	6	1.00%
	合计	602	100.00%

（三）社会保险及住房公积金情况

1、社会保险及住房公积金缴纳情况

报告期各期末，公司及子公司为员工缴纳社会保险和住房公积金的基本情况如下：

项目	工伤	养老	失业	医疗	住房公积金
2026 年 6 月 30 日					
已缴纳人数	**585**	**584**	**584**	**584**	**582**
未缴纳人数	**17**	**18**	**18**	**18**	**20**
缴纳比例	**97.18%**	**97.01%**	**97.01%**	**97.01%**	**96.68%**
2025 年 12 月 31 日					
已缴纳人数	**435**	**430**	**430**	**429**	**427**
未缴纳人数	**8**	**13**	**13**	**14**	**16**
缴纳比例	**98.19%**	**97.07%**	**97.07%**	**96.84%**	**96.39%**
2024 年 12 月 31 日					
已缴纳人数	300	300	300	300	299
未缴纳人数	3	3	3	3	4
缴纳比例	99.01%	99.01%	99.01%	99.01%	98.68%
2023 年 12 月 31 日					
已缴纳人数	295	295	295	294	294
未缴纳人数	0	0	0	1	1
缴纳比例	100.00%	100.00%	100.00%	99.66%	99.66%

注：上述已缴纳人数含后续补缴人数。

报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形，主要原因为部分员工为退休返聘、实习生以及当月新入职员工等。根据苏州市公共信用信息中心、安徽省公共信用信息服务中心等出具的《苏州市企业专用信用报告》《法人和非法人组织公共信用信息报告》，公司及子公司报告期内没有因违反社会保险、住房公积金有关法律法规而受到行政处罚的记录。

2、发行人实际控制人关于社会保险及住房公积金的承诺

公司实际控制人王强承诺：“如因发行人及控股子公司因公开发行前未严格遵守劳动用工相关法律法规及规范性文件，或未严格执行为员工缴纳社会保险和住房公积金政策事宜被有权机关处罚或要求补缴社会保险或住房公积金的，本人将督促发行人及时补缴。若发行人因未足额缴纳需要承担任何罚款、滞纳金，或因有关人员向发行人及控股子公司追索，或因上述情形给发行人或其子公司造成损失的，本人将对罚款、滞纳金及其他损失作出全额赔偿，并承担连带责任，且在承担后不向发行人及其控股子公司追偿。”

（四）劳务派遣用工情况

报告期各期末，公司劳务派遣工的使用情况如下：

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
劳务派遣人数	**44**	42	34	14
用工总数	**646**	485	337	309
劳务派遣人数占比	**6.81%**	8.66%	10.09%	4.53%

注：用工总数=劳务派遣人数+员工人数。

报告期内，公司通过劳务派遣工以满足临时性的用工需求。公司与具备资质的劳务派遣公司签订劳务派遣合同，公司向劳务派遣公司支付劳务派遣费，劳务派遣人员的工资和社会保险由劳务派遣公司发放和缴纳。报告期内，公司不存在因劳务用工相关违法违规事宜受到劳动行政部门行政处罚。公司报告期内曾经存在劳务派遣用工比例超过10%的情形，公司积极整改，报告期末劳务派遣用工比例已下降至 10%以下。

第五节 业务与技术

一、发行人主营业务及主要产品情况

（一）发行人主营业务基本情况

公司是半导体封装测试消耗型硬件解决方案提供商，主营业务为高性能测试座、封测接口组件等产品的研发、生产及销售，覆盖半导体领域从芯片设计至量产交付的全生命周期，为芯片设计公司、封测服务企业、测试设备厂商等半导体产业链关键环节客户提供封装测试消耗型硬件解决方案。公司产品主要应用于 GPU、CPU、SoC 等高性能芯片的核心测试环节，服务于 AI HPC、智能终端、汽车电子、工业控制等国民经济重要领域，实现了高性能芯片封装测试消耗型硬件的国产替代，助力我国集成电路产业的自主可控及战略升级。根据 Yole 统计数据，2025 年公司位居全球半导体测试座行业第十位，也是全球前十大厂商中唯一的中国境内企业。

半导体封装测试消耗型硬件是连通测试设备与待测芯片之间的核心纽带，主要承担低损耗高速信号传输、严苛测试环境维持以及高精度定位接触等功能，其自身的技术指标直接决定了芯片整体测试方案的精度与效率。在芯片设计的工程验证阶段，公司产品可协助客户识别芯片设计缺陷、优化封装方案并提高芯片研发验证效率；在芯片量产的成品测试（FT）、老化测试（Burn-in）和系统级测试（SLT）阶段，公司产品可保障客户有效筛除芯片性能偏差、提高芯片交付良率及可靠性。

随着高性能芯片通过制程微缩及 Chiplet、2.5D/3D 等复杂封装结构持续向高速率、高频率、高功率方向演进，封装测试消耗型硬件的应用场景日益复杂，对其信号传输完整性与稳定性、高功率散热及精准温控以及结构精密程度提出了更高要求，行业技术壁垒和工艺门槛不断提高。面对前沿需求，公司始终聚焦前沿测试场景并持续突破，已形成“高频高速信号的测试座设计与制造”“宽温区、高功率测试座设计与制造”“高性能测试探针设计”“高精度微间距测试座精密制造”“测试分选套件精密制造”与“高速测试机接口模组制造”六大核心技术体系，能够持续满足高性能芯片测试的前沿需求，产品性能指标与工艺水平已达到行业先进水平：在高速高频领域，公司产品可支持最高 224Gbps 超高速信号传输、85GHz 高频射频信号传输；在高功率散热及精准温控领域，公司已开发出适配 2,000W 高功率、满足±1.5℃精准控温的老化测试方案；在精密制造方面，公司测试座产品已实现了万针级高密度布局、250 微米级探针间距以及

110mm×110mm 超大尺寸同轴结构制造；上述行业先进的技术水平助力公司产品精准适配 AI 算力芯片、智能手机 SoC、车规级芯片等高性能芯片测试需求。截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有 68 项发明专利与 65 项实用新型专利，建有省级企业技术中心及省级集成电路芯片测试连接器工程技术研究中心，获评国家级专精特新重点“小巨人”企业、博士后科研工作站。

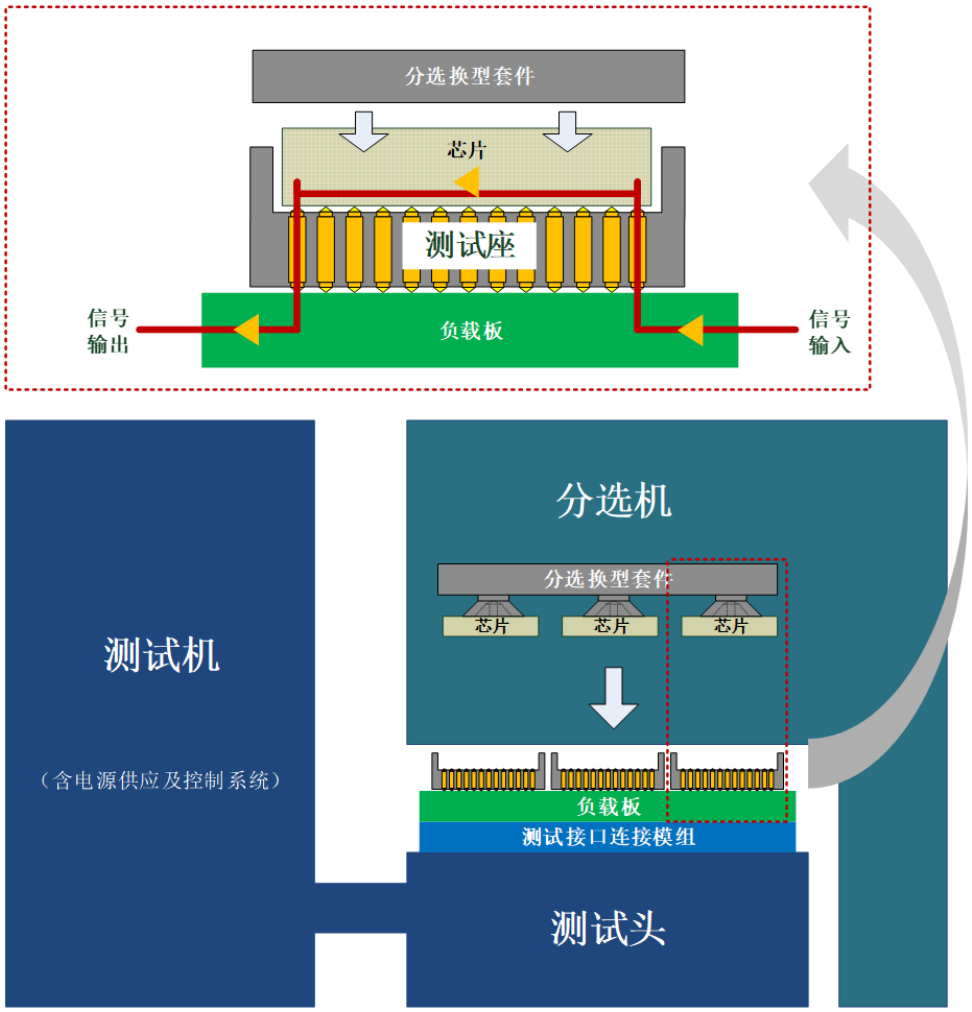
公司客户主要包括芯片设计公司、封测服务企业及测试设备厂商等半导体产业链核心参与者，已成为日月光、芯云半导体、京隆科技、长电科技、通富微电、华天科技、伟测科技以及渠梁电子等业内主流半导体封测服务企业的稳定供应商。公司客户广泛分布于国民经济各重要领域，在 AI HPC 领域，公司客户覆盖 A 公司、D 公司、B 公司、C 公司、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、燧原科技、龙芯中科、清微智能等国内头部算力企业；在智能终端方向，公司长期服务的客户包括 A 公司、新紫光集团、中兴通讯、全志科技、Apple、Microchip 等境内外芯片设计公司；在汽车电子领域，公司已进入 MPS、英飞凌、Bosch、安世半导体、恩智浦、A 公司、地平线、瑞芯微、纳芯微、士兰微、四维图新等境内外汽车电子产业链企业的供应商体系；在工业控制等其他重要领域，公司客户亦包括 MPS、复旦微电、安路科技等知名企业。公司凭借核心技术持续突破、产业链深度协同、全生命周期服务、供应链自主可控以及规模化交付能力，已深入参与全球高性能半导体封装测试消耗型硬件市场竞争。

（二）发行人主要产品基本情况

集成电路产品从设计到最终交付通常需经历芯片设计、晶圆制造及封装测试等核心环节。在芯片设计阶段，芯片设计公司需通过工程验证等方式对芯片功能、性能及可靠性进行评估；在晶圆制造完成后的封装测试阶段，芯片通常还需经过封装、成品测试、老化测试以及系统级测试等中后道环节，以验证芯片是否满足出货标准及终端应用要求。公司产品主要应用于芯片初期设计阶段的工程验证环节、量产后封装测试阶段的成品测试、老化测试以及系统级测试等关键测试场景，是连接测试设备与待测芯片的重要桥梁。

公司长期专注于半导体封装测试消耗型硬件领域，已构建起以功能测试座、老化测试座等高性能测试座为核心，以分选换型套件、测试接口连接模组等封测接口组件为协同的产品矩阵。以成品测试场景为例，公司主要产品在分选机、芯片以及测试机之间的连接关系及应用情况具体如下图所示：

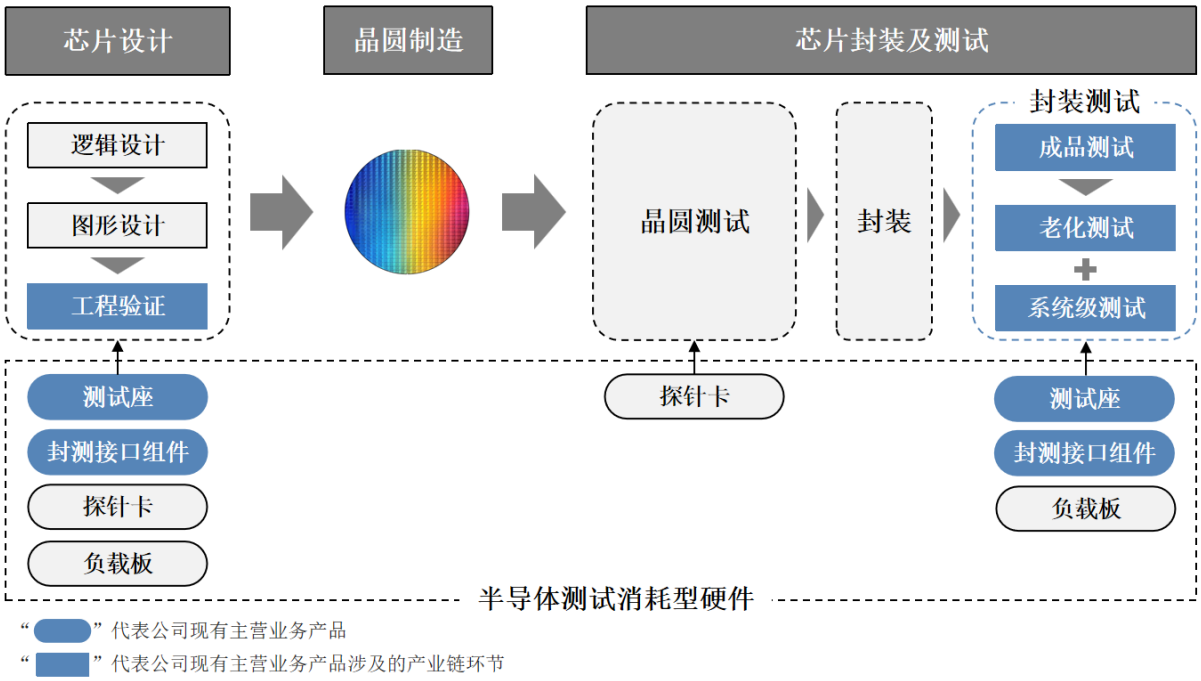
图：成品测试场景下公司主要产品的应用情况



注：老化测试与系统级测试等测试场景根据环境不同，所需的测试设备与成品测试存在一定差异。

公司产品在芯片测试过程中主要承担测试信号通道建立、复杂温度及功率环境维持、芯片精准定位以及机械夹持等功能，各产品线之间有效协同，可提供一站式封装测试接口解决方案。其中，功能测试座和老化测试座是公司现阶段核心的产品类别，公司已围绕高速高频信号传输、高功率散热及精准温控、多工位独立温区及高密度微间距加工等关键技术持续攻关，在功能测试座领域实现了信号传输速率由 56Gbps 向 224Gbps 的跨越；在老化测试座领域完成了由低功率风冷向千瓦级液冷散热及精准温控方案的技术升级，具备 2,000W 高功率散热、多区同步独立控温等技术能力。公司高性能测试座可满足 AI HPC、智能终端、汽车电子以及工业控制等领域高性能芯片对高速高频信号传输、高功率散热及精准温控的严苛要求。

图：公司主营业务产品所在产业链关键环节及应用场景

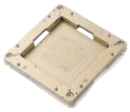


1、测试座

（1）功能测试座

功能测试座主要应用于功能测试环节。功能测试主要是对封装后芯片进行电性及功能参数测试，测试过程中，芯片置于功能测试座中，功能测试座通过内部探针或其他精密接触结构，与芯片引脚或焊球形成稳定连接，并将测试机输出的电源、控制及测试信号传输至芯片，同时将芯片运行结果、输出数据、电性响应等反馈信号回传给测试机，以完成芯片运行逻辑与功能、性能等指标的验证，判断芯片是否满足应用要求。

功能测试主要包括成品测试（FT）及系统级测试（SLT）等场景，由 FT 测试座与 SLT 测试座分别承载相应测试场景下的芯片连接与信号传输功能：

产品名称	产品图示	产品描述及用途
功能测试座	 FT 测试座	功能测试座是连接待测芯片与测试设备的核心接口，在待测芯片与测试设备之间建立稳定的电源、信号传输及控制通道。 其中 FT 和 SLT 两类测试侧重点不同： （1）FT 测试座侧重高速高频信号的传输，主要用于芯片的电性参数及功能验证； （2）SLT 测试座一般采用更复杂的同轴结构设计，主要用于在模拟真实系统环境下测试芯片的模块协同、逻辑功能、系统兼容性及稳定性
	 SLT 测试座	

公司功能测试座产品的发展始终围绕“更高速高频、更高密度、更大尺寸”的技术

演进路径。在支持的芯片信号传输速率方面，公司功能测试座产品 2025 年成功突破 224Gbps，全面覆盖包括 AI 算力芯片在内的测试需求；在支持的芯片引脚密度方面，顺应先进封装高密度趋势，公司功能测试座产品的探针间距已持续微缩至 0.25mm 水平；在支持的芯片尺寸方面，为适应 Chiplet、2.5D/3D 等先进封装带来的大尺寸趋势，公司同轴测试座产品已具备针对 110mm×110mm 大尺寸封装芯片的高可靠性测试能力。随着芯片的性能持续提升，功能测试座需要在更高速频率信号、更高引脚密度、更小探针间距及更复杂的系统级测试环境下保持信号传输完整性与接触稳定性。

（2）老化测试座

老化测试座主要应用于老化测试环节。老化测试主要是模拟芯片在长期使用中可能承受的严苛工作条件，筛除早期失效产品，从而提升芯片在终端应用中的长期可靠性。相较于功能测试座，老化测试座除需实现稳定连接外，还需在长时间高低温循环、高功率运行中保持信息传输性能、热管理能力以及机械结构的稳定：

产品名称	产品图示	产品描述及用途
老化测试座		老化测试座主要用于模拟严苛环境（高温/低温、高功率、大电流或高电压等），通过对芯片进行长时间加速应力测试来验证芯片的长期可靠性；老化测试座能够针对单颗芯片进行精准测试温度调节。产品主要用于 AI 算力芯片、手机 SoC 芯片、车规级芯片以及工业控制芯片等高可靠性或高功率芯片的可靠性筛选，以提前暴露潜在缺陷、筛除早期失效产品

公司老化测试座的技术演进紧扣“更高功率、更高效散热、更精准温控、更宽工作温度范围”等核心方向。在测试功率方面，公司老化测试座产品测试功率从早期<50W 起步，到形成 850W 风冷独立控温技术，并于近年实现 2,000W 大功率算力芯片老化测试能力；在散热效率及温控能力方面，公司已构建“高效散热基底+毫秒级感知+智能算法”三位一体的控温系统，通过“风冷+微通道液冷”的先进散热方案，保证高功率产品芯片测试环境±1.5℃的稳定温度控制，并完成从单点控温到 24 工位同步独立控温的技术跨越，实现温度感知、自主独立加热与散热的一体化布局；在工作温度范围方面，公司老化测试座测试温区覆盖-55℃至 175℃宽温域。以千瓦级散热与多工位独立温控为代表的技术突破，使公司能够为 AI 算力芯片、手机 SoC 芯片、车规级芯片等高功率芯片提供全方位、高可靠性的测试解决方案。随着芯片性能持续提升、单芯片价值量不断提高，以及 AI HPC、智能终端与汽车电子等终端应用对芯片运行环境、安全性及长期可靠性要求日益严苛，老化测试已成为高性能芯片生产工艺的必备流程，正逐步由抽样

筛选向全量测试演进，通过提前暴露芯片潜在缺陷与高失效率周期，降低终端应用中的失效率与运行风险。

（3）探针

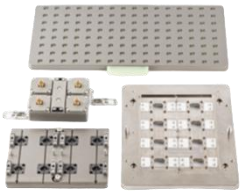
探针是实现测试座与待测芯片之间的核心接触元件，用于测试座与待测芯片之间的连接，决定了测试座的性能边界：

产品名称	产品图示	产品描述及用途
探针		探针是连接待测芯片与测试座的核心元件，应用于功能测试座与老化测试座等产品，主要用途是在芯片测试过程中与芯片引脚或焊球形成稳定接触，将测试设备输出的电信号传输至待测芯片，并将芯片反馈信号回传至测试系统，从而实现对芯片电性能、功能及可靠性的检测

公司凭借对接触力学模型、电磁学仿真技术以及材料学的深刻理解，自主完成探针结构设计、材料选型以及加工工艺选定，保障探针在精密尺寸内兼顾低接触电阻、大电流承载、稳定信号传输、高附着强度、耐磨损及长使用寿命等特性。此外，公司已建立探针自动化检测体系，实现了对探针弹力、电阻、内部结构尺寸等关键参数的全自动检测。公司凭借深度定制设计与严格的供应链管控，确立了领先的探针设计技术与质量的优势，保障了测试座的测试精度和测试稳定性。

2、封测接口组件

公司封测接口组件主要包括分选换型套件和测试接口连接模组，是连接测试座、测试机、分选机及待测芯片的重要协同部件：

产品名称	产品图示	产品描述及用途
封测接口组件	 分选换型套件（Kit）	分选换型套件主要用于实现不同封装规格芯片在分选机和测试座之间的精准定位与传输，保证芯片取放、导向及定位精度，避免因偏位、卡料或接触不良影响测试效率，其微米级定位精度保障了芯片引脚与探针的精准对接
	 测试接口连接模组	测试接口连接模组涵盖了测试基座（Tester Block）、信号塔（Pogo Tower）及信号连接块（Connect Block）等核心组件，该模组不仅为测试机提供电磁屏蔽，更承担着负载板与测试机之间的机械连接及信号传输，保障测试系统整体运行的稳定性和高速信号传输的一致性

由于不同客户的待测芯片尺寸及封装形式、测试机型号、分选机型号及测试流程上

存在差异，封测接口组件通常需要结合客户具体测试方案进行定制化开发。公司通过持续创新已形成完善的技术平台，公司开发的分选换型套件可适配主流分选机型号，机械定位精度达到微米级，并适配不同温度的测试环境；测试接口连接模组可支持负载板与测试机之间高速信号的稳定传输，并拥有良好的机械插拔寿命。

（三）发行人主营业务收入构成及特征

报告期内，公司主营业务收入按业务类别和产品列示如下：

单位：万元

产品分类	产品名称	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
测试座	功能测试座	5,220.53	11.87%	9,754.54	17.94%	9,180.33	29.67%	8,543.21	37.90%
	老化测试座	29,381.69	66.79%	29,876.84	54.95%	11,278.62	36.45%	5,116.33	22.70%
	探针	2,733.03	6.21%	5,873.22	10.80%	4,086.67	13.21%	3,715.36	16.48%
	测试座配件	1,218.43	2.77%	1,738.05	3.20%	1,400.69	4.53%	1,470.38	6.52%
	小计	38,553.68	87.65%	47,242.66	86.89%	25,946.31	83.86%	18,845.29	83.60%
封测接口组件	分选换型套件	2,351.76	5.35%	3,324.53	6.11%	2,191.28	7.08%	1,381.79	6.13%
	测试接口连接模组	918.13	2.09%	1,473.76	2.71%	1,147.17	3.71%	1,056.64	4.69%
	封测接口组件配件	437.97	1.00%	746.95	1.37%	468.69	1.51%	161.58	0.72%
	小计	3,707.86	8.43%	5,545.25	10.20%	3,807.14	12.31%	2,600.01	11.53%
其他		1,726.47	3.92%	1,580.15	2.91%	1,185.59	3.83%	1,096.63	4.86%
总计		43,988.01	100.00%	54,368.05	100.00%	30,939.03	100.00%	22,541.92	100.00%

报告期内，公司主营业务收入按应用领域列示如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
智能终端	12,724.62	28.93%	22,494.41	41.37%	8,011.47	25.89%	8,354.16	37.06%
AI HPC	18,534.70	42.14%	14,676.63	26.99%	9,423.33	30.46%	2,068.97	9.18%
汽车电子	7,704.29	17.51%	9,067.26	16.68%	5,892.91	19.05%	4,120.40	18.28%
工业控制	3,268.32	7.43%	4,095.69	7.53%	3,564.18	11.52%	4,633.88	20.56%
其他	1,756.07	3.99%	4,034.07	7.42%	4,047.14	13.08%	3,364.51	14.93%
总计	43,988.01	100.00%	54,368.05	100.00%	30,939.03	100.00%	22,541.92	100.00%

（四）发行人主要经营模式

1、盈利模式

公司专注于半导体封装测试消耗型硬件领域，主要通过向芯片设计公司、封测服务企业、测试设备厂商等客户直接销售自主研发生产的测试座、封测接口组件等产品，满足客户多方位、一体化的测试需求。

公司产品具有较强的定制化属性，通常需根据客户芯片的类型、封装形式、引脚布局、信号速率以及功耗水平等情况进行方案设计、产品开发和生产交付。公司在芯片工程验证、量产测试等阶段为客户提供半导体封装测试消耗型硬件，并持续服务客户的后续芯片迭代、组件更换及配套产品需求。

2、研发模式

公司采取技术趋势导向、客户需求导向相结合的研发模式。公司建立了规范的研发管理体系，形成了与半导体测试行业特点高度契合的研发模式。公司始终围绕行业技术趋势和客户实际需求，以提升产品性能、拓展产品种类为目标，结合公司中长期发展规划，系统性地开展技术预研、技术开发、产品预研、新产品开发及产品升级等多层次的研发布局。

项目启动前，研发团队会结合公司战略、市场调研及客户特定需求明确方向，通过多维度评估形成立项申请与可行性报告。立项后，公司综合评估技术、质量、风险及成本等因素，制定年度研发计划与资源分配方案，并在关键节点设置评审机制。进入研发验证阶段，公司聚焦于产品设计、样品试制与小批量试产，严格执行样品验证流程，确保所有新产品经过全面检测与验证方可转入批量生产；项目完成后召开鉴定会，从技术、经济角度综合评估成果。

通过完整的研发管理体系，公司有效打通技术创新与市场需求之间的衔接通道，形成了从技术预研到产业化应用的良性循环机制。全生命周期的研发项目管理，配合明确的质量标准和决策评审机制，为公司的持续创新发展提供了坚实的制度保障。

3、采购模式

公司主要采取“以产定采”的采购模式。公司采购活动以客户订单、生产计划、交付周期及安全库存为基础，结合供应商交期、市场价格变化及关键物料供应情况，制定

并实施采购计划。

报告期内，公司采购的主要原材料包括探针、金属/非金属结构部件以及结构部件材料等。公司制定了完整的采购控制体系并建立了合格供应商管理制度，对供应商验证准入、阶段性考核及退出进行管理。采购部门根据生产计划或物料请购需求发起采购流程，通过询价、比价、议价等方式综合评估供应商报价、产品质量、交付周期及服务能力，并经内部审批后下达采购订单。物料到货后，由仓储、质检部门进行数量核对、来料检验及入库管理，确保采购物料满足生产和质量要求。

同时，为保障供应链安全和成本控制，公司持续推进多供应商管理和关键物料国产替代，在满足产品性能要求的前提下，提高供应链稳定性和响应效率。

4、生产模式

公司主要采取“以销定产、适度备货”的生产模式。由于半导体测试座及封测接口组件具有高度定制化、产品规格多样的特点，公司通常紧密围绕客户的具体订单需求组织生产活动，并结合通用结构件及部分标准化部件的需求情况进行适度备货，以提高生产响应速度和交付效率。

在具体生产流程方面，生产部门取得最终的设计图纸与 BOM 清单后形成生产计划；公司采购部门依据生产计划生成的物料清单执行采购，并协同品质部门对供应商来料进行严格质检后入库；生产部门负责生产物料领取、生产执行等，并定期跟踪生产计划执行情况，识别与解决生产风险。

公司产品的核心精密加工与组装环节依托公司的高精度 CNC 机床等设备与标准化作业机制完成，生产过程中严格执行多级质量控制体系，并由专业生产人员实时监控加工精度，严格管控产品生产过程。公司坚持核心工艺自主化，以保障产品交付标准的高一致性与技术保密性，对于部分成熟度和标准化程度较高、附加值较低的非核心工序，公司综合产能安排、交付周期及成本效率等因素，采用外协加工方式完成。公司通过明确工艺标准、质量检验要求及供应商管理机制，对外协加工过程进行严格把控，确保最终产品质量满足客户要求。通过长期的工艺积累，公司已建立了高效、柔性的生产体系，能够快速响应客户的定制化需求并保障高质量交付。

5、销售模式

公司始终坚持以客户需求为导向，主要采取直销模式开展业务。半导体封装测试消

耗型硬件产品具有高度定制化特点，通常需要公司与客户在项目早期即开展深入需求沟通，直销模式有利于公司准确理解客户需求、快速响应产品设计变更以及提升生产效率，并与客户形成长期稳定合作关系。

公司主要客户包括芯片设计公司、封测服务企业及测试设备厂商，多元化的客户结构有助于公司精准把握市场动态。针对芯片设计公司，公司通常在工程验证及量产前测试方案开发阶段即参与项目，为客户持续提供适配其芯片性能和测试条件的测试座等产品；针对封测服务企业与测试设备厂商，公司重点围绕量产测试场景，为客户提供满足测试要求且具备耐用性、高交付效率的高性能测试座、分选换型套件及测试接口连接模组等产品，协助客户降低综合测试成本并提高批量测试效率。

公司通过直销模式建立了从需求获取、方案开发、样品验证、订单生产到售后服务的完整客户服务流程，有利于提升产品与客户测试平台的匹配度，并增强客户黏性。

报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	**43,468.82**	**98.82%**	53,691.73	98.76%	29,729.72	96.09%	21,844.83	96.91%
非直销	**519.19**	**1.18%**	676.32	1.24%	1,209.32	3.91%	697.09	3.09%
合计	**43,988.01**	**100.00%**	**54,368.05**	**100.00%**	**30,939.03**	**100.00%**	**22,541.92**	**100.00%**

6、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及经营模式、影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司当前采用的经营模式是基于半导体封装测试消耗型硬件行业特征、客户需求、公司发展阶段以及市场竞争状况等因素所做出的战略选择，能够满足公司经营发展的需求，符合公司自身业务特征。报告期内，公司经营模式未发生重大变化，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，公司预计未来将继续坚持现有经营模式，经营模式不会发生重大变化。

（五）发行人成立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况

公司自成立以来，始终深耕半导体封装测试消耗型硬件领域，通过持续的技术创新和业务拓展，实现了从单一测试座产品供应商到封装测试消耗型硬件解决方案提供商的稳步成长，已逐步构建起覆盖半导体封装测试关键环节的产品矩阵。自成立以来，公司

的主要经营模式未发生重大变化。

1、立足测试座，夯实技术根基与定制化服务能力（2014-2019 年）

公司成立于 2014 年，在国家大力支持集成电路产业发展的背景下，依托创始团队在半导体测试接口领域的深厚经验，公司自设立之初即聚焦于半导体封装测试消耗型硬件领域，将测试座作为核心产品和业务基石，致力于突破外资厂商垄断，满足国内市场对高可靠性测试连接方案的迫切需求。在此阶段，公司聚焦产品的接触可靠性、机械精度与使用寿命三大核心指标，为包括欧美芯片设计公司在内的海内外客户提供测试座研发、生产服务。这一时期，公司在产品设计、精密制造、头部客户服务上完成了原始能力积累，通过立足测试座产品，夯实了技术根基与定制化服务能力，也为公司后续市场拓展奠定了坚实基础。

2、拓展产品体系，构建系统化多品种协同供应能力（2020-2023 年）

2020 年起，随着国际半导体产业竞争格局深刻演变，国内半导体产业快速发展，芯片测试需求向高速高频、高功率等方向持续升级，国内半导体产业链对高性能测试接口的国产替代需求快速增长。公司同步积极推进技术分层与产品多元化战略，系统性地构建起日趋完整的产品体系，以满足日益上升的本土化需求。

在此阶段，公司以年度为节点实现了多项关键技术突破与产品落地。2020 年，公司成功开发了<50W 独立控温老化测试座，并建立起高频 RF 量测能力，推出了 1mm 探针间距的同轴测试座。2021 年，公司进一步开发了广温域芯片温控测试系统与便携式独立控温测试模组，同时突破了 0.65mm 孔径的阵列孔树脂填充技术，提升了产品温控性能及精密制造能力。进入 2022 年，公司推出了 56Gbps 高速同轴测试座，并开发了 8 工位独立控温测试系统。

与此同时，公司积极响应国内半导体产业链自主可控需求，加大本土客户服务力度，并大力发展封测接口组件等配套产品，实现了封测接口组件与半导体测试座的协同发展。公司逐步构建起完备的封装测试消耗型硬件产品矩阵，显著提升了单客户价值与市场竞争力。

3、布局前沿技术，迈向高端化与平台化阶段（2024 年至今）

面对全球半导体产业格局重塑及 AI 芯片、高性能手机 SoC 以及智驾芯片等高性能芯片需求的爆发，公司自 2024 年起开启了以“高端化、平台化”为特征的新一轮战略

升级，重点攻克高速高频、高功率芯片的测试需求，以早期介入客户芯片设计、共同开发的协同模式构建差异化壁垒，并在此基础上全面实施平台化升级。

一方面，公司在温控散热与支持高速信号传输方面取得突破。在温控散热方面，公司老化测试座的功率支持能力从 2023 年的 350W 风冷升级至 2024 年的 850W 风冷，并在 2025 年实现 2,000W 超大功率液冷；在支持高速信号传输方面，公司功能测试座信号速率从 2022 年的 56Gbps 演进至 2024 年的 112Gbps，并于 2025 年成功推出实现 224Gbps 高速信号传输的同轴测试座；在精密加工方面，公司测试座的最小探针间距微缩至目前先进封装所需的 0.25mm 水平，并成功开发 110mm×110mm 超大尺寸高密度同轴测试座。

另一方面，公司继续推进平台化转型升级，产品协同能力进一步向纵深发展。2025 年，公司已完成了 SLT 测试座在先进制程、高复杂度芯片测试中的方案验证并向客户批量交付。此外，公司设立专门研发团队开发负载板产品，并规划布局 WLCSP 探针卡领域，力图进一步丰富公司产品矩阵。

综上，公司不断攻克高速高频、高功率、多引脚、大尺寸等高性能芯片测试需求，持续打造高性能产品；公司与境内外芯片设计公司客户进一步深度协同，提供以多产品矩阵为代表的测试解决方案，持续打造平台化。公司“高端化、平台化”战略为参与全球高性能半导体测试硬件市场的竞争提供有力支撑。

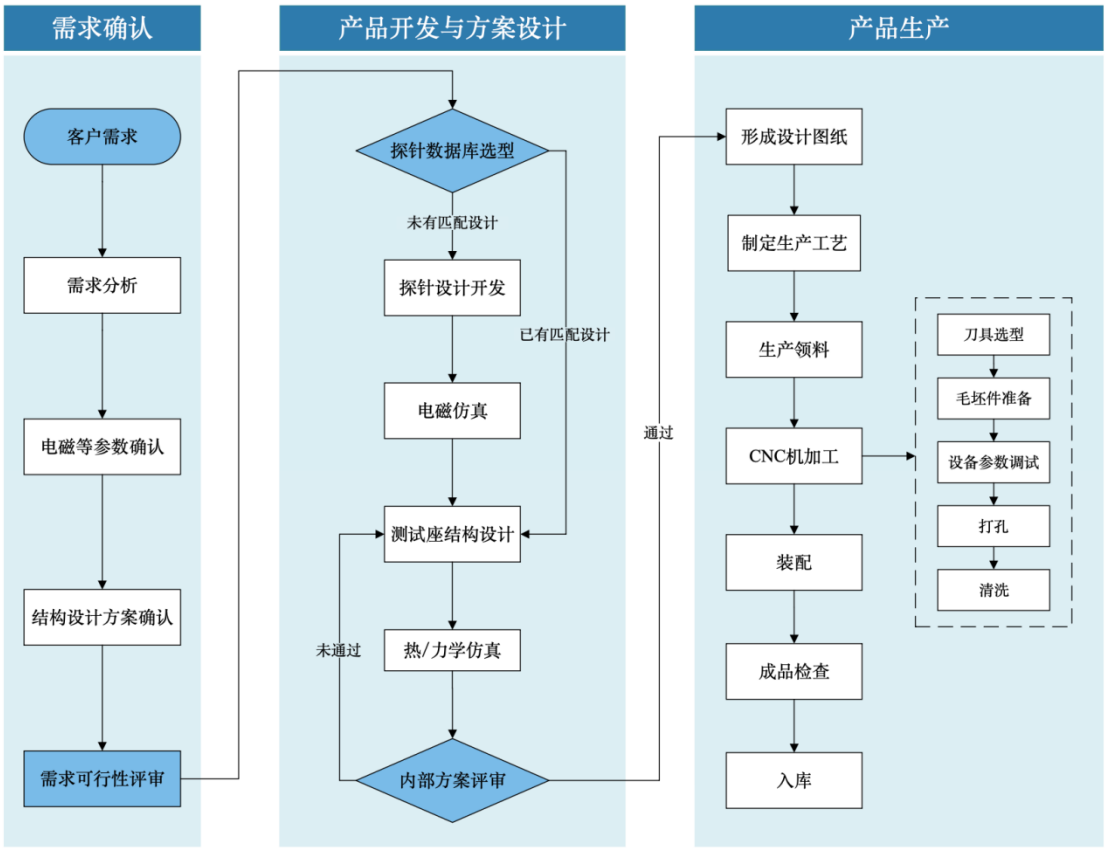
（六）发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况

报告期内，公司深耕半导体封装测试消耗型硬件领域，依托百余项授权专利，针对前沿测试需求，已建立“高频高速信号的测试座设计与制造”“宽温区、高功率测试座设计与制造”“高性能测试探针设计”“高精度微间距测试座精密制造”“测试分选套件精密制造”与“高速测试机接口模组制造”六大核心技术体系，深度融入并应用于主营业务。报告期内，公司核心技术产品的收入贡献分别为 21,445.29 万元、29,753.45 万元、52,787.90 **和 42,261.54** 万元，占营业收入的比例分别为 95.11%、96.13%、97.03% **和 95.99%**。

（七）发行人主要产品的工艺流程图

公司核心产品测试座的工艺流程具体如下：

图：公司测试座产品的标准生产工艺流程



公司主要产品工艺流程主要包括客户需求确认、产品开发与方案设计、产品生产等主要环节，产品生产环节则主要包括生产领料、CNC 机加工、装配、成品检查及入库等细分环节。

（八）发行人报告期各期代表性业务指标的变动情况

近年来，受益于全球半导体产业的持续发展及国内产业链自主可控进程的加速，半导体封装测试消耗型硬件的市场需求强劲增长。根据公司所处行业的特点，衡量行业内企业经营情况及市场地位的代表性指标主要包括各主要产品的营业收入、毛利率、产品技术指标等，营业收入与毛利率详见本节“四、发行人销售情况和主要客户”及本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”，产品技术指标详见本节“三、发行人在行业中的竞争地位”之“（二）行业内主要企业及发行人与同行业公司的比较情况”。

（九）发行人主要业务符合产业政策和国家经济战略的情况

公司主营业务为高性能测试座、封测接口组件等产品的研发、生产及销售。根据国

家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司属于“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。同时，根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类》，公司主营业务属于“1.2 电子核心产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。此外，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》，公司主营业务所属领域为“鼓励类”之“信息产业”相关条目，符合战略性新兴产业的发展方向。

半导体封装测试消耗型硬件应用于确保芯片性能与可靠性的核心环节，直接关系到最终产品的良率与制造成本，在整个半导体产业链中具有基础性地位。集成电路产业作为信息技术的基石，是支撑国家经济社会发展的战略性核心产业，也是全球科技竞争的制高点。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确提出“聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破”，鼓励推动集成电路等关键核心技术攻关与设备零部件的自主可控。公司深耕的半导体测试硬件业务，致力于突破前沿测试环节的技术瓶颈，提升关键封装测试消耗型硬件的国产化率与供应链安全，系落实国家“高水平科技自立自强”战略、以科技创新催生“新质生产力”的具体实践。

综上，公司主要业务紧密围绕国家重大战略需求，高度符合国家产业政策导向及国民经济高质量发展的战略要求。

二、发行人所处行业基本情况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司属于“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类》，公司业务属于“1、新一代信息技术产业”中的“1.2 电子核心产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

（二）所属行业主管部门、监管体制、主要政策

1、所属行业主管部门和监管体制

工信部为公司所处行业主管部门，主要承担行业宏观管理和产业政策制定职能，负责研究提出行业发展规划、产业政策及相关标准规范，推动产业结构优化升级和重点领域技术进步，协调行业发展中的重大事项，并组织实施与产业发展相关的重大专项和科

研成果转化。

中国半导体行业协会为公司所处行业的行业自律组织，主要发挥政府与企业之间的桥梁纽带作用，负责宣传和贯彻国家有关产业政策、法律法规，开展行业调查研究并向主管部门提出政策建议，推动行业自律规范建设，促进会员单位之间的交流合作，并通过开展国际交流、产业协同和市场服务等工作，推动我国半导体产业健康发展。

2、所属行业主要法律法规及政策

公司主营业务聚焦于半导体封装测试环节的核心消耗型硬件，其产品性能直接影响芯片成品的良率验证与质量可靠性，行业发展态势与全球及我国半导体产业链的整体景气度高度共振。集成电路产业作为现代信息技术产业的核心基石，是支撑国家经济社会发展、保障国家安全的战略性、先导性产业。近年来，面对复杂的国际环境与供应链重塑挑战，为加快实现高水平科技自立自强，提升关键核心技术的自主创新能力，国家及相关部委密集出台了一系列关于集成电路行业的顶层设计与支持性产业政策。这些政策涵盖了从基础材料、核心零部件到专用设备的产业链全要素，旨在通过加强关键核心技术攻关、鼓励产业链上下游协同应用、完善财税金融支持体系等维度，全方位构建安全可控、具有国际竞争力的半导体产业生态。近年来，与公司所属行业相关的主要法律法规及政策梳理如下：

（1）所属行业主要法律法规

公司在日常研发及生产经营过程中，严格遵守国家相关法律法规的要求。与公司生产经营密切相关的主要法律法规如下：

序号	法律法规名称	颁布/修订时间	颁布机构	有关本行业的主要内容
1	《中华人民共和国科学技术进步法》	2021.12 修订	全国人大常委会	鼓励企业加大基础研究和应用基础研究投入，支持企业建立技术中心等研发机构。明确对承担国家重大科技攻关任务的企业给予政策倾斜，强化对集成电路等核心技术领域自主创新的法律保障
2	《中华人民共和国安全生产法》	2021.06 修订	全国人大常委会	规范生产经营单位的安全生产保障体系，要求企业建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度
3	《中华人民共和国环境保护法》	2014.04 修订	全国人大常委会	确立了经济社会发展与环境保护相协调的原则。要求制造型企业在新建扩建产线（含半导体精密制造项目）时严格执行环境影响评价制度，落实治污减排责任，推进绿色制造与清洁生产

（2）所属行业主要产业政策

近年来，国家及各部委出台的与公司业务及行业发展直接相关的主要产业政策如下：

序号	行业政策	发布时间	发布单位	有关本行业的主要内容
1	**《信息通信行业发展“十五五”规划》**	**2026.09**	**工信部**	**加快全国一体化算力网建设，构建“枢纽—区域—边缘”多层次算力设施体系，有序部署万卡、十万卡及以上智算集群，面向场景按需部署推理算力设施，加大力度适配国产算力芯片。深化算力自动化监测与供需匹配，提高算力资源利用率**
2	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	2026.03	全国人民代表大会	在“新型基础设施建设”专栏中，将“全国一体化算力网”列为 109 项重大工程项目。明确要构建全国一体化算力体系，实现算力资源的高效调度与绿色低碳运行
3	《2026 年政府工作报告》	2026.03	国务院	首次提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。强调要加快推进算力基础设施的绿色化改造，提升智算集群的能源利用效率
4	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》	2025.10	中共中央委员会	完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破
5	《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》	2025.09	工业和信息化部、国家市场监督管理总局	提出 2025 年至 2026 年电子信息制造业的主要预期目标，推动质的有效提升和量的合理增长。明确提出加力推进电子信息制造业大规模设备更新，发挥好国家集成电路产业投资基金等产业基金的引导作用。聚焦高端化、智能化、绿色化发展方向，强化关键核心技术攻关，提升电子信息制造业产业链供应链韧性和安全水平
6	《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	2025.08	国务院	以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点，深入实施“人工智能+”行动，涌现一批新基础设施、新技术体系、新产业生态、新就业岗位等，加快培育发展新质生产力，使全体人民共享人工智能发展成果，更好服务中国式现代化建设
7	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	2023.12	国家发展和改革委员会	将集成电路设计、集成电路线宽小于 65 纳米（含）的逻辑电路、存储器生产，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产（含掩模版、8 英寸及以上硅片生产）、集成电路封装测试（含引线框架、基板、引线键合、倒装封装、球栅阵列封装 BGA、插针网格阵列封装 PGA、芯片规模封装

序号	行业政策	发布时间	发布单位	有关本行业的主要内容
				CSP、多芯片封装 MCM、栅阵列封装 LGA、系统封装 SIP、倒装封装 FC、MEMS、2.5D、3D 集成电路）、新型封装等先进封装与测试，集成电路装备及关键零部件制造列为鼓励类产业
8	《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》	2023.12	国家发展和改革委员会、国家数据局等部门	明确提出构建全国一体化算力网，统筹通用算力、智能算力、超级算力协同发展。要求加强绿色算力基础设施建设，持续降低数据中心 PUE（电能利用效率）值，鼓励采用液冷等先进散热技术
9	关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告	2023.09	财政部、税务总局等部门	为进一步鼓励企业研发创新，明确集成电路企业开展研发活动中实际发生的研发费用，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，按照实际发生额的 120%在税前扣除
10	《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》	2023.09	工信部、财政部	面向数字经济等发展需求，优化集成电路、新型显示等产业布局并提高供给水平，增强设备、材料、核心零部件等配套能力
11	《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》	2022.12	中共中央、国务院	壮大战略性新兴产业，深入实施国家战略性新兴产业集群发展工程，建设国家级战略性新兴产业基地。聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，推进集成电路、新型显示、人工智能、先进通信、先进计算等技术创新和应用
12	关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策管理办法的通知	2021.03	财政部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、海关总署、税务总局	明确了享受进口税收优惠政策的集成电路生产企业、先进封装测试企业及关键原材料、零配件生产企业清单的联合制定与管理机制。对符合条件的半导体先进封测企业及集成电路关键原材料、零配件生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品及设备零配件，落实免征进口关税的优惠政策
13	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	2020.09	国家发展和改革委员会、科技部、工信部、财政部	加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程建设。加快在光刻胶、高纯靶材、大尺寸硅片、电子化学品等集成电路关键材料领域实现突破，提升集成电路关键材料配套能力，构建自主可控的集成电路产业生态
14	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	2020.07	国务院	聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应

序号	行业政策	发布时间	发布单位	有关本行业的主要内容
				用软件的关键核心技术攻关，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。在先进存储、先进计算、先进制造、先进封装、新一代半导体技术等领域，结合行业特点推动各类创新平台建设

3、报告期初以来新制定或修订、预计近期出台的相关法律法规、行业政策对发行人的具体影响

报告期初以来，我国新制定、修订或预计近期出台的相关法律法规及行业政策，未对公司的经营资质、市场准入门槛及运营模式产生重大不利影响。当前及今后一段时期正处于我国半导体产业发展的战略机遇期与关键攻坚期。报告期内，国家密集出台的一系列产业支持政策，构建了良好的制度环境，有效激发了产业链上下游的创新活力。这不仅为公司提供了广阔的市场空间与发展契机，更有助于加速半导体测试环节的国产化进程，逐步扭转境外厂商主导封装测试消耗型硬件行业的竞争格局，推动行业向自主可控方向高质量发展。

（三）所属行业发展情况

1、半导体测试行业概述及发展情况

（1）半导体测试行业概述

半导体测试贯穿芯片设计、晶圆制造及封装测试的全生命周期，是验证芯片功能、性能、可靠性及一致性的重要工序，也是保障芯片产品质量、提升制造良率和控制终端应用风险的核心环节。近年来，随着先进制程持续迭代以及 Chiplet、2.5D/3D 等先进封装等前沿技术的加速普及与应用，芯片的集成度与复杂度急剧提升，内部结构与引脚分布愈发复杂，信号传输速率及功耗密度不断提升。这导致半导体测试的难度、复杂度和测试成本显著增加，测试环节已成为决定高性能芯片能否顺利量产并推向市场的关键瓶颈之一。半导体测试系统的核心运作高度依赖于两大要素的协同配合：半导体测试设备与半导体测试消耗型硬件，两者共同构成了保障芯片质量的完整测试生态链。

半导体测试设备主要包括分选机（Handler）、测试机（ATE）、探针台（Prober）以及老化测试系统（Burn-in System）。作为测试流程的基础支撑系统，这些设备承担着自动化传送、定位及电性能验证任务。其中，分选机负责成品测试中芯片的自动化传

送、定位并配合测试结果实时分选合格芯片；测试机负责向待测芯片施加测试信号、采集测试反馈并判断芯片电性能是否符合设计要求；探针台则用于晶圆级测试环节，实现晶圆的精密定位、传送及芯片与探针卡的稳定接触；老化测试系统（Burn-in System）主要应用于老化测试环节（Burn-in），在高温高压及长时间运行等条件下对芯片进行加速应力筛选，以识别并剔除潜在早期失效产品。测试设备通常具有单价高昂、技术壁垒深厚及使用周期长等重资产特征。

半导体测试消耗型硬件则是确保测试设备与芯片之间准确定位并建立稳定、可靠连接的关键接口，主要包括测试座、探针卡、负载板、分选换型套件和测试接口连接模组等。作为连接测试设备与待测芯片之间的桥梁，测试消耗型硬件负责在极高信号传输速率和复杂测试环境下，实现测试信号的高保真、低损耗传输。测试消耗型硬件在测试过程中需要与芯片引脚进行高频次、重复性的机械接触，并在高频高速、高功率、高低温、大电流或高电压等复杂测试环境下保持稳定的电气性能，因此通常具有一定的磨损属性和更换需求，是半导体测试产线中不可或缺的精密消耗型硬件。

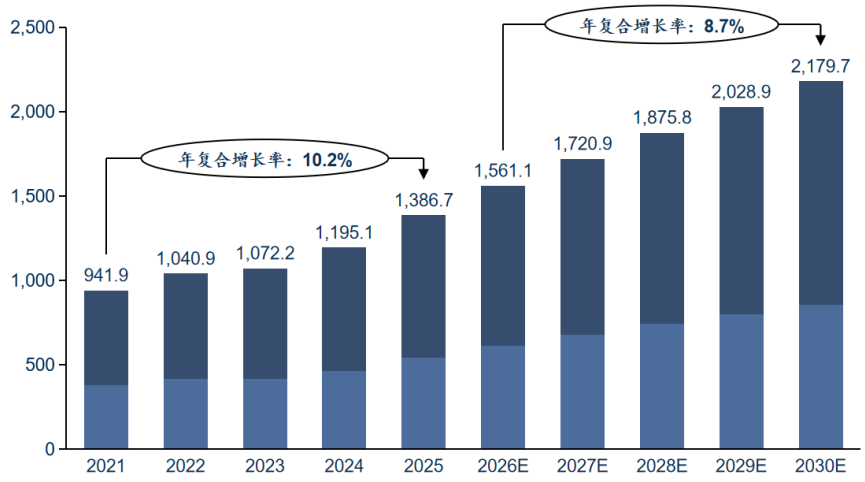
相较于标准化程度较高的测试设备，测试消耗型硬件具有极高的定制化属性。其产品设计需结合待测芯片的类型、尺寸大小、封装形式、引脚数量与排列方式、信号速率、功耗水平、散热要求以及客户测试方案等因素进行针对性开发。随着芯片向高速高频、高功率和先进封装方向发展，测试消耗型硬件在材料选型、结构设计、信号传输以及热管理等方面的技术要求持续提升。测试消耗型硬件的性能水平直接影响测试信号传输质量、测试结果准确性及测试效率，是保障芯片工程验证、量产测试和良率管控的重要基础。

（2）半导体测试设备及消耗型硬件行业市场规模

近年来，以生成式人工智能为代表的新一轮技术革命加速演进，推动全球算力需求进入快速增长阶段。大模型训练、推理对 AI 芯片在算力密度、存储带宽以及功耗控制等方面提出了更高要求，从而带动 GPU、服务器 CPU、加速器等 AI 芯片持续升级。相应地，AI 芯片在 CP 测试、FT 测试、老化测试以及 SLT 测试等测试需求爆发的同时，也将面临更高的测试复杂度，对测试设备及相关接口硬件的测试精度、信号传输完整性以及热管理能力等提出了更为严苛的要求，进而推动半导体测试设备及测试消耗型硬件需求持续增长。

数据显示，全球测试设备与测试消耗型硬件市场规模已由 2021 年的 941.9 亿元增长至 2025 年的 1,386.7 亿元。展望未来，随着人工智能应用的深度渗透及智能手机、新能源汽车以及工业自动化等领域的快速扩产，半导体测试需求将持续从消费电子向泛工业领域外溢。预计全球测试设备与测试消耗型硬件市场规模将保持强劲增长，由 2026 年的 1,561.1 亿元攀升至 2030 年的 2,179.7 亿元，年均复合增长率达到 8.7%。

图：半导体测试设备与测试消耗型硬件市场规模（按收入计），全球，2021-2030E，亿元



											CAGR (2021-2025)	CAGR (2026E-2030E)
半导体测试设备	564.3	624.8	654.9	732.0	845.8	947.0	1,040.7	1,133.2	1,227.4	1,323.2	10.6%	8.7%
半导体消耗型测试硬件	377.5	416.1	417.3	463.1	540.9	614.0	680.3	742.6	801.6	856.6	9.4%	8.7%

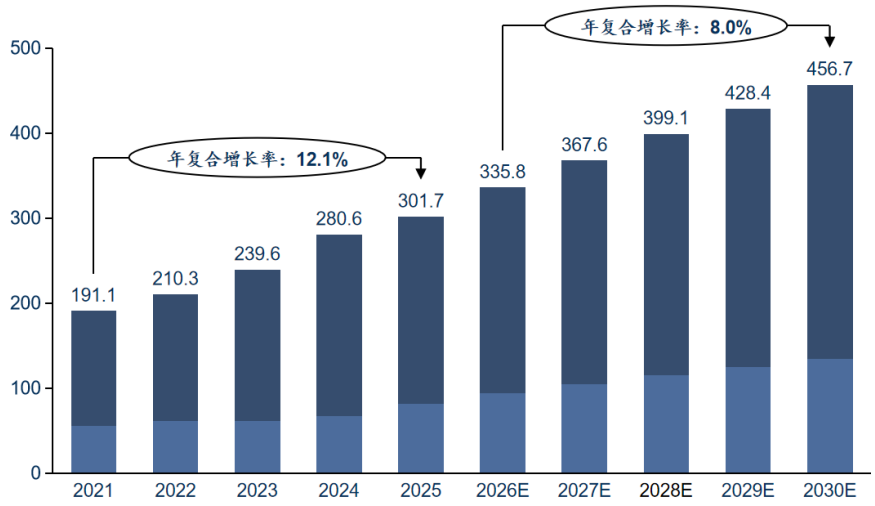
数据来源：Frost & Sullivan。

在境内市场方面，受益于国家产业政策支持、国产替代进程加速以及下游高性能芯片需求持续释放，境内芯片测试设备及测试消耗型硬件市场规模快速扩容。一方面，国产 AI 算力芯片伴随数据中心、智算集群等算力基础设施建设提速，在集成度、功耗及高速互连等方面持续提升，对 CP 测试、FT 测试、老化测试以及 SLT 测试等环节的测试精度、测试效率和可靠性提出更高要求，带动高性能测试设备以及测试座、探针卡、负载板等测试消耗型硬件需求增长。另一方面，智能手机 SoC、AIoT 芯片等高性能芯片持续向高速率、高集成度和高功率方向迭代，测试场景日趋复杂，对测试设备及测试硬件的高速信号传输、精密接触、低损耗互连和稳定温控能力提出更高要求，进一步推动测试设备及接口类产品向高性能升级。同时，新能源汽车产业链持续扩产带动车规级芯片需求快速增长，功率器件、MCU、传感器及智能驾驶相关芯片的出货规模和性能要求同步提升，车规级芯片通常对可靠性、一致性和长期稳定性要求更高，需经过更严格的功能测试、老化筛选和可靠性验证，从而显著增加对高精度、高稳定性测试设备及

消耗型硬件的需求。

国产 AI 算力芯片、智能终端高性能 SoC 及新能源汽车车规级芯片的发展直接拉动了对本土复杂测试的爆发式需求，中国大陆测试设备与测试消耗型硬件市场规模显著扩容，由 2021 年的 191.1 亿元攀升至 2025 年的 301.7 亿元。伴随本土企业的技术突围以及全产业链协同生态的日趋成熟，该市场有望延续强劲增长态势，预计市场规模将从 2026 年的 335.8 亿元进一步增长至 2030 年的 456.7 亿元，年均复合增长率（CAGR）达到 8.0%。公司作为产业链核心供应商，正面临国产算力基础设施大规模部署、高性能消费电子芯片及车规级芯片扩产带来的战略红利。

图：半导体测试设备与测试消耗型硬件市场规模（按收入计），中国大陆，2021-2030E，亿元



半导体测试设备	135.6	149.3	178.3	214.0	220.3	242.4	262.9	283.8	303.3	322.6	12.9%	7.4%
半导体消耗型测试硬件	55.4	61.0	61.2	66.6	81.3	93.5	104.7	115.3	125.2	134.1	10.1%	9.4%

数据来源：Frost & Sullivan。

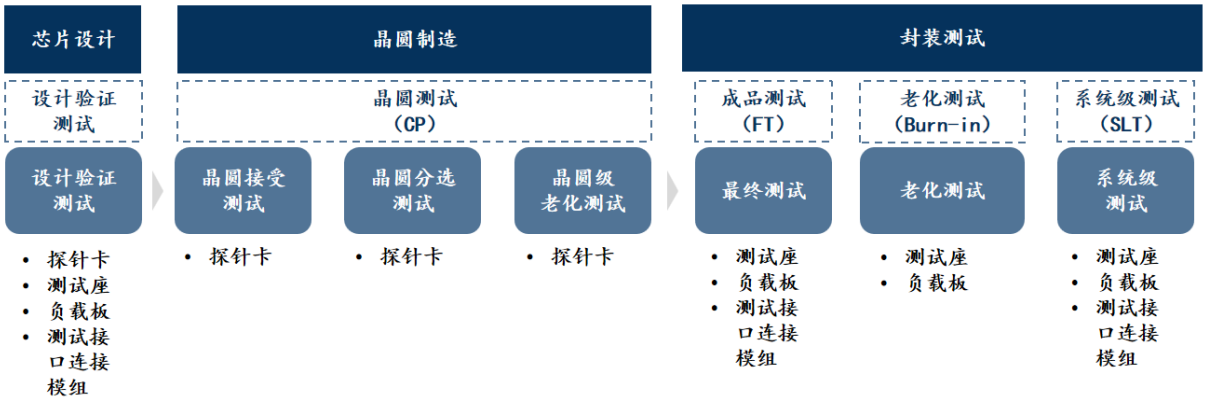
2、半导体封装测试消耗型硬件行业概述及发展情况

（1）半导体测试消耗型硬件行业概况

半导体测试消耗型硬件是贯穿集成电路制造全流程的关键基础接口组件，主要包括测试座（Socket）、探针卡（Probe Card）、负载板（Load Board）、分选换型套件（Kit）和测试接口连接模组等核心部件。这些接口组件广泛应用于芯片的设计验证、晶圆测试（CP）、成品测试（FT）、老化测试（Burn-in）以及系统级测试（SLT）等全生命周期环节，承担着连接、高保真信号传输及极端环境模拟等核心功能，是保障芯片成品良率与长期可靠性的重要基石。

随着芯片制程工艺逼近物理极限、Chiplet、2.5D/3D 等先进封装技术加速应用，叠加 AI HPC、智能终端、汽车电子等应用场景对芯片性能要求持续提升，半导体测试环节面临更高的数据传输速率和功率要求以及更精密的接触要求，半导体测试消耗型硬件已由传统的机械连接与电气导通接口，逐步演变为集高速信号传输、高功率承载、温度管理以及精密接触控制于一体的高技术壁垒、高附加值产业，其性能指标直接决定了芯片测试的效率、测试稳定性及综合测试成本。

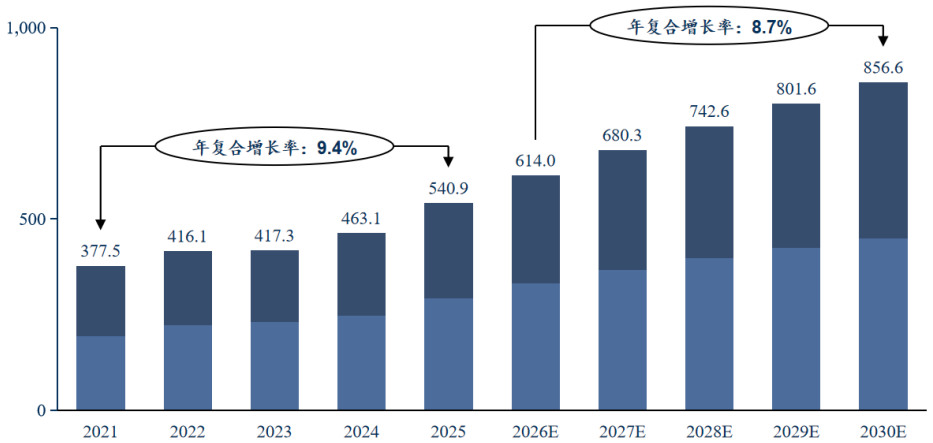
图：半导体测试消耗型硬件在测试环节中的具体应用



数据来源：Frost & Sullivan。

按照测试类型划分，半导体测试消耗型硬件可分为晶圆测试消耗型硬件和封装测试消耗型硬件两大类。晶圆测试消耗型硬件主要应用于晶圆制造后、划片封装前的晶圆或裸芯片（Die）的电性筛选环节，核心产品包括探针卡，重点保障微米级测试精度、信号传输完整性及超高通道密度的实现。封装测试消耗型硬件主要服务于芯片完成封装后的成品测试（FT）、老化测试（Burn-in）及系统级测试（SLT），核心产品涵盖测试座、负载板、分选换型套件及测试接口连接模组等，此类硬件更加侧重于复杂封装形式的适配、高速高频信号稳定传输、高通量/长时间测试环境下的可靠运行能力。两类消耗型硬件互为补充，共同构成了支撑半导体全产业链良率管理的关键接口组件。根据 Frost & Sullivan 数据，全球封装测试消耗型硬件市场规模预计从 2026 年的 332.3 亿元增长至 2030 年的 448.8 亿元，复合增长率（CAGR）为 7.8%。

图：半导体测试消耗型硬件市场规模（按收入计），全球，2021-2030E，亿元



	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	CAGR (2021-2025)	CAGR (2026E-2030E)
晶圆测试	184.0	194.0	186.7	215.7	248.5	281.7	314.1	345.7	377.1	407.7	7.8%	9.7%
封装测试	193.6	222.0	230.6	247.4	292.4	332.3	366.2	397.0	424.5	448.8	10.9%	7.8%

数据来源：Frost & Sullivan。

（2）半导体封装测试消耗型硬件行业情况

在芯片的后道封装测试环节中，半导体封装测试消耗型硬件并非孤立存在，而是与测试机（ATE）、分选机（Handler）以及老化测试系统（Burn-in System）等测试设备深度耦合，共同构成一个高效协同的自动化闭环测试系统：测试座作为最核心的物理接触界面，在芯片引脚与测试设备通道之间建立低阻抗、高稳定的连接。随着芯片集成度不断提升，芯片引脚间距（Pitch）急剧缩小以及测试环境日益严苛，测试座的性能表现直接决定了信号传输的质量与测试结果的保真度；分选换型套件发挥精密导向与定位功能，将不同规格的待测芯片从料盘中高速、精准地搬运并定位至测试座内，确保芯片引脚与微型探针实现微米级的精准对位，是保障自动化分拣效率的关键；测试接口连接模组主要充当机械支撑与信号桥梁，既为负载板、测试座提供刚性固定的物理平台，又负责将测试机台发出的高速信号无损传输至测试端；而功能测试板或老化测试板作为大面积的电气承载平台，其上布设了高度定制化的多层测试电路，负责完成复杂的信号分配、阻抗匹配与电源管理，最终将芯片的各项性能指标转化为可供测试设备读取的标准数据。这一系列封装测试消耗型硬件的协同作业，实现了从芯片上料、微米级定位、高频信号链路构建、高低温环境模拟到自动化测试执行的全流程贯通，共同保障了现代封测产线的高通量与高可靠性。

当前，受 AI HPC、智能终端以及汽车电子等高性能应用驱动，半导体产业正加速向先进制程及先进封装方向演进，芯片持续向高速高频、高功率、多引脚的方向发展，

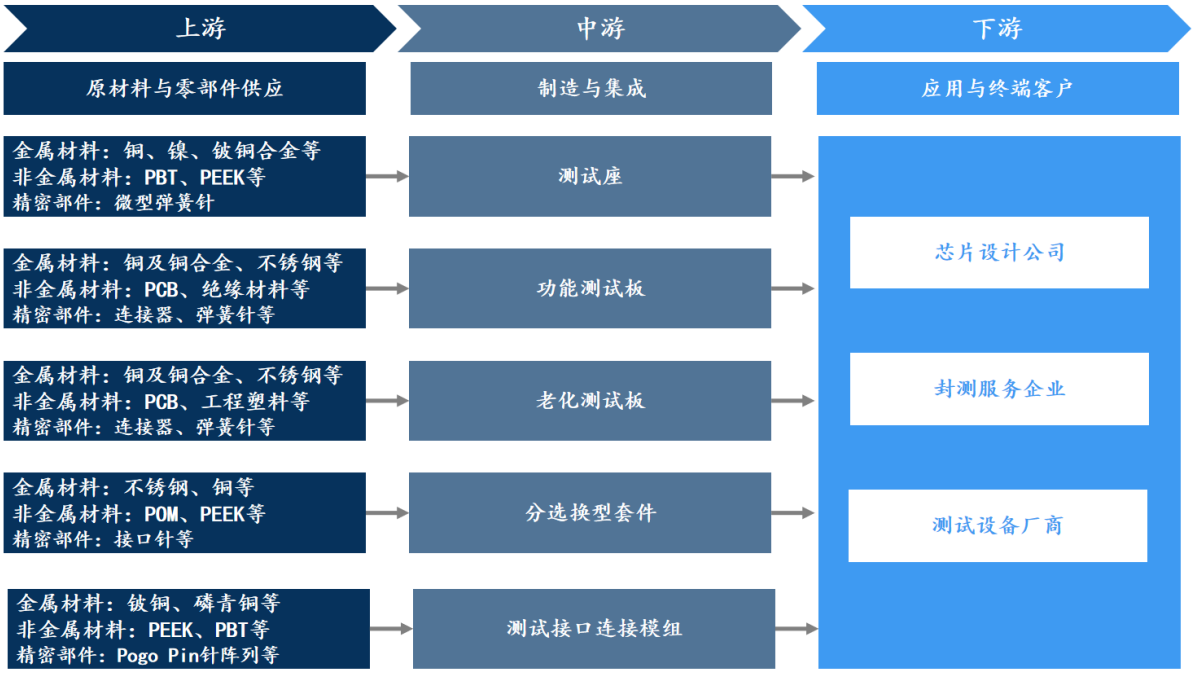
市场对测试系统的综合能力提出了前所未有的挑战。这一趋势推动封装测试消耗型硬件与测试设备由传统配套关系向协同开发和一体化解决方案方向演进。同时，伴随关键核心技术自主可控的宏观产业导向，本土优秀企业凭借持续的研发投入，在高性能测试座、精密微纳加工等细分领域不断突破，逐步缩小与国际头部厂商的差距。在国内庞大测试需求与产业链深度协同双重驱动下，国内半导体封装测试消耗型硬件市场正迎来技术跃迁与份额提升的黄金发展期，其作为集成电路产业链基础支撑的战略地位将进一步巩固。

（3）半导体封装测试消耗型硬件行业产业链

半导体封装测试消耗型硬件行业具有技术密集、工艺复杂、定制化程度高等特征，已形成由上游基础材料与关键零部件、中游精密制造与集成装配、下游封装测试及芯片应用共同构成的产业链体系。该类产品作为芯片测试环节中连接待测芯片与测试设备的关键接口部件，直接决定了测试环节的准确性、效率以及最终芯片的交付质量。

从产业链分工来看，上游主要包括特种金属材料、高性能工程塑料、精密陶瓷、高端 PCB 板材及相关零部件供应商，相关材料在导电性能、耐高温性能、机械疲劳强度、尺寸稳定性及介电性能等方面的表现，直接影响硬件产品的使用寿命、测试环境适应力、测试精度和信号传输能力。中游是产业链的核心价值枢纽，负责将上游材料转化为测试座、负载板、封测接口组件等核心成品。该环节深度融合了精密机械加工、微电子工程与热管理等多学科技术，并持续向着“更高频宽、更高功率、更微间距、更大尺寸”的方向迭代。下游深度绑定芯片设计公司、封测服务企业及测试设备厂商，终端应用对芯片性能的极致追求，成为推进全产业链技术升级与价值重塑的核心动力。

图：半导体封装测试消耗型硬件行业产业链

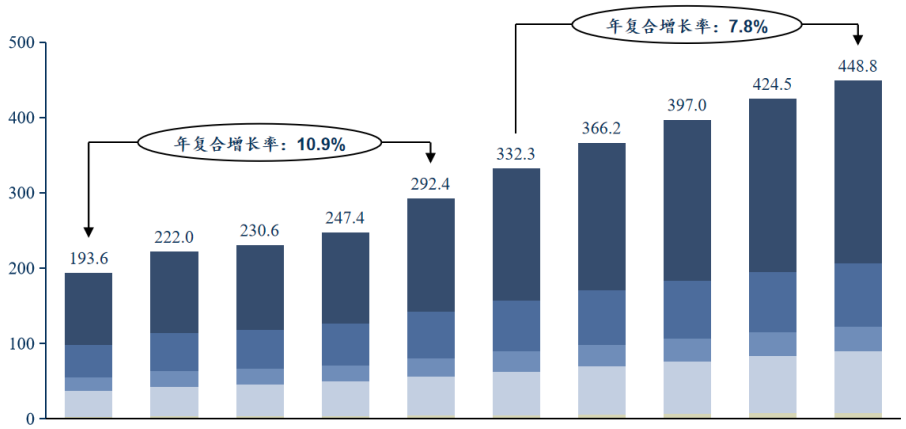


数据来源：Frost & Sullivan。

（4）半导体封装测试消耗型硬件市场规模

全球半导体封装测试消耗型硬件市场正处于高速扩张期，其增长动力主要来自先进制程与先进封装技术演进、高性能芯片测试需求增长以及封装测试环节复杂化、系统化升级。一方面，先进制程持续逼近物理极限与先进封装技术的普及，显著提升了芯片测试的复杂度与覆盖率要求；另一方面，AI HPC、先进存储、智能终端、汽车电子及工业控制等下游应用快速发展，带来了海量的高性能芯片测试需求。此外，测试自动化与高并发并行测试技术的进步，也为相关消耗型硬件市场的扩容提供了坚实的基础。受上述因素推动，全球半导体封装测试消耗型硬件市场规模预计将从 2026 年的 332.3 亿元稳步增长至 2030 年的 448.8 亿元，未来五年年均复合增长率（CAGR）达 7.8%。

图：半导体封装测试消耗型硬件市场规模（按收入计），全球，2021-2030E，亿元

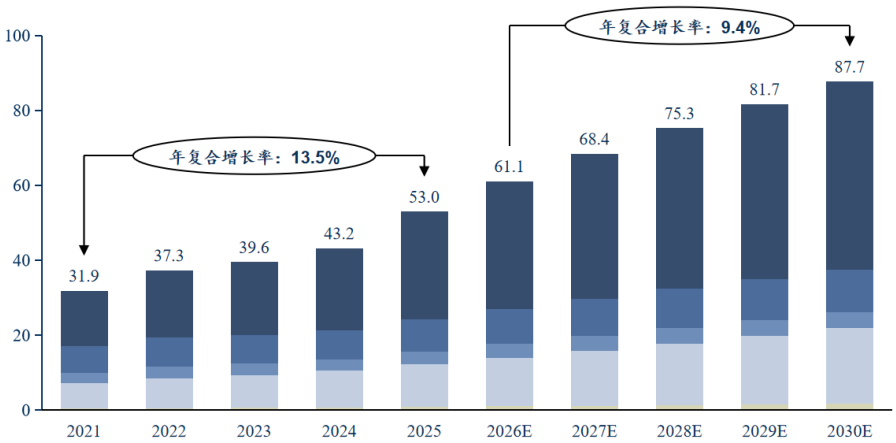


	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	CAGR (2021-2025)	CAGR (2026E-2030E)
测试座	95.2	108.5	112.1	121.1	150.1	174.9	195.3	213.4	229.2	242.7	12.1%	8.5%
功能测试板	43.3	50.1	51.6	55.3	62.0	67.8	72.6	76.9	80.7	84.0	9.4%	5.5%
老化测试板	18.0	20.8	21.4	21.3	24.4	26.9	28.9	30.3	31.3	32.1	7.9%	4.5%
分选换型套件	34.2	39.5	42.1	46.1	51.5	57.6	63.7	69.9	76.0	81.9	10.8%	9.2%
测试接口连接模组	2.8	3.2	3.4	3.6	4.3	5.0	5.7	6.5	7.3	8.1	11.1%	12.7%

数据来源：Frost & Sullivan。

中国大陆半导体封装测试消耗型硬件市场在高性能芯片自主可控需求及技术迭代的推动下，呈现出强劲的增长态势。受益于国内高性能智能手机扩产、AI 算力基础设施建设与新能源汽车加速渗透，本土市场对高速高频、高功率测试硬件的需求增速显著高于全球平均水平。同时，先进封装产能的本土化落地加速，进一步推动了各细分封装测试消耗型硬件的国产化进程。数据显示，2026 年中国大陆半导体封装测试消耗型硬件市场规模预计为 61.1 亿元，到 2030 年将攀升至 87.7 亿元，预测期内年复合增长率高达 9.4%，展现出强劲的增长韧性。

图：半导体封装测试消耗型硬件市场规模（按收入计），中国大陆，2021-2030E，亿元



	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	CAGR (2021-2025)	CAGR (2026E-2030E)
测试座	14.9	17.9	19.5	22.0	28.8	34.1	38.7	42.9	46.8	50.3	17.9%	10.2%
功能测试板	7.0	7.7	7.6	7.7	8.6	9.3	9.9	10.4	10.9	11.2	5.4%	4.7%
老化测试板	2.9	3.2	3.1	3.0	3.4	3.7	3.9	4.1	4.2	4.3	4.1%	3.7%
分选换型套件	6.7	7.9	8.7	9.8	11.3	13.0	14.7	16.4	18.2	20.1	14.2%	11.6%
测试接口连接模组	0.5	0.6	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	15.0%	15.3%

数据来源：Frost & Sullivan。

1）测试座

作为直接接触芯片的核心消耗型硬件，测试座市场深受 AI HPC、智能终端及汽车电子等产业爆发的强力驱动。AI 算力芯片、智能手机 SoC 及车规级芯片等产品的高速率、高频率、高功率及高可靠性特征，叠加 Chiplet、2.5D/3D 等先进封装结构的广泛应用，对测试座的高速高频信号传输、高功率散热及精准温控以及微间距接触精度提出了严苛要求，直接推动了高性能测试座产品单价与需求量的双重提升。受益于 AI HPC、智能终端、汽车电子以及工业控制等下游应用的爆发，全球半导体测试座市场正迎来新一轮增长周期，芯片测试环节对测试硬件的传输精度、传输带宽及热管理要求显著提高，预计全球测试座市场规模预计从 2026 年的 174.9 亿元增长至 2030 年的 242.7 亿元，年均复合增长率达 8.5%；受益于国内半导体产业链快速发展、下游客户国产化需求提升，中国大陆测试座市场的增长动能显著高于全球平均水平，中国大陆测试座市场规模预计将从 2026 年的 34.1 亿元增至 2030 年的 50.3 亿元，年均复合增长率高达 10.2%。

2）负载板

测试负载板是连接芯片与测试设备的大规模电气承载平台，主要分为功能测试负载板和老化测试板，两者在各自差异化应用需求的驱动下保持稳健增长。功能测试负载板专注于芯片的功能验证，其核心壁垒在于极高层数的多层 PCB 布线、严苛的阻抗控制

与高速/高频射频信号的无损传输，全球功能测试板市场预计从 2026 年的 67.8 亿元增至 2030 年的 84.0 亿元（CAGR 5.5%），中国大陆市场同期预计从 9.3 亿元增至 11.2 亿元（CAGR 4.7%）。老化测试板应用于模拟极端环境下的长期可靠性筛选，需在长时间的高温、高压及大电流负荷环境下保持材料结构与电路的绝对稳定，全球市场预计从 2026 年的 26.9 亿元增至 2030 年的 32.1 亿元（CAGR 4.5%），中国大陆市场同期从 3.7 亿元增至 4.3 亿元（CAGR 3.7%）。

3）封测接口组件

封测接口组件主要包括分选换型套件和测试接口连接模组两大类，是保障后道自动化测试产线高效运转的精密物理枢纽。随着芯片尺寸大小、封装形式的日趋多样化及对上料定位精度的高要求，该板块呈现出较高的增长弹性。全球分选换型套件市场规模预计从 2026 年的 57.6 亿元增至 2030 年的 81.9 亿元，年复合增长率 9.2%；其中中国大陆市场因封测厂商产能扩张，增速尤为显著，将从 13.0 亿元增长至 20.1 亿元，年复合增长率达 11.6%。测试接口连接模组市场预计从 2026 年的 5.0 亿元增至 2030 年的 8.1 亿元，年复合增长率 12.7%；中国大陆市场同期从 1.0 亿元增至 1.8 亿元，年复合增长率约 15.3%，整体呈现快速扩张态势。

3、测试座行业概述及发展情况

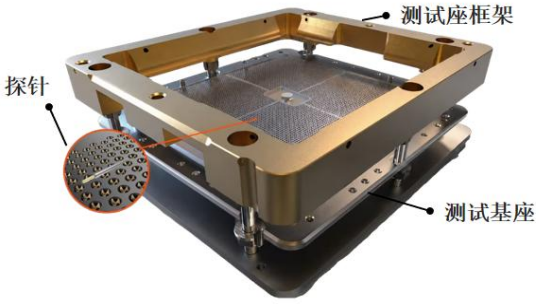
（1）测试座的定义与分类

测试座是连接芯片与测试设备的核心接口部件。根据应用环节不同，主要包括用于封装后功能/性能测试的功能测试座，以及用于老化筛选和可靠性验证的老化测试座，功能测试座通常与 ATE 测试机、功能负载板及分选机配套使用，实现芯片端与测试通道之间的精密接触和高速信号传输；老化测试座通常与老化负载板、老化炉及老化测试系统配套使用，保障芯片在高温、高压及长时间运行等加速应力条件下的稳定接触、功率承载和可靠运行。

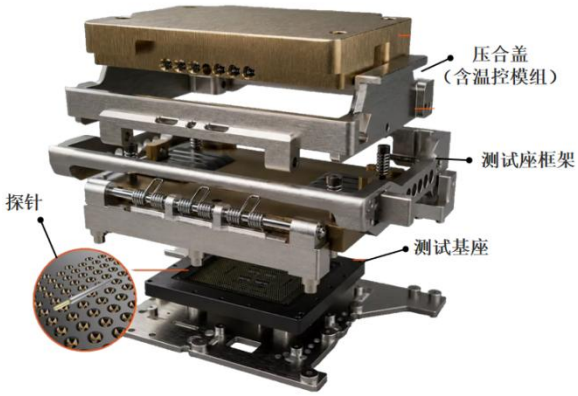
测试座作为高度定制化的精密机械组件，除整体框架外，通常由测试基座（Socket Body）、探针（Pin）以及压合盖（Lid）三大部分构成：测试基座承担整体结构支撑、芯片容纳及连接探针的功能；探针负责建立芯片引脚与底部负载板之间可重复压接的电气通路，是实现电源传输以及信号导通的核心载体；此外，针对 AI 算力芯片、手机 SoC 芯片等高功率芯片，部分高性能测试座还需配备定制化机械压合盖（可含温控模组），

以实现压力控制、稳定接触和高效热管理。

图：功能测试座内部结构示意图



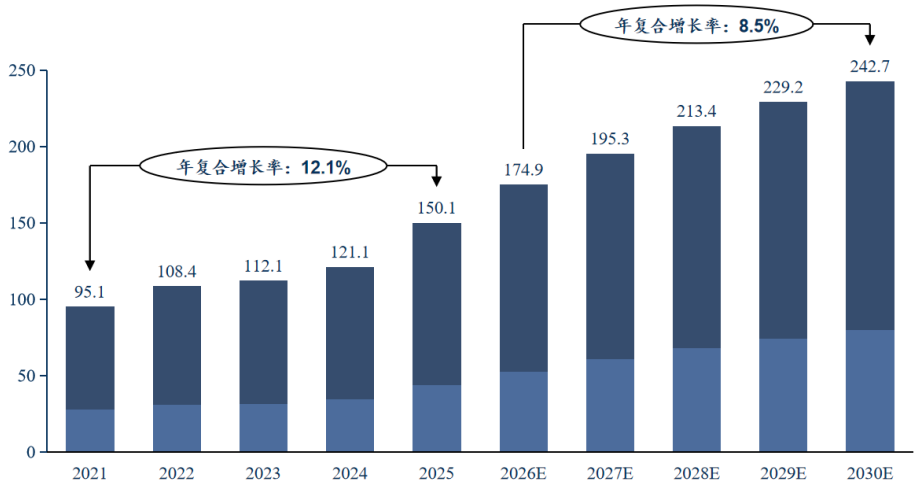
图：老化测试座内部结构示意图



（2）测试座市场规模及产品结构情况

受益于 AI HPC、智能终端、汽车电子以及工业控制等应用的爆发，全球半导体测试座市场正迎来新一轮增长周期，芯片测试环节对测试硬件的传输精度、传输带宽及热管理要求显著提高。预计全球市场规模将从 2026 年的 174.9 亿元攀升至 2030 年的 242.7 亿元，年均复合增长率（CAGR）达 8.5%。其中，功能测试座预计规模将从 2026 年的 122.4 亿元增至 2030 年的 163.1 亿元（CAGR 7.4%）；而受益于 AI 算力芯片、高性能手机 SoC 以及车规级芯片对极端应用场景下可靠性的刚性需求，老化测试座增速更为迅猛，预计将从 2026 年的 52.5 亿元增至 79.6 亿元，年均复合增长率达 10.9%。

图：半导体测试座市场规模（按收入计），全球，2021-2030E，亿元



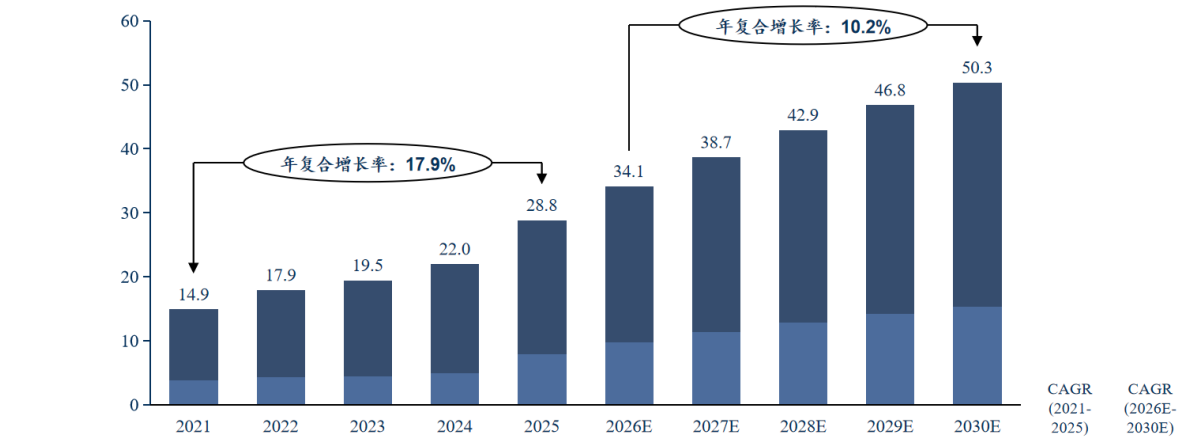
	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	CAGR (2021-2025)	CAGR (2026E-2030E)
功能测试座	67.5	77.6	80.5	86.5	106.4	122.4	134.6	145.4	154.9	163.1	12.0%	7.4%
老化测试座	27.6	30.8	31.6	34.6	43.7	52.5	60.7	68.0	74.3	79.6	12.1%	10.9%

数据来源：Frost & Sullivan。

中国大陆市场方面，中国本土半导体封装测试消耗型硬件市场依托国内半导体产业

链快速发展、下游客户国产化需求提升以及自身研发投入持续加大，国产替代进程持续深化，市场份额显著增长。得益于强有力的产业政策扶持与供应链本土化红利，中国大陆测试座市场的增长动能显著高于全球平均水平，市场规模将从 2026 年的 34.1 亿元攀升至 2030 年的 50.3 亿元，年均复合增长率（CAGR）达 10.2%。其中，功能测试座规模预计从 2026 年的 24.4 亿元增长至 2030 年的 35.0 亿元（CAGR 9.4%）；老化测试座规模预计从 2026 年的 9.7 亿元增长至 2030 年的 15.4 亿元（CAGR 12.1%）。

图：半导体测试座市场规模（按收入计），中国大陆，2021-2030E，亿元



	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	CAGR (2021-2025)	CAGR (2026E-2030E)
功能测试座	11.1	13.6	15.0	17.0	21.0	24.4	27.3	30.1	32.6	35.0	17.3%	9.4%
老化测试座	3.8	4.3	4.5	5.0	7.9	9.7	11.4	12.9	14.2	15.4	19.7%	12.1%

数据来源：Frost & Sullivan。

（四）所属行业的主要壁垒

半导体封装测试消耗型硬件行业的核心竞争壁垒体现在设计与工艺复杂度、客户生态黏性以及产业链协同要求、资本密集度、人才稀缺性等多个维度，这些因素共同构成了新进入者难以逾越的行业门槛。行业核心壁垒主要体现在四个方面：

1、设计壁垒：高速高频信号传输、高功率热管理及系统级协同设计难度大

半导体封装测试消耗型硬件并非单一机械连接件，而是集精密机械、连接、信号传输及热管理于一体的高度定制化测试接口系统。高性能测试座核心在于实现高速、高频信号的低损耗传输，并控制阻抗连续性、回波损耗及串扰等关键指标；对于老化测试座而言，其设计重点除稳定连接外，还体现在高温、长时间、多工位并行测试环境下的可靠性控制，以及高功率芯片测试过程中的热管理能力，通过温度传感、风冷、液冷、加热等方式实现精准温控。因此，企业需要同时具备电学、热学、力学协同设计能力，并

在长期项目实践中积累大量仿真模型、测试数据及设计经验，这种从基础工艺到系统方案的全方位技术壁垒，使新进入者难以在短期内追赶。

2、工艺壁垒：超微米级精密加工与产品性能的高一致性要求高

半导体封装测试消耗型硬件需在有限空间内实现稳定、可靠、低损耗的连接，并在高频次插拔、持续加载、高低温循环等复杂工况下保持性能一致性。随着先进封装及高性能芯片的发展，芯片引脚数量持续增加、接口间距不断缩小，测试座内部探针间距亦呈现持续收窄趋势。在大尺寸、高密度、微间距芯片测试的应用场景下，企业需要在高硬度、高稳定性基材上完成大量微孔及复杂结构加工，并确保孔径尺寸、孔位精度、灌胶工艺、平面度及装配一致性达到较高水平。上述能力高度依赖长期工艺验证、加工参数积累及质量控制体系建设，新进入企业若缺乏持续量产经验，较难在短期内同时保障产品机械寿命、接触稳定性、测试良率及批量交付一致性。

3、客户及产业协同壁垒：验证周期长、切换成本高，早期介入形成持续迭代优势

半导体封装测试消耗型硬件直接影响芯片测试结果的准确性、稳定性和效率，是芯片量产测试及可靠性筛选环节中的关键接口部件。下游客户在导入供应商时，通常需要对产品的信号传输能力、温控性能、接触稳定性、机械寿命、批量一致性以及与测试设备和自动化产线的适配性进行系统验证。对于头部芯片设计公司、封测服务企业及测试设备厂商而言，供应商认证流程严格，验证周期较长，且一旦导入量产体系，后续切换供应商将面临重新验证、产线适配、良率波动及交付风险等时间成本和资金成本，因此，客户通常倾向于维持长期稳定的合作关系，形成了极高的客户黏性。

更为关键的是，公司产品具有较强的定制化属性，已通过“早期介入模式”深入参与客户的芯片设计阶段并共同开发定制化测试方案：公司通常在芯片工程验证阶段即与芯片设计公司开展协同开发，锁定先发优势，随着芯片进入规模化量产阶段，公司产品同步延伸至规模化量产测试场景。在客户芯片产品迭代升级过程中，公司可基于既有合作基础和测试方案积累，持续参与新一代产品的验证及量产测试开发，形成覆盖芯片验证、量产及迭代升级的全周期服务闭环。

4、资金及人才壁垒：持续研发投入、精密制造体系和复合型人才储备要求高

半导体封装测试消耗型硬件行业对资金与人才的双重投入有着极高要求。一方面，企业需要持续投入资金购置高精度精密加工与检测设备，以构建规模化、一致性水平高

的生产交付体系；同时，为紧跟技术迭代并满足客户的高度定制化需求，企业需维持研发投入与工艺试制，这对现金流构成了持续压力。另一方面，行业高度依赖兼具精密机械设计、电子工程、微纳材料科学背景的复合型技术人才，此类跨界专业人才在市场上的供给较为稀缺，企业需要通过长期培养、项目实践和组织沉淀形成稳定的研发及工程团队。资金实力的门槛与核心技术团队的组建难度，共同构成了限制新进入者的双重约束。

（五）所属行业发展态势

近年来，在 AI HPC、智能终端、汽车电子、工业控制、先进存储、光通信等下游应用快速发展的带动下，集成电路产业持续向高算力、高带宽、高集成度、高可靠性方向演进，芯片性能边界不断提升。作为连接芯片与测试设备之间的关键接口部件，半导体封装测试消耗型硬件的技术复杂度和单品价值量持续提升，行业整体呈现国产化、系统化和多场景拓展的发展趋势。

1、芯片性能升级及下游终端应用发展，驱动测试硬件产业价值量持续跃升

随着 AI 算力等前沿应用快速发展，芯片在速率、频率以及集成度等方面持续升级。下游终端应用的深刻变革，使市场对芯片在高速高频运行、高温高压、长时间负载等复杂工况下的稳定性提出更高要求，推动芯片测试从传统的功能验证逐步向系统性验证、极端工况筛选和全生命周期可靠性评估延伸，芯片测试环节面临的技术挑战增大，测试接口部件必须能够支持更高速的信号传输速率、更精密的微米级引脚间距，并完成更严苛的长周期环境可靠性验证。芯片性能升级和测试复杂度提升，持续推动测试接口硬件从普通耗材向高技术含量、高附加值的关键测试部件演进。同时，AI 算力芯片、手机 SoC 芯片以及车规级芯片等高价值芯片对高速高频信号传输的功能测试以及精准温控及散热的长周期老化测试的需求迫切，带动相关产品市场空间持续扩容，行业价值量随之提升。

2、国产替代与深度生态协同加速推进，重塑高性能封装测试消耗型硬件竞争格局

长期以来，高性能半导体封装测试消耗型硬件市场主要由境外厂商占据较高份额，尤其在高速高频测试、高功率老化测试、精密微间距连接、先进封装适配等先进应用领域，产品研发涉及精密机械、电磁仿真、热管理和可靠性验证等多学科能力，对企业技术积累、工艺经验和客户验证基础要求较高。近年来，在全球半导体产业链重构、供应

链安全需求提升以及国家推动集成电路关键环节自主可控的背景下，下游芯片设计公司、封测服务企业和测试设备厂商对本土高性能测试硬件供应商的导入意愿持续增强。对于本土领先企业而言，国产替代不仅体现为对海外产品的单点替换，更体现为与国内芯片设计、封装测试、测试设备及材料供应链的深度协同。通过在芯片研发验证阶段提前介入，本土测试硬件企业能够围绕客户芯片封装形式、测试条件、测试设备平台和量产工艺要求进行定制化开发，并在样品验证、量产导入和产品迭代过程中形成快速响应能力。在该趋势下，具备核心技术能力、稳定交付能力和头部客户协同经验的本土企业，有望在高性能功能测试座、老化测试座及相关测试接口组件领域持续提升市场份额。

3、老化测试由抽样筛检向全检演进，功能测试由 FT 向 SLT 拓展，带动测试硬件市场空间进一步扩大

一方面，随着芯片复杂度和单颗价值量提升，测试环节对产品良率、可靠性和终端应用安全性的影响日益凸显，尤其在 AI 芯片、手机 SoC、车规级芯片和先进存储芯片等领域，芯片失效带来的经济损失和系统风险较高，下游客户对早期失效筛选、极端工况验证和长期稳定性测试的重视程度不断提升；另一方面，随着摩尔定律持续放缓，先进制程在降低单位晶体管成本、提升性能方面的边际效益逐步递减，技术突破难度与投资门槛显著攀升，Chiplet、2.5D/3D 等先进封装技术成为延续系统级集成与芯片性能提升的重要路径，使得封装环节成为影响高性能芯片良率与可靠性的关键瓶颈。在此背景下，芯片老化测试逐步由传统抽样筛检向更高比例测试乃至全检方向发展，带动老化测试座需求增长，并对其高功率承载、精准温控、长期稳定性和多工位一致性提出更高要求。

与此同时，功能测试环节也在持续拓展。传统 FT 测试主要用于封装后芯片的基础电学性能和功能指标验证，而随着芯片系统复杂度提高，仅依靠标准测试程序已难以完全覆盖芯片在真实应用场景中的运行状态。SLT 测试通过模拟终端系统运行环境，对芯片在实际应用条件下的综合性能、兼容性和稳定性进行进一步验证，已成为高性能芯片测试体系的重要补充。功能测试由 FT 测试向 SLT 测试延伸，将进一步提升对高性能测试座、系统级测试接口组件及配套耗材的需求。同时，SLT 测试通常具有测试信号更高频高速、测试项目更多、测试周期更长、并行测试需求更高等特点，下游客户对 SLT 测试座的数量需求和性能提升较 FT 测试座更为显著。

（六）所属行业面临机遇与挑战

1、所属行业面临的机遇

半导体封装测试消耗型硬件行业正迎来一轮由全球产业格局重塑、技术迭代与供应链安全需求共同驱动的多重机遇，为中国本土领先厂商提供了前所未有的发展窗口。

（1）全球供应链重塑与 AI 时代共振，催生本土高端突破窗口

当前半导体产业的深刻变革源于新一代 AI 技术浪潮，中国作为全球最重要的半导体市场之一，其战略地位已从单一的终端需求中心，转变为保障底层核心产业链安全、实现技术自主创新的关键区域。外部宏观贸易环境的变化，从侧面极大强化了国内市场对本土封装测试供应链的迫切需求。中国市场在 AI 时代扮演着自主创新源头和丰富应用场景试验田的双重角色，其战略价值的提升为本土具备底层研发能力的半导体企业提供了广阔的发展空间。

目前，AI HPC 等高性能半导体应用产业正驱动芯片制造技术与测试环节经历双重变革，为本土封装测试消耗型硬件企业创造了结构性机遇。一方面，为满足 AI 训练和推理的海量计算需求，芯片向 Chiplet、2.5D/3D 等先进封装架构快速演进，这对测试硬件的测试精度与性能提出了极高要求。另一方面，为确保芯片在真实应用中的长期可靠性，复杂环境下的高功率老化测试及系统级测试（SLT）已成为关键环节，其复杂度和价值量远超传统成品测试。这些变化动摇了原有的海外巨头先发格局，半导体供应链的自主可控已上升至国家战略安全高度，下游本土芯片设计公司迫切寻求安全、可控且能深度协同的合作伙伴。本土头部测试企业通过紧密的协同开发模式，得以在细分市场实现份额的有效提升，在技术门槛最高的领域打开了国产化局面。

（2）产业链深度融合与需求场景扩容，共同塑造高壁垒竞争格局

未来的行业竞争本质上是产业链生态的竞争，半导体封装测试消耗型硬件企业必须与芯片设计、封测服务企业、测试设备厂商及终端应用端建立深度绑定。随着 AI HPC、智能终端及汽车电子等下游应用快速发展，芯片测试需求正由传统单一功能验证向高功率老化测试以及 SLT 测试等多场景延伸，测试项目数量、测试复杂度、测试覆盖率及测试时长持续提升，带动高性能测试座、老化测试座及封测接口组件等产品的配套需求和单芯片测试硬件价值量同步增长，行业市场空间进一步扩容。

在此背景下，下游客户对测试企业的要求已不再局限于单一产品交付，而是要求其

具备对芯片类型、封装形式、测试流程及终端应用场景的深刻理解，并能够提供高度定制化、一体化的测试接口解决方案。通过“早期介入模式”深入参与客户下一代芯片的测试方案研发，企业能够在工程验证阶段即与客户建立技术协同关系，并伴随客户芯片产品从研发验证延伸至规模化量产及后续迭代升级，在产业链深度和客户覆盖广度上形成长周期、高黏性、高切换成本的可持续竞争优势。

2、所属行业面临的挑战

（1）技术迭代加快，对企业研发、产品化及系统集成能力提出更高要求

随着芯片制程持续微缩、先进封装技术快速演进，以及 AI HPC、智能终端、汽车电子以及先进存储等应用场景不断升级，半导体封装测试消耗型硬件面临更高的性能要求。功能测试座需在更高信号速率、更高通道密度和更小引脚间距条件下保障信号传输完整性与接触稳定性；老化测试座则需在高温、长时间、高功率、多工位并行测试环境下保持温控精度、结构可靠性和一致性。上述趋势要求企业持续开展研发活动，并将新材料、新结构、新工艺快速转化为稳定量产产品。

同时，测试硬件已不再是单一机械连接件，而是需要与 ATE 测试机、分选机、负载板、老化测试系统、老化板及客户测试程序进行深度适配的系统级接口部件。企业不仅需要具备精密机械、电学仿真、热管理和可靠性设计能力，还需具备失效分析和客户现场快速响应能力。若企业在关键技术节点、产品开发效率或系统协同能力等方面跟进不足，可能面临产品竞争力下降或错失客户导入窗口的风险。

（2）国际领先企业占据高性能市场，本土企业实现高性能替代仍需持续突破

全球高性能半导体封装测试消耗型硬件市场长期由国际领先企业占据较高份额，尤其在高速高频功能测试座、高功率老化测试座、先进封装测试接口等领域，海外厂商凭借长期技术积累、专利布局、客户认证基础和全球服务能力，在高端客户供应链中具有较强先发优势。国产替代不仅要求产品在单项性能指标上达到客户要求，还需在量产可靠性、批次一致性、交付稳定性及售后响应等方面经受长期验证。头部芯片设计公司、封测服务企业和测试设备厂商的供应商认证周期较长，切换成本较高，本土企业进入高端客户核心供应链并实现持续放量仍需经历较长积累过程。因此，尽管国产替代趋势明确，但高性能产品市场突破仍面临挑战。

（3）复合型人才稀缺，对企业持续经营和组织能力形成考验

半导体封装测试消耗型硬件行业具有技术密集、人才密集和定制化程度高的特点，深度融合了精密机械设计、材料科学、高频电磁仿真及热动力学等多学科知识，而具备系统级设计能力、深刻理解芯片测试工艺的复合型人才在市场上较为稀缺。全球范围内，顶尖芯片设计公司、测试设备厂商与测试硬件企业对高端人才的争夺异常激烈。企业不仅需承担高昂的人才引进成本，更需建立长效的激励机制与创新文化以降低核心团队流失率，防止技术断层。人才瓶颈已成为制约本土企业技术突破与规模扩张的关键约束。

（七）所属行业周期性特征

公司主营产品为半导体封装测试消耗型硬件，其市场需求与半导体行业景气度、下游应用需求及封测服务产能利用率具有较强相关性。受全球宏观经济波动、终端应用需求变化及半导体厂商资本开支节奏等因素影响，半导体行业存在一定周期性，公司所处行业相应呈现一定的周期性特征。

（八）发行人所处行业在产业链中的地位和作用

半导体封装测试消耗型硬件行业位于半导体产业链后道封装测试环节，并向前延伸至芯片设计工程验证阶段，是连接芯片设计、封装测试及终端应用的重要支撑环节。该行业产品主要包括功能测试座、老化测试座及封测接口组件等，承担芯片与测试机、分选机、老化测试系统之间的精密连接、信号传输、温控散热及机械定位等关键功能，是芯片测试方案得以有效执行的核心接口部件。

从产业链作用来看，半导体封装测试消耗型硬件性能将直接影响封装后芯片测试的准确性、稳定性、效率及筛选能力。在芯片工程验证阶段，高性能测试硬件能够协助芯片设计企业及时识别设计缺陷、优化封装方案并缩短研发验证周期；在量产测试阶段，其能够保障 FT 测试、老化测试以及 SLT 测试等环节的稳定运行，帮助封测服务企业及芯片企业筛除性能异常或存在潜在可靠性风险的芯片，提高最终交付产品的一致性与可靠性。

随着 AI HPC、智能终端以及汽车电子等下游应用快速发展，芯片持续向高速高频、高功率方向演进，封装测试环节对高速高频信号传输、高功率散热及精准温控及微间距精密接触提出更高要求，发行人所处行业逐步成长为高性能芯片研发验证和规模化量产不可或缺的关键基础部件行业，在提升芯片测试效率、保障芯片质量可靠性、支撑高性

能芯片国产化及增强半导体产业链自主可控能力方面具有重要作用。

（九）所属行业与上、下游行业的关联性

半导体封装测试消耗型硬件行业处于产业链的中枢环节，与上游基础材料及下游终端应用形成了紧密协同关系。

1、与上游行业的关联性

半导体封装测试消耗型硬件行业的上游主要包括特种工程塑料、金属材料、精密探针、散热材料、电子元器件以及精密加工、表面处理等配套工艺服务。上游材料及服务的性能、质量稳定性和交付能力，直接影响测试座及其他测试接口组件的接触稳定性、信号传输性能、耐高温性能、使用寿命。

随着芯片制程微缩及应用场景的多元化，下游芯片测试要求不断提高，行业对上游材料的耐热性、绝缘性、导电性、耐磨性、尺寸稳定性及加工精度提出更高要求。功能测试座更关注材料在高速高频环境下的介电性能、阻抗稳定性和高密度微间距精密加工适配性；老化测试座则更关注材料在高温、长时间通电及高功率环境下的热稳定性和可靠性。因此，上游高端材料、精密加工及关键零部件供应能力，是影响本行业产品性能、成本控制和交付稳定性的重要因素。

2、与下游行业的关联性

半导体封装测试消耗型硬件行业的下游主要包括芯片设计公司、封测服务企业、测试设备厂商以及其他终端应用领域客户。下游客户的芯片产品类型、封装形式、测试标准、产能扩张节奏及可靠性要求，直接决定本行业产品的技术方向、市场需求和迭代速度。

从应用领域看，AI HPC、智能手机等终端、汽车电子、工业控制以及先进存储等终端市场的发展，持续推动芯片向高速高频、高功率方向演进，进而提升对功能测试座、老化测试座及相关测试接口组件的需求。下游客户通常在芯片研发验证、量产导入及后续迭代过程中与测试硬件供应商开展协同开发，因此本行业与下游客户具有较强的技术协同和产业联动特征。

三、发行人在行业中的竞争地位

（一）所属行业竞争格局

1、半导体封装测试消耗型硬件市场竞争格局

半导体封装测试消耗型硬件作为集成电路设计与封装测试环节的关键配套组件，其产业重心的转移紧密跟随全球半导体制造产业链的迁移轨迹，历经从美国主导到向日韩、中国台湾地区转移的过程，每一次产业链重构都催生了区域性的龙头企业。长期以来，WinWay、Cohu、Yamaichi、Enplas、Leeno 等全球领先厂商凭借较早的产业布局、深厚的技术积累、丰富的客户验证经验以及较为完整的产品解决方案，在全球及中国大陆市场中占据主导地位。然而，随着中国大陆逐步成长为全球最大且增长最快的半导体市场，本土芯片产业的蓬勃发展为供应链创造了巨大的国产化替代空间与技术迭代机遇。在这一历史性窗口期，本土半导体封装测试消耗型硬件企业从特定细分领域和优势应用场景切入，依托本地化服务响应、定制化协同开发、快速迭代能力及成本效率优势，逐步提升在国内客户供应链中的渗透率。中国大陆封装测试消耗型硬件市场虽仍存在海外领先厂商占据较高份额的情形，但本土厂商市场影响力持续增强，并已在部分先进应用领域实现突破。本土企业凭借持续研发投入、产品性能提升和头部客户导入经验，已进入国内市场核心竞争圈层，在国产替代持续推进的背景下具备进一步提升市场地位的良好基础。

根据 Frost & Sullivan 数据，2025 年公司在半导体封装测试消耗型硬件中国大陆市场排名第一，这表明中国境内企业已在中国大陆先进应用领域实现系统性突破，正逐步从“国产替代”迈向“局部引领”的全新发展阶段。

2、半导体测试座市场竞争格局

测试座是半导体封装测试消耗型硬件中需求量与价值量最高的细分品类。作为连接待测芯片与测试设备的核心接口，测试座的性能直接决定了信号传输的完整性、测试结果的可靠性及量产效率。随着 AI HPC、手机 SoC、车规级芯片等高性能芯片测试需求的爆发，全球测试座市场规模持续扩容，展现出强劲的增长势头。根据公开数据，2025 年全球测试座厂商市场占有率及排名如下：

排名	公司名称	所属地区	市占率
1	Yamaichi	日本	8.32%

排名	公司名称	所属地区	市占率
2	Leeno	韩国	7.99%
3	Smiths Interconnect	英国	7.17%
4	WinWay	中国台湾	7.00%
5	Enplas	日本	6.86%
6	ISC	韩国	6.75%
7	Cohu	美国	5.86%
8	Yokowo	日本	4.91%
9	Advantest	日本	4.53%
10	**法特迪**	**中国大陆**	**3.38%**

注：上述表格数据来源于 Yole，与各公司公开披露数据存在差异主要系数据来源、统计方法以及汇率换算所致。

从全球半导体测试座的竞争格局看，领先企业主要来自日本及韩国，全球测试座市场呈现区域化、分散化特征，为公司未来的全球化发展提供了结构性机遇。根据 Yole 数据，2025 年发行人已首次跻身全球前十测试座厂商，并成为全球前十中唯一的中国大陆厂商，这不仅验证了公司在前沿测试领域的技术实力，也标志着中国本土厂商在全球半导体测试供应链中具备竞争力量。

从中国大陆半导体测试座市场来看，根植于半导体产业整体崛起、高性能需求爆发以及供应链自主可控战略推进，以法特迪为代表的本土领先企业实现快速突破，市场份额显著提升。根据 Frost & Sullivan 数据，2025 年公司在半导体测试座中国大陆市场排名第一，其他主要企业包括韬盛科技、凯智通、Winway、Yamaichi 等。

（二）行业内主要企业及发行人与同行业公司的比较情况

1、行业内全球主要区域竞争对手情况

全球测试座市场的竞争格局呈现明显的区域化、分散化特征，不同地区的竞争对手依托其本土半导体产业基础各具特色，形成了多层次、差异化的竞争态势，主要竞争对手如下：

（1）日本竞争对手

1）Yamaichi

Yamaichi 成立于 1956 年，总部位于日本，是半导体测试接口领域的重要企业。Yamaichi 专注于高精度测试座、连接器及自动化测试设备的研发与制造，广泛应用于高

性能芯片测试环节，主要客户包括台积电、三星等全球领先的半导体制造商。2025 年 4 月-2026 年 3 月，Yamaichi 营业收入为 526.98 亿日元，净利润为 90.88 亿日元。

2）Enplas

Enplas 成立于 1962 年，总部位于日本，是精密塑料部件及测试座领域企业，专注于高精度注塑工艺，产品包括注塑件和半导体测试座等。Enplas 的测试座广泛应用于消费电子和汽车电子芯片测试环节，服务于世界领先的半导体集成电路企业。2025 年 4 月-2026 年 3 月，Enplas 营业收入为 425.40 亿日元，净利润为 52.85 亿日元。

3）Yokowo

Yokowo 成立于 1922 年，总部位于日本，是电子元件和测试接口解决方案供应商，长期专注于高频连接器、天线及半导体测试座的研发与制造，在射频测试和高速数字测试领域具有深厚技术积累，主要服务于通信设备和汽车电子领域的全球知名客户。2025 年 4 月-2026 年 3 月，Yokowo 营业收入为 900.90 亿日元，净利润为 39.01 亿日元。

4）Advantest

Advantest 成立于 1954 年，总部位于日本，是全球半导体测试设备领域企业，主要产品包括存储器测试机、SoC 测试系统以及与之配套的测试座和探针卡。Advantest 凭借其完整的测试解决方案和强大的研发能力，为全球顶尖半导体厂商提供测试服务。2025 年 4 月-2026 年 3 月，Advantest 营业收入为 11,286.10 亿日元，净利润为 3,753.53 亿日元。

（2）中国台湾竞争对手

中国台湾测试座企业的竞争优势根植于其完整的半导体代工产业生态。其中，WinWay 的领先地位尤为突出，主要得益于与台积电等全球顶尖晶圆代工厂的深度协同。

WinWay 成立于 2001 年，总部位于中国台湾，专注于高频、高速测试接口解决方案，产品涵盖高性能测试座、探针卡及负载板，客户覆盖全球头部芯片设计企业与封测厂商。2025 年度，WinWay 营业收入为 78.57 亿新台币，净利润为 16.73 亿新台币。

（3）韩国竞争对手

1）Leeno

Leeno 成立于 1978 年，总部位于韩国，是精密探针及测试治具供应商。Leeno 专注于半导体测试所需的探针、测试座及配套治具的研发与制造，广泛应用于晶圆测试和封装后测试环节。Leeno 的主要客户包括三星、SK 海力士等韩国半导体公司。2025 年度，Leeno 营业收入为 3,725.34 亿韩元，净利润是 1,519.61 亿韩元。

2）ISC

ISC 成立于 2001 年，总部位于韩国，专注于高性能测试座、探针卡及先进测试接口解决方案的研发制造，在 AI 芯片测试和存储芯片测试领域具有优势，其测试解决方案广泛应用于晶圆测试、系统级测试及可靠性验证环节。ISC 的主要客户包括三星、SK 海力士等韩国半导体公司和英伟达等 AI 算力巨头。2025 年度，ISC 营业收入为 2,201.95 亿韩元，净利润为 563.43 亿韩元。

（4）欧美竞争对手

1）Cohu

Cohu 成立于 1947 年，总部位于美国，是半导体测试设备领域的重要企业。Cohu 提供全面的测试解决方案，涵盖测试座、探针卡、分选机及自动化测试设备，客户包括英特尔、高通等全球半导体龙头企业。2025 年财年，Cohu 营业收入为 4.53 亿美元，净利润为-0.74 亿美元。

2）Smiths Interconnect

Smiths Interconnect 成立于 1851 年，总部位于英国，主要提供高可靠性连接解决方案，产品广泛应用于航空航天、国防和工业领域。

（5）中国大陆竞争对手

中国大陆测试座市场的竞争格局正经历深刻变革，随着国内半导体产业自主可控战略的深入，本土企业正迎来走向全球的发展机遇，未来有望涌现出具有全球影响力的中国测试座龙头，实现从“跟跑”到“领跑”的跨越。发行人的本土主要竞争对手情况如下：

1）韬盛科技

韬盛科技成立于 2007 年，总部位于上海，是国内较早从事半导体测试接口产品及解决方案的企业之一，主要提供晶圆测试、成品测试、老化及可靠性测试相关接口和设

备解决方案，产品覆盖 ATE/SLT 测试座、弹簧针、导电胶以及异形针等。2025 年 1-6 月，韬盛科技营业收入为 19,189.96 万元，净利润为 837.56 万元。

2）凯智通

凯智通成立于 2005 年，总部位于深圳，专注于半导体测试模组研发、制造及销售，产品包括 IC 测试座、老化测试座以及测试夹具等，适用于 BGA、PGA、QFN 等多种封装类型。

2、发行人市场竞争地位、技术实力及同行业比较情况

（1）发行人竞争地位及同行业比较情况

根据最新公开数据，公司与同行业公司的经营情况对比如下：

公司简称	股票代码	财年截止日	单位	营业收入	净利润
Yamaichi	6941.T	2026/03/31	亿日元	526.98	90.88
Leeno	058470.KQ	2025/12/31	亿韩元	3,725.34	1,519.61
Smiths Interconnect	未上市	-	-	-	-
WinWay	6515.TW	2025/12/31	亿新台币	78.57	16.73
Enplas	6961.T	2026/03/31	亿日元	425.40	52.85
ISC	095340.KQ	2025/12/31	亿韩元	2,201.95	563.43
Cohu	COHU.O	2025/12/31	亿美元	4.53	-0.74
Yokowo	6800.T	2026/03/31	亿日元	900.90	39.01
Advantest	6857.T	2026/03/31	亿日元	11,286.10	3,753.53
韬盛科技	未上市	2025/06/30	亿人民币元	1.92	0.08
法特迪	未上市	2025/12/31	亿人民币元	5.44	1.32

注 1：以上财务数据来自各公司定期报告、Wind、Capital IQ 等公开信息；
注 2：韬盛科技系未上市在申报企业，最新财务数据期间为 2025 年 1-6 月。

根据 Yole 统计数据，2025 年公司位居全球半导体测试座行业第十位，也是全球前十大厂商中唯一的中国境内企业；根据 Frost & Sullivan 数据，2025 年公司在半导体测试座中国大陆市场排名第一。公司与主要同行业公司测试座市场地位的对比情况详见本节“三、发行人在行业中的竞争地位”之“（一）所属行业竞争格局”之“2、半导体测试座市场竞争格局”。

（2）主要产品技术实力及同行业比较情况

1）功能测试座

公司功能测试座的核心指标与同行业可比公司的对比情况如下：

关键指标	指标含义	公司可实现的最高水平	同行业可比公司可实现的最高水平
芯片封装尺寸	反映测试座对不同尺寸封装芯片的适配能力，覆盖范围越广，说明公司具备更强的结构设计和开发能力	0.5mm-150mm	0.25mm-150mm
最高测试频率	反映测试座在高频信号或射频信号传输场景下的频域响应能力，支持的最高测试频率越高，说明测试座在高频信号环境下阻抗控制、信号传输完整性保障能力越强	85GHz	100GHz
最高测试速率	反映测试座对高速数字信号传输的支持能力，支持的最高测试速率越高，说明测试座在高速数字信号传输过程中控制信号衰减、抖动、串扰和阻抗不连续的能力越强	224Gbps	224Gbps
最小探针间距	通常是指测试座可适配的封装后芯片引脚、焊球、焊盘或触点之间的最小 Pitch，对应测试座内部探针阵列的最小排布间距，封装后最小探针间距越小，说明测试座的精密程度、高密度互连能力和高性能封装芯片适配能力越强	0.25mm	0.25mm
使用寿命	功能测试座使用寿命通常以压接次数或插拔测试次数衡量，使用寿命越长，测试座的机械可靠性、接触稳定性和性能保持能力越强	100 万次	100 万次

数据来源：同行业公司官方网站或其他公开披露信息。

整体来看，功能测试座的技术水平主要体现为对不同封装形态芯片的适配能力、高速高频信号传输能力、高密度微间距精密接触能力以及长期量产使用中的机械寿命，发行人功能测试座产品在封装适配范围、信号传输完整性、精密接触及使用寿命等方面已形成较强的技术基础，能够满足高性能芯片功能测试场景的应用需求，整体技术水平处于行业先进水平。

2）老化测试座

公司老化测试座的核心指标与同行业可比公司的对比情况如下：

关键指标	指标含义	公司可实现的最高水平	同行业可比公司可实现的最高水平
工作温度范围	反映测试座在不同环境温度条件下稳定工作的能力，工作温度范围越宽，说明产品在材料选型、结构设计、热膨胀控制及严苛环境适应性方面具备更强能力	-55℃~175℃	-55℃~200℃
热功率范围	反映测试座在高功率芯片测试过程中承载、传导和散发热量的能力，热功率范围上限越高，说明产品热管理能力越强，越能适配高功率、高价值芯片的老化测试需求	0-2,000W	0-2,000W
温控偏差范围	反映测试座在测试过程中对芯片温度的	±1.5℃	±1.5℃

关键指标	指标含义	公司可实现的最高水平	同行业可比公司可实现的最高水平
	控制能力，温控偏差范围越窄，说明产品的加热设计、冷却设计以及温度传感能力越强		
使用寿命	老化测试座使用寿命通常用运行时间衡量，反映测试座在长期高温通电、反复装载芯片及持续热应力环境下的可靠性，使用寿命越长，说明产品在材料耐热性、接触结构耐久性以及热循环稳定性等方面表现更优	1 万小时	1 万小时

数据来源：同行业公司官方网站或其他公开披露信息。

结合上表，发行人老化测试座产品围绕高功率承载、热管理设计、温控一致性及长期运行可靠性搭建了完善的技术体系，能够适配高性能、高价值芯片对可靠性测试日益提升的要求，在老化测试座细分领域具备行业先进的技术水平。

3、发行人与同行业可比公司的选取依据及可比程度

公司基于行业代表性、业务相关性与数据可获取性原则，发行人采取了以下筛选逻辑确定同行业可比公司：

首先，发行人将对标范围拓展至全球半导体封装测试消耗型硬件领域的主要参与者，结合企业经营信息及财务数据的公开程度，重点聚焦于已上市的 Yamaichi、Leeno、WinWay、Enplas、ISC、Cohu、Yokowo 以及 Advantest 等全球头部企业。

其次，发行人基于主营业务结构与终端应用领域的匹配度进行精准剔除：报告期内，发行人始终深耕半导体测试座领域，核心产品涵盖功能测试座与老化测试座，主要服务于 AI 算力芯片、手机 SoC 以及车规级芯片等非存储类芯片的测试需求。在国际已上市的主要竞争对手厂商中，ISC 的业务重心主要集中在存储芯片测试领域，Cohu、Advantest 业务包含大量的测试机及分选机等设备整机制造，Leeno、Yokowo 产品结构以探针及探针卡为主。上述企业的业务结构与发行人以“非存储领域、封装测试消耗型硬件”为核心的主营业务模式存在显著的结构性差异，可比性相对较弱。

最后，由于国内尚无已上市的半导体测试座企业，发行人结合公开信息披露情况及业务可比性，选取已披露招股说明书的韬盛科技作为境内同行业可比公司。

综上，结合行业地位、业务结构相似性、产品应用领域重叠度及信息披露完整性等核心维度后，发行人最终选取 Yamaichi、WinWay、Enplas 三家中国境外已上市公司，以及中国境内已公开申报的非上市公司韬盛科技，作为同行业可比公司。

（三）发行人的主要竞争优势

公司长期专注于半导体封装测试消耗型硬件领域，围绕功能测试座、老化测试座及相关测试接口组件持续进行技术积累和产品迭代，逐步形成了以核心技术能力为基础、以细分市场卡位为牵引、以客户协同和供应链管控为支撑的综合竞争优势。公司一方面紧跟芯片性能升级、先进封装演进及可靠性测试需求提升的行业趋势，持续提升产品在高速高频信号传输、高功率散热及精准温控、高密度微间距精密接触和长期稳定运行等方面的性能；另一方面依托本土化快速响应能力和产业链协同优势，深度参与客户研发验证和量产导入环节，将技术能力转化为客户黏性和市场竞争力。

1、核心技术突破与战略卡位相结合，形成前沿细分领域先发优势

半导体封装测试消耗型硬件具有较高的技术门槛，产品性能取决于精密机械设计、材料适配、高速信号传输、热管理等多领域能力的综合集成。公司围绕“高频高速信号的测试座设计与制造”“宽温区、高功率测试座设计与制造”“高性能测试探针设计”“高精度微间距测试座精密制造”等方向持续投入研发，在金属同轴测试座、高功率散热模块、精密探针结构、多通道温控等关键环节积累了技术底蕴与工程化经验。

在技术积累基础上，公司结合下游芯片性能升级和测试需求变化，重点布局高性能功能测试座、老化测试座等技术壁垒较高、国产化需求较强的细分领域。尤其在老化测试座领域，随着 AI 算力芯片、手机 SoC、车规级芯片等高价值芯片对可靠性筛选要求不断提升，老化测试逐步由抽样筛检向全检测试发展，对测试座的高功率承载、精准温控、长期运行可靠性和多工位一致性提出更高要求，公司较早围绕上述方向开展技术布局，成功切入了“验证门槛高、国产化替代需求迫切”的高增长赛道，并在相关产品中形成了较强的先发优势。

2、深度参与产业链协同，构建覆盖工程验证至量产测试的优质客户生态

公司长期服务于芯片设计公司、封测服务企业及测试设备厂商等半导体产业链核心参与者，已建立覆盖从芯片研发验证到封装测试量产的客户体系，能够围绕不同芯片类型、封装形式、测试条件和应用场景提供定制化测试接口解决方案。从客户结构看，公司已进入日月光、芯云半导体、京隆科技、长电科技、通富微电、华天科技、伟测科技以及渠梁电子等业内主流半导体封测服务企业供应体系，并与多家头部芯片设计公司建立合作关系，终端应用覆盖 AI HPC、智能终端、汽车电子等领域。在 AI HPC 领域，

公司服务客户包括 A 公司、**D 公司**、B 公司、C 公司、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、燧原科技、龙芯中科、清微智能等国内头部算力企业；在智能终端领域，公司与 A 公司、新紫光集团、中兴通讯、全志科技、Apple、Microchip 等境内外芯片设计公司保持合作；在汽车电子领域，公司已导入 MPS、英飞凌、Bosch、安世半导体、恩智浦、A 公司、地平线、瑞芯微、纳芯微、士兰微、四维图新等境内外知名厂商供应商体系。

上述客户结构体现出公司产品已在多类型高性能芯片测试场景中获得验证和应用，已具备较强的客户覆盖能力和市场认可度。

3、本土化快速响应与全生命周期技术支持能力，提升客户服务效率和合作黏性

公司通常在芯片工程验证阶段即与芯片设计公司开展协同开发，提前参与测试接口方案设计、信号传输、散热温控等环节，帮助客户提高研发验证效率并降低后续量产导入风险。随着客户芯片由工程验证进入试产及规模化量产阶段，前期已完成验证的测试方案通常会延续应用于 FT 测试、老化测试及 SLT 测试等量产测试场景，使公司能够由单一项目开发自然延伸至后续批量供货及持续迭代服务。同时，公司依托本土化研发、制造和工程服务体系，在需求沟通、样品验证、批量交付及售后支持等方面具备较高响应效率。

4、自主可控的供应链管理与规模化交付能力，保障产品质量、成本和交期稳定

公司围绕核心工艺和关键部件持续推进供应链建设，通过加强工艺开发、供应商管理和自动化装备导入，提高产品一致性、交付效率和成本控制能力。在微间距打孔、高密度阵列灌胶、异形结构加工等关键工艺环节，公司持续优化工艺参数和过程控制，提升批量制造稳定性。同时，公司建立了较为完善的供应商准入、评审和质量管控机制，并通过多元化采购渠道提升供应链韧性。在生产过程中，公司通过高精度自动化设备和过程检测手段，提高产品加工精度和良率。上述供应链和制造管理能力有助于公司在保证产品性能可靠性和一致性的同时，实现较好的成本控制和交期保障，为公司持续服务高端客户、扩大市场份额提供了稳定支撑。

（四）发行人的主要竞争劣势

1、国产替代渗透能力、境外市场影响力及全球化布局仍需进一步提升

相较于国际行业巨头，公司在全球范围内的品牌认知度、海外客户覆盖广度、国际化销售渠道及境外本地化服务网络等方面仍存在提升空间。目前，公司业务重心仍主要

集中于中国大陆市场，在海外高端客户供应链中的导入深度和市场影响力仍有待进一步增强。未来，随着国内半导体产业的自主可控持续推进高性能测试接口国产替代，以及公司产品性能和交付能力不断提升，公司仍需进一步扩大在国内高端客户中的渗透率，并加快国际市场开拓、完善境外服务体系、提升全球品牌影响力，从而增强公司在全球半导体测试接口产业链中的综合竞争力。

2、融资渠道相对单一

半导体封装测试消耗型硬件行业属于典型的资本与技术双密集型行业。目前，公司的中国境外主要竞争对手（如 Yamaichi、Cohu、WinWay 等）均已在资本市场上市，具备极为通畅的直接融资渠道和雄厚的资金实力。相比之下，公司现阶段主要依靠自身经营滚动的利润积累和有限的间接融资驱动发展，融资渠道相对单一。面对日益增长的先进产能扩充订单需求、前沿技术研发以及高端人才引进等方面的压力，公司若仅依赖现有融资方式，难以充分满足公司下一阶段规模化发展和技术升级的资金需求。能否成功通过资本市场获取充足、稳定的长期资金，已成为制约公司进一步缩小与国际巨头差距、实现跨越式发展的关键瓶颈。

（五）上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋势

报告期内，上述情况未对公司经营发展构成重大不利影响，亦不存在可能对公司持续经营能力、市场竞争地位或未来发展产生重大不利影响的可预见的变化趋势。

四、发行人销售情况和主要客户

（一）报告期内主要产品的产销情况

1、主要产品的产能、产量情况

报告期内，半导体测试座作为公司收入占比最高的核心产品，其产能利用率是衡量公司整体生产负荷的关键指标。CNC 机加工工序是公司测试座产品的核心产能瓶颈环节，公司对测试座的产能以自有 CNC 机床的额定工时以及自有 CNC 机床数量作为计算依据。公司测试座产品的产能、产量和产能利用率情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
CNC 机加工额定工时（小时）	**234,180**	318,240	218,400	191,400
CNC 机加工实际工时（小时）	**264,668**	320,357	218,827	187,665
产能利用率	**113.02%**	100.67%	100.20%	98.05%

注：公司的 CNC 机加工额定工时=机床数量*机床运行天数*机床每日额定工时（20 小时）。

报告期内，公司产能利用率分别为 98.05%、100.20%、100.67%和 113.02%。公司的设计产能不断提升的同时，产能利用率始终保持在较高水平，这主要系下游半导体测试产业对测试座的需求呈现爆发式增长，公司产销量受客户需求拉动持续处于高位。

2、主要产品的产量、销量情况

报告期内，公司销售的主要产品为测试座，其具体的产量、销量和产销率情况如下：

产品类型	项目	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
测试座	产量（套）	64,287	85,342	47,493	51,787
	销量（套）	61,836	81,600	47,082	52,634
	产销率	96.19%	95.62%	99.13%	101.64%

公司主要采取“以销定产”的经营模式。报告期内，公司测试座产销率分别为 101.64%、99.13%、95.62%和 96.19%，整体保持在较高水平，基本实现产销平衡。

3、公司产品或服务的主要客户群体

公司客户主要包括芯片设计公司、封测服务企业及测试设备厂商等半导体产业链核心参与者，已成为日月光、芯云半导体、京隆科技、长电科技、通富微电、华天科技、伟测科技以及渠梁电子等业内主流半导体封测服务企业的稳定供应商。公司客户广泛分布于国民经济各重要领域，在 AI HPC 领域，公司客户覆盖 A 公司、D 公司、B 公司、C 公司、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、燧原科技、龙芯中科、清微智能等国内头部算力企业；在智能终端方向，公司长期服务的客户包括 A 公司、新紫光集团、中兴通讯、全志科技、Apple、Microchip 等境内外芯片设计公司；在汽车电子领域，公司已进入 MPS、英飞凌、Bosch、安世半导体、恩智浦、A 公司、地平线、瑞芯微、纳芯微、士兰微、四维图新等境内外汽车电子产业链企业的供应商体系；在工业控制等其他重要领域，公司客户亦包括 MPS、复旦微电、安路科技等知名企业。公司凭借核心技术持续突破、产业链深度协同、全生命周期服务、供应链自主可控以及规模化交付能力，已深入参与全球高性能半导体封装测试消耗型硬件市场竞争。

4、营业收入构成情况及主要产品销售单价变动分析

报告期内，公司营业收入的构成情况详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”之“1、营业收入构

成及变动分析”。

公司主营业务产品以功能测试座、老化测试座及探针为主，该等细分产品的单价具体如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
功能测试座（元/套）	**5,314.60**	4,694.65	4,672.87	4,447.74
老化测试座（元/套）	**5,648.91**	4,912.18	4,110.88	1,530.64
探针（元/根）	**12.36**	11.87	11.26	12.76

上述细分产品单价变动分析详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”之“2、主营业务收入构成及变动分析”。

（二）报告期内前五大客户情况

报告期内，公司向前五大客户的销售情况具体如下：

单位：万元

期间	客户名称	主要销售产品	销售金额	占营业收入的比例
2026 年 1-6 月	**芯云半导体**	**老化测试座**	**11,514.44**	**26.15%**
	京隆科技	**老化测试座**	**6,294.44**	**14.30%**
	日月光	**老化测试座、功能测试座**	**5,089.64**	**11.56%**
	渠梁电子	**老化测试座**	**4,349.71**	**9.88%**
	长川科技	**分选换型套件、测试接口连接模组**	**3,469.02**	**7.88%**
	合计		**30,717.24**	**69.77%**
2025 年度	芯云半导体	老化测试座	13,194.14	24.25%
	日月光	老化测试座、功能测试座	9,706.80	17.84%
	长川科技	分选换型套件、测试接口连接模组	5,389.19	9.91%
	京隆科技	老化测试座	4,585.53	8.43%
	MPS	功能测试座	2,940.11	5.40%
	合计		**35,815.76**	**65.83%**
2024 年度	芯云半导体	老化测试座	4,350.52	14.06%
	长川科技	分选换型套件、测试接口连接模组	3,340.63	10.79%
	日月光	老化测试座、功能测试座	3,138.61	10.14%
	京隆科技	老化测试座	3,088.80	9.98%
	MPS	功能测试座	1,669.31	5.39%

期间	客户名称	主要销售产品	销售金额	占营业收入的比例
	合计		**15,587.86**	**50.36%**
2023 年度	日月光	老化测试座、功能测试座	2,568.44	11.39%
	长川科技	分选换型套件、测试接口连接模组	2,398.63	10.64%
	复旦微电	老化测试座	2,388.87	10.59%
	新紫光集团	功能测试座	1,325.10	5.88%
	中电科集团	功能测试座	1,119.74	4.97%
	合计		**9,800.78**	**43.47%**

注：上述客户及其同一控制下企业的销售金额合并披露。

报告期内，公司向前五大客户销售金额占营业收入的比例分别为 43.47%、50.36%、65.83%和 69.77%，不存在向单个客户销售比例超过公司当年销售总额 50%或严重依赖少数客户的情况。除长川科技为公司关联方外，公司及公司实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员与公司报告期内前五大客户不存在关联关系。公司销售给长川科技的产品主要为分选换型套件、测试接口连接模组等，系作为其分选机或测试机产品的协同部件使用。

五、发行人采购情况和主要供应商

（一）报告期内主要原材料采购情况

1、主要原材料的采购情况

报告期内，公司主要原材料包括探针、结构部件、结构部件材料、电气及温控部件、标准件、外协加工等，各类原材料的主要采购内容如下：

序号	类别	主要采购内容
1	探针	功能测试探针、老化测试探针等
2	结构部件	测试座金属部件、测试座塑料底座部件、分选换型套件金属部件等
3	结构部件材料	测试座塑料板材等
4	电气及温控部件	散热器、铜片、加热棒等
5	标准件	钻头、铣刀、螺丝等
6	外协加工	表面处理等

报告期内，公司主要原材料采购的构成情况具体如下：

单位：万元

类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
探针	**14,071.99**	**53.35%**	15,784.85	50.71%	8,165.61	49.07%	4,902.97	49.17%
结构部件	**6,752.92**	**25.60%**	9,934.59	31.91%	5,520.65	33.17%	3,159.10	31.68%
结构部件材料	**1,241.14**	**4.71%**	1,628.22	5.23%	1,059.80	6.37%	628.94	6.31%
电气及温控部件	**1,841.43**	**6.98%**	1,397.23	4.49%	781.38	4.70%	579.93	5.82%
标准件	**1,256.77**	**4.76%**	1,186.77	3.81%	573.74	3.45%	405.35	4.06%
外协加工	**846.38**	**3.21%**	834.07	2.68%	296.49	1.78%	172.68	1.73%
其他	**365.75**	**1.39%**	363.10	1.17%	244.11	1.47%	123.39	1.24%
总计	**26,376.39**	**100.00%**	**31,128.83**	**100.00%**	**16,641.77**	**100.00%**	**9,972.36**	**100.00%**

报告期内，随着公司业务规模的快速扩张，主要原材料的采购金额呈逐年上升趋势，其整体变动趋势与公司营业收入的增长态势基本匹配。

2、主要原材料价格的变动情况

报告期内，公司主要原材料采购价格的变动情况如下：

单位：万支、万件、万孔、元/支、元/件、元/孔

项目	主要细分产品	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		采购数量	平均单价	采购数量	平均单价	采购数量	平均单价	采购数量	平均单价
探针	老化测试探针	**8,237.60**	**1.30**	7,185.75	1.39	3,067.06	1.20	1,385.87	1.08
	功能测试探针	**505.37**	**6.18**	840.66	6.28	655.52	6.45	537.01	5.99
结构部件	测试座金属部件	**58.79**	**65.91**	60.07	69.89	24.85	75.59	12.74	91.67
	测试座塑料底座部件	**6,896.75**	**0.12**	7,705.57	0.31	3,808.84	0.38	1,371.13	0.33

注：测试座塑料底座部件单件价格受打孔数量影响较大，故其采购单价按照每孔单价进行披露。

公司主要原材料采购价格受产品技术复杂度与规模化效应影响，具体变动分析如下：

报告期内，老化测试探针采购单价**整体呈现增长态势**，主要系下游芯片测试需求向“高密度、高功率”演进，公司采购的老化测试探针规格相应向更微细、更高电流承载力的高性能方向升级，导致采购单价上升；功能测试探针单价略有波动，整体保持平稳。

报告期内，测试座金属部件采购价格呈现持续下降趋势，主要系采购规模随业务量增长而扩大，公司凭借规模效应获得了更强的议价能力所致。测试座塑料底座部件 2024 年采购单价较高，主要系当期采购的高密度孔数的底座部件数量增加，加工难度升级导

致每孔单价上升，该部件 2025 年采购单价有所回落，主要系公司采购规模增大，交易单价有所下降。**2026 年 1-6 月单价下降，主要系打孔工艺逐步优化，且单一型号部件订单批量增加，生产设备无需频繁调整参数及更换刀具，设备生产集中度提高，供应商单孔加工工时显著降低，带动加工单价下降**。

（二）报告期内主要能源采购情况

报告期内，公司采购的主要能源为电力，不含税采购金额分别为 82.91 万元、106.45 万元、145.54 和 106.24 万元，均由市政供应，供应充足、价格稳定。报告期内，公司电力采购金额增长较快，主要系下游需求旺盛，公司为保障订单交付快速扩充产能，设备开机时长增加所致。

（三）报告期内前五大供应商情况

报告期内，公司向前五大供应商的采购情况具体如下：

单位：万元

序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占采购总额的比例
2026 年 1-6 月				
1	**苏州迪克微电子有限公司**	**老化测试探针、功能测试探针**	**5,905.26**	**22.39%**
2	**苏州矽图电子科技有限公司**	**老化测试探针**	**4,084.11**	**15.48%**
3	**苏州廷宣精密机械有限公司**	**测试座金属部件**	**2,163.53**	**8.20%**
4	**浙江日拓电子股份有限公司**	**老化测试探针、功能测试探针**	**2,159.04**	**8.19%**
5	**赫思精密科技（苏州）有限公司**	**测试座金属部件**	**2,107.11**	**7.99%**
合计			**16,419.06**	**62.25%**
2025 年度				
1	苏州迪克微电子有限公司	老化测试探针、功能测试探针	6,934.03	22.28%
2	苏州矽图电子科技有限公司	老化测试探针	3,292.68	10.58%
3	浙江日拓电子股份有限公司	老化测试探针、功能测试探针	3,097.81	9.95%
4	凯利研创精密科技（苏州）有限公司	测试座塑料底座部件	2,885.72	9.27%
5	苏州廷宣精密机械有限公司	测试座金属部件	2,386.02	7.66%
合计			**18,596.26**	**59.74%**
2024 年度				
1	苏州矽图电子科技有限公司	老化测试探针	2,709.15	16.28%
2	苏州迪克微电子有限公司	功能测试探针	2,662.17	16.00%

序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占采购总额的比例
3	凯利研创精密科技（苏州）有限公司	测试座塑料底座部件	2,113.47	12.70%
4	苏州廷宣精密机械有限公司	测试座金属部件	1,122.42	6.74%
5	浙江日拓电子股份有限公司	功能测试探针	1,114.50	6.70%
合计			**9,721.71**	**58.42%**
2023 年度				
1	苏州迪克微电子有限公司	功能测试探针	1,470.96	14.75%
2	苏州矽图电子科技有限公司	老化测试探针	1,276.07	12.80%
3	浙江日拓电子股份有限公司	功能测试探针	946.17	9.49%
4	苏州廷宣精密机械有限公司	测试座金属部件	856.16	8.59%
5	凯利研创精密科技（苏州）有限公司	测试座塑料底座部件	746.05	7.48%
合计			**5,295.40**	**53.10%**

注：上述供应商及其同一控制下企业的采购金额合并披露。

报告期内，公司向前五大供应商采购金额占采购总额的比例分别为 53.10%、58.42%、59.74%和 62.25%，不存在向单个供应商采购比例超过公司当年采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情况。公司及其实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员与公司报告期内前五大供应商不存在关联关系。

六、发行人主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产情况

1、固定资产情况

公司固定资产包括通用设备、专用设备及运输工具。目前，公司主要固定资产使用状况良好，不存在抵押、质押等权利瑕疵或限制，不存在权属纠纷和法律风险。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司固定资产的具体情况如下：

单位：万元

项目	折旧年限	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
通用设备	3	86.69	62.22	24.47	28.23%
专用设备	5-10	7,349.26	2,626.07	4,723.20	64.27%
运输工具	4	284.26	204.36	79.89	28.10%
合计	/	7,720.21	2,892.65	4,827.56	62.53%

2、自有不动产情况

截至本招股说明书签署日，公司及公司子公司未拥有不动产。

3、租赁房产情况

截至本招股说明书签署日，公司及公司子公司租赁的用于生产、经营的主要房产情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件七：公司租赁情况”。

（二）主要无形资产情况

1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司及公司子公司未拥有土地使用权。

2、商标

截至本招股说明书签署日，公司及公司子公司拥有 3 项注册商标，具体情况如下：

序号	商标	注册号	类别	所有权人	专用权期限	取得方式
1	FTDevice	59001162	第 9 类	发行人	2022.03.07-2032.03.06	原始取得
2	FTDevice	14403013	第 9 类	发行人	2025.06.07-2035.06.06	原始取得
3	法特迪	14402986	第 9 类	发行人	2025.06.07-2035.06.06	原始取得

3、专利

截至本招股说明书签署日，公司及公司子公司拥有 68 项发明专利与 65 项实用新型专利，具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件五：公司专利具体情况”。

4、软件著作权

截至本招股说明书签署日，公司已实际取得 1 项软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	软件著作权名称	登记号	首次发表日期	取得方式	他项权利
1	发行人	自动化水循环三温控制系统 V1.0	2022SR0667980	2022.01.20	原始取得	无

（三）允许他人使用公司资产情况

截至本招股说明书签署日，公司主要资产不存在允许他人使用的情况。

七、发行人与业务相关的资质及许可情况

截至本招股说明书签署日，公司未拥有特许经营权，公司及公司子公司拥有经营所

需的主要资质及许可情况如下：

序号	资质/认证名称	证书/文件编号	持有人	发证机构	有效期至
1	高新技术企业证书	GR202532002512	法特迪	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局	2028.11.17
2	高新技术企业证书	GR202434004488	蓝泽科技	安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、安徽省税务局	2027.11.27
3	固定污染源排污登记回执	91340221MA8N83E70P001X	蓝泽科技	-	2027.11.03
4	固定污染源排污登记回执	91320594091546438H001Z	法特迪	-	2029.07.30
5	海关进出口货物收发货人备案	3205261716	法特迪	中华人民共和国苏州工业园区海关	长期有效
6	海关进出口货物收发货人备案	320526507X	法特迪电子	中华人民共和国苏州工业园区海关	长期有效

八、发行人核心技术与研发情况

（一）发行人主要产品的核心技术情况

1、发行人核心技术

公司始终重视研发投入和技术创新，通过自主研发形成了在高性能芯片测试解决方案领域突出的技术壁垒和竞争优势，公司的核心技术体系具体如下：

技术方向	技术名称	技术描述	技术先进性或难点	具体表征	技术所处阶段	技术来源
面向高频高速信号的测试座设计与制造	阻抗匹配与高速信号无损耗传输技术	面向高速信号测试，构建“同轴探针结构+低介电灌胶材料+全链路仿真优化”的测试座设计方案，实现芯片引脚、测试座至测试板端的低损耗、阻抗连续传输	高速测试中探针变径、介质损耗及阵列串扰易导致反射和衰减，公司产品通过低损耗灌胶、多孔控制环及系统级仿真，提升阻抗匹配精度并兼容多阻抗场景	支持 56Gbps 及以上高速测试；阻抗覆盖 50Ω-150Ω；介电常数≤2.2，介质损耗因子＜0.005；灌胶无明显气泡；全链路阻抗匹配偏差≤3%	正式应用	自主研发
	高精度、超低电阻设计与检测技术	面向多接触点的高密度测试座，基于全开尔文四线制测量、高密度开关矩阵及多 SMU 并行架构，实现接触电阻的快速、定量化全检，消除从测试机到探针的引线电阻与接触电阻误差	万级触点逐点检测对测试效率、测量精度及通道一致性要求高，传统外观检测难以识别接触隐患。该技术可消除引线与接触路径误差，提升上机前质量筛查能力	支持 10,000+通道扫描；12 组以上 SMU 并行测试；电阻测量范围 1mΩ-10kΩ；测量精度±0.05%，重复性优于 0.5%；单点测试＜10ms，万点全检＜5 分钟	正式应用	自主研发
	晶圆测试高速探针卡设计技术	面向晶圆级高速测试场景，采用同轴探针结构、低损耗灌胶及短链路布局，降低探针卡信号路径引起的反射、衰减和串扰	晶圆测试中通道密度高、传输路径受限，高速信号易受链路长度、介质材料和探针间距影响。该技术在较小探针间距下实现高速信号稳定传输	适用于 250μm 及以上探针间距；支持最高 224Gbps 高速信号测试；采用同轴探针与低损耗灌胶结构	正式应用	自主研发
宽温区高功率老化座设计与制造	精准控温以及宽温区老化座设计与制造技术	面向百瓦级的高功率芯片老化测试，采用铜底座、毛细铜管、铝翅片复合散热结构，集成加热、测温、闭环控制单元及风冷系统，实现宽温区稳定控温	难点在于高功率热负载下兼顾散热效率、温度均匀性和宽温区控制精度。公司产品通过低热阻结构、毫秒级温度采样及功率前馈+串级 PID 算法，提升风冷老化座控温能力	支持百瓦级持续散热；温度采样 10-20ms；850W 阶跃负载下温度过冲≤±3℃，稳态波动≤±1℃	正式应用	自主研发
	超高功率液冷老化座设计制造技术	面向千瓦级及以上高性能芯片老化测试，将微通道液冷冷板与高精度压合测试座一体化集成，实现超高功率散热、精密压接和温度闭环控制	在有限空间内同时满足大功率散热、芯片压接稳定、液冷密封及绝缘安全要求，通过多级微流道、低热阻界面材料及分区压合结构提升系统可靠性	入口水温 40℃、流量 2L/min 条件下可散逸 2,000W 左右热量；芯片表面温度 105±1.5℃；结温≤120℃；面内温差≤4℃；接触热阻＜0.05K·cm²/W；冷板耐压 0.8MPa 无泄漏	正式应用	自主研发
	多区独立控温与三温测试控制技术	面向三温测试和多工位并行测试，基于 TEC 双向控温、主从式总线架构和多区独立 PID 控制，实现各测	多区密集控温需解决升降温速度、温度精度、区域热耦合及低温结露问题，通过增益调度 PID、热耦合	支持 24 个温区同步独立控制；升降温时间＜5 分钟；支持常温环境下三温测试及高	正式应用	自主研发

技术方向	技术名称	技术描述	技术先进性或难点	具体表征	技术所处阶段	技术来源
		试位点的同步、独立温度管理	补偿和露点保护逻辑提升测试效率和稳定性	温老化测试		
高性能测试探针设计	高速射频同轴探针设计技术	面向高频高速芯片测试，采用同轴探针架构、50Ω 阻抗匹配设计及渐变过渡结构，降低寄生参数、信号损耗和通道串扰	高频射频探针对探针几何精度、介质稳定性及接地屏蔽连续性要求高，微小结构偏差均可能引发阻抗突变。该技术通过全波仿真和结构参数优化实现高频性能稳定	实现 50Ω 特征阻抗匹配；变径比＜1.2；测试压缩行程＞0.7mm；可抑制寄生电容、串扰及信号损耗	正式应用	自主研发
高精度微间距测试座精密制造	超大封装测试座平面度控制技术	面向超大尺寸多孔薄板测试座，采用贴膜增强、真空压膜、阶梯固化、对称约束及真空吸附加工工艺，控制灌胶固化和后加工过程中的翘曲变形	大尺寸薄壁多孔结构在灌胶固化及热循环中易产生应力释放和基准偏移，直接影响探针阵列共面性。该技术通过工艺路径和约束方式优化，实现高平面度和高良率制造	适用于大尺寸、孔数＞5,000 的多孔板；固化翘曲量由 1.5mm 降至 0.15mm 以内；平面度≤0.01mm；位置精度±0.02mm	正式应用	自主研发
	高密度阵列、微孔灌胶制造技术	面向高密度微孔阵列填充，采用高压射出成型、直接浇口及变模温控制工艺，实现树脂在微孔阵列中的完整填充和稳定固化	高密度阵列灌胶易发生气泡、短射、收缩和翘曲，影响后续加工及信号性能。该技术通过注射压力、填充速度、模具温度和压缩压力协同控制，提高填充一致性	支持高密度孔阵列填充；可实现 0.1mm 微孔完整填充；无明显气泡、短射等缺陷；制品收缩率降低约 1.5%-2%；材料利用率提升	正式应用	自主研发
测试分选套件精密制造	测试压头定位、多功能检测及温控技术	面向分选机换型及三温测试组件，集成高精度定位、多通道真空吸附、独立加热及多功能检测模块，实现压头与测试座、待测芯片的快速适配	在有限空间内同时满足设备接口、封装尺寸、压接行程、温控及检测功能要求，通过模块化结构和集成检测设计提升换型效率及装配一致性	实现分选机、测试座与芯片之间的高精度机械匹配；支持真空吸附、加热、定位及多项功能检测；提升三温设备组件检测效率和正确率	正式应用	自主研发
高速测试机接口模组制造	高速接口模组制造技术	面向 ATE 测试机头与待测芯片之间的高速互连，采用高密度同轴结构、精密针孔定位及低收缩灌胶工艺，形成宽带低损耗的信号传输通道	超高引脚数接口模组需在有限空间内兼顾高密度排布、机械寿命、共面度和高速信号传输完整性。该技术通过同轴屏蔽、精密研磨及灌胶固化控制降低损耗和串扰	支持多信号通道；机械寿命＞50 万次插拔	正式应用	自主研发

2、核心技术产品或服务占营业收入的比例

报告期内，公司核心技术全面应用于测试座、封测接口组件等封装测试消耗型硬件及其相关配件的研发与生产，报告期内，公司核心技术产品收入占营业收入的比例如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产品收入	**42,261.54**	52,787.90	29,753.45	21,445.29
营业收入	**44,027.78**	54,402.48	30,951.23	22,547.96
占比	**95.99%**	**97.03%**	**96.13%**	**95.11%**

2023 年以来，公司核心技术产品收入保持快速增长态势，占营业收入的比例均保持在较高水平。

3、核心技术的科研实力和成果情况

截至本招股说明书签署日，公司获得的主要奖项、荣誉情况如下：

序号	奖项或荣誉名称	颁发单位	颁发年度
1	**博士后科研工作站**	**江苏省人力资源和社会保障厅**	**2026 年**
2	国家级专精特新重点“小巨人”企业	工业和信息化部	2024 年
3	江苏省专精特新中小企业	江苏省工业和信息化厅	2022 年
4	江苏省企业技术中心	江苏省工业和信息化厅	2024 年
5	江苏潜在独角兽企业	江苏省生产力促进中心	2024 年
6	2022 年度苏州市独角兽培育企业	苏州市科技局	2023 年
7	2023 年江苏省高新技术产业开发区瞪羚企业	江苏省生产力促进中心	2023 年
8	2023 年度江苏省科技企业上市培育计划入库企业	江苏省科学技术厅	2023 年
9	苏州市企业技术中心	苏州市工业和信息化局	2022 年
10	江苏省集成电路芯片测试连接器工程技术研究中心	江苏省科学技术厅	2020 年
11	苏州市半导体测试技术工程中心	苏州市科学技术局	2017 年

4、发行人核心技术的保护措施

公司在注重技术研发与创新的同时，高度重视对核心技术和知识产权的保护工作，并已建立较为完善的技术保护机制。具体而言，公司通过专利布局、制度管控及协议约束等多维度措施，对核心技术成果进行系统性保护：一方面，公司建立了规范的专利申请及管理机制，要求研发部门在关键研发节点及时开展专利挖掘与申请工作，围绕核心工艺、关键结构设计及重要技术路径形成专利布局，以实现对核心技术成果的法律保护；

另一方面，公司结合研发管理实际制定并严格执行研发保密制度，明确研发部门及相关岗位在技术资料管理、成果归档、信息传递等环节的职责要求，并通过定期汇报、监督检查、审计评价及保密培训等方式强化研发过程中的保密管理。

此外，公司与相关员工签署保密及竞业限制协议，对职务成果的知识产权归属、保密义务、技术秘密范围以及员工在职期间和离职后的竞业限制义务作出明确约定，持续履行保密义务。通过上述措施，公司能够有效加强核心技术成果保护，降低核心技术泄露、流失或被不当使用的风险。

（二）发行人研发情况

1、公司在研项目的进展情况

截至本招股说明书签署日，公司正在进行的主要在研项目的情况如下：

序号	领域	在研项目	项目拟达成目标	项目进展阶段
1	高功率、宽温区测试座	针对大功耗（2,000W+）算力芯片老化测试座的开发	围绕 2,000W+的高性能芯片功耗环境下的老化测试需求，拟达到最大芯片测试功率 2,000+W，最大耐电流水平 3A，装针数量达到 30,000pin，适用芯片的最大尺寸 120mmX120mm	**TR5（验证测试）**
2	高功率、宽温区测试座	宽温区芯片测试温控与三温控制模块的开发	针对高功率芯片的高低温精准控温技术的开发，主要应用于汽车电子及高性能芯片三温测试需求，拟达到独立控制系统的控制温度范围至-55℃-155℃，支持最大芯片发热功率 100W/0℃	TR5（验证测试）
3	高频高速信号测试座	针对大尺寸封装高速算力芯片（224Gbps）同轴测试座的开发	开发高性能同轴测试座，支持 224Gbps 测试速率需求，芯片最大尺寸 120X120mm，最大装针数量 30,000pin	TR5（验证测试）
4	高频高速信号测试座	晶圆级别高速测试 WLCSP 探针卡的开发	实现 100um 间距晶圆级别高速探针卡研发，支持 112Gbps 高速信号在晶圆测试阶段的需求	**TR4A（样机开发）**
5	高频高速信号测试座	针对高频射频芯片测试方案的开发	针对 85GHz 及以上射频芯片的测试需求，拟达到测试频率 100GHz，测试寿命 30 万次	TR5（验证测试）
6	高频高速信号测试座	针对高宽带存储芯片（HBM）测试方案的开发	围绕 HBM 高带宽存储芯片测试，提升高速多通道信号传输、高密度连接及稳定测试能力，支持先进存储芯片封装后测试需求	TR3（方案概要设计）
7	高频高速信号测试座	针对高频高速高密度互联芯片测试载板的开发	围绕高速同轴探针卡测试场景，开发高密度 MLO 转换基板，提升高频高速信号转换、高密度互连及低损耗传输能力，拟达到最大叠层次数 12+6+12；最小线宽/线距 20/20um	**TR2（方案设计）**

序号	领域	在研项目	项目拟达成目标	项目进展阶段
8	高性能测试探针	芯片测试探针寿命与可靠性提升的技术开发	提升探针使用寿命及测试性能，拟达到耐电流>3.5A，测试寿命 100 万次，探针电阻<0.05Ω，最大测试行程 1.1mm	TR4A（样机开发）

2、研发投入情况

报告期内，公司研发投入情况详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”之“（四）期间费用分析”之“3、研发费用”。公司将持续加大技术研发与创新投入，为公司的持续创新提供保障，从而增强公司核心竞争力。

3、合作研发情况

报告期内，公司不存在合作研发的情况。

（三）发行人核心技术人员和研发人员情况

1、核心技术人员及研发人员基本情况

公司共有核心技术人员 3 名，其基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况”之“3、核心技术人员”。

报告期各期末，公司研发人员数量及占公司员工总数的比例情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
员工总数（人）	602	443	303	295
研发人员人数（人）	91	80	55	45
研发人员占总员工人数比例	15.12%	18.06%	18.15%	15.25%
本科及以上学历研发人员人数（人）	80	72	49	40
本科及以上学历研发人员占全部研发人员的比例	87.91%	90.00%	89.09%	88.89%

公司的研发人员认定标准为直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的人员。主要包括：在研发部门及相关职能部门中直接从事研发项目的专业人员；具有相关技术知识和经验，在专业人员指导下参与研发活动的技术人员。对于既从事研发活动又从事非研发活动的人员，当期研发工时占比低于 50%的，不认定为研发人员。

2、核心技术人员相关情况及对公司的贡献

公司核心技术人员凭借扎实的专业知识、系统的学术训练以及丰富的研发实践经验，持续跟踪集成电路测试等领域的技术发展动态。核心技术人员的重要研发成果、获得奖项情况以及对公司研发的具体贡献如下：

姓名	学历背景构成、取得的专业资质、获得奖项情况	重要科研成果、对公司研发的贡献、认定为核心技术人员的依据
王强	本科学历，2000 年毕业于北京科技大学材料科学专业；拥有二十年以上封装测试消耗型硬件研发与产业化经验，为苏州市科技领军人才，个人累计获得授权专利 91 项，其中发明专利达 46 项	公司创始人，现任公司董事长，总经理； 1、主导确立了公司聚焦高性能产品、突破先进制程与高功率应用的核心技术路线； 2、领导规划并构建了从省级工程技术研究中心到企业技术中心的多层次研发平台体系； 3、领导了高频高速测试、大功率散热等前沿技术方案的立项与资源保障； 4、主导推动自主核心技术在高价值客户的验证与导入，实现了从技术突破到规模化商业落地的关键跨越； 5、从公司创立初期即高度重视知识产权布局，主导建立了系统化的专利管理体系，打造学习型组织与创新激励机制，持续提升整体团队的创新能力
金永斌	硕士学历，2001 年毕业于苏州大学机械设计与制造专业，并于 2012 年取得同济大学工商管理硕士；为苏州市紧缺人才、国家级制造业先进技术人才，具备二十年以上半导体测试技术研发与管理经验。其作为技术带头人，曾主持市级重点产业前瞻项目，获授权专利 110 项，累计获授权发明专利 65 项	公司研发负责人，现任公司副总经理； 1、主导建立了省级、市级集成电路芯片测试连接器工程技术研究中心及企业技术中心； 2、通过主导完成多家行业龙头企业的实验室研发项目，成功推动自主产品进入其供应链体系，实现了核心技术的市场验证与商业转化； 3、主持开发了支持超高频高速信号传输的芯片测试方案，并成功实现业内领先的超微间距同轴结构，其中晶圆级金属同轴测试座为首创； 4、带领团队完成了全系列探针的自主研发，建立了从设计仿真、零件验证到成品测试的全流程技术能力，形成了核心部件的自主可控； 5、负责公司专利体系的建设与管理，通过系统性的布局，建立了完善的知识产权保护体系，为公司的核心技术构筑了有效的专利壁垒
贺涛	本科学历，2006 年毕业于三峡大学机械设计制造及自动化专业；自 2008 年起专注于测试座领域，拥有近 20 年的行业积淀，在测试座的设计、制造与测试方面具备深厚经验，同时精通探针等精密连接技术的研发与应用	现任公司董事、副总经理，主管生产运营； 1、主导构建了公司常规测试座的设计规则与标准库，为此后的产品开发奠定了体系化基础； 2、主导完成了老化测试用精密探针从开发到验证的全流程，实现了微间距技术的重要突破； 3、深度参与了高频高速芯片同轴测试方案的开发，并主导了与之配套的各型同轴测试座制作工艺的研发与验证工作； 4、参与了大功率芯片测试散热与控温方案的开发，并主导建立了针对大功耗测试座的设计规则与标准库

3、发行人对核心技术人员实施的约束激励措施

为保障核心技术团队的稳定性并激发创新效能，公司建立了一套完整的制度体系。

在法律层面，公司与核心技术人员签署了《劳动合同书》与《保密及竞业限制协议》，明确了双方的权利义务，为长期合作提供了法律基础。在激励与绑定机制上，公司制定了明确的股权激励政策，对为公司发展做出重大贡献的员工或团队，公司以股权激励等方式实现个人与公司发展的深度契合。在研发与成果转化方面，公司通过《研究开发组织管理制度》《科技成果转化管理制度》等一系列规章，系统性地鼓励技术创新。制度明确规定设立发明创新奖励基金，每年根据项目的技术水平、经济效益予以奖励，并对科技成果进行定期评价与效益分配，从而有效促进新技术的研究开发与产业化应用。

公司通过上述法律、产权与管理制度的多重结合，为核心技术人员提供了清晰的职业发展路径和激励保障，为公司的持续创新能力奠定了坚实基础。

（四）发行人保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新安排

公司始终将技术创新作为提升核心竞争力的重要抓手，围绕下游客户需求和行业技术发展趋势，持续完善研发体系、加强人才建设并健全激励机制，保障公司技术能力和产品性能持续提升。具体如下：

1、坚持市场需求导向，持续推进产品研发

公司建立了贴近客户需求和行业发展趋势的研发机制，围绕集成电路测试领域对高速高频信号传输、高功率散热及精准温控以及高密度微间距精密接触等方面的要求，持续开展技术研发和产品优化。公司通过项目立项、方案评审、研发实施、样品验证及量产导入等流程，对研发项目进行全过程管理，确保研发方向与客户应用场景和产品迭代需求相匹配，推动研发成果及时转化为具有市场竞争力的产品。

2、加强研发人才建设，夯实技术创新基础

公司高度重视研发人才的引进和培养，持续引进和培养具备机械设计、材料工程及半导体测试应用经验的专业人才，并通过项目实践、内部培训及跨部门协作等方式，提升研发人员对下游应用场景和客户需求的理解能力。同时，公司注重核心技术人员和中青年技术骨干的培养，为公司持续开展技术创新和产品迭代提供稳定的人才支撑。

3、完善研发激励机制，保持团队稳定发展

公司建立了与技术创新成果、项目研发进度、产品转化效果及客户应用反馈相结合的研发激励机制，充分调动研发团队的创新积极性。公司通过持续完善薪酬激励及绩效

考核机制，有效增强了研发人员的归属感和稳定性，巩固了核心技术团队，为公司保持技术持续创新能力、提升产品竞争力及实现长期稳定发展提供了重要保障。

九、发行人安全生产及环境保护情况

（一）发行人生产经营中主要污染物及处理措施情况

公司所属行业不属于存在重污染情况的行业，日常生产经营活动主要产生少量废气、废水、固体废物和噪声。公司严格遵守环境保护方面的法律法规，生产经营过程中产生的主要污染物名称及相应处理措施如下：

1、废气

报告期内，公司废气主要为 CNC 机床加工环节产生的非甲烷总烃等。该环节使用切削液与水配比形成的混合液体，在机加工过程中受设备运转、工件加工及液体循环使用影响，会产生少量挥发性废气。公司已针对该类废气配套设置静电式油雾净化装置，经设备收集并净化处理后排放。公司相关废气处理措施能够满足处理要求，废气的处理及排放符合相关法律法规。

2、废水

报告期内，公司废水主要为一般生活污水，由市政污水管网接入园区污水处理厂，处理达标后排放。

3、固体废物

报告期内，公司固体废物主要包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾。危险废物产生于生产环节中，包括废切削液、废乳化液、废油桶、废抹布（无尘布）、废包装容器、废清洗化学溶剂等，公司已委托有相应危废处理资质的单位进行安全处置。一般工业固废主要为不合格品、废边角料、废包装等。公司针对一般工业固废制定了分类管理，收集后委托相关有资质单位进行处理。办公及日常生活垃圾由环卫公司清运、回收。公司固体废物的处置符合相关法律法规的要求。

4、噪声

报告期内，公司噪声主要由空压机房运转过程中产生，公司通过采取设备减振、厂房隔声以及厂区合理布局等措施，确保满足相关环境保护要求。

（二）发行人环保投入和环保设施实际运行情况

报告期内，公司严格按照环境保护相关法律法规及主管部门要求，结合生产经营过程中产生的污染物类型及排放特点，配置相应的污染防治设施并持续规范运行。报告期内，公司环保投入金额分别为 9.94 万元、10.34 万元、16.11 万元和 8.30 万元，主要为环保设施建设费用、环保设备购置费用、日常治污费用等。

（三）发行人的环境保护情况

报告期内，公司严格遵守环境保护各项法律法规和规范性文件，未发生环境污染事故，不存在因违反环境保护方面的法律法规和规范性文件而受到处罚的情形。

（四）发行人的安全生产情况

公司所处行业不属于高危行业。公司已建立完善的安全生产管理体系，制定并持续执行安全生产相关制度及操作规范，并通过定期开展安全生产培训，提升员工安全生产意识和规范操作水平。报告期内，公司生产经营活动安全、有序开展，不存在因违反安全生产相关法律法规而受到处罚的情形。

十、发行人境外经营情况

报告期内，公司主营业务收入中境外销售的金额分别为 2,010.91 万元、2,654.27 万元、4,201.68 万元和 2,374.89 万元，占主营业务收入比例分别为 8.92%、8.58%、7.73%和 5.40%。

第六节 财务会计信息与管理层分析

非经特别说明，本节所列公司财务数据，均依据经天健会计师审计的财务会计资料，或根据其中相关数据计算得出；本节所列同行业可比公司财务数据，均依据其公开披露的定期报告等资料，或根据其中相关数据计算得出。公司提示投资者关注和阅读财务报告及审计报告全文，以获取全部的财务会计信息。

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	**125,946,926.35**	75,635,597.29	48,400,139.34	27,018,013.45
交易性金融资产	**20,009,315.07**	39,007,753.94	78,600,035.15	84,145,825.80
应收票据	**33,507,474.82**	27,775,883.41	28,679,082.95	11,949,121.23
应收账款	**336,470,744.78**	289,237,684.08	139,169,093.26	76,805,905.05
应收款项融资	**74,709,925.20**	4,348,857.72	1,931,642.72	5,516,508.53
预付款项	**345,789.66**	122,830.65	472,872.83	266,170.71
其他应收款	**975,538.71**	742,612.59	501,988.46	532,297.76
存货	**154,297,944.47**	89,727,347.83	48,860,534.21	31,610,434.18
一年内到期的非流动资产	**10,888,260.28**	10,737,849.32	-	-
其他流动资产	**3,872,322.89**	1,858,711.81	892,986.73	598,425.18
流动资产合计	**761,024,242.23**	**539,195,128.64**	**347,508,375.65**	**238,442,701.89**
非流动资产：				
固定资产	**48,275,619.32**	42,127,620.33	25,154,908.46	15,715,573.01
在建工程	**-**	235,596.80	-	113,400.00
使用权资产	**9,630,634.35**	8,206,820.45	7,152,152.51	4,912,233.30
无形资产	**815,418.26**	882,274.76	908,681.33	264,444.54
长期待摊费用	**5,622,425.88**	3,853,796.07	3,170,325.25	2,717,061.61
递延所得税资产	**7,880,948.13**	6,346,615.89	3,858,367.57	3,064,680.16
其他非流动资产	**5,393,829.10**	1,320,050.00	150,089.70	771,892.85
非流动资产合计	**77,618,875.04**	**62,972,774.30**	**40,394,524.82**	**27,559,285.47**

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总计	**838,643,117.27**	**602,167,902.94**	**387,902,900.47**	**266,001,987.36**
流动负债：				
短期借款	**-**	8,523,598.10	12,748,491.67	3,970,615.50
应付账款	**227,420,019.74**	125,217,370.96	51,641,124.62	25,374,679.71
合同负债	**247,592.63**	1,255,647.87	123,937.46	162,477.87
应付职工薪酬	**14,647,870.05**	13,488,074.86	10,815,231.31	8,803,199.32
应交税费	**19,690,329.95**	19,069,735.92	7,279,834.78	4,246,560.30
其他应付款	**953,378.25**	736,523.79	604,014.56	558,129.86
一年内到期的非流动负债	**3,217,483.15**	2,275,053.33	2,404,168.91	1,457,056.63
其他流动负债	**16,387,490.72**	11,957,448.71	7,856,350.38	7,483,424.83
流动负债合计	**282,564,164.49**	**182,523,453.54**	**93,473,153.69**	**52,056,144.02**
非流动负债：				
租赁负债	**5,846,387.55**	5,272,114.47	4,409,353.22	3,002,358.24
预计负债	**-**	-	-	-
递延收益	**1,348,089.09**	1,398,089.09	517,846.81	448,047.79
递延所得税负债	**-**	-	-	-
非流动负债合计	**7,194,476.64**	**6,670,203.56**	**4,927,200.03**	**3,450,406.03**
负债合计	**289,758,641.13**	**189,193,657.10**	**98,400,353.72**	**55,506,550.05**
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	**39,000,000.00**	39,000,000.00	39,000,000.00	37,320,000.00
资本公积	**191,837,319.61**	186,199,849.20	175,203,449.08	159,554,901.08
盈余公积	**19,760,396.15**	19,760,396.15	7,136,168.54	1,180,438.43
未分配利润	**298,286,760.38**	168,014,000.49	68,162,929.13	12,440,097.80
所有者权益合计	**548,884,476.14**	**412,974,245.84**	**289,502,546.75**	**210,495,437.31**
负债和所有者权益总计	**838,643,117.27**	**602,167,902.94**	**387,902,900.47**	**266,001,987.36**

（二）合并利润表

单位：元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	**440,277,838.16**	**544,024,755.27**	**309,512,265.41**	**225,479,630.19**
其中：营业收入	**440,277,838.16**	544,024,755.27	309,512,265.41	225,479,630.19
二、营业总成本	**285,917,968.83**	**393,538,753.02**	**241,028,721.58**	**178,926,270.13**

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
其中：营业成本	244,657,308.72	335,709,048.67	198,386,274.60	142,820,889.74
税金及附加	2,015,602.17	3,350,175.44	2,066,773.29	1,923,605.10
销售费用	10,987,704.57	17,387,247.11	13,314,471.06	11,438,934.01
管理费用	11,758,461.64	15,763,271.31	13,817,862.39	12,293,620.23
研发费用	15,484,419.22	21,265,475.94	14,463,757.04	11,227,897.39
财务费用	1,014,472.51	63,534.55	-1,020,416.80	-778,676.34
加：其他收益	7,842,689.96	14,926,884.71	9,941,372.23	4,654,126.72
投资收益（损失以“-”号填列）	157,114.48	1,309,015.77	1,047,380.97	1,540,509.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,315.07	7,753.94	100,035.15	145,825.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,560,239.25	-7,665,189.87	-3,463,883.91	-761,642.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,072,013.73	-4,578,489.82	-4,556,931.33	-7,854,334.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,466.11	10,889.14	39,206.16	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,755,201.97	**154,496,866.12**	**71,590,723.10**	**44,277,845.06**
加：营业外收入	25,652.43	43,806.18	2,600.31	3,314.40
减：营业外支出	23,411.58	67,552.54	362,156.21	20,653.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,757,442.82	**154,473,119.76**	**71,231,167.20**	**44,260,505.86**
减：所得税费用	24,484,682.93	22,497,820.79	9,552,605.76	5,943,012.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,272,759.89	**131,975,298.97**	**61,678,561.44**	**38,317,493.40**
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,272,759.89	131,975,298.97	61,678,561.44	38,317,493.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类：				
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	130,272,759.89	131,975,298.97	61,678,561.44	38,317,493.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	130,272,759.89	**131,975,298.97**	**61,678,561.44**	**38,317,493.40**
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,272,759.89	131,975,298.97	61,678,561.44	38,317,493.40
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	**3.34**	3.38	1.63	1.03
（二）稀释每股收益	**3.34**	3.38	1.63	1.03

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	**347,796,128.74**	438,309,324.58	262,799,617.95	223,843,709.45
收到的税费返还	**-**	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	**4,043,162.26**	9,689,496.99	8,442,641.06	3,623,642.61
经营活动现金流入小计	**351,839,291.00**	**447,998,821.57**	**271,242,259.01**	**227,467,352.06**
购买商品、接受劳务支付的现金	**197,421,167.41**	279,520,513.09	165,637,003.66	108,104,230.16
支付给职工以及为职工支付的现金	**58,139,771.05**	78,678,774.04	64,807,648.64	55,066,783.15
支付的各项税费	**40,707,448.29**	38,408,518.26	22,145,716.09	23,547,964.80
支付其他与经营活动有关的现金	**7,395,546.50**	10,771,900.07	7,995,045.43	9,071,861.75
经营活动现金流出小计	**303,663,933.25**	**407,379,705.46**	**260,585,413.82**	**195,790,839.86**
经营活动产生的现金流量净额	**48,175,357.75**	**40,619,116.11**	**10,656,845.19**	**31,676,512.20**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	**221,000,000.00**	583,820,000.00	357,000,000.00	787,120,000.00
取得投资收益收到的现金	**359,548.28**	1,558,087.41	1,351,528.22	1,843,002.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	**29,000.00**	21,239.04	275,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	**807,417.00**	8,557,582.16	7,079,653.35	13,219,206.74
投资活动现金流入小计	**222,195,965.28**	**593,956,908.61**	**365,706,181.57**	**802,182,209.53**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	**20,870,530.66**	29,374,611.30	17,519,878.28	7,288,877.34
投资支付的现金	**182,000,000.00**	564,320,000.00	351,500,000.00	809,610,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	**1,380,000.00**	12,123,347.22	7,464,030.00	13,561,349.79
投资活动现金流出小计	**204,250,530.66**	**605,817,958.52**	**376,483,908.28**	**830,460,227.13**
投资活动产生的现金流量净额	**17,945,434.62**	**-11,861,049.91**	**-10,777,726.71**	**-28,278,017.60**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	**-**	-	11,256,000.00	-
取得借款收到的现金	**9,311,219.48**	8,483,135.50	12,654,806.14	3,949,910.02

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
筹资活动现金流入小计	**9,311,219.48**	**8,483,135.50**	**23,910,806.14**	**3,949,910.02**
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	19,500,000.00	-	25,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	**3,927,205.93**	3,718,089.31	2,873,154.45	2,431,485.60
筹资活动现金流出小计	**3,927,205.93**	**23,218,089.31**	**2,873,154.45**	**27,431,485.60**
筹资活动产生的现金流量净额	**5,384,013.55**	**-14,734,953.81**	**21,037,651.69**	**-23,481,575.58**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-1,769,889.51**	**-839,372.64**	**580,532.27**	**321,919.83**
五、现金及现金等价物净增加额	**69,734,916.41**	**13,183,739.75**	**21,497,302.44**	**-19,761,161.15**
加：期初现金及现金等价物余额	**53,828,811.70**	40,645,071.95	19,147,769.51	38,908,930.66
六、期末现金及现金等价物余额	**123,563,728.11**	**53,828,811.70**	**40,645,071.95**	**19,147,769.51**

二、审计意见、关键审计事项

（一）审计意见

天健会计师审计了公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日、**2026 年 6 月 30 日**的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度、2025 年度、**2026 年 1-6 月**的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

天健会计师认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日、**2026 年 6 月 30 日**的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度、2024 年度、2025 年度、**2026 年 1-6 月**的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）关键审计事项

关键审计事项是天健会计师根据职业判断，认为对 2023 年、2024 年度、2025 年度、**2026 年 1-6 月**财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，天健会计师不对这些事项单独发表意见。

1、收入确认

（1）事项描述

公司的营业收入主要来自于半导体封装测试消耗型硬件的销售，属于在某一时点履行的履约义务。2023 年度、2024 年度、2025 年度**和 2026 年 1-6 月**营业收入分别为

22,547.96 万元、30,951.23 万元、54,402.48 万元和 44,027.78 万元。

由于营业收入是公司的关键指标之一，可能存在公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，天健会计师将公司收入确认确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对收入确认，天健会计师实施的审计程序主要包括：

1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

3）按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

4）选取项目检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、送货（出库）单、报关单、提单、签收单、对账单、销售发票、销售回款凭证等；

5）结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；

6）对主要客户进行实地走访，核实与主要客户的业务往来情况；

7）对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

8）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2、存货计量

（1）事项描述

截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日及 2026 年 6 月 30 日，公司存货账面余额分别为 4,325.74 万元、6,052.63 万元、10,347.85 万元和 17,071.60 万元，跌价准备分别为 1,164.70 万元、1,166.58 万元、1,375.11 万元和 1,641.80 万元，账面价值分别为 3,161.04 万元、4,886.05 万元、8,972.73 万元和 15,429.79 万元。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，天健会计师将存货的计量确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对存货的计量，天健会计师实施的审计程序主要包括：

1）了解与采购、付款、生产、仓储相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2）获取公司与主要供应商的交易合同，并结合检查采购入库单、采购发票、记账凭证、付款审批及付款单等原始凭证，测试采购真实性和准确性；

3）向主要供应商实施函证程序，对报告期内的交易金额和往来余额进行确认；

4）对公司存货总体情况实施分析程序，结合同行业类似公司情况，分析存货周转率等指标波动的合理性；

5）检查主要产品生产领用等相关的支持性文件，包括销售订单、主要产品 BOM 表、主要材料领用单及销售出库单，检查存货成本结转准确性；

6）结合存货监盘，检查存货的数量，识别期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧的材料及产品，评价管理层就存货可变现净值所作估计的合理性；对期末发出商品实施函证程序，并选取样本检查出库单、送货单、期后结转销售收入资料等；

7）获取公司存货跌价准备计算表，复核计算存货可变现净值，分析存货跌价准备计提是否合理；

8）检查与存货计量相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（三）重要性标准确定方法和选择依据

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，公司财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

涉及重要性标准判断的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的投资活动现金流量	公司将单项金额超过资产总额 5%的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量

三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况

（一）财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用

指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础编制。公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响公司持续经营能力的事项。

（二）合并报表范围及变化情况

报告期内，公司合并财务报表范围内的合并主体具体如下：

1、报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司名称	持股比例（%）	
		直接	间接
1	法特迪电子科技（苏州）有限公司	100.00	-
2	蓝泽半导体科技（芜湖）有限公司	100.00	-

2、报告期内合并财务报表范围变化

报告期内，合并财务报表范围未发生变化。

四、分部信息

公司是半导体封装测试消耗型硬件解决方案提供商，公司将此业务视作一个整体实施管理、评估经营成果。公司主营业务收入的构成和地区分布等情况详见本节“九、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”。

五、主要会计政策及会计估计

（一）收入

1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有

不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4） 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3、收入确认的具体方法

本公司与客户之间的销售商品合同，属于在某一时点履行履约义务。公司产品销售分境内销售和境外销售。

（1）境内销售

若合同未约定验收条款，公司在产品发出并经客户签收后确认收入；若合同约定了验收条款，公司于产品移交给客户，并经客户验收合格后确认收入；若合同约定了验收异议期，客户在签收后一定期限内未提出书面异议的，视为验收合格，公司于达到合同约定的验收异议期限后确认收入。

（2）境外销售

在 DAP、DDP 等结算条款下，公司将货物运送至客户指定地点并取得签收单或通过其他方式提供的签收证明文件时确认销售收入；在 FCA、FOB 等结算条款下，公司货物完成出口报关时确认销售收入；在 EXW 结算条款下，在公司厂区内交货，于客户已提货且签署交接单据后确认收入。

（二）应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	40.00	40.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

（三）存货

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（四）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
通用设备	年限平均法	3	5-10	31.67-30.00
专用设备	年限平均法	5-10	5-10	19.00-9.00

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	年限平均法	4	5-10	23.75-22.50

（五）职工薪酬

1、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利

2、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并

计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（六）政府补助

1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（七）租赁

1、公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）承租人发生的初始直接费用；4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、

用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

（八）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。

公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对 2023 年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下：

单位：元

受影响的报表项目	2023 年度（合并）		2023 年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
营业成本	136,563,236.00	142,820,889.74	138,976,667.36	145,234,321.10
销售费用	17,696,587.75	11,438,934.01	17,685,093.20	11,427,439.46

2、重要会计估计变更

报告期内，公司不存在对财务状况和经营成果产生重大影响的重大会计估计变更。

六、非经常性损益情况

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的规定，经天健会计师出具的《关于苏州法特迪科技股份有限公司最近三年**及一期**非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2026〕**17721** 号）鉴证，报告期内公司非经常性损益的具体内容、金额以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额如下表所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	**1.85**	0.96	-13.50	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	**279.79**	865.31	644.89	282.62

项目	2026年1-6月	2025年度	2024年度	2023年度
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	**36.11**	146.58	122.92	169.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	**0.22**	-2.24	-18.54	-1.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	**-**	-	-124.28	1.42
小计	**317.98**	**1,010.60**	**611.50**	**451.75**
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	**47.76**	152.90	91.57	67.43
归属于母公司股东的非经常性损益净额	**270.22**	**857.70**	**519.93**	**384.33**

报告期内，公司非经常性损益主要包括计入当期损益的政府补助、金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等。报告期各期，公司归属于公司普通股股东的非经常性损益净额占公司归属于母公司股东的净利润的比例为10.03%、8.43%、6.50%及**2.07%**，占比相对较小，对公司经营成果不存在重大影响，公司盈利能力对非经常性损益不存在重大依赖。

七、税项

（一）公司主要税种和税率

报告期内，公司合并范围内各纳税主体适用的主要税种和税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%；出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

（二）税收优惠

1、企业所得税

（1）高新技术企业税收优惠

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局2022年11月18日颁发的证书编号为GR202232006145的《高新技术企业证书》，公司被认定为高

新技术企业，按照税法规定 2022-2024 年减按 15%的税率计缴企业所得税。根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局 2025 年 11 月 18 日颁发的证书编号为 GR202532002512 的《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技术企业，按照税法规定 2025-2027 年减按 15%的税率计缴企业所得税。故报告期内公司适用高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

根据安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局 2024 年 11 月 28 日颁发的证书编号为 GR202434004488 的《高新技术企业证书》，子公司蓝泽科技被认定为高新技术企业，按照税法规定 2024-2026 年减按 15%的税率计缴企业所得税。

2024 年度蓝泽科技被认定为高新技术企业的同时符合小型微利企业认定条件，在汇算清缴时自主选择了税负更低的小型微利企业优惠政策。

蓝泽科技 2025 年度**及 2026 年 1-6 月**研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例未达到《高新技术企业认定管理办法》规定的要求，2025 年度**及 2026 年 1-6 月**暂不满足享受高新技术企业所得税优惠税率的条件，按 25%的税率计缴企业所得税。

（2）企业所得税加计扣除优惠

根据《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》（财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部公告 2023 年第 44 号）的相关规定，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 220%在税前摊销。公司 2023 至 2024 年度享受该优惠政策。

（3）小微企业税收优惠

根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策。子公司法特迪电子享受小微企业税收减免，2023 至 **2026 年 6 月**其所得减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；子公司蓝泽科技享受小微企业税收减免，2023 至 2024 年度其所得减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所

得税。

2、增值税

根据财政部、税务总局《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号）相关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路企业按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。公司及子公司蓝泽科技享受进项税额加计抵减政策。

3、其他优惠

根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。子公司法特迪电子 2023 至 **2026 年 6 月**享受小微企业税收减免，子公司蓝泽科技 2023 至 2024 年度享受小微企业税收减免。

八、主要财务指标

（一）基本财务指标

主要财务指标	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
流动比率（倍）	**2.69**	2.95	3.72	4.58
速动比率（倍）	**2.15**	2.46	3.20	3.97
资产负债率（合并）	**34.55%**	31.42%	25.37%	20.87%
资产负债率（母公司）	**38.10%**	36.64%	33.08%	31.51%
应收账款周转率（次）	**2.67**	2.41	2.72	2.99
存货周转率（次）	**3.57**	4.09	3.82	3.23
息税折旧摊销前利润（万元）	**16,362.06**	16,666.27	8,026.39	5,216.00
归属于母公司股东的净利润（万元）	**13,027.28**	13,197.53	6,167.86	3,831.75
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	**12,757.06**	12,339.83	5,647.92	3,447.42
利息保障倍数（倍）	**573.31**	420.40	167.24	197.23

主要财务指标	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
研发投入占营业收入比例	**3.52%**	3.91%	4.67%	4.98%
每股经营活动产生的现金流量（元）	**1.24**	1.04	0.27	0.85
每股净现金流量（元）	**1.79**	0.34	0.55	-0.53
归属于母公司股东的每股净资产（元）	**14.07**	10.59	7.42	5.64

注 1：流动比率＝流动资产/流动负债；
注 2：速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；
注 3：资产负债率＝（总负债/总资产）×100%；
注 4：应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额，**其中 2026 年 1-6 月已年化处理**；
注 5：存货周转率＝营业成本/存货平均余额，**其中 2026 年 1-6 月已年化处理**；
注 6：息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息费用+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
注 7：利息保障倍数＝（利润总额+利息费用）/利息费用；
注 8：每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
注 9：每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；
注 10：归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末普通股股份总数。

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，报告期内，公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益具体如下：

项目	期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	**2026 年 1-6 月**	**27.09%**	**3.34**	**3.34**
	2025 年度	37.57%	3.38	3.38
	2024 年度	24.95%	1.63	1.63
	2023 年度	18.69%	1.03	1.03
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	**2026 年 1-6 月**	**26.53%**	**3.27**	**3.27**
	2025 年度	35.13%	3.16	3.16
	2024 年度	22.85%	1.50	1.50
	2023 年度	16.81%	0.92	0.92

九、经营成果分析

（一）营业收入分析

1、营业收入构成及变动分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

产品名称	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	**43,988.01**	**99.91%**	54,368.05	99.94%	30,939.03	99.96%	22,541.92	99.97%
其他业务收入	**39.77**	**0.09%**	34.43	0.06%	12.19	0.04%	6.04	0.03%
合计	**44,027.78**	**100.00%**	**54,402.48**	**100.00%**	**30,951.23**	**100.00%**	**22,547.96**	**100.00%**

报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务，主营业务收入占营业收入的比例保持在 99%以上，主营业务突出。公司其他业务收入为废料销售，占营业收入的比重较小。

2、主营业务收入构成及变动分析

报告期内，公司主营业务收入按业务类别列示如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
测试座	**38,553.68**	**87.65%**	47,242.66	86.89%	25,946.31	83.86%	18,845.29	83.60%
封测接口组件	**3,707.86**	**8.43%**	5,545.25	10.20%	3,807.14	12.31%	2,600.01	11.53%
其他	**1,726.47**	**3.92%**	1,580.15	2.91%	1,185.59	3.83%	1,096.63	4.86%
总计	**43,988.01**	**100.00%**	**54,368.05**	**100.00%**	**30,939.03**	**100.00%**	**22,541.92**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务收入主要来源于测试座、封测接口组件的销售收入，其他主要系配套的原材料销售。

（1）测试座

报告期内，公司测试座收入按产品列示如下：

单位：万元

测试座	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
功能测试座	**5,220.53**	**13.54%**	9,754.54	20.65%	9,180.33	35.38%	8,543.21	45.33%
老化测试座	**29,381.69**	**76.21%**	29,876.84	63.24%	11,278.62	43.47%	5,116.33	27.15%

测试座	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
探针	**2,733.03**	**7.09%**	5,873.22	12.43%	4,086.67	15.75%	3,715.36	19.72%
测试座配件	**1,218.43**	**3.16%**	1,738.05	3.68%	1,400.69	5.40%	1,470.38	7.80%
总计	**38,553.68**	**100.00%**	**47,242.66**	**100.00%**	**25,946.31**	**100.00%**	**18,845.29**	**100.00%**

报告期内，公司测试座主要产品包括功能测试座、老化测试座及探针，前述三类细分产品合计收入分别为 17,374.91 万元、24,545.61 万元、45,504.61 万元**及 37,335.25 万元**，占当期测试座收入的比例分别为 92.20%、94.60%、96.32%**及 96.84%**。

1）功能测试座

报告期内，公司功能测试座的数量、单价及销售收入变动情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	数值	数值	变动	数值	变动	数值
收入（万元）	**5,220.53**	9,754.54	6.25%	9,180.33	7.46%	8,543.21
单价（元/套）	**5,314.60**	4,694.65	0.47%	4,672.87	5.06%	4,447.74
数量（套）	**9,823**	20,778	5.76%	19,646	2.28%	19,208

报告期内，公司功能测试座销量及单价整体稳步增长，推动业务收入持续增长。销量方面，依托公司长期的技术积淀、优异的产品性能及稳定的量产交付能力，公司功能测试座产品市场认可度持续提升，下游客户复购需求稳步释放，带动销量逐年增长。单价方面，随着芯片性能持续提升，功能测试座在更高速频率信号、更高引脚密度、更小探针间距及更复杂的系统级测试环境下保持信号传输完整性与接触稳定性等方面的要求持续提升，公司持续推动产品结构优化，产品平均单价稳步上行。

2）老化测试座

报告期内，公司老化测试座的数量、单价及销售收入变动情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	数值	数值	变动	数值	变动	数值
收入（万元）	**29,381.69**	29,876.84	164.90%	11,278.62	120.44%	5,116.33
单价（元/套）	**5,648.91**	4,912.18	19.49%	4,110.88	168.57%	1,530.64
数量（套）	**52,013**	60,822	121.69%	27,436	-17.92%	33,426

近年来，随着 AI 等前沿应用快速发展，芯片的性能、复杂度和单颗价值量持续提升，对芯片早期失效筛选、极端工况验证和长期稳定性测试的重视程度持续提升，芯片

老化测试逐步由传统抽样筛检向更高比例测试乃至全检方向发展。在此背景下，一方面，老化测试座在高功率承载、精准温控、长期稳定性和多工位一致性等方面性能要求大幅提升，行业门槛显著提高，老化测试座产品的单价和附加值大幅提升；另一方面，AI 算力芯片、手机 SoC、车规级芯片等高性能芯片高速发展，以及老化测试全检化的发展趋势，带动老化测试座需求快速增长。

2024 年，公司老化测试座收入同比大幅增长，主要原因系产品销售单价大幅提升。在上述行业发展趋势下，公司老化测试座产品结构持续升级，推动产品单价大幅增长 168.57%，进而拉动老化测试座产品收入大幅增长。销量方面，2024 年公司优先保障高附加值老化测试座产品排产交付，进而导致当期销量有所下降。

2025 年，公司老化测试座产品收入进一步大幅增长，主要得益于销量显著提升。在上述行业发展趋势下，公司一方面凭借前瞻的老化测试技术布局与过硬的产品竞争力，先期导入头部客户供应链体系并持续深化合作，另一方面进行扩产进一步提升公司交付能力，伴随着下游手机 SoC、AI 算力芯片等高性能芯片的放量，公司顺利获取大批量订单，推动当期销量同比大幅增长 121.69%。价格方面，公司老化测试座产品结构持续升级，推动产品单价稳步增长 19.49%。

2026 年 1—6 月，公司老化测试座产品收入持续维持高增长态势，主要系销量及平均销售单价均有所提升。销量方面，受 AI 算力芯片及手机 SoC 等下游需求增长，下游客户需求保持旺盛；同时，基于公司前期与头部客户较多的项目导入及稳固的合作关系，公司在 2026 年 1-6 月持续取得相关头部客户的批量订单，导致公司销售规模持续提升。价格方面，随着高功率、高密度、高引脚数及精准温控等高性能老化测试座销售占比进一步提升，推动平均销售单价较 2025 年度增长 15.00%。

3）探针

报告期内，公司探针的数量、单价及销售收入变动情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	数值	数值	变动	数值	变动	数值
收入（万元）	**2,733.03**	5,873.22	43.72%	4,086.67	9.99%	3,715.36
单价（元/根）	**12.36**	11.87	5.42%	11.26	-11.76%	12.76
数量（万根）	**221.14**	494.70	36.30%	362.95	24.68%	291.11

2023-2025 年，公司探针产品销售收入分别为 3,715.36 万元、4,086.67 万元及 5,873.22

万元，分别同比增长 9.99%、43.72%，收入增长主要系产品销量增加。探针系实现待测芯片与测试设备之间信号传输的关键部件，在反复测试接触过程中易发生磨损，使用性能逐步下降，进而影响芯片测试结果的准确性。下游客户为保障测试精度，在购置测试座后，需结合探针损耗情况进行定期更换。随着公司测试座销售规模持续增长，探针作为配套必备耗材，采购需求同步提升，推动探针销售收入逐年上涨。

销售单价方面，报告期内探针产品单价存在波动，主要系各期产品结构变动所致。

（2）封测接口组件

报告期内，公司封测接口组件收入按产品列示如下：

单位：万元

封测接口组件	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
分选换型套件	**2,351.76**	**63.43%**	3,324.53	59.95%	2,191.28	57.56%	1,381.79	53.15%
测试接口连接模组	**918.13**	**24.76%**	1,473.76	26.58%	1,147.17	30.13%	1,056.64	40.64%
封测接口组件配件	**437.97**	**11.81%**	746.95	13.47%	468.69	12.31%	161.58	6.21%
总计	**3,707.86**	**100.00%**	**5,545.25**	**100.00%**	**3,807.14**	**100.00%**	**2,600.01**	**100.00%**

公司封测接口组件主要产品包括分选换型套件及测试接口连接模组，系连接测试座、测试机、分选机及待测芯片的重要协同部件。报告期内，随着下游客户需求持续增长及公司持续市场拓展，公司分选换型套件、测试接口连接模组等封测接口组件产品收入持续增长。

3、主营业务收入地区分布分析

报告期内，公司主营业务收入按地区分布列示如下：

单位：万元

区域	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内销售	**41,613.12**	**94.60%**	50,166.37	92.27%	28,284.77	91.42%	20,531.01	91.08%
境外销售	**2,374.89**	**5.40%**	4,201.68	7.73%	2,654.27	8.58%	2,010.91	8.92%
总计	**43,988.01**	**100.00%**	**54,368.05**	**100.00%**	**30,939.03**	**100.00%**	**22,541.92**	**100.00%**

报告期内，公司营业收入主要来源于内销业务，报告期各期境内收入占主营业务收入比例分别为 91.08%、91.42%、92.27%和 94.60%。与此同时，公司持续开拓全球市场，境外销售收入保持持续增长。

4、主营业务收入季度变动分析

报告期内，公司主营业务收入季度分布列示如下：

单位：万元

季度	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	**18,449.79**	**41.94%**	6,944.01	12.77%	4,690.87	15.16%	4,734.48	21.00%
第二季度	**25,538.22**	**58.06%**	10,416.70	19.16%	7,146.64	23.10%	6,017.36	26.69%
第三季度	-	-	17,225.74	31.68%	11,160.11	36.07%	6,596.88	29.26%
第四季度	-	-	19,781.60	36.38%	7,941.41	25.67%	5,193.19	23.04%
总计	**43,988.01**	**100.00%**	**54,368.05**	**100.00%**	**30,939.03**	**100.00%**	**22,541.92**	**100.00%**

2023-2025 年，公司整体呈现上半年需求偏弱，下半年需求旺盛的季节性特征，主要系下游芯片设计公司、封测服务企业等通常于年初启动年度项目规划工作后集中组织供应商对接、同步采购需求并完成内部项目立项审批，后续供应商陆续投入生产和交付，因此公司下半年的收入占比较高。**2026 年 1-6 月，随着公司产品需求及行业景气度的持续提升，公司收入大幅高于同期水平。**

（二）营业成本分析

1、营业成本构成情况

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

产品名称	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	**24,465.73**	**100.00%**	33,570.90	100.00%	19,838.63	100.00%	14,282.09	100.00%
其他业务成本	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	**24,465.73**	**100.00%**	**33,570.90**	**100.00%**	**19,838.63**	**100.00%**	**14,282.09**	**100.00%**

报告期内，公司营业成本均来自主营业务，营业成本结构与营业收入结构相匹配。

2、主营业务成本构成及变动分析

报告期内，公司主营业务成本的项目构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	**19,034.64**	**77.80%**	25,360.29	75.54%	13,228.51	66.68%	8,994.88	62.98%
直接人工	**1,649.09**	**6.74%**	2,628.77	7.83%	2,237.06	11.28%	1,663.38	11.65%
制造费用	**2,754.51**	**11.26%**	4,280.89	12.75%	3,618.10	18.24%	2,998.06	20.99%
售后服务费	**1,027.49**	**4.20%**	1,300.95	3.88%	754.96	3.81%	625.77	4.38%
合计	**24,465.73**	**100.00%**	**33,570.90**	**100.00%**	**19,838.63**	**100.00%**	**14,282.09**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用和售后服务费构成。其中，直接材料主要包括探针、结构部件、结构部件材料及电气及温控部件等，直接人工主要为生产人员的职工薪酬，制造费用包括与生产相关的管理及辅助人员的职工薪酬、设备折旧费用等，售后服务费主要为遵循企业会计准则要求预提的产品质保费用。

（三）毛利及毛利率分析

1、营业毛利构成情况

报告期内，公司营业毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	**19,522.28**	**99.80%**	20,797.14	99.83%	11,100.41	99.89%	8,259.83	99.93%
其他业务	**39.77**	**0.20%**	34.43	0.17%	12.19	0.11%	6.04	0.07%
合计	**19,562.05**	**100.00%**	**20,831.57**	**100.00%**	**11,112.60**	**100.00%**	**8,265.87**	**100.00%**

报告期内，公司的营业毛利主要来自主营业务，营业毛利的规模增长与主营业务收入的变动趋势保持匹配，凸显了公司突出的主业盈利能力。

2、主营业务毛利的产品构成及变动分析

报告期内，公司主营业务毛利按业务类别列示如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
测试座	**17,268.90**	**88.46%**	18,229.83	87.66%	9,247.67	83.31%	7,267.44	87.99%
封测接口组件	**1,289.93**	**6.61%**	1,807.87	8.69%	1,311.52	11.82%	553.98	6.71%
其他	**963.44**	**4.94%**	759.44	3.65%	541.21	4.88%	438.40	5.31%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
总计	19,522.28	100.00%	20,797.14	100.00%	11,100.41	100.00%	8,259.83	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利整体呈持续增长趋势，其变动趋势与主营业务收入基本一致。各产品类别毛利构成与主营业务收入结构存在一定差异，主要系不同产品类别毛利率存在差异所致。

3、主营业务毛利率的产品构成及变动分析

报告期各期，公司各产品类别毛利率及收入占比情况如下：

产品分类	产品名称	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		毛利率	主营业务收入占比	毛利率	主营业务收入占比	毛利率	主营业务收入占比	毛利率	主营业务收入占比
测试座	功能测试座	51.48%	11.87%	47.64%	17.94%	44.79%	29.67%	45.35%	37.90%
	老化测试座	42.63%	66.79%	33.29%	54.95%	22.78%	36.45%	15.69%	22.70%
	探针	48.52%	6.21%	47.74%	10.80%	47.10%	13.21%	52.18%	16.48%
	测试座配件	59.92%	2.77%	47.83%	3.20%	45.84%	4.53%	44.34%	6.52%
	小计	44.79%	87.65%	38.59%	86.89%	35.64%	83.86%	38.56%	83.60%
封测接口组件		34.79%	8.43%	32.60%	10.20%	34.45%	12.31%	21.31%	11.53%
其他		55.80%	3.92%	48.06%	2.91%	45.65%	3.83%	39.98%	4.86%
总计		44.38%	100.00%	38.25%	100.00%	35.88%	100.00%	36.64%	100.00%

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 36.64%、35.88%、38.25%和 44.38%，主营业务毛利率变动主要系产品结构变动、细分产品毛利率变动等综合影响所致。公司主要产品的毛利率具体分析如下：

（1）功能测试座

报告期内，公司功能测试座的单价、单位成本及毛利率情况如下：

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度
	数值	变动	数值	变动	数值	变动	数值
单价（元/套）	5,314.60	13.21%	4,694.65	0.47%	4,672.87	5.06%	4,447.74
单位成本（元/套）	2,578.65	4.91%	2,457.94	-4.73%	2,579.89	6.13%	2,430.78
毛利率	51.48%	3.84%	47.64%	2.85%	44.79%	-0.56%	45.35%

2023-2026 年 1-6 月，公司功能测试座产品的毛利率分别为 45.35%、44.79%、47.64%

和 51.48%，持续保持较高水平。

（2）老化测试座

报告期内，公司老化测试座的单价、单位成本及毛利率情况如下：

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度
	数值	变动	数值	变动	数值	变动	数值
单价（元/套）	**5,648.91**	**15.00%**	4,912.18	19.49%	4,110.88	168.57%	1,530.64
单位成本（元/套）	**3,240.83**	**-1.10%**	3,276.74	3.22%	3,174.51	145.98%	1,290.56
毛利率	**42.63%**	**9.34%**	33.29%	10.52%	22.78%	7.09%	15.69%

2023-**2026 年 1-6 月**，公司老化测试座产品的毛利率分别为 15.69%、22.78%、33.29%**及 42.63%**，呈现持续增长趋势，主要原因系随着 AI 算力芯片、手机 SoC、车规级芯片等高性能芯片的复杂度和老化测试要求持续提升，老化测试座产品在高功率承载、精准温控、长期稳定性和多工位一致性等方面性能要求大幅提升，行业门槛显著提高，公司老化测试座产品结构持续向高技术壁垒、高附加值方向升级，带动单价持续提升；高性能产品所需的原材料耗用及工艺投入亦有所增加，推动了单位成本上涨；但整体而言，**2025 年以来，随着规模效应的推动、生产工艺及生产效率的提升，公司单位人工及单位制造费用被摊薄，最终呈现**单位售价上涨幅度大于单位成本上涨幅度，推动老化测试座产品毛利率持续提升。

（3）探针

报告期内，公司探针的单价、单位成本及毛利率情况如下：

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度
	数值	变动	数值	变动	数值	变动	数值
单价（元/根）	**12.36**	**4.12%**	11.87	5.42%	11.26	-11.76%	12.76
单位成本（元/根）	**6.36**	**2.61%**	6.20	4.03%	5.96	-2.30%	6.10
毛利率	**48.52%**	**0.78%**	47.74%	0.65%	47.10%	-5.09%	52.18%

2024 年，公司探针产品毛利率较 2023 年有所下降，主要原因系一方面伴随公司老化测试座产品销售规模增长，单价偏低的老化探针配套销售占比提升拉低了探针整体单价；另一方面探针系测试座配套易耗品，产品客户黏性较强，为深化战略合作、稳固客户资源，公司适度下调探针售价。

2025 年**及 2026 年 1-6 月**，公司探针产品毛利率整体较为稳定。

4、同行业可比公司毛利率对比

报告期内，公司与同行业可比公司的综合毛利率对比具体对比如下：

可比公司	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
Yamaichi	**46.24%**	**40.62%**	38.63%	30.49%
WinWay	**40.47%**	45.26%	43.70%	37.06%
Enplas	**48.50%**	**45.50%**	45.89%	44.98%
韬盛科技	/	36.79%	35.99%	34.96%
平均值	**45.07%**	**42.04%**	**41.05%**	**36.87%**
法特迪	**44.43%**	**38.29%**	**35.90%**	**36.66%**

注 1：**因韬盛科技未披露 2025 年全年财务数据，上表中其 2025 年度相关指标系取自其 2025 年半年报数据，并进行年化处理；**

注 2：Yamaichi 及 Enplas 为日本公司，报告期为当年 4 月 1 日至次年 3 月 31 日。

报告期各期，公司综合毛利率分别为 36.66%、35.90%、38.29%**和 44.43%**，与境内可比公司韬盛科技不存在重大差异，但整体低于境外可比公司 Yamaichi、WinWay 及 Enplas，主要系技术商业化沉淀周期、品牌溢价能力及市场战略扩张阶段不同所致。

Yamaichi、WinWay、Enplas 等全球领先企业凭借较早的技术投入和全球化布局，在测试座领域形成先发优势和品牌护城河，通过长期市场积累与客户深度绑定，具备较强定价权，能够维持较高毛利率水平。而公司作为本土快速崛起的代表企业，在核心技术积累和全球品牌影响力方面仍处于提升阶段；为加快国产替代进程，公司持续加大投入，产品性能逐步向国际先进水平靠拢，并采取更具竞争力的渗透定价策略，以高性价比优势拓展市场。**随着发行人产品逐步往高端化演进，叠加规模效应对成本的摊薄以及工艺优化带来的效率提升，发行人综合毛利率于 2025 年及 2026 年上半年逐步增长，2026 年上半年已接近境外可比公司平均水平。**

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	**1,098.77**	**2.50%**	1,738.72	3.20%	1,331.45	4.30%	1,143.89	5.07%
管理费用	**1,175.85**	**2.67%**	1,576.33	2.90%	1,381.79	4.46%	1,229.36	5.45%
研发费用	**1,548.44**	**3.52%**	2,126.55	3.91%	1,446.38	4.67%	1,122.79	4.98%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
财务费用	101.45	0.23%	6.35	0.01%	-102.04	-0.33%	-77.87	-0.35%
合计	3,924.51	8.91%	5,447.95	10.01%	4,057.57	13.11%	3,418.18	15.16%

注：上表中占比为占同期营业收入的比例。

报告期内，公司期间费用合计金额分别为 3,418.18 万元、4,057.57 万元、5,447.95 万元及 3,924.51 万元，占当期营业收入的比例分别为 15.16%、13.11%、10.01%及 8.91%。随着公司业务规模增长，规模经济效应逐步显现，公司期间费用率呈现逐年下降的趋势。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用明细如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	591.48	53.83%	932.91	53.65%	801.89	60.23%	702.75	61.44%
股份支付费用	141.80	12.91%	283.61	16.31%	108.39	8.14%	20.78	1.82%
业务招待费	114.87	10.45%	165.79	9.54%	165.25	12.41%	176.75	15.45%
差旅费用	81.05	7.38%	143.35	8.24%	126.00	9.46%	131.89	11.53%
样品费	120.30	10.95%	102.55	5.90%	75.65	5.68%	66.13	5.78%
其他	49.26	4.48%	110.51	6.36%	54.26	4.08%	45.59	3.99%
合计	1,098.77	100.00%	1,738.72	100.00%	1,331.45	100.00%	1,143.89	100.00%

报告期各期，公司销售费用分别为 1,143.89 万元、1,331.45 万元、1,738.72 万元和 1,098.77 万元，主要由职工薪酬、股份支付费用、业务招待费、差旅费用及样品费等构成。随着公司销售团队规模、市场开拓力度加大及销售规模的增长，职工薪酬、样品费等销售费用金额整体呈上升趋势；但得益于业绩的快速释放及显著的规模效应，公司销售费用率呈下降趋势。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用明细如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	633.22	53.85%	775.59	49.20%	696.55	50.41%	584.22	47.52%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
折旧与摊销	**94.15**	**8.01%**	226.93	14.40%	184.84	13.38%	197.34	16.05%
办公费用	**144.30**	**12.27%**	191.80	12.17%	122.14	8.84%	120.39	9.79%
股份支付费用	**80.13**	**6.81%**	143.10	9.08%	190.10	13.76%	27.19	2.21%
中介机构服务费	**59.63**	**5.07%**	68.41	4.34%	75.81	5.49%	177.91	14.47%
业务招待费	**105.13**	**8.94%**	62.76	3.98%	24.86	1.80%	45.11	3.67%
差旅费用	**30.71**	**2.61%**	54.66	3.47%	46.32	3.35%	35.56	2.89%
其他	**28.59**	**2.43%**	53.08	3.37%	41.18	2.98%	41.64	3.39%
合计	**1,175.85**	**100.00%**	**1,576.33**	**100.00%**	**1,381.79**	**100.00%**	**1,229.36**	**100.00%**

报告期各期，公司管理费用分别为 1,229.36 万元、1,381.79 万元、1,576.33 万元**和 1,175.85 万元**，主要由职工薪酬、办公费用、中介机构服务费等构成，随着公司业务规模扩张，整体呈上升趋势。

3、研发费用

（1）研发费用构成及变动分析

报告期内，公司研发费用明细如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	**990.89**	**63.99%**	1,284.96	60.42%	950.90	65.74%	697.98	62.17%
直接投入	**296.10**	**19.12%**	414.49	19.49%	213.17	14.74%	203.38	18.11%
股份支付费用	**109.35**	**7.06%**	199.14	9.36%	78.12	5.40%	24.47	2.18%
折旧摊销	**86.62**	**5.59%**	129.00	6.07%	122.29	8.45%	109.24	9.73%
其他	**65.48**	**4.23%**	98.97	4.65%	81.90	5.66%	87.72	7.81%
合计	**1,548.44**	**100.00%**	**2,126.55**	**100.00%**	**1,446.38**	**100.00%**	**1,122.79**	**100.00%**

报告期内，公司研发费用分别为 1,122.79 万元、1,446.38 万元、2,126.55 万元**和 1,548.44 万元**，呈快速增长趋势，2023-2025 年研发投入复合增长率为 37.62%。报告期内，公司的研发费用主要由职工薪酬、直接投入及股份支付构成，合计占比接近 90%。

报告期内，公司研发费用中的职工薪酬分别为 697.98 万元、950.90 万元、1,284.96 万元**和 990.89 万元**，呈现显著增长态势，主要系：一方面，公司大力开展研发活动，

持续推进新技术或新产品迭代，研发团队规模持续扩充；另一方面，公司高度重视研发核心团队建设，报告期内陆续引入优秀的高端研发人才，并匹配了具有竞争力的薪酬体系。

报告期内，公司研发费用中的直接投入主要为研发耗用物料，报告期各期金额分别为 203.38 万元、213.17 万元、414.49 万元**和 296.10 万元**，呈持续增长趋势，主要系报告期内公司研发项目数量增加，针对高性能测试座等产品的研发复杂程度和试错成本提升，导致研发验证阶段所需的物料消耗量增加。

（2）研发费用对应的研发项目情况

报告期内，公司主要研发项目（研发预算超过 100 万元且报告期内累计投入超过 100 万元的项目）情况如下：

单位：万元

项目	总预算	报告期投入金额	截至 2026 年 6 月末研发进度
针对 AI HPC 芯片及裸芯片测试座及可靠性测试方案的开发	2,000.00	**1,176.88**	在研
无烤箱模块化老化测试模块的开发	520.00	510.89	**已结项**
适用于多晶粒 SIP 系统封装金属同轴测试座的开发	750.00	481.07	已结项
针对高功率高脚数芯片水冷式老化测试座的开发	350.00	252.76	**已结项**
针对大功率芯片老化温控模块的开发	230.00	227.91	**已结项**
针对高频无源芯片测试座及测试方案的开发	234.00	217.46	**已结项**
针对大功率芯片风冷式老化测试座的开发	251.00	171.11	已结项
标准化小功率老化座的开发	176.00	144.76	**已结项**
针对小间距封装芯片同轴异形孔灌胶工艺的开发	223.00	136.21	已结项
小间距同轴结构设计的开发	150.00	133.31	**已结项**
针对射频芯片低容抗、低感抗测试座的开发	144.00	128.91	已结项
多控与高功率自动化水循环三温测试方案的开发	450.00	126.89	已结项
老化测试专用探针的开发	171.00	120.85	已结项
独立温控老化测试方案的开发	180.00	106.93	已结项
高功率老化测试座的开发	152.00	106.41	已结项
标准化注塑成型老化座的开发	200.00	106.27	已结项
高密度互联芯片测试载板的开发	**400.00**	**283.80**	在研

项目	总预算	报告期投入金额	截至 2026 年 6 月末研发进度
宽温区芯片测试温控与三温控制模块的开发	400.00	216.29	在研
针对大功耗（2,000W+）算力芯片老化测试座的开发	350.00	154.15	在研
针对大尺寸封装高速算力芯片（224Gbps）同轴测试座的开发	350.00	111.82	在研
芯片测试探针寿命与可靠性提升的技术开发	200.00	105.98	在研
合计		5,020.65	/

4、财务费用

报告期内，公司财务费用明细如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
银行存款利息收入	-106.15	-119.80	-91.68	-64.80
未确认融资费用摊销	21.16	32.79	33.48	20.49
其他利息支出（贴现利息支出）	5.88	4.05	9.37	2.07
汇兑损益	176.99	83.94	-58.05	-40.89
银行手续费	3.56	5.38	4.84	5.27
合计	101.45	6.35	-102.04	-77.87

报告期各期，公司财务费用分别为-77.87 万元、-102.04 万元、6.35 万元及 101.45 万元，主要由存款利息收入、汇兑损益及使用权资产未确认融资费用摊销构成，整体金额较小，表明公司资本结构稳健、现金流状况良好。

5、主要期间费用率与同行业可比公司的比较分析

报告期内，公司与同行业可比公司主要期间费用率的比较情况如下：

（1）与 WinWay 及韬盛科技对比情况

项目	公司简称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售费用率	WinWay	5.85%	7.51%	8.00%	9.67%
	韬盛科技	/	5.32%	6.35%	6.99%
	平均值	5.85%	6.42%	7.18%	8.33%
	本公司	2.50%	3.20%	4.30%	5.07%
管理费用率	WinWay	5.32%	6.19%	6.41%	5.84%
	韬盛科技	/	9.20%	9.19%	11.75%

项目	公司简称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
	平均值	**5.32%**	**7.70%**	**7.80%**	**8.80%**
	本公司	**2.67%**	**2.90%**	**4.46%**	**5.45%**
研发费用率	WinWay	**4.67%**	5.30%	5.99%	6.30%
	韬盛科技	/	14.11%	11.88%	14.73%
	平均值	**4.67%**	**9.71%**	**8.94%**	**10.52%**
	本公司	**3.52%**	**3.91%**	**4.67%**	**4.98%**

注：因韬盛科技未披露 2025 年全年财务数据，上表中其 2025 年度相关指标系取自其 2025 年半年报数据。

（2）与 Yamaichi 及 Enplas 对比情况

项目	公司简称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售费用及管理费用率	Yamaichi	**16.31%**	18.25%	20.05%
	Enplas	**27.01%**	28.06%	29.14%
	平均值	**21.66%**	**23.16%**	**24.60%**
	本公司	**6.09%**	**8.77%**	**10.53%**
研发费用率	Yamaichi	**2.37%**	2.22%	2.38%
	Enplas	**3.99%**	3.95%	3.55%
	平均值	**3.18%**	**3.09%**	**2.97%**
	本公司	**3.91%**	**4.67%**	**4.98%**

注 1：由于 Yamaichi 及 Enplas 2026 年一季报未单独披露销售费用、管理费用及研发费用的金额，故此处无法对比 2026 年 1-6 月的数据；
注 2：Yamaichi 及 Enplas 为日本公司，报告期为当年 4 月 1 日至次年 3 月 31 日；
注 3：Yamaichi 及 Enplas 利润表科目将销售费用与管理费用合并列示，因此，此处与公司销售费用及管理费用合并费用率进行对比。

（3）期间费用率差异的合理性分析

报告期内，公司主要期间费用率与同行业可比公司平均水平存在一定差异，但总体变动趋势**基本**保持一致，呈现因规模效应带来的下降趋势。费用率差异的原因具体分析如下：

1）与境外可比公司 WinWay、Yamaichi、Enplas 对比

境外可比公司在全球多个国家或地区开展广泛的业务布局，设立了众多的海外分支机构，其整体的平均薪酬水平及跨国运营费用水平相对偏高，此外，Yamaichi 及 Enplas 销售费用及管理费用中还包含运费、支付手续费等公司未列报在销售费用及管理费用项下的明细项目，列报口径存在差异。因此，上述三家境外可比公司的销售费用率及管理

费用率整体水平显著高于立足本土市场的本公司。

2）与境内可比公司韬盛科技对比

销售费用率方面，韬盛科技主营业务聚焦于半导体测试接口领域，产品包括芯片测试座、探针卡及测试设备，而发行人主要产品为测试座及配件，其业务及产品类型与公司存在一定差异；韬盛科技的客户结构相对分散，其前五大客户收入占比在 36%至 50%之间，相较而言，公司高度聚焦头部核心大客户，前五大客户收入占比达 43%至 **69%**；此外，韬盛科技近年来新增开拓探针卡业务，客户较为分散及新品市场导入导致韬盛科技所需配备的销售人员数量、营销网络维护成本及其他配套服务费用相对偏高，综合因素导致其销售费用率相对偏高。

管理费用率方面，受全球化业务延展影响，韬盛科技在上海、韩国、美国及新加坡等多地租赁了办公及研发场地，此外，韬盛科技近年新设子公司及厂区搬迁，综合原因使得其折旧与摊销费用、水电及物业费等固定支出相对偏高，而公司近年来办公地区相对稳定，综合因素导致其管理费用率相对偏高。

研发费用率方面，韬盛科技主要产品包括芯片测试座、探针卡及测试设备，研发项目围绕上述产品展开，而公司研发项目专注于测试座的技术迭代与升级。近年来，韬盛科技在探针卡方向进行了高强度研发投入，其 2022 年至 2025 年 1-6 月预算金额大于 100 万元的研发项目中，MEMS 探针及探针卡相关项目的研发投入占比过半，MEMS 探针与探针卡前期研发试错成本及直接投入相对偏高，此外，韬盛科技还在测试设备方向投入研发。公司与韬盛科技主营业务范围差异导致研发方向差异，进而导致研发费用率存在差异。

（五）其他影响经营成果的主要项目分析

1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加分别为 192.36 万元、206.68 万元、335.02 万元**和 201.56 万元**，主要包括城市维护建设税、教育费附加和印花税等。

2、其他收益

报告期内，公司其他收益金额分别为 465.41 万元、994.14 万元、1,492.69 万元**和 784.27 万元**，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
与资产相关的政府补助	**5.00**	10.00	8.59	5.20
与收益相关的政府补助	**279.79**	865.31	644.89	282.62
代扣个人所得税手续费返还	**0.32**	3.82	10.77	2.70
增值税加计抵减	**499.16**	613.56	329.89	173.47
工会经费返还	**-**	-	-	1.42
合计	**784.27**	**1,492.69**	**994.14**	**465.41**

报告期内，公司其他收益主要包括政府补助和增值税加计抵减。

公司与科研项目相关的政府补助情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目类别	实施周期	总预算	其中：财政预算金额	计入其他收益的金额				是否计入经常性损益
						2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度	
1	适用于多晶粒 SIP 系统封装金属同轴测试座的开发	产业前瞻与关键核心技术	2022 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	750.00	50.00	**5.00**	10.00	8.59	5.20	是
2	针对 AI HPC 芯片及裸芯片测试座及可靠性测试方案的开发	姑苏创新创业领军人才计划项目/企业创新人才	2025 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日	2,000.00	100.00	**-**	-	-	-	否

注：项目总预算金额包括财政预算金额及自筹资金。

上述两项与科研相关的政府补助公司均为独立承担单位，计入递延收益。

3、投资收益

报告期内，公司投资收益分别为 154.05 万元、104.74 万元、130.90 万元**和 15.71 万元**，主要为公司利用闲置资金购买结构性存款等理财产品所产生的投资收益。

4、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失分别为 76.16 万元、346.39 万元、766.52 万元**和 256.02 万元**，均为应收账款、应收票据以及其他应收款计提的坏账损失。

5、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失分别为 785.43 万元、455.69 万元、457.85 万元**和 507.20 万元**，均为存货跌价损失。

6、营业外收支

报告期内，公司营业外收入分别为 0.33 万元、0.26 万元、4.38 万元**和 2.57 万元**，营业外支出分别为 2.07 万元、36.22 万元、6.76 万元**和 2.34 万元**，金额均较小，对公司各期利润总额不构成重大影响。

（六）主要税种纳税情况

报告期内，公司增值税缴纳情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
期初未交	**569.11**	256.52	178.20	236.19
本期应交	**1,304.33**	2,187.39	1,261.00	1,205.62
本期已交	**1,482.17**	1,874.80	1,182.67	1,263.62
期末未交	**391.27**	569.11	256.52	178.20

报告期内，公司企业所得税缴纳情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
期初未交	**1,236.16**	406.57	200.44	399.84
本期应交	**2,601.90**	2,498.61	1,034.63	691.51
本期已交	**2,365.73**	1,669.01	828.51	890.91
期末未交	**1,472.33**	1,236.16	406.57	200.44

公司适用的主要税率以及享受的税收优惠的具体情况详见本节“七、税项”。

十、资产质量分析

（一）资产总体构成情况

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	**76,102.42**	**90.74%**	53,919.51	89.54%	34,750.84	89.59%	23,844.27	89.64%
非流动资产	**7,761.89**	**9.26%**	6,297.28	10.46%	4,039.45	10.41%	2,755.93	10.36%
合计	**83,864.31**	**100.00%**	**60,216.79**	**100.00%**	**38,790.29**	**100.00%**	**26,600.20**	**100.00%**

报告期各期末，公司资产总额分别为 26,600.20 万元、38,790.29 万元、60,216.79

万元和 83,864.31 万元，资产规模呈逐年上升趋势，主要系报告期内公司业务规模不断扩大，相应带动了资产规模持续增长。结构上，流动资产占比分别为 89.64%、89.59%、89.54%和 90.74%，保持稳定。

整体而言，公司资产规模、资产结构与自身业务经营实际相匹配，资产流动性保持良好。

（二）流动资产构成及其变动情况

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	**12,594.69**	**16.55%**	7,563.56	14.03%	4,840.01	13.93%	2,701.80	11.33%
交易性金融资产	**2,000.93**	**2.63%**	3,900.78	7.23%	7,860.00	22.62%	8,414.58	35.29%
应收票据	**3,350.75**	**4.40%**	2,777.59	5.15%	2,867.91	8.25%	1,194.91	5.01%
应收账款	**33,647.07**	**44.21%**	28,923.77	53.64%	13,916.91	40.05%	7,680.59	32.21%
应收款项融资	**7,470.99**	**9.82%**	434.89	0.81%	193.16	0.56%	551.65	2.31%
预付款项	**34.58**	**0.05%**	12.28	0.02%	47.29	0.14%	26.62	0.11%
其他应收款	**97.55**	**0.13%**	74.26	0.14%	50.20	0.14%	53.23	0.22%
存货	**15,429.79**	**20.28%**	8,972.73	16.64%	4,886.05	14.06%	3,161.04	13.26%
一年内到期的非流动资产	**1,088.83**	**1.43%**	1,073.78	1.99%	-	-	-	-
其他流动资产	**387.23**	**0.51%**	185.87	0.34%	89.30	0.26%	59.84	0.25%
合计	**76,102.42**	**100.00%**	**53,919.51**	**100.00%**	**34,750.84**	**100.00%**	**23,844.27**	**100.00%**

公司流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收款项融资、应收账款和存货等。

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银行存款	**12,594.69**	**100.00%**	7,563.56	100.00%	4,840.01	100.00%	2,701.80	100.00%
其他货币资金	**-**	**-**	-	-	0.0007	0.00001%	0.0007	0.00003%

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	12,594.69	100.00%	7,563.56	100.00%	4,840.01	100.00%	2,701.80	100.00%

报告期各期末，公司货币资金分别为 2,701.80 万元、4,840.01 万元、7,563.56 万元和 12,594.69 万元，占流动资产的比例分别为 11.33%、13.93%、14.03%和 16.55%。报告期内，公司货币资金持续增长，主要得益于经营业绩提升带来经营活动现金流净流入。

2、交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
结构性存款理财产品	2,000.93	100.00%	3,900.78	100.00%	7,860.00	100.00%	8,414.58	100.00%
合计	2,000.93	100.00%	3,900.78	100.00%	7,860.00	100.00%	8,414.58	100.00%

报告期各期末，公司交易性金融资产账面价值分别为 8,414.58 万元、7,860.00 万元、3,900.78 万元和 2,000.93 万元，占流动资产的比例分别为 35.29%、22.62%、7.23%及 2.63%。公司的交易性金融资产主要配置由大型商业银行发行的结构性存款产品，该产品期限较短、具备本金保障及浮动收益特性，系公司为提高闲置营运资金使用效率而进行的稳健型现金管理。

3、应收票据及应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资变动情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日			2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据												
银行承兑汇票	2,921.13	-	2,921.13	2,370.39	-	2,370.39	1,913.24	-	1,913.24	720.10	-	720.10
商业承兑汇票	452.23	22.61	429.62	428.63	21.43	407.20	1,004.91	50.25	954.67	499.80	24.99	474.81
合计	3,373.36	22.61	3,350.75	2,799.02	21.43	2,777.59	2,918.15	50.25	2,867.91	1,219.90	24.99	1,194.91
应收款项融资												
银行承兑汇票	7,470.99	-	7,470.99	434.89	-	434.89	193.16	-	193.16	551.65	-	551.65

项目	2026 年 6 月 30 日			2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合计	**7,470.99**	**-**	**7,470.99**	**434.89**	**-**	**434.89**	**193.16**	**-**	**193.16**	**551.65**	**-**	**551.65**

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资合计金额分别为 1,746.56 万元、3,061.07 万元、3,212.47 万元**和 10,821.74 万元**，占流动资产比重分别为 7.32%、8.81%、5.96%**和 14.22%**，其中**应收票据及应收款项余额持续增长**，主要系随着公司销售规模的扩大，部分以票据结算为主的客户当期收入贡献占比提升所致。

4、应收账款

报告期各期末，公司应收账款相关情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款账面余额	**35,417.97**	30,446.29	14,649.38	8,096.98
应收账款坏账准备	**1,770.90**	1,522.52	732.47	416.39
应收账款账面价值	**33,647.07**	**28,923.77**	**13,916.91**	**7,680.59**

（1）应收账款总体情况

报告期各期末，公司应收账款余额及其占营业收入的比例如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
应收账款账面余额	**35,417.97**	30,446.29	14,649.38	8,096.98
营业收入	**44,027.78**	54,402.48	30,951.23	22,547.96
应收账款账面余额占当期营业收入的比例	**80.44%**	55.96%	47.33%	35.91%

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 8,096.98 万元、14,649.38 万元、30,446.29 万元**及 35,417.97 万元**，应收账款余额随公司营收规模的增长而增长。

（2）应收账款账龄结构

报告期各期末，公司应收账款账龄结构如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
1 年以内	**35,417.97**	**100.00%**	30,442.13	99.99%	14,649.38	100.00%	7,866.12	97.15%
1-2 年	**-**	**-**	4.16	0.01%	-	-	230.87	2.85%
小计	**35,417.97**	**100.00%**	**30,446.29**	**100.00%**	**14,649.38**	**100.00%**	**8,096.98**	**100.00%**
减：坏账准备	**1,770.90**	**5.00%**	1,522.52	5.00%	732.47	5.00%	416.39	5.14%
合计	**33,647.07**	**95.00%**	**28,923.77**	**95.00%**	**13,916.91**	**95.00%**	**7,680.59**	**94.86%**

报告期内，公司应收账款整体质量良好，账龄结构以 1 年以内为主，坏账风险处于较低水平。

（3）应收账款坏账准备计提情况

公司基于同行业通行实践，并充分结合自身客户资质特征，制定了稳健且谨慎的应收账款坏账准备计提政策：按照应收账款的账龄分布特征划分信用风险组合，并依据不同账龄组合设定差异化的坏账准备计提比例。

报告期各期末，公司全部采用按组合计提的方式，不存在按单项计提坏账准备的情形。按组合计提坏账准备的具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	**35,417.97**	**1,770.90**	**5.00%**
1-2 年	**-**	**-**	**10.00%**
合计	**35,417.97**	**1,770.90**	**5.00%**
项目	**2025 年 12 月 31 日**		
	账面余额	**坏账准备**	**计提比例**
1 年以内	30,442.13	1,522.11	5.00%
1-2 年	4.16	0.42	10.00%
合计	**30,446.29**	**1,522.52**	**5.00%**
项目	**2024 年 12 月 31 日**		
	账面余额	**坏账准备**	**计提比例**
1 年以内	14,649.38	732.47	5.00%
1-2 年	-	-	10.00%
合计	**14,649.38**	**732.47**	**5.00%**

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,866.12	393.31	5.00%
1-2 年	230.87	23.09	10.00%
合计	**8,096.98**	**416.39**	**5.14%**

（4）应收账款前五名单位情况

报告期各期末，公司应收账款账面余额前五名客户情况如下：

单位：万元

期间	客户	应收余额	占应收账款的比例
2026 年 6 月末	**芯云半导体**	**11,490.60**	**32.44%**
	京隆科技	**6,301.38**	**17.79%**
	日月光	**5,305.23**	**14.98%**
	渠梁电子	**2,562.56**	**7.24%**
	长川科技	**2,508.29**	**7.08%**
	合计	**28,168.07**	**79.53%**
2025 年末	芯云半导体	12,611.74	41.42%
	日月光	5,362.22	17.61%
	长川科技	2,869.40	9.42%
	京隆科技	2,429.23	7.98%
	渠梁电子	2,023.12	6.64%
	合计	**25,295.71**	**83.07%**
2024 年末	芯云半导体	2,833.79	19.34%
	京隆科技	2,648.04	18.08%
	长川科技	2,525.29	17.24%
	日月光	1,469.52	10.03%
	中电科集团	835.18	5.70%
	合计	**10,311.82**	**70.39%**
2023 年末	长川科技	1,369.90	16.92%
	日月光	1,137.27	14.05%
	中电科集团	762.31	9.41%
	矽佳半导体	635.08	7.84%
	复旦微电	504.12	6.23%
	合计	**4,408.68**	**54.45%**

注：上述客户及其同一控制下企业的销售金额合并披露。

报告期各期末，公司应收账款账面余额前五名客户合计分别为 4,408.68 万元、10,311.82 万元、25,295.71 万元**和 28,168.07 万元**，占全部应收账款余额的比例分别为 54.45%、70.39%、83.07%**和 79.53%**。报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户均为行业知名企业或大型企业集团，资金实力雄厚、商业信誉较好，且其账龄主要在一年以内，不存在重大回款风险。

5、预付款项

报告期各期末，公司预付款项金额分别为 26.62 万元、47.29 万元、12.28 万元**和 34.58 万元**，主要系预付供应商的材料采购款支出，金额较小且账龄主要在一年以内。

6、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款基本情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
账面余额	**147.56**	117.80	88.46	86.43
坏账准备	**50.01**	43.54	38.26	33.20
账面价值	**97.55**	74.26	50.20	53.23

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 53.23 万元、50.20 万元、74.26 万元**和 97.55 万元**，主要包括房屋租赁押金、项目保证金等。

7、存货

（1）存货构成及变动分析

报告期各期末，公司存货账面价值构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	**4,676.22**	**30.31%**	3,907.48	43.55%	2,998.44	61.37%	2,485.71	78.64%
在产品	**6,473.05**	**41.95%**	2,768.68	30.86%	970.56	19.86%	304.78	9.64%
库存商品	**94.83**	**0.61%**	305.46	3.40%	201.50	4.12%	177.17	5.60%
发出商品	**4,090.27**	**26.51%**	1,741.93	19.41%	704.64	14.42%	191.25	6.05%
委托加工物资	**95.44**	**0.62%**	249.18	2.78%	10.92	0.22%	2.13	0.07%
合计	**15,429.79**	**100.00%**	**8,972.73**	**100.00%**	**4,886.05**	**100.00%**	**3,161.04**	**100.00%**

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 3,161.04 万元、4,886.05 万元、8,972.73 万元**和 15,429.79 万元**，占流动资产的比例分别为 13.26%、14.06%、16.64%**和 20.28%**，存货整体规模随着经营规模增长同步增长。

（2）存货跌价准备计提

报告期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,091.39	1,415.17	4,676.22
库存商品	252.36	157.53	94.83
发出商品	4,145.41	55.14	4,090.27
在产品	6,487.00	13.96	6,473.05
委托加工物资	95.44	-	95.44
合计	17,071.60	1,641.80	15,429.79
项目	2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,087.09	1,179.61	3,907.48
库存商品	448.82	143.36	305.46
发出商品	1,768.36	26.43	1,741.93
在产品	2,794.40	25.71	2,768.68
委托加工物资	249.18	-	249.18
合计	10,347.85	1,375.11	8,972.73
项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,008.10	1,009.66	2,998.44
库存商品	358.42	156.92	201.50
发出商品	704.64	-	704.64
在产品	970.56	-	970.56
委托加工物资	10.92	-	10.92
合计	6,052.63	1,166.58	4,886.05

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,353.46	867.75	2,485.71
库存商品	348.97	171.79	177.17
发出商品	191.25	-	191.25
在产品	429.94	125.16	304.78
委托加工物资	2.13	-	2.13
合计	**4,325.74**	**1,164.70**	**3,161.04**

公司存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 1,164.70 万元、1,166.58 万元、1,375.11 万元和 1,641.80 万元，占存货账面余额的比例分别为 26.92%、19.27%、13.29%和 9.62%，与公司实际的库存规模与库龄结构整体匹配。

8、一年内到期的非流动资产

报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产分别为 0 万元、0 万元、1,073.78 万元和 1,088.83 万元，占流动资产的比例分别为 0.00%、0.00%、1.99%和 1.43%，2026 年 6 月末及 2025 年末的一年内到期的非流动资产为大额存单本金及利息。

9、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
待摊费用	234.01	185.85	82.83	59.82
待抵扣进项税	0.02	0.02	6.47	0.02
预付上市中介费用	153.20	-	-	-
合计	**387.23**	**185.87**	**89.30**	**59.84**

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 59.84 万元、89.30 万元、185.87 万元和 387.23 万元，占流动资产的比例分别为 0.25%、0.26%、0.34%和 0.51%，主要为预付的上市中介费用、待摊员工宿舍房租、物业费、电费等。

（三）非流动资产构成及其变动情况

报告期各期末，公司非流动资产具体构成情况如下：

单位：万元

资产	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	**4,827.56**	**62.20%**	4,212.76	66.90%	2,515.49	62.27%	1,571.56	57.02%
在建工程	**-**	**-**	23.56	0.37%	-	-	11.34	0.41%
使用权资产	**963.06**	**12.41%**	820.68	13.03%	715.22	17.71%	491.22	17.82%
无形资产	**81.54**	**1.05%**	88.23	1.40%	90.87	2.25%	26.44	0.96%
长期待摊费用	**562.24**	**7.24%**	385.38	6.12%	317.03	7.85%	271.71	9.86%
递延所得税资产	**788.09**	**10.15%**	634.66	10.08%	385.84	9.55%	306.47	11.12%
其他非流动资产	**539.38**	**6.95%**	132.01	2.10%	15.01	0.37%	77.19	2.80%
合计	**7,761.89**	**100.00%**	**6,297.28**	**100.00%**	**4,039.45**	**100.00%**	**2,755.93**	**100.00%**

公司非流动资产主要由固定资产、使用权资产、长期待摊费用及递延所得税资产构成。

1、固定资产

报告期各期末，公司固定资产的构成情况如下：

单位：万元

资产类别	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
账面原值				
通用设备	**86.69**	83.86	71.97	62.70
专用设备	**7,349.26**	6,184.69	3,838.66	2,596.64
运输工具	**284.26**	284.26	223.65	253.12
小计	**7,720.21**	**6,552.81**	**4,134.28**	**2,912.46**
累计折旧				
通用设备	**62.22**	55.45	40.99	23.15
专用设备	**2,626.07**	2,097.36	1,408.21	1,147.34
运输工具	**204.36**	187.25	169.59	170.42
小计	**2,892.65**	**2,340.05**	**1,618.79**	**1,340.90**
账面价值				
通用设备	**24.47**	28.41	30.98	39.55
专用设备	**4,723.20**	4,087.34	2,430.45	1,449.30
运输工具	**79.89**	97.01	54.06	82.70
合计	**4,827.56**	**4,212.76**	**2,515.49**	**1,571.56**

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为1,571.56万元、2,515.49万元、4,212.76万元和4,827.56万元，主要由生产相关的机器设备所构成。截至报告期末，公司固定资产不存在抵押、质押或其他权利受限的情形。报告期各期末，公司固定资产金额持续增长，主要原因系公司产品订单持续增长，为此公司购置高精度CNC机床等相关专用设备，以突破产能瓶颈，保障订单交付。

2、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产的账面价值分别为491.22万元、715.22万元、820.68万元和963.06万元，均由为满足日常生产经营及办公需求而租赁的房产构成。

3、无形资产

报告期各期末，公司无形资产主要为生产与办公类软件，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
原值	**126.18**	126.18	115.67	39.82
累计摊销	**44.64**	37.96	24.80	13.37
账面价值	**81.54**	88.23	90.87	26.44

报告期各期末，公司无形资产不存在明显减值迹象，无需计提减值准备。

4、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用构成如下：

单位：万元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
装修费	**562.24**	385.38	317.03	271.71
合计	**562.24**	**385.38**	**317.03**	**271.71**

报告期各期末，公司长期待摊费用主要由租赁厂房及办公区域的装修费用构成，随生产经营场地的扩张而稳步增加。

（四）资产周转能力分析

1、应收账款周转率

报告期内，公司应收账款周转率与同行业可比公司对比如下：

单位：次

可比公司	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
Yamaichi	**7.00**	**6.54**	6.49	5.54
Winway	**4.97**	3.94	4.29	2.97
Enplas	**5.15**	**4.28**	3.75	3.50
韬盛科技	/	2.36	2.77	2.77
平均值	**5.71**	**4.28**	**4.33**	**3.70**
公司	**2.67**	**2.41**	**2.72**	**2.99**

注 1：**因韬盛科技未披露 2025 年全年财务数据，上表中其 2025 年度相关指标系取自其 2025 年半年报数据，并进行年化处理；**

注 2：Yamaichi 及 Enplas 为日本公司，报告期为当年 4 月 1 日至次年 3 月 31 日，**上表中其 2026 年 1-6 月相关指标系取自其 2026 年一季报数据，并进行年化处理**。

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 2.99、2.72、2.41 **及 2.67**，与境内可比公司韬盛科技基本处于同一水平，不存在重大差异，但整体低于境外可比公司 Yamaichi、WinWay 及 Enplas，主要系境内外商业信用环境、客户付款习惯及结算模式存在差异所致：

Yamaichi、WinWay 及 Enplas 深耕全球市场多年，其主要客户分布于欧美及日本等成熟市场，客户信用期较短且回款及时；且其凭借较为领先的行业地位，在结算条款上具备较强的话语权，部分交易可采用预付款或较短信用期的结算方式，从而有效控制了应收账款规模，维持了较高的应收账款周转率。

公司现阶段战略核心为加速国产替代进程、扩大本土市场份额，为快速进入国内头部客户供应链并实现批量供应，公司结合本土市场商业习惯，制定了与客户资信状况相匹配的信用政策。

2、存货周转率

报告期内，公司的存货周转率与同行业可比公司对比如下：

单位：次

可比公司	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
Yamaichi	**4.23**	**3.64**	3.88	3.77
Winway	**7.57**	5.38	4.89	3.44
Enplas	**4.36**	**5.18**	5.20	4.87
韬盛科技	/	2.64	3.11	2.72
平均值	**5.39**	**4.21**	**4.27**	**3.70**

可比公司	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
公司	3.57	4.09	3.82	3.23

注 1：**因韬盛科技未披露 2025 年全年财务数据，上表中其 2025 年度相关指标系取自其 2025 年半年报数据，并进行年化处理；**

注 2：Yamaichi 及 Enplas 为日本公司，报告期为当年 4 月 1 日至次年 3 月 31 日，**上表中其 2026 年 1-6 月相关指标系取自其 2026 年一季报数据，并进行年化处理**。

整体而言，公司存货周转率处于同行业可比公司合理区间。伴随经营规模快速扩张，公司仍具备高效的库存管控能力与供应链协同响应能力，未出现产品积压滞销、存货周转效率走低等重大经营风险。

十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债状况分析

1、负债总体构成情况

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	**28,256.42**	**97.52%**	18,252.35	96.47%	9,347.32	94.99%	5,205.61	93.78%
非流动负债	**719.45**	**2.48%**	667.02	3.53%	492.72	5.01%	345.04	6.22%
合计	**28,975.86**	**100.00%**	**18,919.37**	**100.00%**	**9,840.04**	**100.00%**	**5,550.66**	**100.00%**

报告期各期末，公司负债规模分别为 5,550.66 万元、9,840.04 万元、18,919.37 万元及 **28,975.86 万元**，整体呈现伴随业务规模扩张而持续增长的态势。

2、流动负债构成及其变动情况

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	-	-	852.36	4.67%	1,274.85	13.64%	397.06	7.63%
应付账款	**22,742.00**	**80.48%**	12,521.74	68.60%	5,164.11	55.25%	2,537.47	48.74%
合同负债	**24.76**	**0.09%**	125.56	0.69%	12.39	0.13%	16.25	0.31%
应付职工薪酬	**1,464.79**	**5.18%**	1,348.81	7.39%	1,081.52	11.57%	880.32	16.91%
应交税费	**1,969.03**	**6.97%**	1,906.97	10.45%	727.98	7.79%	424.66	8.16%

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他应付款	**95.34**	**0.34%**	73.65	0.40%	60.40	0.65%	55.81	1.07%
一年内到期的非流动负债	**321.75**	**1.14%**	227.51	1.25%	240.42	2.57%	145.71	2.80%
其他流动负债	**1,638.75**	**5.80%**	1,195.74	6.55%	785.64	8.40%	748.34	14.38%
合计	**28,256.42**	**100.00%**	**18,252.35**	**100.00%**	**9,347.32**	**100.00%**	**5,205.61**	**100.00%**

报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他流动负债等构成。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 397.06 万元、1,274.85 万元、852.36 万元**和 0 万元**，均系公司附追索权的银行承兑汇票贴现形成。

（2）应付账款

报告期各期末，公司应付账款分别为 2,537.47 万元、5,164.11 万元、12,521.74 万元**和 22,742.00 万元**，呈现持续增长趋势，主要系报告期内公司订单放量，为保障交付，公司加大了对原材料的采购规模。整体而言，公司在供应链中享有良好的商业信用，自身经营性现金流充沛稳定，应付账款均能按照合同账期及时足额支付。

（3）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 880.32 万元、1,081.52 万元、1,348.81 万元**和 1,464.79 万元，**呈现持续增长趋势，主要系一方面，公司业绩显著提升，人员绩效奖金随之上浮；另一方面，伴随经营规模的持续扩张，为保障运营效率，公司引进多个岗位的专业人才，员工队伍规模同步扩张。

（4）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 55.81 万元、60.40 万元、73.65 万元**和 95.34 万元**，主要系应付员工的费用报销款项等。

（5）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 145.71 万元、240.42 万元、227.51 万元**及 321.75 万元**，主要系一年内到期的租赁负债。

（6）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 748.34 万元、785.64 万元、1,195.74 万元及 **1,638.75 万元**，主要系计提的产品质量保证金。

3、非流动负债构成及其变动情况

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁负债	**584.64**	**81.26%**	527.21	79.04%	440.94	89.49%	300.24	87.01%
递延收益	**134.81**	**18.74%**	139.81	20.96%	51.78	10.51%	44.80	12.99%
合计	**719.45**	**100.00%**	**667.02**	**100.00%**	**492.72**	**100.00%**	**345.04**	**100.00%**

报告期各期末，公司非流动负债主要由租赁负债和递延收益构成。

（1）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债余额分别为 300.24 万元、440.94 万元、527.21 万元和 **584.64 万元**，主要系公司为满足产能扩充及办公需求而租赁的房产，依据新租赁准则确认的应付租赁付款额的现值。

（2）递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 44.80 万元、51.78 万元、139.81 万元和 **134.81 万元**，系公司收到的与资产或收益相关的政府补助。

（二）偿债能力分析

1、偿债能力指标分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
流动比率（倍）	**2.69**	2.95	3.72	4.58
速动比率（倍）	**2.15**	2.46	3.20	3.97
资产负债率（合并）	**34.55%**	31.42%	25.37%	20.87%
资产负债率（母公司）	**38.10%**	36.64%	33.08%	31.51%
息税折旧摊销前利润	**16,362.06**	16,666.27	8,026.39	5,216.00

项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
（万元）				
利息保障倍数（倍）	**573.31**	420.40	167.24	197.23

报告期内，随着公司业务规模的快速增长，为保障生产交付，公司采购规模大幅增加，带动应付账款等流动负债快速增长，导致公司流动比率和速动比率在报告期内有所下降，资产负债率有所上升。但整体来看，公司流动比率与速动比率依然维持在较高且安全的水平，资产负债率总体偏低，息税折旧摊销前利润充足，利息保障倍数极高，公司具备较强的长短期偿债能力，流动性风险较低。

2、偿债能力指标与同行业公司比较分析

报告期各期末，公司主要偿债能力指标与同行业可比公司比较情况如下：

项目	可比公司	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率	Yamaichi	**3.15**	**3.05**	3.07	3.22
	WinWay	**2.25**	2.55	2.78	2.43
	Enplas	**5.09**	**6.07**	7.49	7.12
	韬盛科技	/	2.78	2.17	2.74
	平均值	**3.50**	**3.61**	**3.88**	**3.88**
	公司	**2.69**	**2.95**	**3.72**	**4.58**
速动比率	Yamaichi	**2.39**	**2.32**	2.36	2.47
	Winway	**2.03**	2.21	2.37	1.84
	Enplas	**4.16**	**5.34**	6.70	6.44
	韬盛科技	/	2.24	1.72	2.25
	平均值	**2.86**	**3.03**	**3.29**	**3.25**
	公司	**2.15**	**2.46**	**3.20**	**3.97**
资产负债率	Yamaichi	**25.78%**	**26.16%**	25.69%	25.06%
	Winway	**44.89%**	28.74%	26.91%	28.43%
	Enplas	**12.85%**	**11.93%**	10.45%	12.26%
	韬盛科技	/	38.68%	51.31%	35.38%
	平均值	**27.84%**	**26.38%**	**28.59%**	**25.28%**
	公司	**34.55%**	**31.42%**	**25.37%**	**20.87%**

注 1：**因韬盛科技未披露 2025 年全年财务数据，上表中其 2025 年度相关指标系取自其 2025 年半年报数据，并进行年化处理；**

注 2：Yamaichi 及 Enplas 为日本公司，报告期为当年 4 月 1 日至次年 3 月 31 日。

报告期内，公司的流动比率、速动比率及资产负债率与同行业可比公司均值基本相当，资本结构稳健，各项偿债能力指标与行业平均水平不存在重大差异。

（三）股利分配情况

公司报告期内的股利分配情况详见本招股说明书**“第二节 概览”之“六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标”。**

（四）现金流量分析

报告期内，公司现金流量的总体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	**4,817.54**	4,061.91	1,065.68	3,167.65
投资活动产生的现金流量净额	**1,794.54**	-1,186.10	-1,077.77	-2,827.80
筹资活动产生的现金流量净额	**538.40**	-1,473.50	2,103.77	-2,348.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-176.99**	-83.94	58.05	32.19
期末现金及现金等价物余额	**12,356.37**	5,382.88	4,064.51	1,914.78

1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量明细如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	**34,779.61**	43,830.93	26,279.96	22,384.37
收到其他与经营活动有关的现金	**404.32**	968.95	844.26	362.36
经营活动现金流入小计	**35,183.93**	**44,799.88**	**27,124.23**	**22,746.74**
购买商品、接受劳务支付的现金	**19,742.12**	27,952.05	16,563.70	10,810.42
支付给职工以及为职工支付的现金	**5,813.98**	7,867.88	6,480.76	5,506.68
支付的各项税费	**4,070.74**	3,840.85	2,214.57	2,354.80
支付其他与经营活动有关的现金	**739.55**	1,077.19	799.50	907.19
经营活动现金流出小计	**30,366.39**	**40,737.97**	**26,058.54**	**19,579.08**
经营活动产生的现金流量净额	**4,817.54**	**4,061.91**	**1,065.68**	**3,167.65**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,167.65万元、1,065.68万元、4,061.91万元**及4,817.54万元**。其中，2024年度公司经营活动现金流量净额相对偏低，主要系当期公司业务规模扩张与资金收付存在时间差异所致。

报告期内，公司净利润调节为经营活动现金流量的情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	13,027.28	13,197.53	6,167.86	3,831.75
加：资产减值准备	507.20	457.85	455.69	785.43
信用减值准备	256.02	766.52	346.39	76.16
固定资产折旧、使用权资产、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	759.38	1,011.39	729.50	631.35
无形资产摊销	6.69	13.16	11.42	3.89
长期待摊费用摊销	93.21	157.58	119.50	132.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1.85	-1.09	-3.92	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	0.13	17.42	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-0.93	-0.78	-10.00	-14.58
财务费用（收益以“－”号填列）	203.82	120.24	-15.20	-18.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-35.18	-145.81	-112.92	-154.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-153.43	-248.82	-79.37	-97.20
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,964.26	-4,544.53	-2,180.70	-17.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-14,486.92	-17,407.11	-8,291.42	-1,960.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,042.77	9,586.01	3,304.19	-200.47
其他	563.75	1,099.64	607.25	170.33
经营活动产生的现金流量净额	4,817.54	4,061.91	1,065.68	3,167.65

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,827.80 万元、-1,077.77 万元、-1,186.10 万元及 1,794.54 万元，主要源于“收回投资收到的现金”与“投资支付的现金”净额变动。上述两项主要反映了公司利用闲置营运资金进行结构性存款等理财产品申购与赎回所形成的资金滚动。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-2,348.16 万元、2,103.77 万元、-1,473.50 万元和 538.40 万元。公司筹资活动现金流入主要系公司收到的投资款及票据

贴现，筹资活动现金流出主要系现金分红。

（五）持续经营能力分析

公司长期专注于半导体封装测试消耗型硬件领域，紧跟芯片性能升级、先进封装演进及可靠性测试需求提升的行业趋势，围绕功能测试座、老化测试座及相关测试接口组件进行技术积累和产品迭代，持续提升产品在高速高频信号传输、高功率散热及精准温控、高密度微间距精密接触和长期稳定运行等方面的性能。

报告期内，受益于 AI 产业化进程加速、高性能 GPU、CPU、SoC 等芯片产品持续升级、半导体封装测试环节国产替代加快以及下游客户需求快速增长，公司营业收入和业绩持续增长。

目前，全球半导体封装测试消耗型硬件市场正处于高速扩张期，其增长动力主要来自先进制程与先进封装技术演进、高性能芯片封装测试需求量增长以及封装测试环节复杂化、系统化升级。一方面，先进制程持续逼近物理极限，先进封装技术成为推动芯片算力密度提升的重要手段，封装工艺的复杂性显著提升了芯片测试的复杂度与覆盖率要求；另一方面，AI HPC、先进存储、智能终端、汽车电子及工业控制等下游应用快速发展，带来了海量的高性能芯片测试需求。此外，测试自动化与高并发并行测试技术的进步，也为相关消耗型硬件市场的扩容提供了坚实的基础。公司技术储备与行业未来产品需求、技术发展方向较为一致，能够满足未来测试座市场复杂化、系统化的测试需求，公司业务规模发展具有持续性。

面向未来，公司计划将本次首发上市募集资金紧密围绕主营业务，重点用于先进生产基地建设项目、总部及研发中心项目、针对高功率芯片液冷散热控温技术的研发及生产项目等。上述项目的实施，将有效打破公司当前面临的产能瓶颈，扩大高性能测试座产能规模；同时，将进一步加码前沿测试技术的研发投入，完善测试消耗型硬件产品线布局。公司将依托募投项目的赋能，持续深化在半导体测试领域的技术布局，募投项目的全面落地将为公司业务规模的持续攀升提供了动能。

综上，公司主营业务突出，所处的半导体封装测试消耗型硬件赛道发展前景广阔，产品结构持续向高附加值优化，商业模式成熟稳健，未来具有持续经营能力。

可能影响公司持续经营能力的相关风险因素详见本招股说明书“第三节 风险因素”相关内容。

十二、重大投资或重大资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司不存在重大资本性支出。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目，相关项目属于公司主营业务范畴，公司不存在跨行业投资的情况。

公司本次募集资金投资项目情况详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

（三）重大资产业务重组事项

报告期内，公司不存在重大资产业务重组情况。

（四）股权收购合并事项

报告期内，公司不存在股权收购合并事项。

十三、资产负债表期后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项

（一）资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在应披露而未披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在应披露而未披露的或有事项。

十四、盈利预测

公司未编制盈利预测报告。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概况

（一）募集资金投资项目

本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	先进生产基地建设项目	74,223.83	74,223.83
2	针对高功率芯片液冷散热控温技术的研发及生产项目	52,869.60	52,869.60
3	总部及研发中心项目	29,636.34	29,636.34
4	补充流动资金项目	23,710.57	23,710.57
合计		**180,440.34**	**180,440.34**

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将通过自筹资金解决；若本次发行实际募集资金高于募集资金投资项目投资额，剩余部分公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用。

本次募集资金投资项目的实施不会新增构成重大不利影响的同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

（二）募集资金使用管理制度

公司按照相关法律法规并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度对募集资金存储、使用、投资项目的变更、闲置募集资金管理安排等内容进行了明确规定，最大限度保护投资者权益。

（三）募集资金投资项目确定依据

公司本次募集资金投资项目的确定，系综合考虑公司主营业务发展需要、现有生产经营规模、技术储备基础、组织管理能力及未来发展战略等因素后作出的审慎决策。公司长期专注于半导体封装测试消耗型硬件的研发、设计、生产和销售，已形成以高性能

测试座为核心，以分选换型套件、测试接口连接模组为协同，并逐步向 WLCSP 探针卡、负载板、芯片测试液冷板、微流道液冷板等相关产品延伸的业务布局。本次募投项目均围绕公司现有主营业务及同源技术方向展开，与公司现有产品体系、技术路线和客户需求具有较强的匹配性。

从生产经营规模来看，随着 AI HPC、智能终端以及汽车电子等下游应用快速发展，客户对测试消耗型硬件的性能及交付能力提出了更高要求。公司现有产能及部分生产设备已难以完全匹配未来业务扩张和产品升级需求。通过实施“先进生产基地建设项目”，公司将进一步提升高性能测试座、WLCSP 探针卡、**分选换型套件**等产品的规模化生产能力和自动化制造水平，增强对下游客户大批量订单需求的承接能力。“针对高功率芯片液冷散热控温技术的研发及生产项目”则顺应 AI 算力芯片功耗提升趋势，推动公司在极限散热、精准控温等关键方向实现持续突破，打造公司新的收入增长来源。

从技术条件和管理能力来看，公司在高速高频信号传输、高功率散热及精准温控、微间距精密接触以及结构设计等方面已形成一定技术积累，并建立了较为成熟的研发、生产体系。本次募投项目在公司既有技术平台和管理体系基础上，“总部及研发中心项目”将进一步加大先进设备、研发平台和专业人才投入，强化公司研发中枢平台建设。

从财务状况和发展目标来看，公司报告期内经营规模持续扩大，盈利能力和持续经营能力为募投项目实施提供了必要基础；同时，公司所属行业属于资金与技术密集型行业，公司本次募集资金投资项目以提升先进产能、完善产品矩阵、强化研发能力和补充营运资金为主要目标，符合公司成为全球领先的半导体测试消耗型硬件解决方案提供商的发展战略。

（四）募集资金投资项目对发行人主营业务发展的贡献及未来经营战略的影响

公司本次募集资金投资项目均围绕主营业务展开，是公司提升高性能半导体测试消耗型硬件产品供给能力、完善业务布局、增强持续盈利能力的重要举措。项目实施后，公司将在现有业务基础上，进一步提升 FT 测试座、老化测试座、SLT 测试座、**封测接口组件**等核心产品的规模化制造能力和交付能力，并同步拓展 WLCSP 探针卡、负载板、芯片测试液冷板、微流道液冷板等相关产品，推动公司向综合性、全方位的半导体测试消耗型硬件解决方案供应商升级。

（五）募集资金投资项目对公司业务创新、创造、创意性的支持作用

“先进生产基地建设项目”通过大规模引进高精度加工设备与自动化产线，将公司的前沿创新研发成果快速转化为具备规模化、高一致性与高稳定性的量产能力。项目着力化解当前公司面临的先进产能瓶颈，确保高性能测试座、WLCSP 探针卡、**分选换型套件**等核心产品能够高效满足下游市场需求，以扎实的工程化创造力推动高性能半导体测试消耗型硬件的国产替代与份额跃升。

“针对高功率芯片液冷散热控温技术的研发及生产项目”体现了公司敏锐的市场洞察与商业创意。公司面对 AI 大算力时代千瓦级芯片的极限散热痛点，依托现有的产品设计与精密制造能力，将微空间液冷技术由测试端横向延伸至服务器液冷板等算力热管理蓝海市场，打破业务边界，为公司培育新的收入增长点。

“总部及研发中心项目”聚焦于半导体测试消耗型硬件的底层技术迭代，重点攻坚高功率、高密度、极微间距 AI 算力芯片的测试方案，并延展孵化 WLCSP 探针卡、**负载板**等战略产品。通过系统性提升高速高频信号传输与高密度微间距加工等核心护城河技术，切入全球先进封装与算力芯片演进的技术腹地，实现向高附加值科技创新的跨越。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件六：募集资金运用情况”。

三、发行人未来发展规划

（一）发行人发展战略规划

自成立以来，公司始终专注以半导体测试座为核心的封装测试消耗型硬件的研发、设计、生产和销售，致力于为集成电路产业链客户提供高性能、高可靠性的测试接口产品及解决方案。公司紧跟芯片向高频高速、高功率方向演进的技术趋势，持续推进核心技术攻关和产品迭代升级，推动半导体封装测试消耗型硬件的自主可控和国产替代进程。公司产品及服务已获得境内外知名的芯片设计公司、封测服务企业、测试设备厂商等客户认可，报告期内经营规模持续增长，行业影响力不断提升。

未来，公司将围绕半导体封装测试消耗型硬件的核心主业，坚持“技术领先、产品延伸、平台化发展”的战略方向，以客户高性能测试需求为牵引，持续提升高频高速信号传输、高功率散热及精准控温、高密度微间距精密加工等关键技术能力，不断完善覆

盖测试座、**封测接口组件**、WLCSP 探针卡、负载板以及芯片测试液冷板、微流道液冷板的产品矩阵，进一步提升公司在全球半导体测试消耗型硬件领域的综合竞争力，力争发展成为全球领先的半导体测试消耗型硬件解决方案提供商。

短期来看，公司将以本次募集资金投资项目的实施为重要抓手，进一步强化产能、研发和新产品产业化能力。在产能建设方面，公司将依托“先进生产基地建设项目”，重点提升 AI 及超算芯片功能测试座、AI 及超算芯片老化测试座等核心产品的规模化生产能力，并完善 WLCSP 探针卡、**分选换型套件**等配套产品线，提升高性能产品交付能力和产品性能一致性。在前沿技术产品拓展方面，公司将依托“针对高功率芯片液冷散热控温技术的研发及生产项目”，聚焦 AI HPC 等高功率芯片在老化测试下的散热控温需求，提升公司在千瓦级以上高功率芯片测试热管理领域的研发和产业化能力。在研发平台建设方面，公司将依托“总部及研发中心项目”，构建集技术研发、实验测试、设计仿真和运营管理于一体的综合性平台，开展关键技术攻关，增强底层研发能力和技术成果转化效率。

长期来看，公司将充分发挥募投项目对产能扩张、产品延伸以及研发升级的支撑作用，深化在半导体测试消耗型硬件的系统化布局。公司将坚持核心技术自主研发，围绕客户芯片工程验证、成品测试、老化测试和系统级测试等全生命周期需求，强化早期介入和协同开发能力，提升客户黏性和综合服务能力。在此基础上，公司将推动业务由以测试座为核心的供应商，逐步升级为覆盖**封测接口组件**、WLCSP 探针卡、负载板、芯片测试液冷板、微流道液冷板的综合性半导体测试消耗型硬件解决方案提供商，进一步拓宽业务边界和成长空间。

（二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

1、持续深化技术创新，巩固测试座领域领先优势

公司始终将技术创新作为发展的核心驱动力，在半导体测试座领域持续保持较高水平的研发投入。基于在功能测试座和老化测试座方面积累的丰富量产经验，公司不断提升产品性能，优化技术路线，丰富应用场景。在高性能测试座领域，公司成功攻克了多项核心技术难题，完成了面向先进制程、先进封装芯片的定制化测试解决方案开发及量产导入，为后续的技术代差升级奠定了坚实基础。通过持续的研发投入和技术积累，公司建立了完善的知识产权体系，为业务拓展提供了强有力的技术支撑。

2、完善产品布局，积极拓展新的业务领域

依托在测试座领域建立的技术优势和市场地位，公司积极把握半导体测试消耗型硬件市场的发展机遇。在持续优化现有测试座、**封测接口组件**产品性能的同时，公司战略性地向 WLCSP 探针卡、负载板、芯片测试液冷板、微流道液冷板等高附加值新兴业务领域延伸。通过深入的市场调研和技术预研，公司已在上述具备前景的赛道内完成了关键底层技术的早期积累，为后续新产品的规模化商业落地做好准备。

3、优化产业布局，提升客户服务能力

报告期内，公司围绕半导体产业区域集聚和客户分布特点，不断完善产业布局和服务体系。公司立足长三角地区半导体产业集聚优势，通过苏州、芜湖等地的研发、生产和服务资源布局，增强了对客户需求的快速响应能力和产品交付保障能力。随着业务规模扩大和产品复杂度提升，公司持续强化研发开展、生产组织、质量控制、项目交付和售后支持能力，提升全流程服务水平。

4、完善治理体系，提升经营管理水平

为适应业务规模扩大和产品体系延伸的需要，公司持续完善治理结构和内部管理体系，逐步建立起符合规范运作要求的现代企业制度。报告期内，公司不断优化组织架构、研发管理、生产管理、质量控制等流程，提升经营决策效率和资源配置能力，为公司战略目标实施提供了制度保障。同时，公司高度重视人才队伍建设，围绕技术研发、生产制造和运营管理等关键岗位持续引进和培养专业人才，逐步形成与业务发展阶段相匹配的人才梯队。

（三）发行人未来发展规划采取的措施

1、深化测试座业务优势，巩固市场领先地位

未来，公司将继续深耕半导体封装测试消耗型硬件核心主业，围绕功能测试座、老化测试座等主导产品，持续提升产品在高频高速传输、精准温控及散热等方面的性能表现。公司将通过引进先进生产设备、优化工艺流程、提升自动化和精密制造水平，进一步增强高性能测试座产品的规模化生产能力和质量稳定性。

在应用领域方面，公司将重点面向 AI HPC、智能终端、汽车电子以及工业控制等高增长市场，持续开发适配先进制程、先进封装芯片的测试接口解决方案。公司将进一

步深化与现有客户的协同开发和长期合作，通过提供定制化、高可靠性的封装测试消耗型硬件产品和技术服务，增强客户黏性，巩固和提升在高性能测试座领域的市场竞争地位。

2、拓展业务领域，培育新的增长点

在保持测试座等核心业务稳定发展的基础上，公司将有序推进**封测接口组件**、WLCSP 探针卡、负载板、芯片测试液冷板、微流道液冷板等产品的研发和产业化进程。公司将依托现有客户基础、精密制造能力和测试接口技术积累，围绕晶圆级测试、封装后成品测试、老化测试、系统级测试等场景，逐步完善覆盖测试关键环节的产品体系。

其中，在 WLCSP 探针卡方向，公司将重点推进高速、微间距探针卡；在负载板方向，公司将加强高速多层 PCB 设计，提升与测试设备、分选设备及客户测试方案的协同能力；在液冷散热控温方向，公司将围绕 AI 算力等高功率芯片的测试热管理需求，推动芯片测试液冷板、微流道液冷板及相关散热控温组件的研发和产业化，培育新的业务增长点。

3、加强研发创新体系建设，提升自主创新能力

公司将以“总部及研发中心项目”项目为契机，持续保持合理的研发投入规模。通过搭建测试座中试平台以及信号传输完整性测试、热性能测试、机械耐久性测试等多个专业实验室，进一步完善底层的研发基础设施。公司计划通过自主研发、产学研合作等多种途径，集中力量突破关键技术瓶颈。同时，公司将持续完善知识产权保护体系，加强核心设计与工艺的攻关，推动封装测试消耗型硬件产品的稳步迭代升级，全面提升企业的自主创新与核心技术可控能力。

4、优化人才队伍结构，提升组织运营效率

公司将持续完善人才引进与培养机制，重点吸收行业内的高端技术研发人才和复合型经营管理人才，进一步优化人才队伍结构。通过建立科学、长效的薪酬体系和股权激励机制，提升核心团队的凝聚力与创造力。同时，为适应业务规模的不断扩张，公司将持续优化内部组织架构和精益化管理流程，加强跨部门协同，提升整体运营和资金周转效率，为公司各项长期战略目标的平稳落地提供坚实的组织保障。

第八节 公司治理与独立性

一、发行人公司治理情况

公司自整体变更为股份有限公司以来，按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了由股东会、董事会及专门委员会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间协调运转、有效制衡的机制。同时，公司结合实际情况制定完善了公司章程及内部控制制度，为公司规范运作提供了制度保证，公司治理层面不存在重大缺陷。

二、发行人内部控制情况

（一）公司管理层的自我评估意见

公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（二）注册会计师对发行人内部控制制度的审计意见

根据天健会计师出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕17719 号），天健会计师认为：“法特迪于 2026 年 6 月 30 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。

（三）报告期内公司财务内控不规范的整改情况

报告期内，公司不存在财务内控不规范的情形。

三、报告期内发行人违法违规及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况

报告期内，公司不存在重大违法违规行为或受到重大处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况。

四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情况。

五、发行人独立运行情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立、健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于实际控制人及其控制的其他企业，具有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整情况

公司拥有独立、完整的与生产经营相配套的资产，包括厂房、机器设备等固定资产，以及专利、商标等无形资产的所有权或使用权。公司与实际控制人之间资产权属清晰，公司资产独立于实际控制人及其控制的其他企业。

截至本招股说明书签署日，公司不存在以资产、权益或信誉为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况；也不存在资产、资金被实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立情况

公司已建立独立的劳动、人事、工资报酬、社会保障管理体系，独立招聘员工，与员工签署劳动合同。公司董事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生。

公司的高级管理人员均未在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；未在实际控制人控制的其他企业领薪。公司的财务人员专职在公司工作并领取薪酬，未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立情况

公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；公司独立设立银行账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司的财务独立于实际控制人及其控制的其他企业。

（四）机构独立情况

公司按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，建立了股东会、董事会及其下属各专门委员会、经营管理层等权力机构、决策机构、监督机构及经营管理机构，并制定了各机构的议事规则，明确了各机构的职责，建立了独立的法人治理结构及公司组织机构。

公司拥有独立的职能部门，各职能部门之间分工明确、各司其职、协同配合，保证了公司的规范运作。公司与实际控制人控制的其他企业在机构设置、办公场所等方面完全独立，不存在机构混同、合署办公的情形。

（五）业务独立情况

公司的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在构成重大不利影响的同业竞争以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易，具有独立面对市场的能力。

（六）主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定

公司主营业务、控制权、管理团队稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；公司的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近两年实际控制人没有发生变更。

（七）不存在对持续经营有重大影响的或有事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在涉及主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况

截至本招股说明书签署日，除发行人及其子公司外，发行人实际控制人王强控制的企业均系公司的员工持股平台，未实际经营业务，不存在与发行人从事相同、相似业务的情况。因此，公司与实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争的情况。

（二）实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为避免今后与发行人之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，发行人的实际控制人及其一致行动人向发行人出具了避免同业竞争的承诺函，具体内容详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺”之“（八）实际控制人及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺”。

七、关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则》及中国证监会、深交所的规定，公司主要关联方包括：

（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人

截至本招股说明书签署日，公司无控股股东，实际控制人为王强，济沧海、杭州端一、杭州且何为实际控制人的一致行动人，具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”及“（二）实际控制人的一致行动人”。

（二）持有公司 5%以上股份的法人股东及其一致行动人、持有发行人 5%以上股份的自然人股东

截至本招股说明书签署日，除公司实际控制人及其一致行动人以外，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东包括天堂硅谷长实、赵轶、长川科技、半导体装备二期基金、嘉兴芯传、嘉兴芯测，具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况”之“（五）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东”。

此外，持有公司 5%以上股份的法人股东的一致行动人为公司的关联方。

（三）公司董事、高级管理人员

公司现任董事、高级管理人员具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况”。

（四）上述（一）至（三）项中关联自然人关系密切的家庭成员

公司上述关联自然人关系密切的家庭成员，包括其配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、年满 18 周岁的子女及其配偶、子女配偶的父母。

（五）上述（一）至（四）项中关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的其他法人或其他组织

由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及公司控制子公司外的其他法人或其他组织如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	江西和众贸易有限公司	实际控制人王强配偶的哥哥持有 50%股权，并担任董事、经理
2	武汉伟豫金属材料有限公司（已注销公告）	实际控制人王强配偶的哥哥持有 100%股权
3	苏州市能源发展集团有限公司	独立董事王要玉担任董事
4	聊城市华信汽车服务有限公司	职工代表董事丁宁的弟弟持有 100%股权
5	聊城市高才教育咨询有限公司	职工代表董事丁宁的弟弟持有 90%股权，并担任执行董事、总经理；职工代表董事丁宁的父亲持有 10%股权，并担任财务负责人
6	长川科技哈尔滨分公司	股东赵轶控制的长川科技的分公司
7	长川科技成都分公司	股东赵轶控制的长川科技的分公司
8	长川科技北京分公司	股东赵轶控制的长川科技的分公司
9	CCTECH JAPAN 株式会社	股东赵轶控制的长川科技的日本全资子公司
10	长川科技（香港）有限公司	股东赵轶控制的长川科技的中国香港全资子公司
11	杭州长新投资管理有限公司	股东赵轶控制的长川科技的全资子公司
12	Semiconductor Technologies&Instruments Pte Ltd.	杭州长新投资管理有限公司的新加坡全资子公司
13	Semiconductor Technologies& Instruments SDN. BHD.	Semiconductor Technologies&Instruments Pte Ltd.的马来西亚全资子公司
14	STI Tech Korea Co., Ltd.	Semiconductor Technologies&Instruments Pte Ltd.的韩国全资子公司
15	Semiconductor Technologies& Instruments PHILS., INC	Semiconductor Technologies&Instruments Pte Ltd.的菲律宾全资子公司
16	杭州长奕科技有限公司	股东赵轶控制的长川科技的全资子公司
17	EXIS TECH SDN.BHD.	杭州长奕科技有限公司的马来西亚全资子公司
18	EXIS TECH SALES AND SERVICES SDN. BHD.	EXIS TECH SDN.BHD.的马来西亚全资子公司
19	利益高科技（香港）有限公司	EXIS TECH SDN.BHD.的中国香港全资子公司
20	CCTECH INTERNATIONAL SALES & SERVICES SDN.	利益高科技（香港）有限公司的马来西亚全资子公司

序号	关联方名称	关联关系
	BHD.	
21	长川科技（苏州）有限公司	股东赵轶控制的长川科技的全资子公司
22	镇江超纳仪器有限公司	长川科技（苏州）有限公司的全资子公司
23	长川科技（内江）有限公司	股东赵轶控制的长川科技的全资子公司
24	杭州长川人进出口有限公司	股东赵轶控制的长川科技的全资子公司
25	长川人科技（上海）有限公司	股东赵轶控制的长川科技的全资子公司
26	长川（内江）进出口有限公司	股东赵轶控制的长川科技的全资子公司
27	科为升视觉技术（苏州）有限公司	股东赵轶控制的长川科技的全资子公司
28	长川半导体（深圳）有限公司	股东赵轶控制的长川科技的控股子公司
29	长迈半导体（成都）有限公司	股东赵轶控制的长川科技的控股子公司
30	长川科技（武汉）有限公司	长迈半导体（成都）有限公司的全资子公司
31	杭州长川智能制造有限公司	股东赵轶控制的长川科技的**全资**子公司
32	PYXIS CF PTE.LTD	股东赵轶控制的长川科技的控股子公司
33	宁波芯怡股权投资合伙企业（有限合伙）	股东赵轶担任执行事务合伙人
34	杭州长越科技有限公司	股东赵轶担任董事、经理
35	杭州长川投资管理合伙企业（有限合伙）	股东赵轶的配偶担任执行事务合伙人
36	杭州芯合壹投资合伙企业（有限合伙）	股东赵轶的配偶担任执行事务合伙人
37	长越科技香港有限公司	股东赵轶的配偶担任董事
38	长超科技香港有限公司	股东赵轶的配偶担任董事
39	重庆迈恒输配电设备制造有限公司	股东赵轶关系密切的家庭成员持有 63.50%股权，并担任执行董事兼总经理
40	**长川半导体（内江）有限公司**	**股东赵轶控制的长川科技的全资子公司**

（六）发行人控股子公司、合营企业及联营企业

截至本招股说明书签署日，公司控股子公司的基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人分公司、子公司及参股公司情况”。公司不存在合营企业以及联营企业。

（七）报告期内曾经的关联方

序号	关联方名称	关联关系	备注
1	芜湖县花桥镇硕朋电子经营部	实际控制人王强的弟弟王军曾经营的个体工商户	已于 2025 年 1 月注销

序号	关联方名称	关联关系	备注
2	苏州工业园区俊秀办公商贸经营部	董事朱伟曾经营的个体工商户	已于 2023 年 3 月注销
3	苏州工业园区妆丝木鱼化妆品店	职工代表董事丁宁曾经营的个体工商户	已于 2023 年 12 月注销
4	李明	原董事	李明已于 2025 年 10 月卸任公司董事
5	玖溢投资管理（上海）有限公司	原董事李明曾担任董事	李明已于 2025 年 10 月卸任公司董事
6	湖南富华生态农业发展有限公司	原董事李明担任董事	李明已于 2025 年 10 月卸任公司董事
7	侯文	原监事	侯文已于 2025 年 11 月卸任公司监事
8	无为县刘渡镇老街超市	原监事侯文父亲侯晓兵经营的个体工商户	侯文已于 2025 年 11 月卸任公司监事
9	王传刚	原职工代表监事	王传刚已于 2025 年 11 月卸任职工代表监事
10	宋晓燕	原监事	宋晓燕已于 2023 年 5 月卸任公司监事
11	浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	原监事宋晓燕担任董事	宋晓燕已于 2023 年 5 月卸任公司监事
12	浙江数投资产管理有限公司	原监事宋晓燕担任董事	宋晓燕已于 2023 年 5 月卸任公司监事
13	赋实投资	曾持有发行人 5%以上股份	已于 2025 年转让发行人股份
14	共青城长柳	曾持有发行人 5%以上股份	已于 2026 年转让发行人股份
15	苏州灿途益高智能装备有限公司	股东长川科技曾间接持有 100%股权	已于 2025 年 12 月注销
16	常州长川科技有限公司	股东长川科技曾持有 100%股权，且股东赵轶曾担任执行董事	已于 2024 年 8 月注销
17	紫津原石（杭州）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	股东赵轶曾担任执行事务合伙人	已于 2025 年 11 月注销
18	湖北鑫铧股权投资管理有限公司	股东赵轶曾担任董事	已于 2022 年 10 月注销
19	重庆迈恒向德机电设备有限公司	股东赵轶关系密切的家庭成员曾持有 100%股权并担任执行董事兼经理	已于 2023 年 3 月注销
20	**芜湖三莳室内设计有限公司**	**原监事侯文的配偶担任财务负责人**	**侯文已于 2025 年 11 月卸任公司监事**

八、关联交易

（一）重大关联交易的判断标准及依据

报告期内，公司与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；或与关联法人发生的成交金额超过 300 万元，且高于发行人最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易；以及与关联方之间的资金拆借、资产转让等关联交易，在综合考虑关联交易对公司财务状况和经营成果的影响下，认定为重大关联交易。公司与关联方的其他交易视

为一般关联交易。具体情况如下：

（二）关联交易汇总表

报告期内，公司与关联方发生的关联交易汇总如下：

单位：万元

交易类型	交易对方	交易内容	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经常性关联交易	长川科技	采购分选机等	-	1.06	-	76.40
	长川科技	销售分选换型套件、测试接口连接模组等	**3,469.02**	5,389.19	3,340.63	2,398.63
	关键管理人员	关键管理人员薪酬	详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、高级管理人员及核心技术人员”之“（六）董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况”			

（三）重大经常性关联交易

报告期内，发行人存在向关联方长川科技销售的情形，具体如下：

单位：万元

交易方名称	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占当期营业收入比例	金额	占当期营业收入比例	金额	占当期营业收入比例	金额	占当期营业收入比例
长川科技	**3,469.02**	**7.88%**	5,389.19	9.91%	3,340.63	10.79%	2,398.63	10.64%

报告期各期，公司对长川科技关联销售的金额分别为 2,398.63 万元、3,340.63 万元、5,389.19 万元**和 3,469.02 万元**，分别占当期营业收入的 10.64%、10.79%、9.91%**和 7.88%**，销售内容主要系分选换型套件、测试接口连接模组等，系长川科技基于其自身实际经营与生产需求向公司进行的采购。

公司上述关联销售具备充分的商业合理性与必要性，销售定价遵循市场化原则，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况，亦不存在关联交易披露不规范或应披露未披露的关联交易事项。

（四）一般经常性关联交易

1、关联采购

报告期内，发行人存在向关联方长川科技采购的情形，具体如下：

单位：万元

交易方名称	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占当期采购金额比例	金额	占当期采购金额比例	金额	占当期采购金额比例	金额	占当期采购金额比例
长川科技	-	-	1.06	0.003%	-	-	76.40	0.77%

报告期各期，公司关联采购的金额分别为 76.40 万元、0.00 万元、1.06 万元和 0.00 万元，分别占当期采购金额的 0.77%、0.00%、0.003%和 0.00%。采购内容主要系分选机等，采购金额较小，占公司采购金额比例较低。

2、关键管理人员薪酬

公司关键管理人员薪酬具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、高级管理人员及核心技术人员”之“（六）董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况”。

（五）重大偶发性关联交易

报告期内，公司与关联方不存在重大偶发性关联交易。

（六）一般偶发性关联交易

报告期内，公司与关联方不存在一般偶发性关联交易。

（七）关联方往来款项余额

报告期各期末，公司关联方往来款项余额情况如下：

单位：万元

关联方名称	款项性质	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
长川科技	应收账款	2,508.29	2,869.40	2,525.29	1,369.90
	应收票据	550.69	1,179.89	377.53	625.11
	应收款项融资	2,261.19	286.22	125.39	248.08
	预付款项	1.20	-	1.20	-

（八）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方发生的经常性关联交易均建立在真实业务需求基础之上，具备商业合理性；公司与关联方不存在偶发性关联交易。报告期内，公司与关联方发生的关联交易定价依据合理、交易价格公允，且履行了相关的审议程序。

综上，公司报告期内的关联交易对其财务状况与经营成果均未造成重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

（九）规范和减少关联交易的措施及承诺

公司根据《公司法》等法律法规的规定，建立了完善的公司治理结构，在《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等制度中对关联交易的决策权力、决策程序、回避表决制度及信息披露义务作出了明确的规定，以保证公司关联交易的公允性，并确保关联交易不损害公司及其他中小股东的利益。

公司实际控制人以及公司董事、高级管理人员承诺规范和减少关联交易，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺”之“（九）控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员、单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东关于规范和减少关联交易的承诺”。

（十）报告期内关联交易制度的执行情况、履行的审批程序及独立董事意见

1、报告期内发行人关联交易程序执行情况

公司已召开董事会、董事会审计委员会、股东会对报告期内公司与关联方交易情况进行确认，确认公司报告期内发生的关联交易不存在损害发行人及发行人其他股东利益的情形，相关关联董事、关联股东均已严格依法履行了回避表决程序。

2、独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议对报告期内公司与关联方交易情况的内容、交易价格公允性、审议程序合法有效性等进行了审议，并同意提交董事会审议。

第九节 投资者保护

一、本次发行前滚存利润分配方案

根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》，公司本次发行上市前所形成的滚存未分配利润，由本次发行上市完成后的全体新老股东按照发行后的持股比例共享。

二、发行人股利分配政策

（一）公司本次发行后的股利分配政策

1、公司章程中利润分配相关规定

公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《苏州法特迪科技股份有限公司章程（草案）》，自公司首次公开发行股票并上市后适用，约定了公司本次发行后的股利分配政策如下：

（1）公司的利润分配原则：公司应实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（2）公司的利润分配形式：可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金方式分配股利。公司采用股票方式分配股利的，应结合公司的经营状况和股本规模，充分考虑成长性、每股净资产的摊薄等因素。

（3）现金分红的条件：1）公司累积可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的 10%，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（4）股票股利分红的条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润与上一年度相比保持增长，且董事会认为公司进行股票股利分配不会造成公司股本规模及股权结构不合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

（5）利润分配的比例及期间间隔：在符合利润分配原则及条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东会召开后可以进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，半年度财务报告可不经审计。

公司应保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

考虑到公司目前处于成长期，如公司有重大资金支出安排的，公司进行利润分配时现金分红在该次利润分配中所占比例不低于 20%；如公司无重大资金支出安排的，公司进行利润分配时现金分红在该次利润分配中所占比例不低于 30%。

前款所称“重大资金支出”指预计在未来一个会计年度一次性或者累计资金支出超过 5,000 万元或公司未来一个会计年度内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 30%。

（6）公司利润分配的制定和审议程序：

1）公司利润分配政策和利润分配方案应由公司董事会制订，并经董事会审议通过后提交公司股东会批准，独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。审计委员会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议。

①董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

②董事会在决策和形成利润分配预案时，应详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、审计委员会意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

③股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2）公司因特殊原因而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报中详细披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益事项，并经股东会审议通过。

（7）公司利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、本章程的有关规定，分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。独立董事、审计委员会应当对利润分配政策调整方案发表意见。

（8）公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履责尽职并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

2、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，公司制订了公司上市后未来三年股东分红回报规划。公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年分红回报规划的议案》。

制定该规划的原则如下：公司董事会根据相关法律法规要求及当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东要求和意愿的基础上，平衡股东回报与公司未来发展的关系，保证股利分配政策的稳定性和可行性，通过建立更加科学、合理的投资者回报机制，在兼顾股东回报和企业发展的同时，保证股东长期利益的最大化，从而确定合理的利润分配规划及具体方案。

制定该规划考虑的因素如下：公司上市后未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前

及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。

3、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性

（1）发行人上市后三年内的利润分配计划

1）利润分配方式

公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序：具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2）实施现金分配的条件

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②公司累计可供分配利润为正值；

③审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

④公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来一个会计年度内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 30%或在未来一个会计年度一次性或者累计资金支出超过 5,000 万元。

3）实施股票分红的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

4）现金分配的比例

①公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时公司应当优

先采用现金分红进行利润分配，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%。

②公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十；

B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之四十；

C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之二十；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理；

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

5）现金分配的时间间隔

在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东会审议通过后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东会审议批准。

6）公司利润分配的制定和审议程序

①公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

②公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

③审计委员会应当审议利润分配方案，并作出决议。

④董事会和审计委员会审议并通过利润分配方案后提交股东会审议批准。

⑤股东会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东会表决。股东对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

⑥公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会审议通过后 2 个月内完成利润分配事项。

7）公司利润分配政策的调整机制

公司应当严格执行章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。根据公司发展阶段变化、生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；独立董事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合章程规定的条件等事项发表明确意见，且公司应在股东会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题，必要时，可通过网络投票系统征集股东意见。

公司调整现金分红政策的具体条件：

①公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；

②自利润分配的股东会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金

等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；

③按照既定分红政策执行将导致公司股东会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；

④董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。

8）利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、审计委员会发表意见，同时在召开股东会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

（2）制订的依据和可行性

公司上市后三年内的利润分配计划的制定依据详见本节“二、发行人股利分配政策”之“（一）公司本次发行后的股利分配政策”之“2、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由”，上述利润分配计划具有可行性。

4、公司长期回报规划内容及制定考虑因素

公司将着眼于长远和可行性发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的稳定性和连续性。

公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。公司至少每

三年重新审阅一次股东分红回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当前资金需求，制定年底或中期分红方案。

公司长期回报规划的内容详见本节“二、发行人股利分配政策”之“（一）公司本次发行后的股利分配政策”之“1、公司章程中利润分配相关规定”及“3、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性”。

（二）发行前后股利分配政策的差异情况

与发行前股利分配政策相比，本次发行后的股利分配政策进一步细化了在利润分配的比例及期间间隔、公司利润分配的制定和审议程序等方面的具体规定，以更好地保障公众投资者利益，给予投资者合理、稳定的投资回报。

三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

本节所披露的重大合同是指报告期内公司及子公司履行完毕、正在履行和将要履行且对公司生产经营、财务状况或未来发展具有重要影响的合同，公司结合自身业务特点，参照重要性水平的确定标准和依据，综合考虑总资产、营业收入、净利润等财务指标，确定了各类重大合同的标准，具体情况如下：

（一）销售合同

公司与主要客户一般采用“框架性协议+订单”或订单式销售的合作方式。其中，“框架性协议+订单”方式中，公司通常与客户签署框架合作协议，协议中约定产品购销相关原则性事宜及双方的权利义务，但针对具体采购的产品型号、数量、单价等，双方将通过单独订单的方式确定。

公司重要销售合同的认定标准为：报告期内各期与前五大客户所签订的框架协议；如未与相关客户签订框架协议，则选取报告期内单笔交易金额最高的销售订单作为重要销售合同。报告期内，公司重大销售合同情况如下：

序号	客户名称	合同金额（万元）	主要销售内容	履行期限	截至本招股说明书签署日履行情况
1	杭州芯云半导体集团有限公司及其部分子公司	框架协议	具体以订单为准	自 2024 年 1 月 5 日起长期有效，除（1）双方以书面方式约定终止本协议；（2）双方前述新的相同主题的协议取代该协议	正在履行
2	矽品科技（苏州）有限公司	2,958.25	老化测试座	自 2025 年 6 月 27 日起生效，至产品交付完成	履行完毕
3	杭州长川科技股份有限公司及其部分子公司	框架协议	具体以订单为准	自 2023 年 1 月 29 日起长期有效，需方有权提前 30 日书面通知供方终止协议，原则上供方不得单方终止协议，如确有特殊原因需提前 10 个月以书面形式提出	**履行完毕**
4	京隆科技（苏州）有限公司	框架协议	具体以订单为准	自 2024 年 11 月 29 日起生效，有效期间至 2029 年 12 月 31 日止，合约期满，若双方无反对续约之意思外，合同自动延展一年	正在履行
5	Chengdu Monolithic Power Systems Co.,	框架协议	具体以订单为准	2025 年 11 月 7 日至 2028 年 12 月 31 日	正在履行

序号	客户名称	合同金额（万元）	主要销售内容	履行期限	截至本招股说明书签署日履行情况
	Ltd				
6	上海复旦微电子集团股份有限公司	框架协议	具体以订单为准	2022 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 7 日	履行完毕
7	展讯通信（上海）有限公司	框架协议	具体以订单为准	自 2022 年 8 月 15 日起长期生效，除非根据该协议的约定被提前终止	正在履行
8	杭州海康智能科技有限公司	框架协议	具体以订单为准	2020 年 9 月 21 日至 2022 年 9 月 20 日。协议一方未在终止日前 60 天发出终止通知，自动延续一次，延续有效期一年	履行完毕
9	**杭州长川科技股份有限公司及其部分子公司**	**框架协议**	**具体以订单为准**	**2026 年 4 月 7 日至 2028 年 4 月 6 日，需方有权提前 30 日书面通知供方终止协议，原则上供方不得单方终止协议，如确有特殊原因需提前 10 个月以书面形式提出**	**正在履行**
10	**渠梁电子有限公司**	**3,219.69**	**老化测试座**	**自 2026 年 4 月 24 日起生效，至产品交付完成**	**履行完毕**

（二）采购合同

对于主要原材料供应商，公司通常与其采用“框架性协议+订单”的采购合作方式，即公司通常与该类供应商签署年度框架性协议，协议中一般仅约定原材料采购的相关原则性事宜及双方的权利义务，在具体采购执行中，公司会与供应商就具体物料类型、数量以及单价协商一致后再另行签署采购订单。

公司重要采购合同的认定标准为：公司与报告期各期前五大供应商签署的框架性协议，若与供应商未签署框架性协议或框架性协议未明确约定原材料采购类型，则选取报告期内单笔金额最大的采购订单。报告期内，公司重大采购合同情况如下：

序号	供应商名称	合同标的	合同价款	履行期限	截至本招股说明书签署日履行情况
1	苏州迪克微电子有限公司	功能测试探针	162.45 万元	2023 年 12 月 7 日至合同标的履行完毕	履行完毕
2	苏州矽图电子科技有限公司	老化测试探针	758.23 万元	2023 年 7 月 4 日至合同标的履行完毕	履行完毕
3	浙江日拓电子股份有限公司	功能测试探针	97.76 万元	2023 年 6 月 5 日至合同标的履行完毕	履行完毕
4	苏州廷宣精密机械有限公司	机械结构组件	94.40 万元	2023 年 2 月 16 日至合同标的履行完毕	履行完毕
5	凯利研创精密科技	测试座塑料底座	99.95 万元	2023 年 7 月 17 日至合	履行完毕

序号	供应商名称	合同标的	合同价款	履行期限	截至本招股说明书签署日履行情况
	（苏州）有限公司	部件等		同标的履行完毕	
6	苏州矽图电子科技有限公司	老化测试探针	943.55 万元	2024 年 6 月 19 日至合同标的履行完毕	履行完毕
7	苏州迪克微电子有限公司	功能测试探针、老化测试探针	204.79 万元	2024 年 9 月 14 日至合同标的履行完毕	履行完毕
8	凯利研创精密科技（苏州）有限公司	测试座塑料底座部件等	223.35 万元	2024 年 7 月 9 日至合同标的履行完毕	履行完毕
9	苏州廷宣精密机械有限公司	测试座金属部件等	89.18 万元	2024 年 7 月 8 日至合同标的履行完毕	履行完毕
10	浙江日拓电子股份有限公司	功能测试探针	85.19 万元	2024 年 7 月 3 日至合同标的履行完毕	履行完毕
11	苏州迪克微电子有限公司	老化测试探针、功能测试探针	1,001.12 万元	2025 年 8 月 1 日至合同标的履行完毕	履行完毕
12	苏州矽图电子科技有限公司	老化测试探针	2,313.00 万元	2025 年 11 月 5 日至合同标的履行完毕	履行完毕
13	浙江日拓电子股份有限公司	老化测试探针	600.00 万元	2025 年 8 月 1 日至合同标的履行完毕	履行完毕
14	凯利研创精密科技（苏州）有限公司	测试座塑料底座部件等	613.98 万元	2025 年 5 月 28 日至合同标的履行完毕	履行完毕
15	苏州廷宣精密机械有限公司	测试座金属部件	227.49 万元	2025 年 5 月 28 日至合同标的履行完毕	履行完毕
16	**苏州迪克微电子有限公司**	**老化测试探针**	**1,017.70 万元**	**2026 年 5 月 21 日至合同标的履行完毕**	**正在履行**
17	**苏州矽图电子科技有限公司**	**老化测试探针**	**3,300.00 万元**	**2026 年 2 月 5 日至合同标的履行完毕**	**正在履行**
18	**苏州廷宣精密机械有限公司**	**测试座金属部件**	**148.01 万元**	**2026 年 5 月 15 日至合同标的履行完毕**	**履行完毕**
19	**浙江日拓电子股份有限公司**	**老化测试探针**	**318.58 万元**	**2026 年 6 月 24 日至合同标的履行完毕**	**正在履行**
20	**赫思精密科技（苏州）有限公司**	**测试座金属部件**	**311.50 万元**	**2026 年 5 月 15 日至合同标的履行完毕**	**履行完毕**

（三）授信合同

报告期内，公司重大授信合同（5,000 万元及以上）情况如下：

单位：万元

序号	类型	签署主体	授信银行	授信金额	授信期限	截至本招股说明书签署日履行情况	担保情况
1	授信	公司	招商银行苏州分行	5,000.00	2025 年 12 月 18 日至 2026 年 12 月 17 日	正在履行	无
2	授信	公司	招商银行苏州分行	5,000.00	2024 年 9 月 2 日至 2025 年 9 月 1 日	履行完毕	无
3	授信	公司	招商银行苏州分行	5,000.00	2023 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日	履行完毕	无

序号	类型	签署主体	授信银行	授信金额	授信期限	截至本招股说明书签署日履行情况	担保情况
4	授信	公司	招商银行苏州分行	5,000.00	2022 年 4 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日	履行完毕	无

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司及子公司不存在对外担保事项。

三、重大诉讼、仲裁或其他事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在尚未完结的重大诉讼、仲裁或其他对公司经营有重大影响的事项。

第十一节 声明

一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：

王 强　　贺 涛　　朱 伟

丁 宁　　庞 凌　　王要玉

王 帆

苏州法特迪科技股份有限公司

2026 年 9 月 22 日

一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员签字：

王 帆	王要玉	朱 伟

苏州法特迪科技股份有限公司

2026 年 9 月 22 日

一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

除董事以外的全体高级管理人员签字：

金永斌 张辉 郭文霞

苏州法特迪科技股份有限公司

2026 年 9 月 22 日

二、发行人实际控制人声明

本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

实际控制人签字：

王 强

苏州法特迪科技股份有限公司

2026 年 9 月 22 日

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐代表人：

李 想　　王风雷

项目协办人：

王 娴（已离职）

法定代表人：

张佑君

中信证券股份有限公司

2026 年 9 月 22 日

保荐人（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读苏州法特迪科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

董事长：

张佑君

中信证券股份有限公司

2026 年 9 月 22 日

保荐人（主承销商）总经理声明

本人已认真阅读苏州法特迪科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

总经理：

邹迎光

中信证券股份有限公司

2026 年 9 月 22 日

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师：

项 也　　卢丽莎

律师事务所负责人：

徐旭青

国浩律师（杭州）事务所

2026 年 9 月 22 日

天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants
地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888
传真：（0571） 8821 6999

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《苏州法特迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2026〕17718 号）、《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕17719 号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对苏州法特迪科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

滕培彬

余慧玲

天健会计师事务所负责人：

缪志坚

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年 九月二十日

六、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读苏州法特迪科技股份有限公司招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的坤元评报〔2023〕753号资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资产评估师：

正式执业会员 资产评估师 柴 山 33000013

柴 山 韦艺佳（已离职）

资产评估机构负责人：

俞华开

坤元资产评估有限公司

2023 年 9 月 22 日

关于签字评估师离职的说明

本公司作为苏州法特迪科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的评估机构，出具了《法特迪精密科技（苏州）有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2023〕753 号），签字评估师为柴山、韦艺佳。

评估师韦艺佳已于 2026 年 4 月从本公司离职，故无法在苏州法特迪科技股份有限公司招股说明书之评估机构声明中签字。

特此说明！

资产评估机构负责人：

俞华开

坤元资产评估有限公司

2026 年 9 月 22 日

PAN-CHINA 天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888
传真：（0571） 8821 6999

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《苏州法特迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《验资报告》（天健验〔2023〕563 号、天健验〔2025〕462 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对苏州法特迪科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

滕培彬

余慧玲

严善明（已离职）

天健会计师事务所负责人：

缪志坚

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年 九 月二十二日

PAN-CHINA 天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888
传真：（0571） 8821 6999

关于签字注册会计师离职的说明

深圳证券交易所：

本所作为苏州法特迪科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板板上市验资机构，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕563 号），签字注册会计师为严善明和余慧玲。

严善明已于 2025 年 2 月从本所退休，故无法在《苏州法特迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》之“验资机构声明”中签字。

专此说明，请予察核。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：

缪志坚

二〇二六年 九 月二十二日

八、出资复核机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，确认招股说明书中引用的苏州法特迪科技股份有限公司专项复核报告（报告文号为：国府核字（2026）第01100002号）与本所出具的专项复核报告的内容不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的由本所出具的上述专项复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因引用由本所出具的上述专项复核报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述专项复核报告的真实性、准确性、完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

陈红燕

古涉

会计师事务所负责人：

申利超

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 9 月 22 日

第十二节 附件

一、备查文件

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报告及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；

（七）与投资者保护相关的承诺；

（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；

（九）内部控制审计报告；

（十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（十一）股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；

（十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；

（十三）募集资金具体运用情况；

（十四）子公司、参股公司简要情况；

（十五）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间及地点

（一）发行人

查阅地点：苏州法特迪科技股份有限公司

办公地点：苏州工业园区兴浦路 200 号 5#101、102、201、202

查阅时间：工作日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00

联系人：张辉

电话：0512-65916786

（二）保荐人

查阅地点：中信证券股份有限公司

办公地点：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 22 层

查阅时间：工作日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00

联系人：王风雷

电话：021-20262230

附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

（一）投资者关系的主要安排

为规范公司的信息披露行为，保护投资者依法享有的权利，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等相关法律、法规、规章和规则及《公司章程（草案）》的要求，结合公司实际情况制定了保护投资者权益的措施。具体如下：

1、信息披露制度和流程

公司通过制定《信息披露管理制度》，对公司信息披露的总体原则、披露内容、信息披露事务管理、信息沟通制度等事项进行了详细规定，确保公司按照有关法律法规履行信息披露义务，加强信息披露的管理工作，明确信息披露的具体流程。

2、投资者沟通渠道的建立情况

公司制定了《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》与《信息披露管理制度》等，由公司董事会秘书负责投资者关系管理；完善了公司与投资者的沟通、接待和服务工作机制；制定了详细的投资者关系管理原则、方式及内容，保证投资者与公司的顺利沟通。

3、未来开展投资者关系管理的规划

为加强投资者关系管理，提高信息披露质量，促进投资者对公司的了解，公司将严格按照《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等相关法律、法规、规章和规则及《公司章程（草案）》的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度。

公司将不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体股东利益，特别是中小股东的利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（二）股利分配决策程序

公司的股利分配决策程序详见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、发行

人股利分配政策”之“（一）公司本次发行后的股利分配政策”。

（三）股东投票机制建立情况

公司通过采用累积投票、中小投资者单独计票机制、网络投票、征集投票等方式，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策和选择管理者等事项的权利。

1、累积投票制度

根据《公司章程（草案）》《苏州法特迪科技股份有限公司累积投票制度》相关规定，股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票；股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制；单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司，应当采用累积投票制。

2、中小投资者单独计票机制

根据《公司章程（草案）》相关规定，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

3、提供股东会网络投票方式

根据《公司章程（草案）》相关规定，股东会将设置会场，以现场会议形式召开，还可以同时采用电子通信方式召开。公司还将提供网络或采用安全、经济、便捷的其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

4、征集投票权的相关安排

根据《公司章程（草案）》相关规定，公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

附件二：与投资者保护相关的承诺

（一）关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺

1、实际控制人及其一致行动人承诺

（1）王强承诺

自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前股份，也不由公司回购该部分股份。

自公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行上市的发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。

公司上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。

本人所持公司股份锁定期届满后，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，所持股份总数不超过 1,000 股的除外；自本人离职之日起六个月内，不转让本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守前述限制。

本人在所持公司股份锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行上市的发行价（若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权除息事项，则发行价作相应调整）。

在前述承诺的股份锁定期限届满后，本人减持公司首发前股份时将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。

本人在减持所持有的公司股份前，如通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所备案减持计划并予以公告；如采取其他方式减持的，将提前三个交易日予以公告。本人采取集中竞价、大宗交易方式减持股份的，在计算减持比例时，如果本人存在一致行动人，本人与一致行动人的持股比例应当合并计算。

本人持股锁定期届满后拟减持公司股份的，将严格遵守减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等公司内部治理制度的有关最新规定。

本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，且不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行；如本人未遵守上述承诺，本人因此所得收益将归属公司，对公司造成任何损失的，本人同意依法承担相应责任。

（2）济沧海、杭州且何、杭州端一承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前股份，也不由公司回购该部分股份。

自公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行上市的发行价，则本企业持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。

公司上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月。

本企业在所持公司股份锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行上市的发行价（若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权除息事项，则发行价作相应调整）。

在前述承诺的股份锁定期限届满后，本企业减持公司首发前股份时将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。

本企业在减持所持有的公司股份前，如通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所备案减持计划并予以公告；如采取其他方式减持的，将提前三个交易日予以公告。本企业采取集中竞价、大宗交易方式减持股份的，在计算减持比例时，如果本企业存在一致行动人，本企业与一致行动人的持股比例应当合并计算。

本企业持股锁定期届满后拟减持公司股份的，将严格遵守减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等公司内部治理制度的有关最新规定。

本企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，如本企业未遵守上述承诺，本企业因此所得收益将归属公司，对公司造成任何损失的，本企业同意依法承担相应责任。

2、天堂硅谷长实、长川科技承诺

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前股份，也不由公司回购该部分股份。

本企业在所持公司股份锁定期届满后两年内减持的，减持公司股票价格将结合公司股票市场交易价格，且在符合法律、法规及相关规则的前提下，本企业减持的股份数量最高不超过本企业所持公司股份的 100%。

在本企业持有公司 5%以上股份期间，本企业在减持所持有的公司股份前，如通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划并予以公告，如采取其他方式减持的，依照减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件有关最新规定执行；本企业采取集中竞价、大宗交易方式减持股份的，在计算减持比例时，如果本企业存在一致行动人，本企业与一致行动人的持股比例应当合并计算。本企业及一致行动人（如有）直接或间接合计持有公司股份低于 5%以下时，则本企业减持适用减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件有关最新规定。

本企业持股锁定期届满后拟减持公司股份的，将严格遵守减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等公司内部治理制度的有关最新规定。

本企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，如本企业未遵守上述承诺，本企业因此所得收益将归属公司，对公司造成任何损失的，本企业同意依法承担相应责

任。

3、半导体装备二期基金、嘉兴芯测、嘉兴芯传承诺

本企业作为公司本次公开发行申报前 12 个月内通过受让股份入股的新增股东，自本企业实际取得该等股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前股份，也不由公司回购该部分股份。

本企业在所持公司股份锁定期届满后两年内减持的，减持公司股票价格将结合公司股票市场交易价格，且在符合法律、法规及相关规则的前提下，本企业减持的股份数量最高不超过本企业所持公司股份的 100%。

在本企业单独或合计持有公司 5%以上股份期间，本企业在减持所持有的公司股份前，如通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划并予以公告，如采取其他方式减持的，依照减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件有关最新规定执行；本企业采取集中竞价、大宗交易方式减持股份的，在计算减持比例时，如果本企业存在一致行动人，本企业与一致行动人的持股比例应当合并计算。本企业及一致行动人直接或间接合计持有公司股份低于 5%以下时，则本企业减持适用减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件有关最新规定。

本企业持股锁定期届满后拟减持公司股份的，将严格遵守减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等公司内部治理制度的有关最新规定。

本企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，如本企业未遵守上述承诺，本企业因此所得收益将归属公司，对公司造成任何损失的，本企业同意依法承担相应责任。

4、赵轶承诺

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前股份，也不由公司回购该部分股份。

本人在所持公司股份锁定期届满后两年内减持的，减持公司股票价格将结合公司股票市场交易价格，且在符合法律、法规及相关规则的前提下，本人减持的股份数量最高不超过本人所持公司股份的 100%。

在本人单独或合计持有公司 5%以上股份期间，本人在减持所持有的公司股份前，如通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划并予以公告，如采取其他方式减持的，依照减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件有关最新规定执行；本人采取集中竞价、大宗交易方式减持股份的，在计算减持比例时，如果本人存在一致行动人，本人与一致行动人的持股比例应当合并计算。本人及一致行动人直接或间接合计持有公司股份低于 5%以下时，则本人减持适用减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件有关最新规定。

本人持股锁定期届满后拟减持公司股份的，将严格遵守减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等公司内部治理制度的有关最新规定。

本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，如本人未遵守上述承诺，本人因此所得收益将归属公司，对公司造成任何损失的，本人同意依法承担相应责任。

5、创新资本、湾区社保基金、永鑫融堰、苏州融享、嘉兴鑫先、宝台杜鹃、冯源晟芯、冯源仁芯、铜陵施捷、元利一期承诺

本企业作为公司本次公开发行申报前 12 个月内通过受让股份入股的新增股东，自本企业实际取得该等股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前股份，也不由公司回购该部分股份。

本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。

如违反上述承诺，本企业因此所得收益将归属公司，因此给公司或其股东造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。

6、黄建满、徐越、陈军、江俊豪、郑梅莲、魏来、石磊承诺

本人作为公司本次公开发行申报前 12 个月内通过受让股份入股的新增股东，自本人实际取得该等股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前股份，也不由公司回购该部分股份。

本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行

公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。

如违反上述承诺，本人因此所得收益将归属公司，因此给公司或其股东造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

7、其他直接股东承诺

自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的首次公开发行前发行人股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致其持有的发行人股份发生变化的，本企业/本人仍将遵守上述承诺。

本企业/本人将严格遵守上述关于股份锁定的相关承诺，本企业/本人持股锁定期届满后拟减持发行人股份的，将严格遵守包括但不限于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《创业板上市规则》等减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等公司内部治理制度的有关最新规定。

若中国证监会、证券交易所对创业投资基金、私募股权投资基金等减持股份另有规定的，从其规定执行。

如本企业/本人未遵守上述承诺，对发行人造成任何损失的，本企业/本人同意依法承担相应责任。

8、其他董事、高级管理人员、核心技术人员承诺

（1）贺涛、朱伟、丁宁、张辉、郭文霞、金永斌承诺

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前股份，也不由公司回购该部分股份。

自公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，

则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行上市的发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。

本人所持发行人股份锁定期届满后，本人在发行人担任董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，所持股份总数不超过 1,000 股的除外；自本人离职之日起六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守前述限制。

本人在所持公司股份锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行上市的发行价。

若公司因重大违法情形触及退市标准的，本人自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判做出之日起至公司股票终止上市并摘牌前不减持公司股份。

本人持股锁定期届满后拟减持公司股份的，将严格遵守减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等公司内部治理制度的有关最新规定。

本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，且不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。如本人未遵守上述承诺，本人因此所得收益将归属公司，对公司造成任何损失的，本人同意依法承担相应责任。

（二）稳定股价的措施和承诺

1、首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案

（1）启动和停止股价稳定预案的条件

1）启动条件

公司首次公开发行股票并上市后 3 年内，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，若公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产（第 20 个交易日构成“稳定股价措施触发日”，最近一期审计基准日后，公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）则启动股价稳定预案。

2）停止条件

公司在稳定股价措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实

施完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：①公司股票连续 20 个交易日的收盘价均达到或高于公司最近一期末经审计的每股净资产；②单一会计年度内增持或回购金额累计已达到下述具体措施规定的上限要求；③继续实施将导致公司股权分布不符合上市条件。

因上述第①项条件达成而实施的稳定股价具体措施实施期满或方案终止执行后，如再次发生符合上述第①项的启动条件，则再次启动股价稳定预案。

（2）股价稳定的具体措施

当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。

公司稳定股价的具体措施包括公司回购股票，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股票、公司董事（独立董事除外，下文如无额外说明，公司董事均不含独立董事）及高级管理人员增持公司股票、公司回购公司股票。当公司某一交易日的股票收盘价触发稳定股价预案的启动条件时，公司将视股票市场情况、公司实际情况，按如下优先顺序：①公司回购股票；②控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股票；③董事、高级管理人员增持股票，实施股价稳定措施，直至触发稳定股价预案的条件消除。

具体措施如下：

1）公司回购股票

在不影响公司正常生产经营、持续盈利能力的情况下，经董事会、股东会审议通过，由公司通过法定方式回购公司股票。

①公司回购股份应符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2025 年修订）》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

②公司应当在稳定股价措施触发日起十五个交易日内召开董事会，审议稳定股价具体方案（方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容）。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票（如有投票权）。

③公司股东会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺就该等回购事宜在股东会上投赞成票。

④在股东会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续（如需）。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

⑤公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律、行政法规和规范性文件之要求外，还应符合下列各项要求：

A.公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；B.公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额，单次用于回购股份的资金金额不低于人民币 1,000 万元；C.公司累计回购股份总数不超过公司总股本的 10%，单次回购股份数量不得超过公司总股本的 2%。

公司通过交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。

公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续 20 个交易日回升到或超过最近一期末经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。

⑥在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下，公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，认为公司不宜或暂无须回购股票的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2）控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股票

在触发启动条件的情况下，如果公司未能在十五个交易日内公告股份回购计划，或因各种原因导致股份回购计划未能通过股东会的，或公司实施稳定股价措施后仍不满足“连续 10 个交易日公司股份收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产”的，控股股东、实际控制人应自触发启动条件之日起 20 个交易日内，或自知道公司股份回购计划未通过股东会之日起 10 个交易日内，或自公司稳定股价措施实施完毕之日起 10

个交易日内，就其采取稳定股价措施的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，具体包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息。公司控股股东、实际控制人增持股票的措施如下：

①公司控股股东、实际控制人应当在符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关法律法规、部门规章及规范性文件规定的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，通过交易所集中竞价交易方式或者中国证监会、证券交易所认可的其他方式增持公司股票。

②控股股东、实际控制人应当在公司回购股份具体措施实施完毕后连续 10 个交易日的收盘价低于每股净资产时采取增持公司股票方式稳定股价。

③公司控股股东、实际控制人应在其稳定股价措施触发日起十五个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。

④公司控股股东、实际控制人为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律、行政法规和规范性文件之要求外，还应符合下列各项：

A.单次触发启动条件时用于增持公司股票的资金不少于其上一会计年度从公司获取税后现金分红合计金额的 20%，单一会计年度内用于增持公司股票的资金累计不超过其上一个会计年度从公司获取税后现金分红合计金额的 50%；

B.增持价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产；

C.合计单次增持金额不少于人民币 300 万元，每十二个月内合计增持股票数量不超过公司总股本的 2%。

3）公司董事及高级管理人员增持公司股票

若公司控股股东、实际控制人一次或多次实施增持后“启动条件”再次被触发，且控股股东、实际控制人用于增持公司股份的资金总额累计已经达到其上一个会计年度从公司获取税后现金分红合计金额的 50%的，则控股股东、实际控制人不再进行增持，而由各董事、高级管理人员进行增持。公司董事、高级管理人员增持股票的措施如下：

①公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事

和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，通过交易所集中竞价交易方式或者中国证监会、证券交易所认可的其他方式增持公司股票。

②公司董事、高级管理人员应在稳定股价措施触发日起十五个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。

③公司的董事、高级管理人员单次增持金额应不少于其上年度自公司领取薪酬的税后金额的 20%，每个自然年度内，公司的董事、高级管理人员因稳定股价而投入的资金不超过其上年度在公司领取薪酬（税后）的 40%，且增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。

④在遵守所适用的法律、法规、规范性文件的前提下，公司董事、高级管理人员以不高于公司最近一期末经审计的每股净资产的价格进行增持。

⑤公司董事、高级管理人员不得因职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。自本稳定股价预案生效之日至公司首次公开发行股票并上市之日及上市之日起三年内，公司若聘任新的董事、高级管理人员的，将在聘任前要求其签署承诺书，保证其履行公司本次发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。

（3）约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、负有增持义务的董事、高级管理人员均未采取上述稳定股价的具体措施或经协商应由相关主体采取稳定公司股价措施但相关主体未履行增持/回购义务以及无合法合理理由对公司股份回购方案投反对票或弃权票并导致股份回购方案未获得公司董事会/股东会通过的，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人、负有增持义务的董事、高级管理人员或未履行承诺的相关主体承诺接受以下约束措施：

1）对公司的约束措施

公司将在公司股东会及证券监管机构指定披露的媒体上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，公司将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。若公司董事会未履行相关公告义务、未制定股份回购计划并召开股东会审议，公司将暂停向董事发放薪酬或津贴，直至

其履行相关承诺为止。

2）对控股股东、实际控制人及其一致行动人的约束措施

控股股东、实际控制人及其一致行动人增持计划完成后 6 个月内不得转让所增持的公司股份。公司可扣留其下一年度与履行增持股份义务所需金额相对应的应得现金分红。如下一年度其应得现金分红不足用于扣留，该扣留义务将顺延至以后年度，直至累计扣留金额与其应履行增持股份义务所需金额相等或控股股东、实际控制人及其一致行动人采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，控股股东、实际控制人及其一致行动人将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。

3）对负有增持义务的董事、高级管理人员的约束措施

负有增持义务的董事、高级管理人员在增持计划完成后 6 个月内不得转让所增持的公司股份。如未采取上述稳定股价措施，董事、高级管理人员将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司将扣留该董事或高级管理人员与履行上述增持股份义务所需金额相对应的薪酬，直至该等人员采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，董事、高级管理人员将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。

任何对本预案的修订均应经股东会审议通过，且需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。

（三）关于股东信息披露的承诺

1、发行人承诺

本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。

本公司股东及其上层股东直接或间接持有发行人的股份均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。

本公司历史沿革中股权代持、委托持股等情形已经完全清理，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；本公司目前股东不存在股权代持、委托持股等情形，不存在纠纷和潜在纠纷。

发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他利益关系。

不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

本公司现任股东不存在离开中国证监会系统未满十年的原工作人员（以下简称“证监会系统离职人员”），具体包括从中国证监会会机关、派出机构、证券交易所、全国股转公司离职的人员；从中国证监会其他会管单位离职的原会管干部；在中国证监会发行监管司或公众公司监管司借调累计满十二个月并在借调结束后三年内离职的中国证监会其他会管单位人员；从中国证监会会机关、派出机构、证券交易所、全国股转公司调动到中国证监会其他会管单位并在调动后三年内离职的人员。

本公司现任股东不存在中国证监会系统离职人员的父母、配偶、子女及其配偶。

本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。

（四）对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺

1、发行人承诺

公司本次发行上市不存在不符合发行条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。

若中国证监会、深圳证券交易所或司法机关等有权部门认定公司存在欺诈发行行为的，公司将在该等违法事实被中国证监会、深圳证券交易所或司法机关等有权部门最终认定之日起五个工作日内启动股份回购程序、制定股份回购方案，并按照董事会、股东会审议通过的股份回购方案在规定时间内购回公司本次公开发行的全部新股。股票回购根据相关法律法规规定的程序实施，回购价格按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件依法确定，且不低于本次发行上市的公司股票发行价。如果公司上市后因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整。

如公司未履行相关承诺事项，公司将及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉；公司将在有关监管部门要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺。

2、实际控制人承诺

公司本次发行上市不存在不符合发行条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。

若中国证监会、深圳证券交易所或司法机关等有权部门认定公司存在欺诈发行行为的，本人将在该等违法事实被中国证监会、深圳证券交易所或司法机关等有权部门最终认定之日起极力督促公司在五个工作日内启动股份回购程序、制定股份回购方案，并按照董事会、股东会审议通过的股份回购方案在规定时间内购回公司本次公开发行的全部新股。股票回购根据相关法律法规规定的程序实施，回购价格按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件依法确定，且不低于本次发行上市的公司股票发行价。如果公司上市后因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整。

如本人未履行相关承诺事项，本人将及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉；本人将在有关监管部门要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺。

3、实际控制人的一致行动人承诺

公司本次发行上市不存在不符合发行条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。

若中国证监会、深圳证券交易所或司法机关等有权部门认定公司存在欺诈发行行为的，本企业将在该等违法事实被中国证监会、深圳证券交易所或司法机关等有权部门最终认定之日起极力督促公司在五个工作日内启动股份回购程序、制定股份回购方案，并按照董事会、股东会审议通过的股份回购方案在规定时间内购回公司本次公开发行的全部新股。股票回购根据相关法律法规规定的程序实施，回购价格按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件依法确定，且不低于本次发行上市的公司股票发行价。如果公司上市后因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整。

如本企业未履行相关承诺事项，本企业将及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉；本企业将在有关监管部门要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺。

（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、发行人承诺

为降低首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）摊薄即期回报的影响，公司将采取以下措施：

（1）积极提高公司竞争力，加强市场开拓

公司将不断加大研发投入，加强技术创新，完善管理制度及运行机制，积极研发新产品。同时，公司将不断增强市场开拓能力和快速响应能力，进一步提升公司品牌影响力及主要产品的市场占有率。

（2）加强内部控制，提升经营效率

公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，完善内控体系、制度建设，提高资金使用效率，节省公司的费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率和盈利能力。

（3）建立持续、稳定的利润分配政策，强化对股东的回报措施

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定和要求，在公司依照创业板相关业务规则制订的《公司章程》中明确规定利润分配政策的具体内容及分配条件，以及利润分配政策调整的决策程序和机制。公司已制定了上市后三年股东分红回报的具体计划，将按照上述规定和计划实施持续、稳定、科学的利润分配政策，以实现对股东的合理回报，保护投资者的合法权益。

（4）积极实施募集资金投资项目，加强募集资金管理

本次发行募集资金投资项目经过公司充分论证，符合行业发展趋势及公司发展规划。在募集资金到位前，对于部分募集资金投资项目，公司将以自有资金先行投入建设，同时，公司将加快推进募集资金投资项目的建设，以争取尽早实现预期效益。

公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储及使用、募集资金使用的管理与监督等进行了详细规定。本次发行募集资金到位后，募集资金将存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，做到专户存储、专款专用。公司将按照相关法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的使用进行严格管理，并积极配合募集资金专户的开户银行、保荐人对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金使用的

合法合规性，防范募集资金使用风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。

2、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

（1）王强承诺

本人将忠实、勤勉地履行作为实际控制人和/或控股股东的职责，维护发行人和全体股东的合法权益，不侵占发行人公司利益。

本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

对本人的职务消费行为进行约束。

本人不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

在自身职责和权限范围内，本人将全力促使发行人董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

如果发行人拟实施股权激励，本人将在自身职责和权限范围内，全力促使发行人拟公布的股权激励行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。

（2）济沧海、杭州端一、杭州且何承诺

本企业将忠实、勤勉地履行作为实际控制人和/或控股股东的一致行动人职责，维护发行人和全体股东的合法权益，不侵占发行人公司利益

本企业不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

本企业不动用发行人资产从事与本企业履行职责无关的投资、消费活动。

在自身职责和权限范围内，本企业将全力促使发行人董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

如果发行人拟实施股权激励，本企业将在自身职责和权限范围内，全力促使发行人拟公布的股权激励行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩

若本企业违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意按照证券监管机构制定或

发布的有关规定、规则，对本企业作出处罚或采取相关管理措施。

3、董事、高级管理人员承诺

承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；

承诺对本人的职务消费行为进行约束；

承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

承诺在自身职责和权限范围内，全力促使发行人董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；

如公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使发行人拟公布的股权激励行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；

若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。

（六）发行人关于利润分配政策的承诺

公司在本次发行上市后将严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程（草案）》及《苏州法特迪科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》等法律、法规和其他规范性文件的规定及公司治理制度的规定执行利润分配政策。如遇相关法律、法规和其他规范性文件修订的，公司将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。

如公司未能依照本承诺严格执行利润分配政策的，公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

（七）关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

1、发行人承诺

发行人承诺包括招股说明书在内的上市申请文件所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若包含招股说明书在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，而致使投资者在证券交易

中遭受损失的，则发行人将依照相关法律、法规和其他规范性文件的规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门或其他有权部门认定的方式或金额确定。

若包含招股说明书在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，且该等情形对判断是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则发行人承诺将依法回购本次公开发行的全部新股。股票回购根据相关法律法规规定的程序实施，回购价格按照证券监督管理部门颁布的规范性文件依法确定，且不低于本次发行上市的公司股票发行价。如果发行人上市后因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整。

若法律、法规和其他规范性文件及证券监督管理部门或其他有权部门对发行人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，发行人自愿无条件地遵从该等规定。

2、实际控制人承诺

本人承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若招股说明书及其他信息披露资料被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，而致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依照相关法律、法规和其他规范性文件的规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门或其他有权部门认定的方式或金额确定。

若招股说明书及其他信息披露资料被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人将促使发行人依法回购本次公开发行的全部新股，同时，本人作为实际控制人，将承担相关法律责任。股票回购根据相关法律法规规定的程序实施，回购价格按照证券监督管理部门颁布的规范性文件依法确定，且不低于本次发行上市的公司股票发行价。如果发行人上市后因派息、送股、资本公积金转

增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整。

若法律、法规和其他规范性文件及证券监督管理部门或其他有权部门对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。

3、董事、高级管理人员承诺

本人承诺包括招股说明书在内的上市申请文件所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若包含招股说明书在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，而致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依照相关法律、法规和其他规范性文件的规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门或其他有权部门认定的方式或金额确定。

若法律法规、规范性文件及证券监督管理部门或其他有权部门对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。

4、约束措施

如上述承诺未能及时履行，发行人将在股东会及中国证监会指定信息披露媒体及时进行公告，公开说明未能及时履行的原因，并将在定期报告中披露发行人及其实际控制人、董事、高级管理人员关于上述承诺事项的履行情况以及未能及时履行承诺时的相关补救及改正措施的实施情况。

如上述承诺未能及时履行，发行人及其实际控制人、董事、高级管理人员将在发行人股东会及中国证监会指定信息披露媒体就未及时履行上述承诺公开向社会公众股东及其他股东道歉。

在违反上述承诺期间，发行人的实际控制人、董事、高级管理人员直接或者间接持有的发行人股份将不得转让，直至其履行完毕上述承诺事项或者实施完毕相关补救及改正措施之日为止。

（八）实际控制人及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺

1、王强承诺

本人及本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员（以下合称“本人及近亲属”）目前没有投资或控制其他对发行人构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对发行人构成直接或间接竞争的业务或活动；本人及近亲属控制的其他企业未直接或间接从事与发行人相同或相似的业务。

本人及近亲属保证不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或控制从事与发行人有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

如发行人进一步拓展其业务范围，本人及近亲属承诺将不与发行人拓展后业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的业务产生竞争的情形，本人及近亲属将按照包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。

本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的企业遵守上述承诺。如因本人及近亲属未履行在本承诺中的承诺给发行人或其他股东造成损失的，本人将赔偿发行人或其他股东的实际损失。

上述承诺自签署之日起生效，直至本人不再为发行人实际控制人之日止。

2、济沧海、杭州端一、杭州且何承诺

本企业目前没有投资或控制其他对发行人构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对发行人构成直接或间接竞争的业务或活动；本企业控制的其他企业（如有）未直接或间接从事与发行人相同或相似的业务。

本企业保证不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或控制从事与发行人有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、

发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

如发行人进一步拓展其业务范围，本企业承诺将不与发行人拓展后业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的业务产生竞争的情形，本企业将按照包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。

如本企业控制其他企业，本企业将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。如因本企业未履行在本承诺函中的承诺给发行人或其他股东造成损失的，本企业将赔偿发行人或其他股东的实际损失。

上述承诺自签署之日起生效，直至本企业不再为发行人实际控制人的一致行动人之日止。

（九）实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员、单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东关于规范和减少关联交易的承诺

1、实际控制人及其一致行动人承诺

本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业（不包括发行人及其控制的企业，下同）将尽可能避免与发行人及其控制的企业发生关联交易（自发行人领取薪酬或津贴的情况除外）。对于将来不可避免发生的关联交易事项，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发行人及其控制的企业发生交易。

本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为发行人输送利益。如关联交易无法避免，本人/本企业保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、交易所规则、发行人章程的规定履行交易审批程序及信息披露义务。

本人/本企业保证不会利用关联交易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策以损害发行人及其他股东的合法权益。

在持有发行人股份期间，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及发行人相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用发行人的资金和资产，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股东利益的行为。

本人/本企业将促使本人的近亲属及本人/本企业控制的企业按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述承诺，本人/本企业将承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给发行人及其他股东造成的损失承担赔偿责任。本人拒不赔偿相关损失的，发行人有权相应扣减其应向本人/本企业支付的分红并向应当受偿的主体进行支付。

2、赵轶承诺

本人及本人控制的其他企业（不包括发行人及其控制的企业，下同）将尽可能避免与发行人及其控制的企业发生关联交易（自发行人领取薪酬或津贴的情况除外）。对于将来不可避免发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发行人及其控制的企业发生交易。

作为发行人关联方期间，本人及本人控制的其他企业保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为发行人输送利益。如关联交易无法避免，本人保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、交易所规则、发行人章程的规定履行交易审批程序及信息披露义务。

本人保证不会利用关联交易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策以损害发行人及其他股东的合法权益。

在持有发行人股份期间，本人及本人控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及发行人相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用发行人的资金和资产，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股东利益的行为。

作为发行人关联方期间，本人将促使本人的近亲属及本人控制的企业按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给发行人及其他股东造成的损失承担赔偿责任。本人拒不赔偿相关损失的，发行人有权相应扣减其应向本人支付的分红并向应当受偿的主体进行支付。

3、长川科技、天堂硅谷长实、半导体装备二期基金、嘉兴芯测、嘉兴芯传承诺

本企业及本企业控制的其他企业（不包括发行人及其控制的企业，下同）将尽可能避免与发行人及其控制的企业发生关联交易（自发行人领取薪酬或津贴的情况除外）。对于将来不可避免发生的关联交易事项，本企业及本企业控制的其他企业保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发行人及其控制的企业发生交易。

本企业及本企业控制的其他企业保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为发行人输送利益。如关联交易无法避免，本企业保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、交易所规则、发行人章程的规定履行交易审批程序及信息披露义务。

本企业保证不会利用关联交易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策以损害发行人及其他股东的合法权益。

在持有发行人股份期间，本企业及本企业控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及发行人相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用发行人的资金和资产，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股东利益的行为。

若违反上述承诺，本企业将承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给发行人及其他股东造成的损失承担赔偿责任。本企业拒不赔偿相关损失的，发行人有权相应扣减其应向本企业支付的分红并向应当受偿的主体进行支付。

4、非独立董事、高级管理人员承诺

本人及本人控制的其他企业（不包括发行人及其控制的企业，下同）将尽可能避免与发行人及其控制的企业发生关联交易（自发行人领取薪酬或津贴的情况除外）。对于将来不可避免发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发行人及其控制的企业发生交易。

本人及本人控制的其他企业保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为发行人输送利益。如关联交易无法避免，本人保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、交易所规则、发行人章程的规定履行交易审批程序及信息披露义务。

本人保证不会利用关联交易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策以损害发行人及其他股东的合法权益。

在持有发行人股份期间，本人及本人控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及发行人相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用发行人的资金和资产，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股东利益的行为。

本人将促使本人的近亲属及本人控制的企业按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给发行人及其他股东造成的损失承担赔偿责任。本人拒不赔偿相关损失的，发行人有权相应扣减其应向本人支付的分红并向应当受偿的主体进行支付。

（十）关于未能履行承诺的约束措施承诺

1、发行人承诺

公司将严格履行在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出的公开承诺事项，若非因不可抗力原因导致相关承诺未能完全履行、明确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取如下措施：

及时在股东会及证券监管机构指定的披露媒体上说明相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

若未能履行的相关承诺存在继续履行必要的，公司将继续履行该承诺。

若有关监管机关要求期限内予以整改或对本公司进行处罚的，公司将依法予以整改或接受处罚。

如因公司未能履行相关承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿，赔偿方式和金额依据公司与投资者协商或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

如公司在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。

根据届时有关规定可以采取的其他措施。

2、实际控制人承诺

鉴于本人作为发行人的实际控制人，在发行人申请首次公开发行股票并上市过程中出具了一系列承诺，为保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定，若非因不可抗力原因导致相关承诺未能完全履行、明确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取如下措施：

立即告知公司及公司其他股东，并在证券监管机构指定的披露媒体上说明相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

若未能履行的承诺存在继续履行必要的，本人将继续履行该承诺。

若有关监管机关要求期限内予以整改或对本人进行处罚的，本人将依法予以整改或接受处罚。

本人因违反相关承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失且经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的，本人将依法对公司或投资者进行赔偿，赔偿方式和金额依据本人与投资者协商或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人直接或间接持有的公司股份（如有）在其履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人薪酬、津贴或所获分配的现金红利（如有）用于承担前述赔偿责任。

本人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。

根据届时的有关规定可以采取的其他措施。

本人保证不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。

3、实际控制人之一致行动人承诺

本企业系苏州法特迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人之一致行动人，本企业将严格履行在公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出的公开承诺事项，若非因不可抗力原因导致相关承诺未能完全履行、明确已无法履行或无法按期履行的，本企业将采取如下措施：

立即告知公司及公司其他股东，并在证券监管机构指定的披露媒体上说明相关承诺

未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

若未能履行的相关承诺存在继续履行必要的，本企业将继续履行该承诺。

若有关监管机关要求期限内予以整改或对本企业进行处罚的，本企业将依法予以整改或接受处罚。

本企业因违反相关承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失且经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本企业应承担责任的，将依法对公司或投资者进行赔偿，赔偿方式和金额依据本企业与投资者协商或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

本企业在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。

根据届时有关规定可以采取的其他措施。

4、董事、高级管理人员承诺

本人系苏州法特迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事或高级管理人员，本人将严格履行在公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出的公开承诺事项，若非因不可抗力原因导致相关承诺未能完全履行、明确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取如下措施：

立即告知公司及公司其他股东，并在证券监管机构指定的披露媒体上说明相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

若未能履行的承诺存在继续履行必要的，本人将继续履行该承诺。

若有关监管机关要求期限内予以整改或对本人进行处罚的，本人将依法予以整改或接受处罚。

本人因违反相关承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失且经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的，本人将依法对公司或投资者进行赔偿，赔偿方式和金额依据本人与投资者协商或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人直接或间接持有的公司股份（如有）在其履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人薪酬、津贴或所获分配的现金红利（如有）用于承担前述赔偿责任。

本人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。

根据届时的有关规定可以采取的其他措施。

本人保证不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。

5、自然人股东承诺

本人系苏州法特迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，本人将严格履行在公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出的公开承诺事项，若非因不可抗力原因导致相关承诺未能完全履行、明确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取如下措施：

立即告知公司及公司其他股东，并在证券监管机构指定的披露媒体上说明相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

若未能履行的相关承诺存在继续履行必要的，本人将继续履行该承诺。

若有关监管机关要求期限内予以整改或对本人进行处罚的，本人将依法予以整改或接受处罚。

本人因违反相关承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失且经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的，将依法对公司或投资者进行赔偿，赔偿方式和金额依据本人与投资者协商或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

本人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。

根据届时有关规定可以采取的其他措施。

6、法人股东承诺

本企业系苏州法特迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，本企业将严格履行在公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出的公开承诺事项，若非因不可抗力原因导致相关承诺未能完全履行、明确已无法履行或无法按期履行的，本企业将采取如下措施：

立即告知公司及公司其他股东，并在证券监管机构指定的披露媒体上说明相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

若未能履行的相关承诺存在继续履行必要的，本企业将继续履行该承诺。

若有关监管机关要求期限内予以整改或对本企业进行处罚的，本企业将依法予以整改或接受处罚。

本企业因违反相关承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失且经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本企业应承担责任的，将依法对公司或投资者进行赔偿，赔偿方式和金额依据本企业与投资者协商或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

本企业在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。

根据届时有关规定可以采取的其他措施。

附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项

（一）关于社会保险金及住房公积金的相关承诺

发行人实际控制人王强出具承诺函：如因发行人及控股子公司因公开发行前未严格遵守劳动用工相关法律法规及规范性文件，或未严格执行为员工缴纳社会保险和住房公积金政策事宜被有权机关处罚或要求补缴社会保险或住房公积金的，本人将督促发行人及时补缴。若发行人因未足额缴纳需要承担任何罚款、滞纳金，或因有关人员向发行人及控股子公司追索，或因上述情形给发行人或其子公司造成损失的，本人将对罚款、滞纳金及其他损失作出全额赔偿，并承担连带责任，且在承担后不向发行人及其控股子公司追偿。

（二）关于租赁房产相关事项的相关承诺

发行人实际控制人王强出具承诺函：如发行人及其子公司所租赁的房产因出租方权属原因或租赁物业未办理房屋租赁备案等原因而无法继续承租/使用该等物业遭受损失的，本人将积极采取有效措施（包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的房产供相关企业经营使用等），促使发行人业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响。若发行人因其租赁的房产被有关政府主管部门要求收回房产或被处以处罚或承担其他法律责任，或因此产生其他损失的，在相关损失无法向出租方追索的情况下，由本人承担所产生的损失、罚款、费用和其他开支，且在承担相关费用和开支后不向发行人追偿，保证发行人不会因此遭受损失。

（三）关于劳务派遣相关事项的相关承诺

发行人实际控制人王强出具承诺函：如因发行人及其控股子公司因公开发行前违反《劳务派遣暂行规定》等关于劳务派遣的相关规定，从而给发行人及子公司造成直接和间接损失或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚）的，本人将对公司作出全额赔偿，并承担连带责任，且在承担后不向发行人及其子公司追偿，保证发行人及其子公司不会因此遭受任何损失。

（四）关于不谋求实际控制人地位的相关承诺

1、赵轶承诺

本人充分认可王强作为发行人实际控制人的地位，且不存在谋求获得发行人控制权的意图。

本人将独立行使股东权利，不会以所持有的发行人股份单独或共同谋求发行人的控股股东、实际控制人地位，不会以委托、征集投票权、签订一致行动协议或达成类似协议、联合其他股东以其他任何方式单独或共同谋求发行人的控股股东、实际控制人地位，亦不会协助或促使任何其他股东通过任何方式谋求发行人的控股股东、实际控制人地位。

2、长川科技、天堂硅谷长实、半导体装备二期基金、嘉兴芯测、嘉兴芯传承诺

本企业充分认可王强作为发行人实际控制人的地位，且不存在谋求获得发行人控制权的意图。

本企业将独立行使股东权利，不会以所持有的发行人股份单独或共同谋求发行人的控股股东、实际控制人地位，不会以委托、征集投票权、签订一致行动协议或达成类似协议、联合其他股东以其他任何方式单独或共同谋求发行人的控股股东、实际控制人地位，亦不会协助或促使任何其他股东通过任何方式谋求发行人的控股股东、实际控制人地位。

附件四：公司治理制度的建立健全及运行情况

（一）股东会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司制定了《股东会议事规则》，为规范化运作提供了进一步制度保障。《公司章程》中规定了股东的权利、股东会的职责、权限及股东会会议的基本制度，同时《股东会议事规则》针对股东会的召开程序制定了详细规则。

报告期内公司股东会在召集、出席、议事、表决、决议及会议记录等方面均符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规定，各股东均认真履行职责，充分行使股东权利，股东会依法忠实履行了《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》所赋予的权利和义务。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司设董事会，由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，董事会设董事长一名。公司根据《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定了《董事会议事规则》，对董事会的组成、职权、召开方式与条件、表决方式等进行了明确规定，董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。

报告期内公司董事会会议在召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等方面均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，董事会依法忠实履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。独立董事均出席历次董事会并按相关规定发表独立审核意见。

（三）独立董事工作制度的建立健全及运行情况

公司本届董事会设 3 名独立董事，达到董事会总人数的三分之一。公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权利，履行职责。公司独立董事积极参与公司重大经营决策，完善了公司治理结构，维护了全体股东的利益，在完善公司治理结构、公司战略发展选择等方面起到了促进作用。截至本招股说明书签署日，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

（四）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。为规范公司行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、职责、任免及工作程序进行了规定。

自公司聘任董事会秘书以来，董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》有关规定履行职责，认真筹备董事会和股东会，并及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东会正常行使职责发挥了重要作用。

（五）董事会专门委员会制度的建立健全及运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，并制定了各专门委员会的工作细则。董事会各专门委员会组成如下：

名称	召集人、主任委员	委员
战略委员会	王强	王强、贺涛、朱伟
审计委员会	王帆	王帆、王要玉、朱伟
薪酬与考核委员会	王要玉	王要玉、庞凌、王强
提名委员会	庞凌	庞凌、王要玉、王强

自公司董事会有关专门委员会成立以来，各专门委员会能够根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则等规定，勤勉尽职地履行职责。各专门委员会的日常运作、会议的召集、召开、表决程序符合公司《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的有关规定，规范、有效。

附件五：公司专利具体情况

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	申请日	取得方式
1	发行人	一种存储器芯片用的测试装置及方法	ZL202311147463.6	发明	2023-09-07	原始取得
2	发行人	一种高温老化测试插座的循环结构	ZL202311300067.2	发明	2023-08-02	原始取得
3	发行人	一种高温老化测试方法	ZL202310961726.0	发明	2023-08-02	原始取得
4	发行人	一种旋转探针与配套插座的适配装置及方法	ZL202311162547.7	发明	2023-09-11	原始取得
5	发行人	一种芯片测试载具及具有其的芯片测试设备及方法	ZL202311168588.7	发明	2023-09-12	原始取得
6	发行人	一种转接探针测试方法	ZL202310500283.5	发明	2023-05-06	原始取得
7	发行人	老化测试插座	ZL202311263565.4	发明	2023-09-27	原始取得
8	发行人	一种晶圆激光切割机及晶圆驱动方法	ZL202311393206.0	发明	2023-10-25	原始取得
9	发行人	一种高温老化测试插座调节方法	ZL202310992887.6	发明	2023-08-08	原始取得
10	发行人	一种适用射频模组的分布式大功率测试插座	ZL202210825344.0	发明	2022-07-14	原始取得
11	发行人	一种转接探针测试装置	ZL202310500284.X	发明	2023-05-06	原始取得
12	发行人	一种超高频模组测试夹具及其测试座的生产工艺	ZL201910337066.2	发明	2019-04-25	原始取得
13	发行人	一种三维芯片测试优化方法及系统	ZL202311141588.8	发明	2023-09-06	原始取得
14	发行人	片上芯片高温老化测试插座	ZL202310013047.0	发明	2023-01-05	原始取得
15	发行人	一种芯片温度循环老化测试台的芯片座	ZL202310401669.0	发明	2023-01-06	原始取得
16	发行人	一种芯片老化测试装置	ZL202311092011.2	发明	2023-08-29	原始取得
17	发行人	一种芯片检测用抓取机构及方法	ZL202311112667.6	发明	2023-08-31	原始取得
18	发行人	一种芯片温度循环老化测试台的降温插座	ZL202310429235.1	发明	2023-01-06	原始取得
19	发行人	一种芯片温度循环老化测试台的加热插座	ZL202310360987.7	发明	2023-01-06	原始取得
20	发行人	一种高温老化测试插座调节结构	ZL202310992865.X	发明	2023-08-08	原始取得
21	发行人	一种高温老化测试插座及其循环结构	ZL202310961736.4	发明	2023-08-02	原始取得
22	发行人	一种测试插座用探针	ZL202111169130.4	发明	2021-10-08	原始取得
23	发行人	片上芯片高温老化测试插座控制系统及控制方法	ZL202310013046.6	发明	2023-01-05	原始取得
24	发行人	一种芯片温度循环老化测试台上实现的芯片温度循环老化测试方法	ZL202310381860.3	发明	2023-01-06	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	申请日	取得方式
25	发行人	芯片老化测试台	ZL202310018152.3	发明	2023-01-06	原始取得
26	发行人	一种高频同轴探针塔和测试探针孔	ZL202310486753.7	发明	2023-05-04	原始取得
27	发行人	一种超高频雷达芯片测试插座	ZL202110612739.8	发明	2021-06-02	原始取得
28	发行人	MEMS 探针硅片切割装置	ZL202210368510.9	发明	2022-04-09	原始取得
29	发行人	LGA 和 BGA 封装标定高温老化测试插座上盖结构	ZL202310015882.8	发明	2023-01-06	原始取得
30	发行人	一种芯片温度循环老化测试台、关键座及测试方法	ZL202310016215.1	发明	2023-01-06	原始取得
31	发行人	一种温度循环老化测试插座及测试方法	ZL202310029490.7	发明	2023-01-09	原始取得
32	发行人	便于两种封装芯片切换测试的高温老化测试插座上盖结构	ZL202310037461.5	发明	2023-01-10	原始取得
33	发行人	MEMS 探针硅片切割方法	ZL202210368523.6	发明	2022-04-09	原始取得
34	发行人	测试探针清洁方法的探针固定方法	ZL202210126254.2	发明	2020-11-28	原始取得
35	发行人	一种开尔文方式多路弹簧针电阻测试装置及方法	ZL202211636140.9	发明	2022-12-20	原始取得
36	发行人	一种半导体姿态调整结构、调整方法和探针台	ZL202210648758.0	发明	2022-06-09	原始取得
37	发行人	一种垂直探针卡装置的组装、修复和测试参数设定方法	ZL202111376210.7	发明	2021-11-19	原始取得
38	发行人	测试探针清洁方法的粘性吸附方法	ZL202210126255.7	发明	2020-11-28	原始取得
39	发行人	面向探针台的晶圆吸附方法	ZL202210811301.7	发明	2022-07-12	原始取得
40	发行人	一种电磁驱动旋转探针及固定插座结构	ZL202210663252.7	发明	2022-06-13	原始取得
41	发行人	面向探针台的晶圆吸附台及其变径环槽和转动环槽	ZL202210811302.1	发明	2022-07-12	原始取得
42	发行人	一种晶圆检测样品台的固定方法	ZL202210779270.1	发明	2022-07-04	原始取得
43	发行人	一种晶圆检测样品台	ZL202210779293.2	发明	2022-07-04	原始取得
44	发行人	一种电磁驱动旋转探针及固定插座的匹配方法	ZL202210663249.5	发明	2022-06-13	原始取得
45	发行人	测试探针清洁方法的摩阻刮除方法	ZL202210126256.1	发明	2020-11-28	原始取得
46	发行人	一种插座结构	ZL202110992664.0	发明	2020-11-29	原始取得
47	发行人	一种探针结构	ZL202110992579.4	发明	2020-11-29	原始取得
48	发行人	一种垂直探针卡装置及其检测方法	ZL202111376229.1	发明	2021-11-19	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	申请日	取得方式
49	发行人	MEMS 探针测试基座超精密光刻定位装置	ZL202011365961.4	发明	2020-11-29	原始取得
50	发行人	MEMS 探针测试基座超精密光刻定位方法	ZL202011365963.3	发明	2020-11-29	原始取得
51	发行人	一种排线限位板探针组合结构	ZL202110556811.X	发明	2020-11-29	原始取得
52	发行人	一种冷水机水温调节时间优化方法	ZL202111375643.0	发明	2021-11-19	原始取得
53	发行人	一种测试探针清洁装置及其夹持构件和测试基座	ZL202011365615.6	发明	2020-11-28	原始取得
54	发行人	测试探针清洁方法	ZL202011365614.1	发明	2020-11-28	原始取得
55	发行人	一种探针及插座结构	ZL202011365950.6	发明	2020-11-29	原始取得
56	发行人	一种探针及插座匹配方法	ZL202011365971.8	发明	2020-11-29	原始取得
57	发行人	一种手动弹簧针测试装置及耐电流测试方法	ZL202110532517.5	发明	2021-05-17	原始取得
58	发行人	同步或类同步测试的探针转接件及插座结构及关键结构	ZL202011365952.5	发明	2020-11-29	原始取得
59	发行人	面向同步测试或类同步测试的探针转接件及插座匹配方法	ZL202011365958.2	发明	2020-11-29	原始取得
60	发行人	一种探针结构及其安装方法、闭路方法、抗干扰方法	ZL202011228331.2	发明	2020-11-06	原始取得
61	发行人	一种测试装置及测试方法	ZL202011227744.9	发明	2020-11-06	原始取得
62	发行人	探针承插件及探针组件	ZL202011227365.X	发明	2020-11-06	原始取得
63	发行人	一种插槽式端子的测试插座	ZL201710613636.7	发明	2017-07-25	原始取得
64	发行人	可自动定位芯片的半导体芯片测试插座	ZL201410443449.5	发明	2014-09-02	原始取得
65	**发行人**	**一种 ATE 探针漏装检测方法**	**ZL202311656588.1**	**发明**	**2023-12-05**	**原始取得**
66	**发行人**	**一种芯片用老化测试夹具**	**ZL202311482078.7**	**发明**	**2023-11-08**	**原始取得**
67	蓝泽科技	一种可调节晶圆吸附台	ZL202210789919.8	发明	2022-07-06	原始取得
68	蓝泽科技	一种晶圆吸附方法	ZL202210789918.3	发明	2022-07-06	原始取得
69	发行人	一种晶圆探测装置及晶圆探测系统	ZL202521025010.0	实用新型	2025-05-23	原始取得
70	发行人	一种凸轮加压芯片测试设备及系统	ZL202520567333.6	实用新型	2025-03-28	原始取得
71	发行人	一种用于高频信号传输的插座及芯片老化测试装置	ZL202423287182.3	实用新型	2024-12-31	原始取得
72	发行人	一种用于测试芯片的插座结构及芯片老化测试装置	ZL202423287183.8	实用新型	2024-12-31	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	申请日	取得方式
73	发行人	一种可提高芯片测试效率的结构及芯片老化测试设备	ZL202423222981.2	实用新型	2024-12-26	原始取得
74	发行人	一种用于消除共振的探针卡	ZL202421719580.5	实用新型	2024-07-19	原始取得
75	发行人	一种三轴加工中心加工斜面用的工装夹具	ZL202220442527.X	实用新型	2022-03-01	原始取得
76	发行人	一种兼容性高的视觉检测仪平台治具	ZL202223580528.X	实用新型	2022-12-31	原始取得
77	发行人	一种大力量手测盖	ZL202320336102.5	实用新型	2023-02-28	原始取得
78	发行人	一种多工位芯片测试夹具	ZL202223572614.6	实用新型	2022-12-30	原始取得
79	发行人	一种高效率压销钉平台治具	ZL202223588509.1	实用新型	2022-12-31	原始取得
80	发行人	模组测试座	ZL202222089229.X	实用新型	2022-08-09	原始取得
81	发行人	一种芯片无划伤侧试装置	ZL202222493833.9	实用新型	2022-09-20	原始取得
82	发行人	一种芯片真空压力测试治具	ZL202223194101.6	实用新型	2022-11-30	原始取得
83	发行人	一种芯片管脚整形装置	ZL202223212638.0	实用新型	2022-11-30	原始取得
84	发行人	一种芯片定位治具	ZL202223194075.7	实用新型	2022-11-30	原始取得
85	发行人	一种 PGA 芯片大电流开尔文测试插座	ZL202222237560.1	实用新型	2022-08-24	原始取得
86	发行人	一种埋容埋阻基板测试插座	ZL202222583562.6	实用新型	2022-09-28	原始取得
87	发行人	一种嵌入式射频测试插座	ZL202221916502.5	实用新型	2022-07-22	原始取得
88	发行人	滑动测试盖	ZL202221261764.2	实用新型	2022-05-24	原始取得
89	发行人	一种感光芯片检测治具	ZL202221259399.1	实用新型	2022-05-24	原始取得
90	发行人	温控测试装置	ZL202221668667.5	实用新型	2022-06-30	原始取得
91	发行人	一种测试插座定位治具	ZL202221325814.9	实用新型	2022-05-30	原始取得
92	发行人	一种芯片反装测试插座	ZL202220451711.0	实用新型	2022-03-02	原始取得
93	发行人	一种芯片一体化自主测试装置	ZL202220403941.X	实用新型	2022-02-24	原始取得
94	发行人	一种陶封芯片用管脚整形治具	ZL202220454326.1	实用新型	2022-03-02	原始取得
95	发行人	一种 LID 通用型高度测量治具	ZL202220442525.0	实用新型	2022-03-01	原始取得
96	发行人	一种同轴连接器	ZL202122104605.3	实用新型	2021-09-02	原始取得
97	发行人	一种晶圆级封装类芯片测试夹具	ZL202122104386.9	实用新型	2021-09-02	原始取得
98	发行人	一种芯片低温测试插座	ZL202122104571.8	实用新型	2021-09-02	原始取得
99	发行人	一种用于测试机精确度调试的辅助测试治具	ZL202022110687.8	实用新型	2020-09-23	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	申请日	取得方式
100	发行人	一种用于麦克风芯片的测试插座	ZL202020911043.6	实用新型	2020-05-26	原始取得
101	发行人	用于集成电路老化测试的手动测试夹具	ZL201922105069.1	实用新型	2019-11-29	原始取得
102	发行人	一种气体密封结构的测试座	ZL201920932197.0	实用新型	2019-06-20	原始取得
103	发行人	一种适用于集成电路的超高频测试用插座	ZL201921029067.2	实用新型	2019-07-03	原始取得
104	发行人	针对芯片集成模块中通讯端口的测试夹具	ZL201920279504.X	实用新型	2019-03-06	原始取得
105	发行人	PCB 倒置于测试座上表面的测试插座	ZL201920279516.2	实用新型	2019-03-06	原始取得
106	发行人	一种用于芯片上表面不能受力情况下的测试插座	ZL201920280553.5	实用新型	2019-03-06	原始取得
107	发行人	一种大电流特殊管脚芯片测试插座	ZL201820952483.9	实用新型	2018-06-20	原始取得
108	发行人	一种带自清洁的弹簧针结构	ZL201821083087.3	实用新型	2018-07-09	原始取得
109	发行人	一种多工位自动化精准定位的测试夹具	ZL201821082044.3	实用新型	2018-07-09	原始取得
110	发行人	一种带载具的热流道测试夹具	ZL201820952484.3	实用新型	2018-06-20	原始取得
111	发行人	一种立体结构芯片的测试插座	ZL201820288832.1	实用新型	2018-03-01	原始取得
112	发行人	一种高频测试插座	ZL201820216637.8	实用新型	2018-02-07	原始取得
113	发行人	一种全金属结构的半导体集成电路测试插座	ZL201820004158.X	实用新型	2018-01-02	原始取得
114	发行人	一种用于集成电路的高频测试用插座	ZL201820004159.4	实用新型	2018-01-02	原始取得
115	发行人	IC 芯片双面测试夹具	ZL201721272662.X	实用新型	2017-09-29	原始取得
116	发行人	一种 SIM 卡类芯片测试插座	ZL201721395153.6	实用新型	2017-10-25	原始取得
117	发行人	一种金属同轴连接的芯片测试插座	ZL202522242374.0	实用新型	2025-10-23	原始取得
118	蓝泽科技	一种用于 DIP 封装芯片三温性能测试的治具及测试机台	ZL202423280048.0	实用新型	2024-12-30	原始取得
119	蓝泽科技	一种用于高温测压模块的升温测试装置	ZL202422916771.7	实用新型	2024-11-28	原始取得
120	蓝泽科技	一种具有定位功能的膜片气缸	ZL202423287168.3	实用新型	2024-12-31	原始取得
121	蓝泽科技	一种用于膜片气缸疲劳寿命测试的平台	ZL202423169739.3	实用新型	2024-12-23	原始取得
122	蓝泽科技	一种膜片气缸	ZL202423159413.2	实用新型	2024-12-20	原始取得
123	蓝泽科技	一种半导体产品双面封测用防呆工装	ZL202323337995.4	实用新型	2023-12-08	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	申请日	取得方式
124	蓝泽科技	一种电路板 AOI 模块化通用装载治具	ZL202322900490.8	实用新型	2023-10-27	原始取得
125	蓝泽科技	一种弹簧针射频特性用 S 参数的测试装置	ZL202323421362.1	实用新型	2023-12-14	原始取得
126	蓝泽科技	一种便于不同角度斜侧孔加工的方向矫正工装	ZL202323531699.8	实用新型	2023-12-22	原始取得
127	蓝泽科技	一种低成本低损耗的连接器	ZL202322726833.3	实用新型	2023-10-11	原始取得
128	蓝泽科技	一种芯片测试同轴插座防脱落结构	ZL202223520177.3	实用新型	2022-12-28	原始取得
129	蓝泽科技	一种精准度高的凸台定位工装	ZL202223457311.X	实用新型	2022-12-23	原始取得
130	蓝泽科技	一种镀金产品用压针治具	ZL202223583710.0	实用新型	2022-12-31	原始取得
131	蓝泽科技	一种针对小尺寸低功耗封装集成电路温度测试的控温装置	ZL202223204002.1	实用新型	2022-11-30	原始取得
132	蓝泽科技	一种用于 socket 接头测试装置	ZL202222506582.3	实用新型	2022-09-20	原始取得
133	蓝泽科技	一种产品静电消除装置	ZL202222494018.4	实用新型	2022-09-20	原始取得

附件六：募集资金运用情况

（一）先进生产基地建设项目

1、项目基本情况

本项目拟通过新建智能化生产厂房及配套设施，在公司现有半导体测试接口产品体系基础上进行全面技术升级与产能扩张。形成覆盖测试座、WLCSP 探针卡及**分选换型套件**的全流程产品矩阵，填补国内在高性能芯片测试接口领域的技术空白，为芯片设计、制造及封测企业提供高精度、高可靠性的测试硬件支持，助力客户提升测试效率与产品良率。

本项目拟投资 74,223.83 万元，分 36 个月投入。本项目实施主体为发行人母公司。

2、项目实施可行性

（1）蓬勃发展的半导体测试设备市场与坚实的客户基础，为项目提供了充分的市场可行性

当前，全球半导体产业正经历深刻的技术变革，先进制程、先进封装等创新技术的快速发展，对测试环节提出了极高要求。半导体测试设备与消耗型测试硬件作为确保芯片质量与可靠性的关键，其市场需求与半导体技术演进及下游应用扩张紧密相连。随着 AI HPC、智能终端、汽车电子等新兴领域的崛起及持续扩张，高性能芯片测试需求持续增长。特别是数据中心朝着规模化建设持续推进，作为数据中心设备关键组成部分的高性能芯片需求随之增长，进而带动对半导体测试设备及封装测试消耗型硬件的市场需求。

发行人作为国内半导体封装测试消耗型硬件的领军企业，已建立起良好的市场声誉。公司客户涵盖国内外芯片设计公司、封测服务企业和测试设备厂商，与众多知名企业建立了长期合作关系。通过多年的发展，公司已形成覆盖国内主要半导体产业链参与者的服务网络，能够及时响应客户需求。这种深厚的客户积累与广泛的市场覆盖，为本项目新增产能的消化提供了可靠保障，确保了项目的市场可行性。

（2）国家产业政策的大力支持与国产化战略导向，为项目提供了坚实的政策可行性

近年来，国家高度重视半导体封装测试消耗型硬件制造和核心技术攻关，相关部委

持续出台多项支持半导体产业链自主可控与技术创新的产业政策。在构建现代化产业体系的战略指引下，半导体测试作为产业链的关键环节，获得了前所未有的政策关注度。各级政府通过专项资金、税收优惠、产业基金等多种方式，持续加大对半导体测试等基础环节的扶持力度。

行业协会也通过制定具有前瞻性的行业发展规划和技术标准体系，有效引导产业资源向关键领域集聚。这些多层次、全方位的政策举措为公司建设先进生产基地提供了有力的制度保障和资源支持，完全符合国家推动科技自立自强、建设制造强国的战略方向。本项目的实施，正是响应国家半导体封装测试消耗型硬件制造自主可控的具体实践，具有明确的政策可行性。

（3）深厚的技术沉淀与系统化的研发体系，为项目提供了可靠的技术可行性

发行人在半导体封装测试消耗型硬件领域拥有深厚的技术积淀和丰富的知识产权，掌握了高速信号传输、高功率散热、微间距接触等多项关键技术。公司获评国家高新技术企业、国家级专精特新重点“小巨人”企业、博士后科研工作站等多项荣誉资质。通过持续的研发投入和技术创新，公司产品在核心性能指标方面已达到行业先进水平，部分技术实现突破。

公司构建了完善的研发管理体系，涵盖从概念设计到产品验证的全流程。研发团队具备扎实的理论基础，能够针对 AI 算力芯片、手机 SoC 等不同应用场景开发配合的测试解决方案。这种系统化的技术创新能力和成熟的产品开发经验，确保了本项目在高性能测试座、WLCSP 探针卡等产品上的技术可行性，能够突破国外厂商在高性能测试接口领域的技术垄断。

3、项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

随着公司在功能测试座、老化测试座等核心产品的技术积累和市场拓展不断深入，公司主营业务保持稳健发展。报告期内，公司测试座系列产品收入持续增长，其中 2025 年功能测试座收入达到 9,754.54 万元，占主营业务收入的 17.94%；老化测试座收入 29,876.84 万元，占比 54.95%。本项目拟新增功能标准测试座年产能 5 万套、AI 及超算功能测试座年产能 2.5 万套、老化标准测试座年产能 5.3 万套以及 AI 及超算老化测试座年产能 2 万套，并同步扩充 WLCSP 探针卡及分选换型套件等配套产能，均围绕公司现有主营业务的延伸和扩展。

本项目将充分利用公司已掌握的精密加工技术、热管理技术和高速信号传输技术等核心技术。具体而言，公司在高精度模具设计、微间距插针工艺、高功率散热管理等方面的技术积累将直接应用于新产线的建设和优化。通过引进飞秒激光打孔机、全自动插/装针机等先进设备，项目将进一步提升产线自动化水平，实现产品性能的显著提升。

本项目实施后，公司现有核心技术将得到更充分的应用和迭代优化。在功能测试座方面，项目将推动测试频率向更高频段发展，支持更小间距的芯片测试需求；在老化测试座领域，项目将进一步提升产品的功率密度和温控精度。同时，项目的实施还将促进公司在 WLCSP 探针卡、**分选换型套件**等配套产品方面的技术协同发展，完善公司产品矩阵。

通过本项目的建设，公司现有主营业务优势将得到进一步巩固，核心技术实现迭代升级，产品结构更加优化。项目达产后，预计将显著提升公司市场份额和盈利能力，为公司在半导体测试消耗型硬件领域的持续发展提供有力支撑。

4、项目投资概算

本项目预计总投资为 74,223.83 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	项目名称	金额	比例
1	工程建设费用	64,293.83	86.62%
2	生产投入	4,805.80	6.47%
3	基本预备费	3,454.98	4.65%
4	铺底流动资金	1,669.22	2.25%
合计		**74,223.83**	**100.00%**

5、项目土地、环保情况

（1）项目土地情况

本项目建设地点为“苏州市苏州工业园区 胜浦路西、同胜路南”，土地使用权尚在取得中。

（2）项目环保情况

本项目产生的主要环境污染物为少量废水、废气、噪声、固体废物等。公司将严格按照《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规的规定，根据公司生产的实际情况，

建设与主体工程相匹配的环境保护设施。

6、项目履行审批、核准或备案情况

本项目的项目代码为 2601-320571-89-01-284373，于 2026 年 5 月取得了“苏园行审备〔2026〕521 号”《江苏省投资项目备案证》，**于 2026 年 9 月取得了《苏州工业园区建设项目环保审批意见》（审批文号：20260112）**。

（二）针对高功率芯片液冷散热控温技术的研发及生产项目

1、项目基本情况

本项目拟聚焦 AI 算力芯片等高功率芯片在老化测试及实际应用场景下的极限散热需求，建设高功率芯片液冷散热控温技术研发及产业化平台。通过购置高精度加工中心、特种焊接设备、无损检测仪器等先进装备，引进热管理、流体仿真及精密制造等专业人才，进一步完善公司在超高功率芯片测试液冷板、微流道液冷板及相关测试解决方案方面的研发和产业化能力。

本项目的建设将全面提升公司在高功率芯片测试领域的核心技术能力，重点突破 AI 算力芯片等高性能芯片在千瓦级以上功耗条件下的散热、控温及长期可靠性难题，推动公司现有的老化测试座等产品向更高功率、更强热管理能力的方向迭代升级，并前瞻性布局智算中心级液冷散热组件，显著增强公司在高性能半导体测试消耗型硬件领域的技术领先优势与市场覆盖能力。

本项目拟投资 52,869.60 万元，分 36 个月投入。本项目实施主体为发行人母公司。

2、项目实施可行性

（1）契合国家算力战略与“双碳”绿色降耗导向

当前，全球科技竞争聚焦于算力底座，国家大力推进“东数西算”工程并加速构建“全国一体化算力网”。相关部委相继出台政策，鼓励集成电路关键测试设备的自主化攻坚。同时，在“双碳”目标导向下，国家对数据中心 PUE（电能利用效率）指标的要求日益严苛，推动了高能效、低能耗的绿色液冷散热技术在算力中心的渗透。本项目聚焦高性能 AI 算力芯片产业链中不可或缺的液冷测试核心硬件，并前瞻性布局智算中心液冷散热组件，高度契合国家关于增强半导体产业链韧性、构筑“全国一体化算力网”绿色物理底座的宏观战略。

（2）单颗芯片功耗挑战物理极限，催生海量液冷需求

随着生成式 AI 大模型及 HPC 的爆发，芯片晶体管密度攀升，单颗算力芯片的热设计功耗已突破 1,000W 大关，并正向 2,500W 以上的物理极限迈进。在此趋势下，传统风冷散热已达物理瓶颈。在芯片测试端，具备微流道冷板技术的主动温控液冷测试座已成为封测服务企业量产测试准确性的核心刚需；在算力应用端，芯片级冷板液冷正成为智算中心建设的标配。本项目精准切入这一蓝海市场，具备广阔的市场前景。

（3）依托深厚精密制造底座，实现跨领域技术平移

公司在半导体测试接口领域深耕多年，系统掌握了微间距精密接触、精密机加工及多物理场仿真技术。芯片测试座内部的散热环境远比服务器机箱内部更为“恶劣”，公司在攻克高频测试液冷技术后，其核心技术具备向下兼容性。本项目计划投入的装备，将与公司已有的仿真技术形成闭环，确保项目在技术维度上的高成功率。

（4）跨学科人才扩编，打造复合型特种研发团队

公司已制定了明确的人才扩编战略，计划专项招聘具备工程热物理、微流体动力学、材料科学等多学科交叉背景的高端研发人员。公司旨在以此项目为契机，打造一支复合型研发团队，为项目的全生命周期高效运转提供持续的智力支持。

3、项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

本项目是公司在现有测试座业务基础上的战略升维与业务边界拓展：

项目将直接提升公司在高性能 AI 算力芯片老化测试环节的技术能力，重点解决千瓦级以上芯片在测试过程中的极限温控难题，满足下游客户对先进封装芯片的苛刻测试需求。

项目将充分利用公司已掌握的精密加工与热管理技术，通过引进先进设备，实现高性能微流道冷板的大规模、高一致性量产。

依托在微观测试空间内积累的极限散热技术，公司将顺应产业趋势，将高性能液冷产品向智算中心服务器级散热场景延伸。这不仅打开了算力热管理领域的广阔市场空间，更使公司从单一的测试耗材供应商向算力系统热管理综合解决方案提供商跨越，打造全新利润增长极。

4、项目投资概算

单位：万元

序号	项目名称	金额	比例
1	工程建设费用	47,247.10	89.37%
2	研发投入	4,043.30	7.65%
3	基本预备费	1,025.81	1.94%
4	铺底流动资金	553.39	1.05%
合计		**52,869.60**	**100.00%**

5、项目土地、环保情况

（1）项目土地情况

本项目建设地点为“苏州市苏州工业园区 胜浦路西、同胜路南”，土地使用权尚在取得中。

（2）项目环保情况

本项目产生的主要环境污染物为实验性废水、噪声、固体废物等。公司将严格按照《中华人民共和国环境保护法》等有关法律的规定，根据公司生产的实际情况，建设与主体工程相匹配的环境保护设施。

6、项目履行审批、核准或备案情况

本项目的项目代码为 2601-320571-89-01-284373，于 2026 年 5 月取得了“苏园行审备〔2026〕521 号”《江苏省投资项目备案证》，**于 2026 年 9 月取得了《苏州工业园区建设项目环保审批意见》（审批文号：20260112）**。

（三）总部及研发中心项目

1、项目基本情况

本项目为公司总部及研发中心项目，主要建设目的为通过新建总部及研发载体，打造集技术研发、实验测试与运营管理于一体的综合性创新平台，构建覆盖全品类测试接口产品的完整研发体系，显著增强公司的技术储备与产品迭代能力，填补国内高性能测试硬件的关键技术空白，助力半导体测试核心零部件的国产化替代进程。

本项目拟投资 29,636.34 万元，分 36 个月投入。本项目实施主体为发行人母公司。

2、项目实施可行性

（1）项目建设符合产业政策导向及行业发展趋势

本项目围绕高性能半导体测试接口产品研发能力建设展开，重点提升公司在测试座、WLCSP 探针卡、负载板等方向的研发、设计能力，符合国家推动集成电路关键环节自主可控、强化产业链供应链韧性的政策导向，也契合下游客户对高性能测试接口产品国产化、系统化和高可靠性的市场需求，具备良好的政策和市场基础。

（2）公司已具备较好的技术积累和客户基础

公司长期专注于半导体封装测试消耗型硬件领域，在功能测试座、老化测试座等核心产品方面积累了较为丰富的研发设计和量产应用经验，形成了涵盖高频高速信号传输、精准温控及散热以及微间距精密接触等方面的技术基础。上述技术积累与本项目拟建设的研发方向高度匹配，为项目顺利实施提供了重要技术支撑。

（3）公司具备项目实施所需的组织管理和人才保障

本项目将建设总部及研发中心，涉及研发平台搭建、实验测试能力建设、研发人才引进、项目管理体系完善等多个方面，对公司的组织协同和管理能力提出较高要求。公司在既有经营过程中已建立了较为完善的研发管理、质量控制、项目评审和内部管理体系，能够保障研发活动规范、高效开展。

3、项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

本项目与公司现有主营业务具有较强的协同性，是公司围绕半导体封装测试消耗型硬件主业进行研发能力升级和产品矩阵延伸的重要举措。公司现有主要产品包括功能测试座、老化测试座等封装测试消耗型硬件，主要应用于芯片封装后成品测试、老化测试及系统级测试等环节。本项目拟建设的研发中心将重点围绕测试座、WLCSP 探针卡、负载板等方向开展研发攻关，其中测试座研发方向直接服务于公司现有核心产品的技术升级，WLCSP 探针卡、负载板等方向则与公司现有测试接口业务具有技术同源性和客户协同性。

从核心技术角度来看，本项目将依托公司已掌握的高频高速信号传输、热管理以及结构设计等技术基础，进一步建设专业研发平台，推动公司现有技术体系实现系统化升级。通过本项目实施，公司将增强面向高功率、高密度 AI 算力芯片等应用场景的研发

验证能力，为现有功能测试座、老化测试座等产品向更高速率、更高功率、更小间距和更高可靠性方向迭代提供支撑。

4、项目投资概算

单位：万元

序号	项目名称	金额	比例
1	工程建设费用	21,817.39	73.62%
2	研发投入	6,407.70	21.62%
3	基本预备费	1,411.25	4.76%
合计		**29,636.34**	**100.00%**

5、项目土地、环保情况

（1）项目土地情况

本项目建设地点为“苏州市苏州工业园区 胜浦路西、同胜路南”，土地使用权尚在取得中。

（2）项目环保情况

本项目为总部及研发中心项目，产生的主要环境污染物为实验性废水、噪声、固体废物等。公司将严格按照《中华人民共和国环境保护法》等有关法律的规定，根据公司生产的实际情况，建设与主体工程相匹配的环境保护设施。

6、项目履行审批、核准或备案情况

本项目的项目代码为 2601-320571-89-01-284373，于 2026 年 5 月取得了“苏园行审备〔2026〕521 号”《江苏省投资项目备案证》，**于 2026 年 9 月取得了《苏州工业园区建设项目环保审批意见》（审批文号：20260112）**。

（四）补充流动资金项目

1、项目基本情况

本次发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，公司综合考虑行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等，拟使用募集资金中的 23,710.57 万元用于补充公司主营业务发展所需要的流动资金，满足公司战略发展和对流动资金的需求。

2、项目建设的必要性

报告期内，伴随公司生产经营规模稳步扩张，主营业务收入复合增长率达到 55.30%。展望未来，公司业务版图将进一步拓展，原材料采购、员工薪酬支付等日常经营活动均需持续的流动资金支撑。同时，半导体行业具备技术密集、迭代快速的特征，为保持核心竞争力，公司将持续推进新产品研发与现有技术升级，研发投入亦将维持较高水平。综合业务扩张等因素，公司后续存在一定的流动资金需求缺口。

本次将部分募集资金用于补充流动资金，可有效充实公司营运资金储备，充分保障日常经营运转、持续研发投入及业务规模扩张的资金需求，为公司持续经营和发展提供资金保障。

附件七：公司租赁情况

（一）发行人及其境内控股子公司租赁情况

截至本招股说明书签署日，公司及公司子公司用于生产、经营活动的租赁房产具体情况如下：

序号	承租方	出租方/提供方	地点	租赁面积（平方米）	租赁期限	主要用途
1	发行人	苏州联东金吴实业有限公司	苏州工业园三信机件项目1期1批次一号楼1单元101	730.80	2024.01.01-2028.12.31	生产、办公、研发、装配
2	发行人	苏州联东金吴实业有限公司	苏州工业园区兴浦路200号1#-201	1,648.32	2026.03.31-2028.03.30	生产、办公、研发、仓储
3	发行人	苏州联东金吴实业有限公司	苏州工业园三信机件项目1期1批次五号楼1单元101	428.21	2024.03.31-2029.03.30	生产、办公、研发、仓储
4	发行人	苏州联东金吴实业有限公司	苏州工业园三信机件项目1期1批次五号楼1单元102	434.71	2024.03.31-2029.03.30	生产、办公、研发、仓储
5	发行人	苏州联东金吴实业有限公司	苏州工业园三信机件项目1期1批次五号楼1单元103	46.32	2024.03.31-2029.03.30	生产、办公、研发、仓储
6	发行人	苏州联东金吴实业有限公司	苏州工业园三信机件项目1期1批次五号楼1单元201	534.23	2024.03.31-2029.03.30	生产、办公、研发、仓储
7	发行人	苏州联东金吴实业有限公司	苏州工业园三信机件项目1期1批次五号楼1单元202	534.23	2024.03.31-2029.03.30	生产、办公、研发、仓储
8	发行人	苏州联东金吴实业有限公司	苏州工业园三信机件项目1期1批次五号楼1单元301	536.47	2025.05.31-2029.03.30	生产、办公、研发、仓储
9	发行人	苏州联东金吴实业有限公司	苏州工业园三信机件项目1期1批次五号楼1单元302	534.56	2024.03.31-2029.03.30	生产、办公、研发、仓储
10	发行人	苏州联东金吴实业有限公司	苏州工业园区兴浦路200号6#201-2-2	200.00	2025.12.10-2028.12.31	生产、办公、研发、仓储
11	发行人	苏州联东金吴实业有限公司	苏州工业园三信机件项目1期1批次八号楼1单元101	801.22	2025.07.01-2029.03.30	生产、办公、研发、仓储
12	发行人	苏州联东金吴实业有限公司	苏州工业园区兴浦路200号8#401	988.87	2025.12.22-2028.12.31	生产、办公、研发、仓储
13	发行人	苏州联东金吴实业有限公司	苏州工业园区兴浦路200号8#201	988.87	2026.04.01-2028.03.31	生产、办公、研发、仓储
14	发行人	苏州联东金吴实业有限公司	苏州工业园区兴浦路200号8#301	988.87	2026.03.16-2028.03.15	生产、办公、研发、仓储

序号	承租方	出租方/提供方	地点	租赁面积（平方米）	租赁期限	主要用途
15	发行人	苏州工业园区建屋产业园开发有限公司	苏州工业园区东长路 88 号 M2 幢 1 层 102 室	367.66	2022.04.01-2027.03.31	研发
16	发行人芜湖分公司	芜湖宜创科技产业园运营管理有限公司	芜湖梦溪科创走廊园区 8 号楼 4 层 401	842.61	2026.01.01-2028.12.31	法特迪芜湖分公司办公场所
17	蓝泽科技	芜湖直通车产业园管理有限公司	旗塘路与中兴五路交叉口	4,600.00	2026.03.01-2029.12.31	生产、装配
18	发行人杭州分公司	杭州生物医药科技创业园有限公司	亚科中心 A 楼第 34A 层 03/04 室	535.00	2026.07.01-2028.06.30	法特迪杭州分公司办公、研发
19	发行人	苏州联东金吴实业有限公司	苏州工业园区兴浦路 200 号 1#501-1	947.41	2026.08.03-2028.08.02	生产、办公、研发、仓储